江苏长晶科技股份有限公司

（Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd.）

（中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座 13 楼）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、公司上市的目的

半导体分立器件和电源管理 IC 是电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，主要承担电能的转换、分配、调节与保护等核心功能，在电路系统中发挥着不可替代的物理支撑作用，广泛渗透于国民经济与生产生活的各个应用领域，与负责信息处理的数字集成电路协同，共同构成了现代电子工业的硬件基础。随着全球能源结构转型、终端应用持续向智能化升级，功率半导体技术加速迭代演进。分立器件与电源管理 IC 作为基础性、关键性战略元器件，既影响下游支柱行业的技术发展空间，也关乎产业链供应链安全，其重要性日益凸显。

长晶科技是一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。公司具备上万种规格型号产品的量产能力，是国内产品门类最齐全、系列最丰富的分立器件与电源管理 IC 企业之一。公司自设立以来，以半导体产品研发、设计与销售为基础，凭借内生发展与外延并购双轮驱动，逐步实现了从 Fabless 模式到“Fabless+IDM”模式的演变，部分产品具备从产品定义设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。公司顺应全球半导体行业演进规律，在分立器件、电源管理 IC 领域确立了“平台化”、“一体化”战略发展宗旨。

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”，是国内分立器件行业具有代表性的企业。公司主要产品及市场占有率在行业细分市场具有领先地位：（1）公司是国内二三极管产品的市场领先企业，根据中国半导体行业协会的证明，2024 年，公司二三极管合计销售规模在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 2 名，处于国内龙头地位；（2）在 MOSFET 产品领域，公司近年来收入快速增长，打造了第二增长曲线，自主研发的 CSP MOSFET 产品经江苏省工信厅鉴定为国内领先、国际先进水平，系公司实现国产自主创新的代表性产品。根据中国半导体行业协会证明，2024 年，公司 CSP MOSFET 市场占有率在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 1 名。

通过本次发行，公司将利用资本市场的平台优势，进一步加强技术研发和产品创新，加大市场开拓力度，扩充人才储备，扩大业务规模，持续增强公司的品牌影响力。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升业绩和规模，致力于为股东、投资者以及社会带来持续的价值回报。

二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。通过持续的改进与优化，公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。

公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回报策略，通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。

三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次公开发行股票所募集资金计划投资于“年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目”、“MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目”、“电源管理 IC 研发项目”和补充流动资金。

“年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目”主要投入建设工控及车规级功率器件封装测试产能，进一步深化公司在半导体封装测试环节的 IDM 纵向一体化布局，提升产业链协同与供应安全，优化成本，提高产品性能与技术水平，满足不断增长的市场需求。“MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目”、“电源管理 IC 技术研发项目”将进一步拓展公司在高端分立器件、电源管理 IC 产品领域的技术应用能力，推进“平台化”战略，横向拓宽产品边界。补充流动资金有利于公司降低财务费用，改善财务结构，增加运营资金，为公司持续快速发展提供有力支持。

综上，本次募集资金均围绕发行人主营业务开展投资，募集资金的用途和规模与公司现有的经营情况、技术水平、管理能力相适应。

四、公司持续经营能力及未来发展规划

公司作为一家半导体行业的专精特新“小巨人”企业，将持续聚焦于分立器件、电源管理 IC 和晶圆的研发、生产及销售。报告期内，发行人营业收入分别为 22.60 亿元、26.78 亿元和 29.85 亿元，扣非后归母净利润分别为 1.24 亿元、2.18 亿元和 3.34 亿元，销售规模和盈利水平逐年上升。

未来期间，公司将遵循国际主流分立器件与模拟集成电路产业发展路径，深化确立“平台化”、“一体化”战略发展宗旨，致力于通过全矩阵的产品布局与垂直整合的制造协同，在下游消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等国民经济发展的支柱产业链，全面实现客户对一站式、系统级产品及解决方案的采购诉求，提升公司产品在先进生产力领域的应用深度与广度。

公司将以市场需求为导向，持续扩充二极管、三极管、全系列 MOSFET、IGBT 及各类电源管理 IC 的产品规格与技术能力；稳步推动业务向新能源汽车、光伏储能、工业自动化、机器人、人工智能等高附加值应用领域拓展；依托 IDM 模式垂直整合能力的持续优化，进一步统筹设计与制造关键技术环节、全产业链产能布局，加速新产品的迭代周期，优化整体成本结构，持续提升核心产品的综合性能及供应链安全性。

公司秉持“创造世界一流半导体品牌”的发展愿景，以“市场引领”和“研发驱动”为发展战略，努力锻造技术优势，稳步推进供应链整合，持续深耕及推动分立器件和电源管理 IC 等业务板块快速、稳健、可持续发展，向具备国际竞争力的功率与模拟半导体综合供应商稳步迈进。

（本页无正文，为《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页）

实际控制人、董事长：

杨国江

江苏长晶科技股份有限公司

2026年6月8日

发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数、股东公开发售股数（如有）	本次公开发行股票不超过 5,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所主板
发行后总股本	不超过 48,503.17 万股
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目 录

声明.....1

致投资者的声明.....2

发行概况.....6

目 录.....7

第一节 释 义.....12

一、一般释义.....12

二、专业释义.....17

第二节 概 览.....21

一、重大事项提示.....21

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....23

三、本次发行概况.....24

四、发行人主营业务经营情况.....25

五、发行人符合主板定位.....28

六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.....32

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....33

八、发行人选择的具体上市标准.....33

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....33

十、募集资金运用与未来发展规划.....33

十一、其他对发行人有重大影响的事项.....35

第三节 风险因素.....36

一、与行业相关的风险.....36

二、与发行人相关的风险.....37

三、其他风险.....41

第四节 发行人基本情况.....43

一、发行人基本情况.....43

二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.....44

三、发行人成立以来重要事件.....63

四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.....70

五、发行人的股权结构.....70
六、发行人控股及参股公司情况.....71
七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.....75
八、特别表决权或类似安排.....83
九、协议控制架构的情况.....83
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.....83
十一、发行人股本情况.....83
十二、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.....98
十三、发行人与董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.....103
十四、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.....103
十五、董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况.....104
十六、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.....105
十七、董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.....106
十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.....108
十九、发行人员工情况.....117
第五节 业务和技术.....121
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.....121
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.....142
三、销售情况和主要客户.....179
四、采购情况和主要供应商.....184

五、发行人的主要固定资产和无形资产.....187
六、发行人的核心技术及研发情况.....194
七、发行人环境保护与安全生产情况.....207
八、发行人的境外经营及境外资产情况.....211
第六节 财务会计信息与管理层分析 212
一、财务报表.....212
二、主要会计政策和会计估计.....219
三、非经常性损益情况.....230
四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况.....231
五、主要财务指标.....234
六、经营成果分析.....236
七、资产质量分析.....262
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....282
九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.....297
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....298
第七节 募集资金运用与未来发展规划 299
一、募集资金运用情况.....299
二、未来发展与规划.....301
第八节 公司治理与独立性 307
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....307
二、发行人内部控制情况.....307
三、报告期内发行人违法违规情况.....309
四、发行人资金占用和对外担保情况.....309
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.....309
六、同业竞争.....311
七、关联方及关联交易.....311
第九节 投资者保护 322
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.....322
二、发行人的股利分配政策.....322

三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施.....327
第十节 其他重要事项.....328
一、重要合同.....328
二、对外担保情况.....332
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.....332
四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.....332
第十一节 声明.....333
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.....333
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....335
三、保荐人（主承销商）声明.....336
四、发行人律师声明.....338
五、承担审计业务的会计师事务所声明.....339
六、承担评估业务的资产评估机构声明.....340
七、承担验资业务的机构声明.....342
第十二节 附件.....343
一、备查文件.....343
二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....344
三、与投资者保护相关的承诺.....347
四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.....374
五、股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....375
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....376
七、募集资金具体运用情况.....377
八、其他子公司及参股公司简要情况.....393
第十三节 附表.....397

附表一：专利权.....397
附表二：集成电路布图设计.....406
附表三：商标专用权.....411
附表四：软件著作权.....413
附表五：美术作品著作权.....415

第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、一般释义

公司、发行人、长晶科技	指	江苏长晶科技股份有限公司
长晶有限	指	江苏长晶科技有限公司，发行人前身
深圳长晶	指	深圳长晶半导体有限公司，曾用名“深圳长电科技有限公司”，发行人全资子公司
长晶浦联	指	江苏长晶浦联功率半导体有限公司，发行人控股子公司
新顺微	指	江苏新顺微电子股份有限公司，曾用名“江阴新顺微电子有限公司”，原为发行人控股子公司，于 2025 年 7 月成为发行人全资子公司
海德半导体	指	江苏海德半导体有限公司，发行人全资子公司
长晶微电子	指	深圳长晶微电子有限公司，发行人控股子公司
长华智芯	指	南京长华智芯微电子有限公司，发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司
香港长晶	指	长晶科技（香港）有限公司，曾用名“长电科技（香港）有限公司”，发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司
南京顺芯	指	南京顺芯管理咨询有限公司，发行人全资子公司
长芯检测	指	南京长芯检测科技有限公司，原为发行人参股公司，于 2024 年 9 月成为发行人全资子公司
上海长晶	指	长晶（上海）半导体有限公司，发行人全资子公司
Universal	指	UNIVERSAL SEMICONDUCTOR PTE. LTD.，发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司
G&C	指	G&C MICROTECH COMPANY LIMITED，Universal 参股 40%的参股公司
长晶联合	指	江苏长晶联合电子有限公司，发行人全资子公司
新申弘达	指	江阴新申弘达半导体销售有限公司，已注销
长芯顺联	指	南京长芯顺联电子有限公司，原为发行人全资子公司，于 2025 年 1 月注销
南京芯联	指	南京芯联企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人原直接和间接持股 100%的合伙企业，于 2025 年 9 月注销
南京海德	指	海德半导体（南京）有限公司，原为发行人全资子公司，于 2026 年 3 月注销
上海江昊	指	上海江昊企业管理咨询有限公司，发行人控股股东
南京江澄	指	南京江澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“上海江澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“上海长电新联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，发行人股东
南京瑞联	指	南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名“北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）”，发行人股东

晨壹越腾	指	嘉兴晨壹越腾股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海长镌	指	上海长镌企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海观成	指	上海观成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海摩勤	指	上海摩勤智能技术有限公司，发行人股东
深圳展想	指	深圳市展想信息技术有限公司，发行人股东
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司，发行人股东
傅传企管	指	舟山傅传企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“上海傅传企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”、“上海傅誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，发行人股东
杭州晶舰	指	杭州晶舰股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“湖州晶舰股权投资合伙企业（有限合伙）”，发行人股东
大美众芯	指	南通大美众芯创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州汾湖	指	苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙），发行人股东
财通创新	指	财通创新投资有限公司，发行人股东
湖北小米	指	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
晶智众达	指	南京晶智众达企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
东方富海	指	芜湖市东方富海三号股权投资企业（有限合伙），发行人股东
宁波汉途	指	宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
瑞芯晶云	指	井冈山瑞芯晶云股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
海通创新	指	海通创新证券投资有限公司，发行人股东
通达信	指	武汉通达信数字科技有限公司，发行人股东
瑞芯晶泽	指	上海瑞芯晶泽企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“南通瑞芯晶泽企业管理合伙企业（有限合伙）”，发行人股东
华业天成	指	湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
泰亚富国	指	泉州市泰亚富国股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
上海斯瑞	指	上海斯瑞投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
南京创鼎	指	南京创鼎铭和股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
格金六号	指	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
越秀智创	指	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
广州国资产业	指	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
越秀金蝉	指	广州越秀金蝉三期股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
晨壹佰赢	指	嘉兴晨壹佰赢股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
领益基石	指	南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
江阴澄芯	指	江阴澄芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东

节能环保战新	指	江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙），发行人股东
信晶长腾	指	芜湖信晶长腾股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州聚源	指	苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
财富趋势	指	深圳市财富趋势科技股份有限公司，发行人股东
服务贸易基金	指	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙），发行人股东
广东广祺	指	广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
宁波烈焰	指	宁波烈焰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
远智先行	指	广东远智先行九号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
常州红土	指	常州红土人才投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
广州科导	指	广州科导投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
虹润科技	指	虹润（杭州）科技有限公司，发行人股东
苏州广祺	指	苏州广祺智行产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
聿泉金环	指	江苏聿泉金环土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
江阴澄顺	指	江阴澄顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
江苏聿泉	指	江苏聿泉红土智能创业投资基金（有限合伙），发行人股东
厦门建发	指	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙），发行人股东
蓝天投资	指	南京蓝天投资有限公司，发行人股东
宁波美橙	指	宁波美橙企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东
泉州海丝	指	泉州海丝科宇盛达贰号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
君众睿华	指	惠州君众睿华企业管理中心（有限合伙），发行人股东
清石晶晟	指	苏州清石晶晟创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东
惠友豪创	指	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙），发行人报告期内历史股东
上海半导体	指	上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
浦口产业	指	南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙），发行人控股子公司长晶浦联的股东
金浦创业	指	南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
金浦新兴	指	南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
宝辰投资	指	宁波梅山保税港区宝辰投资管理合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
上海汇付	指	上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心（有限合伙），新顺微历史股东
安吉璟升	指	安吉璟升股权投资合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东

盈进智能	指	盈进智能制造（深圳）投资中心（有限合伙），新顺微历史股东
闻勤新顺	指	厦门闻勤新顺股权投资合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
澄芯二号	指	江阴澄芯二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
澄顺二号	指	江阴澄顺二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙），新顺微历史股东
长晶企达	指	扬州长晶企达投资合伙企业（有限合伙），发行人持股平台
长晶佳瑞	指	扬州长晶佳瑞投资合伙企业（有限合伙），发行人持股平台
新能德	指	东莞新能德科技有限公司（NVT），全球消费类锂电池龙头企业，系新能源科技有限公司 (ATL) 旗下的全资子公司
飞毛腿	指	飞毛腿电池有限公司，国内消费类锂电池头部企业
安瑞光电	指	芜湖安瑞光电有限公司，国内领先的车灯制造企业，三安光电全资子公司
安波福	指	安波福是一家全球汽车技术公司，前身是德尔福汽车，总部设在爱尔兰都柏林，在纽约证券交易所上市（股票代码：APTV）
安闻科技	指	安闻科技集团股份有限公司（简称 AEW），国内领先的汽车内饰件制造商
麦田能源	指	麦田能源股份有限公司（FOX ESS），全球户用储能头部企业，主营储能逆变器、光伏储能系统
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，主板上市公司，代码：600584，发行人供应商
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司，曾用名“绍兴中芯集成电路制造股份有限公司”，科创板上市公司，代码：688469，发行人供应商
力积电	指	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation，中国台湾上市公司，代码：6770.TW，发行人供应商
格瑞宝	指	上海格瑞宝电子有限公司，发行人供应商
芯德半导体	指	江苏芯德半导体科技股份有限公司，曾用名“江苏芯德半导体科技有限公司”，发行人供应商
扬杰科技	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司，创业板上市公司，代码：300373，发行人同行业可比公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司，主板上市公司，代码：600460，发行人同行业可比公司
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司，主板上市公司，代码：605111，发行人同行业可比公司
捷捷微电	指	江苏捷捷微电子股份有限公司，创业板上市公司，代码：300623，发行人同行业可比公司
安森美	指	ON Semiconductor Corporation，全球领先的功率半导体、模拟器件及汽车电子解决方案供应商
英飞凌	指	Infineon Technologies AG，全球领先的汽车电子、功率半导体及工业控制芯片供应商
安世半导体	指	Nexperia B.V.，全球领先的分立器件、MOSFET 及逻辑器件供应商，2019 年被闻泰科技（600745）收购
意法半导体	指	STMicroelectronics N.V.，全球领先的半导体公司，提供微控制器、功率器件、模拟芯片及传感器等解决方案
东芝半导体	指	Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation，简称 Toshiba，

		一家日本知名功率半导体、存储器件及工业电子解决方案供应商
德州仪器	指	Texas Instruments Incorporated，全球领先的模拟芯片、嵌入式处理器及半导体解决方案供应商
华润微	指	华润微电子有限公司，科创板上市公司，代码：688396，国内领先的功率半导体、模拟集成电路供应商
报告期各期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度
报告期各期末	指	2023 年末、2024 年末、2025 年末
本次发行	指	江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深交所主板上市
本招股说明书	指	《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上市招股说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏长晶科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《江苏长晶科技股份有限公司章程（草案）》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、主承销商、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师、发行人会计师、审计机构、验资机构、验资复核机构、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、发行人律师、世纪同仁	指	江苏世纪同仁律师事务所
评估师、评估机构、中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股票、A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。常见的半导体材料有硅、碳化硅、氮化镓、砷化镓等，其中硅因工艺成熟、资源丰富，目前是商业应用最广泛的半导体材料
分立器件	指	以半导体材料为基础的，具有固定单一特性和功能的电子器件，如：二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等
小信号器件	指	耗散功率小于 1W（或者额定电流小于 1A）的分立器件
功率器件	指	耗散功率不小于 1W（或者额定电流不小于 1A）的分立器件
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件，将电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等集成在一个芯片上，成为具有所需电路功能的电子器件
功率半导体	指	功率器件与电源管理 IC 的统称
电源管理 IC	指	Power Management Integrated Circuits，是一种特定用途的集成电路，在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责，按电路功能可分为 DC/DC、AC/DC、线性稳压器等
线性稳压器	指	线性稳压器本质上是一种电压调整器，其核心目标是将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压
三端稳压 IC	指	三端稳压 IC 用于将输入的电压稳定在特定的输出电压上，具有三个引脚：输入端（Vin）、输出端（Vout）和接地端（GND）。三端稳压 IC 能够自动调节输入电压的变化，提供稳定的输出电压
LDO	指	Low Dropout Regulator，低压差线性稳压器，是新一代的集成电路稳压器，可用于电流主通道控制，通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比
电压基准源	指	电压基准源是一种能提供稳定、精确、不随温度、负载、电源电压变化而波动的电压源，广泛应用于电子电路中，尤其是在需要高精度和稳定性的场合，如模数转换（ADC）、数模转换（DAC）、稳压电路、传感器电路等
DC-DC	指	直流变换器，可将一个固定的直流电压变换为另一个直流电压
AC-DC	指	交流-直流变换器，能够将交流电压转换为直流电压
晶圆	指	晶圆是根据设计出的电路版图使用专业制造设备，通过氧化扩散、光刻、刻蚀、薄膜生长、离子注入等工艺步骤，制造形成的具有特定功能的圆形晶片
芯片	指	芯片是将晶圆经划片形成裸晶粒，再经封装、测试后制成的功能完整的半导体器件，分立器件和集成电路均属于芯片
二极管	指	用半导体材料制成的，具有两个电极的器件，具有单向导电性能
TVS	指	Transient Voltage Suppressor，瞬态电压抑制二极管，一种浪涌保护器件，可以有效地保护电子线路中的精密元器件，免受各种浪涌脉冲的损坏
ESD	指	Electro-Static Discharge，静电阻抗器，是用来避免电子设备中的敏感电路受到静电放电影响的一种二极管
FRD	指	Fast Recovery Diode，快恢复二极管，是具有开关特性好、反向恢复时间短特点的一种二极管
SBD	指	Schottky Barrier Diode，肖特基势垒二极管，是利用金属与半导

		体接触形成的肖特基势垒制作的一种二极管，根据结构不同可分为 Trench SBD（沟槽型肖特基二极管）、Planar SBD（平面型肖特基二极管）和 JBS SBD（结势垒肖特基二极管）等
Zener	指	稳压二极管，又称齐纳二极管，在反向击穿时，在一定的电流范围内，两端电压几乎不变，表现出稳压特性
三极管（BJT）	指	Bipolar Junction Transistor，也称双极型晶体管，是一种电流控制的半导体器件，其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号
MOSFET 或 MOS	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
沟槽型 MOSFET、Trench MOSFET	指	Trench MOSFET，通过沟槽工艺制备栅极结构，具有高元胞密度、低导通损耗等特点
超结 MOSFET、SJ MOSFET	指	Super Junction MOSFET，高压超结金属氧化物半导体场效应晶体管，是一种新型功率器件，在平面垂直双扩散金属-氧化物半导体场效应晶体管的基础上，引入电荷平衡结构。具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片面积小等特点
屏蔽栅 MOSFET、SGT MOSFET	指	Shield Gate Trench MOSFET，屏蔽栅沟槽型场效应晶体管，在传统的功率 MOSFET 中加入额外的多晶硅场板进行电场调制从而提高耐压和降低导通电阻的器件
CSP MOSFET	指	Chip Scale Package MOSFET，即芯片级封装金属氧化物半导体场效应晶体管，是采用芯片级封装技术的功率 MOSFET 器件，封装尺寸与裸片尺寸基本一致，省去传统引线框架与键合线，具有体积小、寄生参数低、导通电阻低、散热性能优异等特点，可满足高集成度、小型化的消费电子应用需求
VDMOS	指	Vertical Double-diffused MOSFET，是 MOSFET 中的一种，也称垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管，其电流流通路径为芯片的表面至芯片底部的纵向流通
FRMOS	指	FRMOS 为内置集成快恢复二极管的改良型功率 MOS 器件，在单芯片整合 MOS 开关与续流二极管，相较分立搭配方案可精简外围电路、降低损耗、提升整机可靠性
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管，同时具备 MOSFET 和双极型晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，垂直整合制造，是集半导体设计、制造、封装测试及产品销售于一体的一种半导体行业经营模式
Fabless	指	无晶圆厂模式，该模式下，设计企业仅负责半导体产品的设计和销售，将制造、封装测试等环节外包给专业的晶圆制造和封测企业。也代指此类只从事研发和销售的半导体设计企业
Foundry	指	在集成电路行业是指专门从事晶圆制造，接受 IC 设计公司委托制造晶圆而不自行从事芯片设计的晶圆代工厂
晶圆代工	指	专业晶圆制造企业，为芯片设计企业提供晶圆制造服务的商业模式，服务内容包括工艺开发、流片试产、大规模量产等全流程晶圆加工环节
封装	指	将生产加工后的晶圆进行切割、焊线、塑封等操作，使电路与外部器件实现连接，并为集成电路提供机械保护，使其免受物理、化学等环境因素损伤的工艺
封测	指	封装及封装后测试的简称
流片	指	芯片设计企业完成电路设计后，委托晶圆代工企业进行验证性晶

		圆制造，以获取样片用于功能、性能测试的过程，是芯片从设计到量产的关键验证环节
SiC、碳化硅	指	碳化硅（SiC）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等性质，特别适用于高压、大功率半导体功率器件领域
GaN、氮化镓	指	氮化镓（GaN）是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高、直接带隙、击穿电场高等性质
AEC-Q	指	汽车电子委员会制定的汽车电子元器件可靠性认证标准，为车规产品核心认证
优值系数（FOM）	指	Figure of merit，在功率器件中特指导通损耗及开关损耗的乘积，数值越低，器件综合损耗越小，性能越优
导通电阻（Rsp）	指	功率器件单位面积导通电阻，是衡量导通损耗的核心指标，数值越低，导通损耗越小
开关损耗	指	功率器件开通、关断过程中的功率损耗，影响高频应用效率，数值越低，工作效率越高
结温（Tj）	指	半导体芯片内部 PN 结的工作温度，衡量器件耐热性与可靠性，额定最高结温越高，器件耐高温能力越强；实际工作结温越低，器件寿命越长
反向恢复电荷（Qrr）	指	二极管反向恢复过程存储的电荷，决定开关损耗与高频性能，数值越低，开关损耗越小，高频性能越好
正向压降（VF）	指	二极管、三极管等器件正向导通时两端的电压降，是衡量导通损耗的核心技术指标，数值越低导通损耗越小
寄生参数	指	寄生参数是指电子元器件或电路中与原本设计目标无关的电阻、电容或其他参数，参数值越小，器件电气性能越理想
栅极电荷（Qg）	指	功率 MOSFET、IGBT 等器件栅极导通所需的电荷量，是衡量开关损耗、驱动难度及高频性能的核心技术指标，Qg 值越低，开关损耗越小、驱动功耗越低、高频性能越好
EMI	指	Electromagnetic Interference（电磁干扰），表征功率器件开关切换过程中产生传导、辐射电磁噪声的强弱水平，为衡量器件电磁兼容性能的核心指标；噪声水平越低，器件电磁干扰越小，终端整机滤波配套成本越低、电磁合规性能越好
hFE	指	三极管的电流放大倍数，三极管的核心技术指标，表征器件的电流放大能力；hFE 档位指根据放大系数大小划分的不同区间，用于满足不同电路对放大能力的需求
BVCBO	指	三极管集电极-基极反向击穿电压，指发射极开路时，集电极与基极之间可承受的最大反向电压，是衡量三极管高压可靠性与稳定性的关键指标，数值越高，耐压能力与可靠性越强
PSRR	指	Power Supply Rejection Ratio，电源抑制比，用于表征电源管理芯片、模拟器件抑制输入端电压波动与纹波噪声的能力，单位为 dB，数值越高，稳压、抗干扰性能越优异

特别说明：

1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，

包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

3、本招股说明书中涉及第三方数据均非专门为本次发行准备，数据出处权威、可靠，均在引用处或图表下方注明了资料来源。发行人向第三方专业咨询公司芯谋研究付费购买了《2025 中国功率分立器件市场年度报告》和《全球 WLCSP MOSFET 产业研究报告》，芯谋研究是国内领先的专注半导体领域的研究机构，连续多年对分立器件市场进行分析并出具报告，其研究报告向市场公开发售。除上述情况外，发行人未就其他第三方数据支付费用或提供帮助。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：

1、宏观经济及下游需求波动风险

公司所属半导体行业的下游主要为消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等领域，公司半导体产品的市场需求变化与下游应用端及终端消费市场需求息息相关，受宏观经济波动的影响较大。近年来，在全球经济周期波动和国际贸易环境变化的影响下，下游行业的发展存在一定的波动性。其中，2022 年至 2023 年，受消费电子等需求下滑、产能供应增加、下游库存去化等影响，功率半导体整体行情出现阶段性调整。虽然自 2024 年以来，随着半导体产品去库存化，消费电子需求边际改善，叠加新能源、汽车电子、人工智能等新兴应用持续扩容，功率半导体景气度持续提升，公司收入呈增长趋势，但未来如果下游行业景气度再次下行，将对发行人业绩产生负面影响，甚至可能会导致发行人出现业绩下滑的风险。

2、行业竞争加剧的风险

公司主营的分立器件和电源管理 IC 作为电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，产品广泛应用于国民经济建设和社会生活各环节领域，对推动其他产业的升级和发展起着关键作用，是不可替代的基础性电子元器件。近年来，随着下游应用领域的发展，我国分立器件和电源管理 IC 行业的整体技术水平不断提升，生产厂商不断增加。同时，为争夺市场份额，不同生产厂家之间的竞争也日益激烈。日益加剧的行业竞争将对公司的盈利能力和经营业绩带来不利影响。

3、商誉减值的风险

截至报告期期末，公司合并报表商誉账面价值为 8.27 亿元，占公司总资产的比重为 18.14%。上述商誉的形成主要系公司自成立以来，分别于 2018 年 12 月收购了深圳长晶 100%股权及新申弘达（承接长电科技本部分立器件销售业务）100%股权，于 2022 年 1-3 月合计收购了新顺微 67.11%直接或间接股权并实现对新顺微的控制。

根据《企业会计准则》相关规定，上述收购交易为非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉，该商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等规定及公司会计政策，公司已于收购完成后的各期末，对相关资产组的商誉进行减值测试。其中，根据测试和评估结果，发行人对 2022 年新顺微计提商誉减值准备 9,578.54 万元。

若行业环境变化、宏观经济波动、国际贸易摩擦加剧，公司不能有效地应对市场竞争加剧、国家法律法规及产业政策变化、国际形势的改变等情形，则以上因素可能对收购的资产组业绩产生较大的不利影响，并对公司生产经营、财务状况及未来发展产生较大不利影响。如果相关资产组无法实现预期的经营业绩，则公司可能面临进一步商誉减值的风险，从而对公司的业绩表现带来不利影响。

4、固定资产投资风险

不同于数字芯片，分立器件强调设计、制造、应用的深度结合，更重视设计、晶圆制造和封装测试的一体化。因此，IDM 模式是行业发展趋势，也是国际主流分立器件厂商的经营模式。发行人沿袭该产业逻辑持续演进自身的经营模式，形成了“Fabless+IDM”的经营模式。为提升自主封测和自产晶圆能力，报告期内，发行人对晶圆和封测生产的固定资产投入较大。截至报告期末，公司固定资产和在建工程账面价值分别为 113,917.48 万元和 8,184.66 万元，合计占总资产的 26.79%。未来，为了进一步深化 IDM 模式，公司将继续增加相关资产投入，从而导致固定资产规模持续扩大。若公司收入规模的增长短期内无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临经营业绩下降的风险。

（二）业绩下滑情形相关承诺

本公司提示投资者认真阅读控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的业绩下滑而延长股份锁定期的相关承诺，以及本公司及实际控制人、主要股东、董事、审计委员会委员、高级管理人员、本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”。

（三）上市后分红政策

本公司提示投资者认真阅读本公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，详细参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	江苏长晶科技股份有限公司	**成立日期**	2018 年 11 月 29 日
注册资本	435,031,732 元	**法定代表人**	杨国江
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座 13 楼	**主要生产经营地址**	中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座 13 楼
控股股东	上海江昊企业管理咨询有限公司	**实际控制人**	杨国江
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业	**在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况**	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	**主承销商**	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	江苏世纪同仁律师事务所	**其他承销机构**	无
审计机构	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	**评估机构**	中联资产评估集团有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		公司保荐机构华泰联合证券的控股股东华泰证券股份有限公司为南京瑞联、晨壹越腾经过逐层追溯后的间接出资人。截至本招股说明书签署日，华泰证券股份有限公司通过南京瑞联、晨壹越腾合计间接持有发行人 0.13%的股份	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	**收款银行**	**【】**

其他与本次发行有关的机构	无

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 5,000.00 万股	**占发行后总股本比例**	不低于 10%
其中：发行新股数量	不超过 5,000.00 万股	**占发行后总股本比例**	不低于 10%
股东公开发售股份数量	无	**占发行后总股本比例**	无
发行后总股本	不超过 48,503.17 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
发行前每股净资产	【】元	**发行前每股收益**	【】元
发行后每股净资产	【】元	**发行后每股收益**	【】元
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目		
	MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目		
	电源管理 IC 技术研发项目		
	补充流动资金项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括： 1、保荐及承销费用【】万元； 2、审计及验资费【】万元； 3、律师费【】万元； 4、用于本次发行的信息披露费用【】万元； 5、发行手续费及其他费用【】万元。		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	若公司决定实施高级管理人员、员工战略配售，则在本次公开发行注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案并依法披露		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	无		

（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人主营业务经营情况

（一）主营业务、主要产品及其用途

长晶科技是一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。公司具备上万种规格型号产品的量产能力，是国内产品门类最齐全、系列最丰富的分立器件与电源管理 IC 企业之一。公司自设立以来，以半导体产品研发、设计与销售为基础，凭借内生发展与外延并购双轮驱动，逐步实现了从 Fabless 模式到“Fabless+IDM”模式的演变，部分产品具备从产品定义设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。公司顺应全球半导体行业演进规律，在分立器件、电源管理 IC 领域确立了“平台化”、“一体化”战略发展宗旨。

分立器件是指具有单独功能且功能不能拆分的基本电子元件，属于半导体产业的基础元素；电源管理 IC 是将分立器件与其控制/接口/保护等电路集成在同一芯片的集成电路，是系统信号处理部分和执行部分的桥梁。

分立器件和电源管理 IC 是电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，主要承担电能的转换、分配、调节与保护等核心功能，在电路系统中发挥着不可替代的物理支撑作用，广泛渗透于国民经济与生产生活的各个应用领域，与负责信息处理的数字集成电路协同，共同构成了现代电子工业的硬件基础。我国作为世界第一制造大国和全球最大的能源市场，分立器件和电源管理 IC 的国产化直接关系能源利用效率和高端装备制造能力，分立器件和电源管理 IC 的快速发展对于国民经济和社会发展具有重大意义。近年来，随着新能源汽车、人工智能、机器人等行业的蓬勃发展，分立器件和电源管理 IC 作为电子信息产业的基石，产业支撑作用及价值重要性愈发提升。

当前，全球贸易摩擦与技术封锁持续加剧，地缘政治冲突对产业链供应链安全构成严峻挑战。2024 年 12 月，美国商务部将全球功率半导体龙头安世半导体母公司闻泰科技列入“实体清单”；2025 年 9 月，在外部地缘政治升级及出口管制规则传导下，荷兰政府依托本国产业安全相关法规出台限制性行政命令，造成闻泰科技对安世半导体境外主体经营管控权利受限，引发全球分立器件产能供给波动，并对全球汽车等关键产业链造成阶段性扰动。在此背景下，推动我国分立器件与电源管理 IC 产业加速自主化进程，实现供应链自主可控、保障产业链安全稳定的战略意义愈发重大。

报告期内，发行人主营业务收入按产品分类具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分立器件	222,281.41	75.70%	194,327.57	73.59%	161,058.91	72.35%
其中：二极管	76,274.26	25.98%	67,688.36	25.63%	56,706.47	25.47%
三极管	60,650.34	20.65%	56,618.92	21.44%	48,377.15	21.73%
MOSFET	81,321.96	27.69%	65,383.41	24.76%	50,982.77	22.90%
其他分立器件	4,034.84	1.37%	4,636.88	1.76%	4,992.53	2.24%
电源管理 IC	23,877.36	8.13%	23,104.78	8.75%	20,521.30	9.22%
晶圆	46,634.34	15.88%	46,157.11	17.48%	40,670.55	18.27%
其他	844.62	0.29%	491.12	0.19%	369.77	0.17%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

（二）主要原材料及重要供应商情况

公司主要采购的内容包括晶圆、封测服务、集中委托成品采购等，主要供应商包括芯联集成、长电科技、力积电等行业知名企业。

公司采购具体情况参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、采购情况和主要供应商”。

（三）主要生产模式

公司采取 Fabless+IDM 的生产模式，Fabless 模式下，公司主要将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给外部的晶圆制造企业或封测企业完成。同时，公司通过自建、收购等形式，形成了自有晶圆制造、封测加工产线，采用“以销定产”

与“安全库存”相结合的生产模式。

公司生产模式具体情况参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（二）公司主要经营模式”之“3、生产模式”。

（四）销售方式和渠道及重要客户

公司目前采用买断式经销和直销相结合的销售模式，客户覆盖国内外上千家终端客户，包括多个行业的头部终端企业。其中，公司主要直销客户包括欣旺达（300207）、比亚迪（002594）、传音控股（688036）、华勤技术（603296）、石头科技（688169）、格力电器（000651）等。公司主要经销客户包括深圳海格微电子有限公司、南京高上美电子有限公司、深圳翰世宇科技有限公司、深圳市联盛电子有限公司等，其下游终端客户包括新能德（全球消费类锂电池龙头）、飞毛腿（国内消费类锂电池头部企业）、泉峰控股（02285）、拓邦股份（002139）、朗科智能（300543）、德业股份（605117）等。

公司销售具体情况参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“三、销售情况和主要客户”。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

分立器件产业起源于欧美，日韩后续不断形成其自身竞争优势，目前全球分立器件市场仍以欧美日企业为主导，如英飞凌、安森美、安世半导体、意法半导体等。根据芯谋研究统计，2024 年度全球分立器件市场规模为 323.00 亿美元，全球分立器件市场前十大市场份额占比达到 61.6%，前十大厂商均为国外品牌。

国内市场方面，我国作为全球最大的分立器件消费市场，近年来受益于“智能制造”、“新基建”、“碳达峰、碳中和”等国家政策和战略深入推进，叠加半导体、能源电子等产业政策扶持，我国分立器件市场增速高于全球平均水平，本土厂商越来越多地参与到全球市场的供应体系，部分本土优秀企业已逐步积累了较为丰富的半导体研发和生产技术经验，取得了一定的知名度和市场占有率。但在 MOSFET、IGBT 等细分产品，以及汽车等高端应用市场，仍以国际一流半导体企业为主导。根据中国半导体行业协会的评定，发行人与华润微、扬杰科技、士兰微、捷捷微电等“中国半导体行业功率器件十强企业”，组成了本土分立器件

企业的第一梯队。

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”，是国内分立器件行业具有代表性的企业。公司主要产品及市场占有率在行业细分市场具有领先地位：（1）公司是国内二三极管产品的市场领先企业，根据中国半导体行业协会的证明，2024 年，公司二三极管合计销售规模在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 2 名，处于国内龙头地位；（2）在 MOSFET 产品领域，公司近年来收入快速增长，打造了第二增长曲线，自主研发的 CSP MOSFET 产品经江苏省工信厅鉴定为国内领先、国际先进水平，系公司实现国产自主创新的代表性产品。根据中国半导体行业协会证明，2024 年，公司 CSP MOSFET 市场占有率在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 1 名。

五、发行人符合主板定位

（一）公司业务模式成熟

报告期内，公司采用 Fabless 与 IDM 并行的模式开展业务，Fabless 和 IDM 均是半导体行业成熟的经营模式。目前，公司 IDM 模式主要应用于二极管、三极管等相对成熟的产品，可以充分发挥 IDM 模式供应链稳定、降低成本的优势；而针对 MOSFET、IGBT、电源管理 IC 等仍在快速成长期的产品而言，公司主要通过 Fabless 模式或封测环节自产的方式进行生产，可以发挥 Fabless 模式资本投入小、灵活性高、市场适应性强的优势。

此外，公司在研发、生产、采购与销售方面均已建立起成熟的业务模式。研发方面，公司以市场需求为导向，建立研发平台，通过自主开发实现产品升级迭代；生产方面，公司采取 Fabless+IDM 的模式，针对不同产品的特性、发展阶段，以及市场供需情况采用不同的模式，充分发挥不同模式的优势；采购方面，公司在 Fabless 模式下主要采购晶圆和封测服务，在 IDM 模式下主要采购硅片等晶圆制造材料，以及引线框架、塑封料等封测材料。销售方面，公司目前采用买断式经销和直销相结合的销售模式，下游客户覆盖面广且涵盖了行业内知名企业。

（二）公司经营业绩稳定、规模较大

公司经营业绩稳定向好，销售与盈利规模较大。2023 年至 2025 年，公司营

业收入分别为 22.60 亿元、26.78 亿元和 29.85 亿元，扣非后归母净利润分别为 1.24 亿元、2.18 亿元和 3.34 亿元，呈稳固增长趋势。从销量来看，2023 年至 2025 年，公司分立器件和电源管理 IC 的合计销量分别为 246.08 亿颗、317.26 亿颗和 371.70 亿颗，晶圆对外销量分别为 122.18 亿颗、154.41 亿颗和 161.99 亿颗，增长幅度较大，显著提升了市场份额、推动了收入增长。

公司资产规模较大，截至 2025 年末，公司资产总额为 45.57 亿元，净资产为 22.79 亿元。公司产能较大，是国内少有的具备 IDM 能力的分立器件企业。2025 年度，公司子公司长晶浦联和海德半导体已具备合计约 160 亿颗/年的封测产能，子公司新顺微已具备约 180 万片/年的晶圆产能，在分立器件领域形成全产业链核心技术自主可控的能力。

公司作为分立器件行业的领先企业，在保持二极管、三极管等传统产品优势和市场地位的基础上，通过 MOSFET、电源管理 IC、IGBT 等产品开辟第二增长曲线，经营规模和业绩仍具备较大增长空间。

（三）公司具有行业代表性

1、公司主营的分立器件及电源管理 IC 作为不可替代的基础性电子元器件，具有行业代表性

公司主营的分立器件和电源管理 IC 作为电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，主要承担电能的转换、分配、调节与保护等核心功能，在电路系统中发挥着不可替代的物理支撑作用，广泛渗透于国民经济与生产生活的各个应用领域。分立器件和电源管理 IC 能够通过提升能源转换效率、支撑智能化转型和促进产业升级，对推动其他产业的升级和发展起着关键作用，是不可替代的基础性电子元器件。

由于分立器件和电源管理 IC 在国民经济运行中承担的基础性作用，具有下游应用广泛、功能不可替代的特点，行业规模均达到千亿级水平。根据芯谋研究，2024 年国内分立器件市场规模为 145.76 亿美元；根据中商产业研究院数据，2024 年，国内电源管理 IC 行业市场规模为 1,246 亿元。近年来，随着新能源、汽车电子、AI、机器人等行业的蓬勃发展，分立器件和电源管理 IC 的市场需求和重要性进一步凸显，市场规模保持持续增长。

因此，公司主营的分立器件和电源管理 IC 是不可替代的基础性电子元器件，具有广阔的市场空间，具有行业代表性。

2、公司在分立器件行业处于领先地位，属于行业代表性企业

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被中国半导体行业协会评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”。细分市场来看，公司二三极管产品处于国内龙头地位，MOSFET 产品处于高速发展阶段，IGBT 具备未来快速发展的潜力，具体如下：

（1）二三极管是公司业务的基本盘，报告期内占公司主营业务收入比例分别为 47.20%、47.07%和 46.63%。公司在二三极管领域具备 IDM 全流程生产能力，报告期内实现收入的二三极管产品超过 8,000 款，产品矩阵丰富，覆盖场景广泛，目前已处于市场领先地位。根据芯谋研究数据，2024 年，国内二三极管合计市场规模为 30.64 亿美元。根据中国半导体行业协会的证明，2024 年，公司二三极管合计销售规模在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 2 名，处于国内龙头地位。

（2）MOSFET 是公司重点打造的第二增长曲线，已在市场中占据一定份额，处于高速发展阶段。根据芯谋研究数据，2024 年，国内 MOSFET 市场规模为 57.52 亿美元，是分立器件市场占比最高的品类。2022 年至 2025 年，公司 MOSFET 产品收入由 3.25 亿元增长至 8.13 亿元，复合增长率达到 35.82%，远超行业增速。此外，自主研发的 CSP MOSFET 产品经江苏省工信厅鉴定为国内领先、国际先进水平，系公司实现国产自主创新的代表性产品。根据中国半导体行业协会证明，2024 年，公司 CSP MOSFET 市场占有率在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 1 名。

（3）IGBT 是公司重点研发突破的产品，具备未来快速发展的潜力。公司研发并推出的大功率 IGBT 单管及模块，部分产品性能可对标国际一线品牌最新代次产品，技术实力位居国内品牌前列。公司 IGBT 产品凭借优异的性能，已在汽车电子、光伏储能、充电桩等领域取得突破，并被纳入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录。根据芯谋研究数据，2024 年，国内 IGBT 市场规模为 54.30 亿美元，市场规模较大。IGBT 市场长期被安森美、英飞凌等国外品牌所占据，2024

年国产自给率仅为 32.9%，国产自主创新空间依然广阔，公司凭借领先的技术水平，具备未来快速发展的潜力。

3、公司战略布局契合产业演进及发展趋势，具有行业代表性

公司顺应全球半导体行业演进规律，对标英飞凌、安森美、安世半导体等国际主流分立器件、功率半导体龙头企业，确立了“平台化”、“一体化”发展战略，业务模式、产品布局、下游应用等方面契合产业发展趋势，具有行业代表性。

在业务模式方面，分立器件强调设计、制造、应用的深度结合，更重视设计、晶圆制造和封装测试的一体化。因此，IDM 模式是行业发展趋势，也是国际主流功率半导体厂商的经营模式。公司从设立之初的 Fabless 模式，通过自建长晶浦联封测厂、收购海德半导体及新顺微逐步构建 Fabless+IDM 模式，具备从产品定义设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。报告期内，公司逐步深化 IDM 模式，稳步提升了自主封测和自产晶圆能力。

在产品布局方面，分立器件品类规格多样、下游需求场景分散，客户普遍需要多品类、全系列的一站式解决方案。因此，打造覆盖多品类的产品矩阵并持续推进技术迭代与型号扩充，是行业发展趋势。公司自设立以来，以二三极管为基本盘，持续开发产品系列，已完成 MOSFET 和电源管理 IC 产品的延伸，开辟了第二增长曲线。同时，公司逐步实现了 IGBT 的量产与第三代半导体分立器件的突破，为后续进一步发展奠定了基础。

在下游应用方面，分立器件广泛应用于国民经济与信息产业的各个领域，是现代各类电子设备及系统不可或缺的基础核心元器件。公司在稳固消费电子、工业控制等传统优势领域基本盘、持续提升市场占有率的基础上，积极顺应国家产业政策导向，下游应用持续向汽车电子、新能源、机器人及服务器等高附加值、高门槛的应用领域拓展，进一步覆盖下游多场景、领域客户应用，持续实现规模化收入增量。

4、公司产品技术优势及持续创新能力，具有行业代表性

自设立以来，长晶科技高度重视技术创新，深挖技术护城河，通过搭建并优化人才团队、迭代产品平台、研发掌握关键核心技术、完善专利布局等手段，持续提升公司综合竞争力。经过多年的发展，公司已具备半导体产品设计、晶圆制

造及封装测试等全产业链的核心技术能力。

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”。公司被评定为江苏省企业技术中心，设有江苏省工程技术研究中心、国家博士后工作站。同时，公司参与起草《半导体器件金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的可动离子试验》等 7 项国标，以及《IGBT 器件结构及制备工艺通用技术要求》等 4 项团标，覆盖 MOSFET、IGBT、二三极管及第三代半导体等不同种类与不同材料的分立器件。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利 244 项（其中发明专利 85 项），以及集成电路布图设计专有权 130 项，对公司核心技术形成了有效保护，提升了公司的技术壁垒；公司研发人员 305 人，占总人数的比例为 15.51%，且拥有众多曾在国内外知名半导体企业任职的复合型技术人才，为公司的技术创新提供了有力支持，推动产品不断更新迭代。

综上所述，公司业务模式成熟、经营业绩稳定、经营规模较大且在行业中具有代表性，符合主板定位要求。

六、发行人报告期主要财务数据及财务指标

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
资产总额（万元）	455,746.26	441,618.14	392,759.78
归属于母公司所有者权益（万元）	227,531.67	191,503.42	164,571.30
资产负债率（母公司）（%）	42.25	47.60	37.14
营业收入（万元）	298,523.51	267,765.34	225,989.82
净利润（万元）	34,900.73	24,230.82	16,700.14
归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,573.44	21,911.20	15,341.71
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	33,433.87	21,755.77	12,429.85
基本每股收益（元）	0.78	0.52	0.36
稀释每股收益（元）	0.78	0.52	0.36
加权平均净资产收益率（%）	16.13	12.31	9.83
经营活动产生的现金流量净额（万元）	39,234.64	45,350.70	32,965.54
现金分红（万元）	-	-	-

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
研发投入占营业收入的比例（%）	4.88	4.62	4.99

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

发行人财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

八、发行人选择的具体上市标准

（一）财务指标

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司归属于母公司净利润（按照扣非前后净利润孰低）分别为 1.24 亿元、2.18 亿元和 3.34 亿元，累计净利润为 6.76 亿元；经营活动产生的现金流量净额累计 11.76 亿元；营业收入累计 79.23 亿元。

（二）标准适用判定

发行人结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市标准中的“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或营业收入累计不低于 15 亿元。”

根据上述分析，发行人满足其所选择的上市标准。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

本次募集资金投资项目经 2026 年第一次临时股东大会确定，由董事会负责实施，主要用于投资如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	实施主体
1	年产100亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目	68,149.10	68,149.10	长晶浦联
2	MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目	23,190.90	23,190.90	长晶科技
3	电源管理 IC 技术研发项目	20,700.00	20,700.00	长晶科技
4	补充流动资金项目	37,000.00	37,000.00	长晶科技
合计		**149,040.00**	**149,040.00**	**-**

若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自有或自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。

本次募集资金运用具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（二）未来发展规划

公司作为一家半导体行业的专精特新“小巨人”企业，将持续聚焦于分立器件及其晶圆、电源管理 IC 的研发、生产及销售。

未来期间，公司将遵循国际主流分立器件与模拟集成电路产业发展路径，深化确立“平台化”、“一体化”战略发展宗旨，致力于通过全矩阵的产品布局与垂直整合的制造协同，在下游消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等国民经济发展的支柱产业链，全面实现客户对一站式、系统级产品及解决方案的采购诉求，提升公司产品在先进生产力领域的应用深度与广度。

公司将以市场需求为导向，持续扩充二极管、三极管、全系列 MOSFET、IGBT 及各类电源管理 IC 的产品规格与技术能力；稳步推动业务向新能源汽车、光伏储能、工业自动化、机器人、人工智能等高附加值应用领域拓展；依托 IDM 模式垂直整合能力的持续优化，进一步统筹设计与制造关键技术环节、全产业链产能布局，加速新产品的迭代周期，优化整体成本结构，持续提升核心产品的综合

性能及供应链安全性。

公司秉持“创造世界一流半导体品牌”的发展愿景，以“市场引领”和“研发驱动”为发展战略，努力锻造技术优势，稳步推进供应链整合，持续深耕及推动分立器件和电源管理 IC 等业务板块快速、稳健、可持续发展，向具备国际竞争力的功率与模拟半导体综合供应商稳步迈进。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对发行人有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。公司的主要风险因素如下：

一、与行业相关的风险

（一）宏观经济及下游需求波动风险

公司所属半导体行业的下游主要为消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等领域，公司半导体产品的市场需求变化与下游应用端及终端消费市场需求息息相关，受宏观经济波动的影响较大。近年来，在全球经济周期波动和国际贸易环境变化的影响下，下游行业的发展存在一定的波动性。其中，2022年至 2023 年，受消费电子等需求下滑、产能供应增加、下游库存去化等影响，功率半导体整体行情出现阶段性调整。虽然自 2024 年以来，随着半导体产品去库存化，消费电子需求边际改善，叠加新能源、汽车电子、人工智能等新兴应用持续扩容，功率半导体景气度持续提升，公司收入呈增长趋势，但未来如果下游行业景气度再次下行，将对发行人业绩产生负面影响，甚至可能会导致发行人出现业绩下滑的风险。

（二）行业竞争加剧的风险

公司主营的分立器件和电源管理 IC 作为电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，产品广泛应用于国民经济建设和社会生活各环节领域，对推动其他产业的升级和发展起着关键作用，是不可替代的基础性电子元器件。近年来，随着下游应用领域的发展，我国分立器件和电源管理 IC 行业的整体技术水平不断提升，生产厂商不断增加。同时，为争夺市场份额，不同生产厂家之间的竞争也日益激烈。日益加剧的行业竞争将对公司的盈利能力和经营业绩带来不利影响。

（三）税收优惠和政府补助政策变化的风险

公司享受的税收优惠主要包括高新技术企业所得税率优惠、部分项目加计扣除等。如果公司及相关子公司未来未取得高新技术企业资质，或者所享受的其他

税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩产生一定影响。

报告期各期，公司计入其他收益的政府补助分别为 3,234.78 万元、3,218.85 万元及 1,741.86 万元，如果公司未来不能继续获得政府补助或者获得的政府补助减少，将导致公司净利润减少，对公司当期经营业绩产生不利影响。

（四）汇率波动的风险

报告期内，公司生产所需的部分原材料和设备采购自境外，部分产品也销往境外，公司境外销售及境外采购主要以港币、美元等外币定价和结算，外币汇率波动将会影响公司盈利水平。报告期内，公司因汇率波动产生的汇兑损益分别为 -40.47 万元、-26.49 万元及 51.52 万元。随着公司产销规模的迅速增长，未来若汇率发生大幅波动，公司未通过有效手段管理外汇风险，公司未来生产经营活动将会受到不利影响。

二、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、经销模式的风险

公司目前采用买断式经销和直销相结合的销售模式。报告期各期，公司主营业务收入中经销模式收入占比分别为 53.34%、55.46%和 57.97%，占比较高。如果经销商销售能力难以满足公司的发展需要，或者经销商自身的经营状况发生改变，可能会对公司的产品销售造成不利影响。

2、新产品推广不及预期的风险

凭借不断的研发创新与市场开拓，公司在巩固传统优势产品市场占有率与竞争力的基础上，不断开发并推广新产品。其中，二三极管系公司基本盘，已处于国内领先地位；公司 MOSFET 产品处于高速发展阶段，已在市场中占据一定份额；公司电源管理 IC 在报告期内保持稳固增长；IGBT 产品系公司近年重点研发并推广的产品，部分产品性能可对标国际品牌最新代次产品。若公司未来新产品推广不及预期，将可能对公司未来盈利能力的稳定性和持续性产生不利影响。

3、供应链管理不善的风险

报告期内，公司采用 Fabless 与 IDM 并行的经营模式，集芯片设计、晶圆制

造、封装测试、销售服务等纵向产业链为一体，但是，公司也存在将部分芯片的制造、封装测试环节委托给专业代工厂商完成，因此该部分产品质量、交货时间、生产能力等都与产业链其他环节紧密相关。如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等出现问题，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

（二）财务风险

1、商誉减值的风险

截至报告期期末，公司合并报表商誉账面价值为 8.27 亿元，占公司总资产的比重为 18.14%。上述商誉的形成主要系公司自成立以来分别于 2018 年 12 月收购了深圳长晶 100%股权及新申弘达（承接长电科技本部分立器件销售业务）100%股权，于 2022 年 1-3 月合计收购了新顺微 67.11%直接或间接股权并实现对新顺微的控制。

根据《企业会计准则》相关规定，上述收购交易为非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉，该商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等规定及公司会计政策，公司已于收购完成后的各期末，对相关资产组的商誉进行减值测试。其中，根据测试和评估结果，发行人对 2022 年新顺微计提商誉减值准备 9,578.54 万元。

若行业环境变化、宏观经济波动、国际贸易摩擦加剧，公司不能有效地应对市场竞争加剧、国家法律法规及产业政策变化、国际形势的改变等情形，则以上因素可能对收购的资产组业绩产生较大的不利影响，并对公司生产经营、财务状况及未来发展产生较大不利影响。如果相关资产组无法实现预期的经营业绩，则公司可能面临进一步商誉减值的风险，从而对公司的业绩表现带来不利影响。

2、固定资产投资风险

不同于数字芯片，分立器件强调设计、制造、应用的深度结合，更重视设计、晶圆制造和封装测试的一体化。因此，IDM 模式是行业发展趋势，也是国际主流分立器件厂商的经营模式。发行人沿袭该产业逻辑持续演进自身的经营模式，

形成了 Fabless 与 IDM 并行的经营模式。为提升自主封测和自产晶圆能力，报告期内，发行人对晶圆和封测生产的固定资产投入较大。截至报告期末，公司固定资产和在建工程账面价值分别为 113,917.48 万元和 8,184.66 万元，合计占总资产的 26.79%。未来，为了进一步深化 IDM 模式，公司将继续增加相关资产投入，从而导致固定资产规模持续扩大。若公司收入规模的增长短期内无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临经营业绩下降的风险。

3、存货规模较大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 57,895.63 万元、56,103.86 万元和 64,247.33 万元，占流动资产的比例分别为 30.66%、26.35%及 28.57%。为及时满足下游客户产品需求，公司按照安全库存需求和市场供需情况进行备货。未来，如果公司存货规模控制不当，导致存货规模过大，货物滞销或减值的情况出现，可能会对公司的运营效率产生影响，公司生产经营业绩也将受到影响。

4、毛利率波动的风险

报告期各期，公司的综合毛利率分别为 28.64%、30.00%和 31.33%，总体保持稳定。未来宏观经济的变动、行业竞争格局的变化、公司下游市场的波动以及公司的核心技术优势、持续创新能力、市场开拓能力、供应链管理水平以及新产品的升级迭代等因素都可能影响公司毛利率水平，若上述因素发生重大不利变化，公司产品将面临毛利率波动的风险。

5、应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 54,612.79 万元、58,930.84 万元及 67,113.76 万元，占营业收入的比例分别为 24.17%、22.01%及 22.48%。虽然报告期各期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比超过 99%，且公司已制订合理的坏账计提政策并有效执行，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的风险。

6、公司未来一定时期内股权激励费用进一步增加的风险

为进一步建立、健全公司的激励机制，持续激发员工的积极性，留住并吸引优秀人才，公司制定实施了股权激励计划。尽管该等激励有助于稳定人员结构以

及留住核心人才，但将导致当期及未来特定期间股份支付金额较大，且未来随着新员工引进及市场竞争不断加剧，公司仍可能对已有或新加入员工再次进行股权激励，可能导致公司再次产生大额股份支付金额，从而对未来期间的净利润造成一定影响。

（三）技术风险

1、研发技术人员流失的风险

半导体行业属于人才及技术密集型行业，公司的产品质量、产品技术升级、新产品推出、产品交付能力、产品的售后服务均依赖于人才和团队的专业技术水平和稳定性。优秀的研发技术人员不但要具备扎实的多学科基础知识，还需要拥有成熟的设计能力，培养周期较长。自成立以来，公司已培养和引进了一批高素质研发人才，并通过实施股权激励、签订保密协议、竞业禁止协议等多项激励和约束机制，以维系研发团队稳定。随着半导体行业对专业技术人才的需求与日俱增，人才竞争不断加剧，如果公司未来不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬水平、更先进的研发环境、更好的企业文化氛围，公司将可能面临研发技术人员流失的风险，对在研项目的推进和创新能力的维持产生不利影响。

2、核心技术泄密风险

公司所属的半导体行业具有技术密集的特点，公司已经掌握了一系列主营业务相关的核心技术。公司核心技术贯穿公司产品研发设计及生产的全过程，是公司的核心竞争力。如果公司在经营过程中出现核心技术保护不力或核心技术人员外流导致关键技术外泄、被盗用、或被竞争对手模仿的情形，则将可能对公司的技术创新、业务发展乃至经营业绩产生不利影响。

（四）内控风险

随着公司业务规模的扩大和募集资金投资项目的实施，公司的资产规模和收入规模都将大幅增加，公司员工数量也将相应增加，组织结构将趋于复杂，这对公司的经营管理、人力资源管理、内部控制等各方面提出了更高的要求。若公司不能及时健全内部控制体系、提高管理水平、充实管理人才队伍，可能导致发生规模扩张引起的管理风险。

（五）法律风险

公司拥有的专利、集成电路布图设计等知识产权是公司赢得市场的关键因素之一，是公司核心竞争力的重要组成部分。公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本较高。因此，如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。此外亦不排除其他竞争者指控公司侵犯其知识产权的可能，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）实际控制人控制股份比例较低导致控制权变化的风险

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人杨国江通过南京江澄、上海江昊和傅传企管合计控制公司 31.14%的股份，能够控制公司的总体战略部署和日常经营决策。根据本次公开发行的方案，发行人拟发行新股不超过 5,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 10.00%。如本次公开发行股票数量为 5,000.00 万股，本次发行完成后，杨国江控制的发行人股份比例预计将降至 27.93%。公司实际控制人控制股份比例较低，存在公司控制权不稳定的风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。

（二）募投项目实施的风险

本次募集资金金额及投资项目综合考虑了行业和市场状况、技术水平及发展趋势、场地、设备和人员等因素，并对其可行性进行了充分论证，但该论证主要基于当前产业政策、市场环境和技术水平等因素作出。由于募投项目产生的固定资产折旧等费用短期内会大幅增加，若在项目实施过程中发生未来行业或市场环境发生难以预期的不利变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期等不利情形，将导致募集资金投资项目不能如期实施或经济效益不达预期，进而对公司业绩产生不利影响。

（三）即期回报被摊薄的风险

2025 年度，公司扣除非经常性损益后的每股收益为 0.78 元/股，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 16.06%。本次发行完成后，公司总股本及净资产将有所增加，而募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，公司

即期回报存在被摊薄的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

（一）注册名称（中文）：江苏长晶科技股份有限公司

注册名称（英文）：Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd.

（二）注册资本：435,031,732 元人民币

（三）法定代表人：杨国江

（四）有限公司成立日期：2018 年 11 月 29 日

（五）股份公司成立日期：2021 年 12 月 8 日

（六）住所和邮政编码：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座 13 楼（211800）

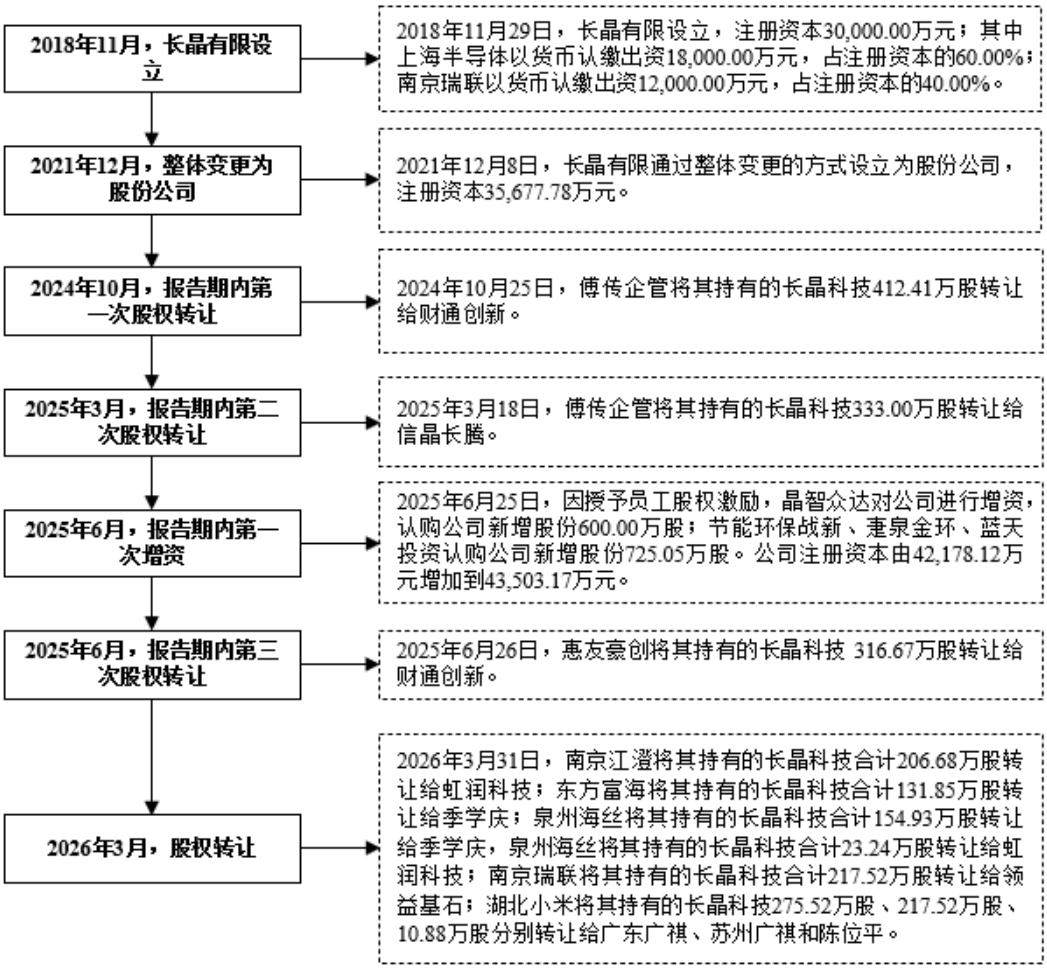
（七）电话号码：025-68372989；传真号码：025-68372988

（八）互联网网址：https://www.jscj-elec.com

（九）电子信箱：IR@jscj-elec.com

（十）负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室，负责人：李澄，联系方式：025-68372989

二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况



（一）发行人设立情况

1、长晶有限设立情况

2018 年 11 月 29 日，长晶有限召开股东会，全体股东一致同意成立长晶有限，注册资本 30,000.00 万元；其中上海半导体以货币认缴出资 18,000.00 万元，占注册资本的 60.00%；南京瑞联以货币认缴出资 12,000.00 万元，占注册资本的 40.00%。

2018 年 11 月 29 日，长晶有限取得南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。

长晶有限成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海半导体	18,000.00	60.00
2	南京瑞联	12,000.00	40.00
合计		**30,000.00**	**100.00**

2018 年 12 月 5 日，杨国江与上海半导体、南京瑞联签署了《共同投资协议》，就设立管理层平台（即南京江澄），管理层平台、上海半导体、南京瑞联各自持股比例及管理层平台投资入股长晶有限等相关事宜进行了明确约定。长晶有限的注册资本为人民币 30,000.00 万元，其中，管理层平台出资 12,900.00 万元，持股 43.00%；上海半导体出资 10,260.00 万元，持股 34.20%；南京瑞联出资 6,840.00 万元，持股 22.80%。

2019 年 4 月 10 日，长晶有限召开股东会，一致同意上海半导体将其所持有的公司 7,740.00 万元出资额（实缴 0.00 万元）以 0.00 万元的价格转让给南京江澄；一致同意南京瑞联将其所持有的公司 5,160.00 万元出资额（实缴 3,260.00 万元）以 3,260.00 万元的价格转让给南京江澄。

2019 年 4 月 10 日，上海半导体、南京瑞联分别与南京江澄签署了《股权转让协议》。同日，南京江澄、上海半导体和南京瑞联签署了《江苏长晶科技有限公司章程》。杨国江、南京江澄与上海半导体、南京瑞联另行签署了《共同投资协议》，对南京江澄受让上海半导体及南京瑞联所持长晶有限的部分股权并入股长晶有限等相关事宜作出了约定，并对 2018 年 12 月 5 日签署的《共同投资协议》进行了终止。

2019 年 5 月 16 日，长晶有限就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。

2019 年 7 月 9 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华苏验字[2019]32050005 号），对本次转让完成后的首次出资到位情况予以验证。2022 年 8 月 28 日，立信会计师出具了《关于江苏长晶科技股份有限公司历次股本验证的复核报告》（信会师报字[2022]第 ZA15742 号）。经审验：本次股权转让完成后，各股东于 2019 年 4 月完成首次出资，出资后实收资本为 30,000.00 万元。

本次股权转让完成后，长晶有限的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	南京江澄	12,900.00	43.00
2	上海半导体	10,260.00	34.20
3	南京瑞联	6,840.00	22.80
合计		**30,000.00**	**100.00**

2、长晶科技设立情况

2021 年 10 月 28 日，立信出具信会师报字[2021]第 ZA15646 号《审计报告》，经审计，截至 2021 年 7 月 31 日，长晶有限的账面净资产值为 69,874.35 万元。

2021 年 10 月 28 日，中联评估出具中联评报字[2021]第 3086 号《江苏长晶科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》，经评估，截至 2021 年 7 月 31 日，长晶有限净资产评估价值为人民币 93,219.49 万元。

2021 年 12 月 1 日，长晶有限召开股东会，全体股东一致同意将长晶有限通过整体变更的方式设立为股份有限公司，同意以长晶有限截至 2021 年 7 月 31 日经审计的净资产 69,874.3501 万元折成股份公司股本计 35,677.7815 万股，每股面值 1 元，注册资本 35,677.7815 万元，其余部分转入资本公积。

2021 年 12 月 3 日，公司的全体发起人签署了《江苏长晶科技有限公司整体变更为江苏长晶科技股份有限公司之发起人协议》，约定长晶有限的全体股东作为发起人共同将长晶有限整体变更设立为股份有限公司，全体发起人以其拥有的长晶有限经审计的净资产对股份公司进行出资，并按其在长晶有限的出资比例确定其对股份公司的出资比例。

2021 年 12 月 3 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于江苏长晶科技有限公司整体变更为江苏长晶科技股份有限公司的议案》等相关议案。

2021 年 12 月 8 日，公司就本次整体变更设立为股份公司在南京市江北新区管理委员会行政审批局办理了工商登记，并领取了新的《营业执照》。

2022 年 1 月 18 日，立信出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10779 号），经审验：截至 2021 年 12 月 3 日止，公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将公司截至 2021 年 7 月 31 日止经审计的所有者权益（净资

产）人民币 69,874.3501 万元按 1:0.5106 的比例折合股份总额 35,677.7815 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 35,677.7815 万元，大于股本部分计入资本公积。发行人系由长晶有限整体变更设立的股份有限公司。

本次整体变更后，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,900.00	27.75
2	南京瑞联	4,507.22	12.63
3	上海江昊	3,000.00	8.41
4	上海长镌	1,801.33	5.05
5	上海观成	1,666.67	4.67
6	晨壹越腾	1,396.09	3.91
7	上海摩勤	1,288.24	3.61
8	湖北小米	1,143.90	3.21
9	深圳展想	950.00	2.66
10	OPPO	950.00	2.66
11	杭州晶舰	775.60	2.17
12	苏州汾湖	760.46	2.13
13	瑞芯晶云	504.14	1.41
14	海通创新	465.36	1.30
15	通达信	465.36	1.30
16	瑞芯晶泽	422.22	1.18
17	泰亚富国	387.80	1.09
18	上海斯瑞	387.80	1.09
19	南京创鼎	387.80	1.09
20	格金六号	387.80	1.09
21	越秀智创	387.80	1.09
22	广州国资产业	387.80	1.09
23	越秀金蝉	387.80	1.09
24	华业天成	316.67	0.89
25	苏州聚源	316.67	0.89
26	惠友豪创	316.67	0.89
27	财富趋势	310.24	0.87
28	泉州海丝	310.24	0.87

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
29	服务贸易基金	310.24	0.87
30	宁波烈焰	249.74	0.70
31	常州红土	232.68	0.65
32	广州科导	232.68	0.65
33	江苏聿泉	155.12	0.43
34	宁波美橙	138.06	0.39
35	深创投	77.56	0.22
合计		**35,677.78**	**100.00**

（二）报告期内的股本和股东变化情况

报告期初，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,900.00	23.47
2	南京瑞联	4,507.22	10.69
3	上海江昊	3,000.00	7.11
4	晨壹越腾	2,481.93	5.88
5	上海长镌	1,801.33	4.27
6	上海观成	1,666.67	3.95
7	傅传企管	1,600.00	3.79
8	上海摩勤	1,288.24	3.05
9	湖北小米	1,143.90	2.71
10	深圳展想	950.00	2.25
11	OPPO	950.00	2.25
12	杭州晶舰	775.60	1.84
13	大美众芯	775.60	1.84
14	苏州汾湖	760.46	1.80
15	东方富海	690.29	1.64
16	宁波汉途	542.92	1.29
17	瑞芯晶云	504.14	1.20
18	海通创新	465.36	1.10
19	通达信	465.36	1.10
20	瑞芯晶泽	422.22	1.00
21	华业天成	394.23	0.93

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
22	泰亚富国	387.80	0.92
23	上海斯瑞	387.80	0.92
24	南京创鼎	387.80	0.92
25	格金六号	387.80	0.92
26	越秀智创	387.80	0.92
27	广州国资产业	387.80	0.92
28	越秀金蝉	387.80	0.92
29	晨壹佰赢	387.80	0.92
30	江阴澄芯	371.84	0.88
31	苏州聚源	316.67	0.75
32	惠友豪创	316.67	0.75
33	财富趋势	310.24	0.74
34	泉州海丝	310.24	0.74
35	服务贸易基金	310.24	0.74
36	宁波烈焰	249.74	0.59
37	远智先行	240.44	0.57
38	常州红土	232.68	0.55
39	广州科导	232.68	0.55
40	江阴澄顺	185.12	0.44
41	江苏聿泉	155.12	0.37
42	领益基石	155.12	0.37
43	厦门建发	155.12	0.37
44	宁波美橙	138.06	0.33
45	君众睿华	116.34	0.28
46	清石晶晟	116.34	0.28
47	深创投	77.56	0.18
合计		**42,178.12**	**100.00**

1、2024 年 10 月，报告期内长晶科技第一次股权转让

2024 年 10 月 10 日，傅传企管与财通创新签订了《关于江苏长晶科技股份有限公司之投资协议》。傅传企管将其持有的长晶科技 412.41 万股转让给财通创新，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让价款（万元）	转让单价（元/股）
1	傅传企管	财通创新	412.41	4,400.00	10.67

2024 年 10 月 25 日，长晶科技就上述股份转让事宜出具了《股东名册》。

本次股权转让完成后，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,900.00	23.47
2	南京瑞联	4,507.22	10.69
3	上海江昊	3,000.00	7.11
4	晨壹越腾	2,481.93	5.88
5	上海长镌	1,801.33	4.27
6	上海观成	1,666.67	3.95
7	上海摩勤	1,288.24	3.05
8	傅传企管	1,187.59	2.82
9	湖北小米	1,143.90	2.71
10	深圳展想	950.00	2.25
11	OPPO	950.00	2.25
12	杭州晶舰	775.60	1.84
13	大美众芯	775.60	1.84
14	苏州汾湖	760.46	1.80
15	东方富海	690.29	1.64
16	宁波汉途	542.92	1.29
17	瑞芯晶云	504.14	1.20
18	海通创新	465.36	1.10
19	通达信	465.36	1.10
20	瑞芯晶泽	422.22	1.00
21	财通创新	412.41	0.98
22	华业天成	394.23	0.93
23	泰亚富国	387.80	0.92
24	上海斯瑞	387.80	0.92
25	南京创鼎	387.80	0.92
26	格金六号	387.80	0.92
27	越秀智创	387.80	0.92

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
28	广州国资产业	387.80	0.92
29	越秀金蝉	387.80	0.92
30	晨壹佰赢	387.80	0.92
31	江阴澄芯	371.84	0.88
32	苏州聚源	316.67	0.75
33	惠友豪创	316.67	0.75
34	财富趋势	310.24	0.74
35	泉州海丝	310.24	0.74
36	服务贸易基金	310.24	0.74
37	宁波烈焰	249.74	0.59
38	远智先行	240.44	0.57
39	常州红土	232.68	0.55
40	广州科导	232.68	0.55
41	江阴澄顺	185.12	0.44
42	江苏聿泉	155.12	0.37
43	领益基石	155.12	0.37
44	厦门建发	155.12	0.37
45	宁波美橙	138.06	0.33
46	君众睿华	116.34	0.28
47	清石晶晟	116.34	0.28
48	深创投	77.56	0.18
合计		**42,178.12**	**100.00**

2、2025 年 3 月，报告期内长晶科技第二次股权转让

2025 年 2 月 19 日，傅传企管与信晶长腾签订了《股权转让协议》。傅传企管将其持有的长晶科技合计 333.00 万股转让给信晶长腾，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让价款（万元）	转让单价（元/股）
1	傅传企管	信晶长腾	333.00	3,789.54	11.38

2025 年 3 月 18 日，长晶科技就上述股份转让事宜出具了《股东名册》。

本次股权转让完成后，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,900.00	23.47
2	南京瑞联	4,507.22	10.69
3	上海江昊	3,000.00	7.11
4	晨壹越腾	2,481.93	5.88
5	上海长镌	1,801.33	4.27
6	上海观成	1,666.67	3.95
7	上海摩勤	1,288.24	3.05
8	湖北小米	1,143.90	2.71
9	深圳展想	950.00	2.25
10	OPPO	950.00	2.25
11	傅传企管	854.59	2.03
12	杭州晶舰	775.60	1.84
13	大美众芯	775.60	1.84
14	苏州汾湖	760.46	1.80
15	东方富海	690.29	1.64
16	宁波汉途	542.92	1.29
17	瑞芯晶云	504.14	1.20
18	海通创新	465.36	1.10
19	通达信	465.36	1.10
20	瑞芯晶泽	422.22	1.00
21	财通创新	412.41	0.98
22	华业天成	394.23	0.93
23	泰亚富国	387.80	0.92
24	上海斯瑞	387.80	0.92
25	南京创鼎	387.80	0.92
26	格金六号	387.80	0.92
27	越秀智创	387.80	0.92
28	广州国资产业	387.80	0.92
29	越秀金蝉	387.80	0.92
30	晨壹佰赢	387.80	0.92
31	江阴澄芯	371.84	0.88
32	信晶长腾	333.00	0.79
33	苏州聚源	316.67	0.75

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
34	惠友豪创	316.67	0.75
35	财富趋势	310.24	0.74
36	泉州海丝	310.24	0.74
37	服务贸易基金	310.24	0.74
38	宁波烈焰	249.74	0.59
39	远智先行	240.44	0.57
40	常州红土	232.68	0.55
41	广州科导	232.68	0.55
42	江阴澄顺	185.12	0.44
43	江苏聿泉	155.12	0.37
44	领益基石	155.12	0.37
45	厦门建发	155.12	0.37
46	宁波美橙	138.06	0.33
47	君众睿华	116.34	0.28
48	清石晶晟	116.34	0.28
49	深创投	77.56	0.18
合计		**42,178.12**	**100.00**

3、2025 年 6 月，报告期内长晶科技第一次增资

2024 年 12 月 4 日，长晶科技召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于员工股权激励方案的议案》，决定成立员工持股平台通过对公司增资进行员工股权激励。2025 年 3 月 10 日，公司员工持股平台晶智众达与公司签署《增资协议》，晶智众达认购公司新增股份 600.00 万股。

2025 年 6 月 19 日，节能环保战新、聿泉金环、蓝天投资与公司等签署《江苏长晶科技股份有限公司投资协议》，约定节能环保战新、聿泉金环、蓝天投资认购公司新增股份 725.0527 万股。

根据上述协议，本次增资的具体情况如下：

序号	增资方	增资总额（万元）	计入股本金额（万元）	增资价格（元/股）
1	节能环保战新	5,000.00	362.53	13.79
2	聿泉金环	3,000.00	217.52	13.79
3	蓝天投资	2,000.00	145.01	13.79

序号	增资方	增资总额（万元）	计入股本金额（万元）	增资价格（元/股）
4	晶智众达	3,120.00	600.00	5.20

2025 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司增资扩股事宜暨修改公司章程的议案》，审议通过上述股本变更事宜。

2025 年 6 月 25 日，公司就本次增资事宜完成了工商变更登记。

2025 年 8 月 28 日，立信出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA53561 号），对本次出资情况予以确认。

本次增资完成后，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,900.00	22.76
2	南京瑞联	4,507.22	10.36
3	上海江昊	3,000.00	6.90
4	晨壹越腾	2,481.93	5.71
5	上海长镌	1,801.33	4.14
6	上海观成	1,666.67	3.83
7	上海摩勤	1,288.24	2.96
8	湖北小米	1,143.90	2.63
9	深圳展想	950.00	2.18
10	OPPO	950.00	2.18
11	傅传企管	854.59	1.96
12	杭州晶舰	775.60	1.78
13	大美众芯	775.60	1.78
14	苏州汾湖	760.46	1.75
15	东方富海	690.29	1.59
16	晶智众达	600.00	1.38
17	宁波汉途	542.92	1.25
18	瑞芯晶云	504.14	1.16
19	海通创新	465.36	1.07
20	通达信	465.36	1.07
21	瑞芯晶泽	422.22	0.97
22	财通创新	412.41	0.95

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
23	华业天成	394.23	0.91
24	泰亚富国	387.80	0.89
25	上海斯瑞	387.80	0.89
26	南京创鼎	387.80	0.89
27	格金六号	387.80	0.89
28	越秀智创	387.80	0.89
29	广州国资产业	387.80	0.89
30	越秀金蝉	387.80	0.89
31	晨壹佰赢	387.80	0.89
32	江阴澄芯	371.84	0.85
33	节能环保战新	362.53	0.83
34	信晶长腾	333.00	0.77
35	苏州聚源	316.67	0.73
36	惠友豪创	316.67	0.73
37	财富趋势	310.24	0.71
38	泉州海丝	310.24	0.71
39	服务贸易基金	310.24	0.71
40	宁波烈焰	249.74	0.57
41	远智先行	240.44	0.55
42	常州红土	232.68	0.53
43	广州科导	232.68	0.53
44	聿泉金环	217.52	0.50
45	江阴澄顺	185.12	0.43
46	江苏聿泉	155.12	0.36
47	领益基石	155.12	0.36
48	厦门建发	155.12	0.36
49	蓝天投资	145.01	0.33
50	宁波美橙	138.06	0.32
51	君众睿华	116.34	0.27
52	清石晶晟	116.34	0.27
53	深创投	77.56	0.18
合计		**43,503.17**	**100.00**

4、2025 年 6 月，报告期内长晶科技第三次股权转让

2025 年 6 月 20 日，惠友豪创与财通创新签订了《股权转让协议》。惠友豪创将其持有的长晶科技合计 316.67 万股转让给财通创新，具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让价款（万元）	转让单价（元/股）
1	惠友豪创	财通创新	316.67	3,600.00	11.37

2025 年 6 月 26 日，长晶科技就上述股份转让事宜出具了《股东名册》。

本次股权转让完成后，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,900.00	22.76
2	南京瑞联	4,507.22	10.36
3	上海江昊	3,000.00	6.90
4	晨壹越腾	2,481.93	5.71
5	上海长镌	1,801.33	4.14
6	上海观成	1,666.67	3.83
7	上海摩勤	1,288.24	2.96
8	湖北小米	1,143.90	2.63
9	深圳展想	950.00	2.18
10	OPPO	950.00	2.18
11	傅传企管	854.59	1.96
12	杭州晶舰	775.60	1.78
13	大美众芯	775.60	1.78
14	苏州汾湖	760.46	1.75
15	财通创新	729.08	1.68
16	东方富海	690.29	1.59
17	晶智众达	600.00	1.38
18	宁波汉途	542.92	1.25
19	瑞芯晶云	504.14	1.16
20	海通创新	465.36	1.07
21	通达信	465.36	1.07
22	瑞芯晶泽	422.22	0.97
23	华业天成	394.23	0.91
24	泰亚富国	387.80	0.89

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例（%）
25	上海斯瑞	387.80	0.89
26	南京创鼎	387.80	0.89
27	格金六号	387.80	0.89
28	越秀智创	387.80	0.89
29	广州国资产业	387.80	0.89
30	越秀金蝉	387.80	0.89
31	晨壹佰赢	387.80	0.89
32	江阴澄芯	371.84	0.85
33	节能环保战新	362.53	0.83
34	信晶长腾	333.00	0.77
35	苏州聚源	316.67	0.73
36	财富趋势	310.24	0.71
37	泉州海丝	310.24	0.71
38	服务贸易基金	310.24	0.71
39	宁波烈焰	249.74	0.57
40	远智先行	240.44	0.55
41	常州红土	232.68	0.53
42	广州科导	232.68	0.53
43	聿泉金环	217.52	0.50
44	江阴澄顺	185.12	0.43
45	江苏聿泉	155.12	0.36
46	领益基石	155.12	0.36
47	厦门建发	155.12	0.36
48	蓝天投资	145.01	0.33
49	宁波美橙	138.06	0.32
50	君众睿华	116.34	0.27
51	清石晶晟	116.34	0.27
52	深创投	77.56	0.18
合计		**43,503.17**	**100.00**

5、2026 年 3 月，长晶科技股权转让

2026 年 2 月 5 日，南京江澄与虹润科技签订了《股权转让协议》，南京江澄将其持有的长晶科技合计 206.68 万股转让给虹润科技；2026 年 2 月 10 日，东方

富海与季学庆签订了《股权转让协议》，东方富海将其持有的长晶科技合计 131.85 万股转让给季学庆；2026 年 2 月 15 日，泉州海丝与季学庆、虹润科技分别签订了《股权转让协议》，泉州海丝将其持有的长晶科技合计 154.93 万股转让给季学庆，泉州海丝将其持有的长晶科技合计 23.24 万股转让给虹润科技；2026 年 3 月 12 日，南京瑞联与领益基石签订了《股权转让协议》，南京瑞联将其持有的长晶科技合计 217.52 万股转让给领益基石。2026 年 3 月 31 日，湖北小米与广东广祺、苏州广祺和陈位平签订了《股权转让协议》，湖北小米将其持有的长晶科技 275.52 万股、217.52 万股、10.88 万股分别转让给广东广祺、苏州广祺和陈位平。具体转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让股份数（万股）	转让价款（万元）	转让单价（元/股）
1	南京江澄	虹润科技	206.68	2,679.48	12.96
2	东方富海	季学庆	131.85	1,818.52	13.79
3	泉州海丝	季学庆	154.93	2,136.77	13.79
4		虹润科技	23.24	320.51	13.79
5	南京瑞联	领益基石	217.52	3,000.00	13.79
6	湖北小米	广东广祺	275.52	3,800.00	13.79
7		苏州广祺	217.52	3,000.00	13.79
8		陈位平	10.88	150.00	13.79

2026 年 3 月 31 日，长晶科技就上述股份转让事宜出具了《股东名册》。

本次股权转让完成后，长晶科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,693.32	22.28
2	南京瑞联	4,289.71	9.86
3	上海江昊	3,000.00	6.90
4	晨壹越腾	2,481.93	5.71
5	上海长镌	1,801.33	4.14
6	上海观成	1,666.67	3.83
7	上海摩勤	1,288.24	2.96
8	深圳展想	950.00	2.18
9	OPPO	950.00	2.18
10	傅传企管	854.59	1.96

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
11	杭州晶舰	775.60	1.78
12	大美众芯	775.60	1.78
13	苏州汾湖	760.46	1.75
14	财通创新	729.08	1.68
15	湖北小米	639.99	1.47
16	晶智众达	600.00	1.38
17	东方富海	558.44	1.28
18	宁波汉途	542.92	1.25
19	瑞芯晶云	504.14	1.16
20	海通创新	465.36	1.07
21	通达信	465.36	1.07
22	瑞芯晶泽	422.22	0.97
23	华业天成	394.23	0.91
24	泰亚富国	387.80	0.89
25	上海斯瑞	387.80	0.89
26	南京创鼎	387.80	0.89
27	格金六号	387.80	0.89
28	越秀智创	387.80	0.89
29	广州国资产业	387.80	0.89
30	越秀金蝉	387.80	0.89
31	晨壹佰赢	387.80	0.89
32	领益基石	372.64	0.86
33	江阴澄芯	371.84	0.85
34	节能环保战新	362.53	0.83
35	信晶长腾	333.00	0.77
36	苏州聚源	316.67	0.73
37	财富趋势	310.24	0.71
38	服务贸易基金	310.24	0.71
39	季学庆	286.78	0.66
40	广东广祺	275.52	0.63
41	宁波烈焰	249.74	0.57
42	远智先行	240.44	0.55
43	常州红土	232.68	0.53

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
44	广州科导	232.68	0.53
45	虹润科技	229.92	0.53
46	苏州广祺	217.52	0.50
47	聿泉金环	217.52	0.50
48	江阴澄顺	185.12	0.43
49	江苏聿泉	155.12	0.36
50	厦门建发	155.12	0.36
51	蓝天投资	145.01	0.33
52	宁波美橙	138.06	0.32
53	泉州海丝	132.08	0.30
54	君众睿华	116.34	0.27
55	清石晶晟	116.34	0.27
56	深创投	77.56	0.18
57	陈位平	10.88	0.03
合计		**43,503.17**	**100.00**

（三）关于对赌协议的情况

1、《共同投资协议》

2019 年 4 月 10 日，杨国江、上海半导体、南京瑞联和南京江澄签署了《共同投资协议》，协议中存在优先清算权、转让限制、优先购买权、优先认购权和共同出售权等特殊股东权利条款。

2022 年 3 月 31 日，杨国江、上海半导体、南京瑞联和南京江澄签署了《关于<共同投资协议>之补充协议》，约定 2019 年 4 月 10 日各方签署的《共同投资协议》中存在的优先清算权、转让限制、优先购买权、优先认购权和共同出售权等特殊股东权利，自补充协议签订之日起彻底终止并自始无效且不可恢复。

2、《江苏长晶科技股份有限公司之股东协议》

2021 年 12 月 19 日，发行人、杨国江及当时的全体 44 名股东签署了《江苏长晶科技股份有限公司之股东协议》，协议中存在转让限制、优先购买权、共同出售权、售回权、优先认购权、反稀释保护、清算和最优惠权等特殊股东权利条款。

2022 年 3 月 31 日，发行人、杨国江及南京江澄等 44 名股东签署了《关于<江苏长晶科技股份有限公司之股东协议>的补充协议》，约定 2021 年 12 月 19 日各方签署的《江苏长晶科技股份有限公司之股东协议》中存在的转让限制、优先购买权、共同出售权、售回权、优先认购权、反稀释保护、清算和最优惠权等特殊股东权利，自补充协议签订之日起彻底终止并自始无效且不可恢复。

3、《财通创新投资有限公司、上海傅誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与江苏长晶科技股份有限公司关于江苏长晶科技股份有限公司之投资协议》

2024 年 10 月 10 日，财通创新与傅传企管、长晶科技及实际控制人杨国江签署了《财通创新投资有限公司、上海傅誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与江苏长晶科技股份有限公司关于江苏长晶科技股份有限公司之投资协议》的补充协议，协议中存在反悔权、平等权利、信息知情权等特殊权利条款，其中，反悔权义务承担方系傅传企管及杨国江。

2026 年 2 月 12 日，财通创新与傅传企管、长晶科技及实际控制人杨国江签署了关于《<财通创新投资有限公司、上海傅誉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与江苏长晶科技股份有限公司关于江苏长晶科技股份有限公司之投资协议>的补充协议》的补充协议，约定 2024 年 10 月 10 日，原补充协议中第三条约定的“反悔权”未曾触发亦不生效，各方均不得依据原补充协议第三条的约定主张任何权利或要求对方履行相关义务。原补充协议中第四条“平等权利”、第五条“信息知情权”“第 11.2 条”及其他股东特殊权利（若有）自长晶科技递交首次公开发行申请前一日起彻底终止并自始无效且不可恢复。

综上所述，截至长晶科技递交首次公开发行申请日，上述相关股东特殊权利条款均已全部终止且自始无效，上述特殊权利条款之终止为不可撤销终止，且不附带其他任何恢复条件，公司与其股东之间不存在现行有效的对赌协议。

（四）关于代持及解除情况

截至本招股说明书签署日，发行人直接层面股东不存在股份代持情况，也不存在纠纷或潜在纠纷。发行人员工持股平台南京江澄曾存在合伙份额代持情形，合伙份额代持已经通过转让方式完成解除，不存在纠纷或者潜在纠纷。具体情况如下：

代持方	被代持方	代持标的	形成原因	演变情况及解除过程	是否存在纠纷或潜在纠纷
刘健	汤振凯	南京江澄50万元合伙份额	南京江澄作为创始员工持股平台拟投资入股发行人。2018年12月，发行人员工刘健作为创始员工获得南京江澄350万元合伙份额，刘健自身资金不足，发行人员工汤振凯、徐初惠、缪国平作为刘健多年同事，分别向刘健转款人民币50万元隐名认购南京江澄50万元合伙份额，刘健与汤振凯、徐初惠、缪国平分别形成代持关系。	2026年3月，刘健分别与汤振凯、徐初惠、缪国平签署了《合伙份额转让协议》、《合伙份额代持解除及确认协议》，约定刘健向汤振凯、徐初惠、缪国平无偿转让所持南京江澄合伙份额各50万元，从而实现代持还原。2026年3月23日，上述份额转让完成了工商变更登记手续。至此，刘健与汤振凯、徐初惠、缪国平之间的代持关系完全解除。	刘健与汤振凯、徐初惠、缪国平均已确认上述合伙份额代持及解除行为不存在任何纠纷或潜在纠纷
	徐初惠	南京江澄50万元合伙份额			
	缪国平	南京江澄50万元合伙份额			
陈炜	王嘉诚	南京江澄30万元合伙份额	南京江澄作为创始员工持股平台拟投资入股发行人。2018年12月，发行人员工陈炜作为创始员工获得南京江澄300万元合伙份额，陈炜自身资金不足，发行人员工王嘉诚、叶阿娇、孙陶作为陈炜多年同事，分别向陈炜转款人民币30万元隐名认购南京江澄30万元合伙份额，陈炜与王嘉诚、叶阿娇、孙陶分别形成代持关系。	2026年3月，陈炜分别与王嘉诚、叶阿娇、孙陶签署了《合伙份额转让协议》、《合伙份额代持解除及确认协议》，约定陈炜向王嘉诚、叶阿娇、孙陶无偿转让所持南京江澄合伙份额各30万元，从而实现代持还原。2026年3月23日，上述份额转让完成了工商变更登记手续。至此，陈炜与王嘉诚、叶阿娇、孙陶之间的代持关系完全解除。	陈炜与王嘉诚、叶阿娇、孙陶均已确认上述合伙份额代持及解除行为不存在任何纠纷或潜在纠纷
	叶阿娇	南京江澄30万元合伙份额			
	孙陶	南京江澄30万元合伙份额			
于世珩	张胜凯	南京江澄50万元合伙份额	2021年2月，发行人前员工张胜凯为中国台湾人，出于便利操作的考虑委托同为中国台湾人的于世珩暂时代持南京江澄50万元的合伙份额。	2022年1月，于世珩将所持南京江澄50万元合伙份额转让给张胜凯，实现代持还原。	于世珩与张胜凯均已确认上述合伙份额代持及解除行为不存在任何纠纷或潜在纠纷

注：于世珩、张胜凯均已离职，截至招股说明书签署日不存在通过员工持股平台持股的情形。

三、发行人成立以来重要事件

（一）重大资产重组情况

自设立以来，发行人构成重大资产重组的事件，系 2018 年 12 月收购深圳长晶 100%股权和新申弘达 100%股权，具体情况如下：

1、收购的背景及原因

为进一步优化资源配置、专注半导体封测代工业务，长电科技将从事分立器件销售业务的子公司深圳长晶及本部分立器件自销业务（长电科技于 2018 年 11 月新设子公司新申弘达用于承接本部分立器件自销业务）进行了剥离，由长晶有限进行受让。

深圳长晶的基本情况参见本节之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（一）重要子公司”之“1、深圳长晶”。

发行人收购新申弘达后，为了更好地进行业务整合，将相关人员和客户关系注入至长晶有限。新申弘达未实际开展经营业务，于 2020 年 11 月注销。

2、所履行的法定程序

2018 年 11 月 28 日，长晶有限召开股东会，同意公司签署《股权转让协议》，收购深圳长晶 100%股权及新申弘达 100%股权。

2018 年 12 月 10 日，长晶有限分别与长电科技，以及杨国江、范荣定、杨澄平、刘法洪、向荣、孔祥鹭、周东、何剑峰和孙鹏飞 9 名自然人签订《股权转让协议》，约定长电科技及 9 名自然人将新申弘达 100%股权和深圳长晶 100%股权转让给长晶有限，交易对价合计为 30,000.00 万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳长晶及新申弘达 2017 年及 2018 年 1-6 月的财务数据进行了审计。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2018]第 01-552-1 号），截至 2018 年 6 月 30 日，深圳长晶的股东全部权益评估值为 26,369.02 万元。考虑到交割日前深圳长晶现金分红金额 6,370.00 万元后，经交易各方协商确定，深圳长晶 100%股权作价 20,000.00 万元。

根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2018]第 01-552-3 号），截至 2018 年 6 月 30 日，长电科技本部分立器件自销业务资产组评估值为 14,666.00 万元。长电科技仅将本部分立器件自销业务相关的人员和客户关系注入新申弘达，长电科技本部分立器件自销业务相关其他资产、负债未注入新申弘达，考虑到截至评估基准日长电科技本部分立器件自销业务净资产账面价值 4,719.26 万元后，经交易双方协商确定，新申弘达 100%股权作价 10,000.00 万元。

2019 年 1 月 30 日，新申弘达就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。2019 年 3 月 21 日，深圳长晶就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

3、对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

本次收购系基于长电科技聚焦封测业务而进行的资产剥离。发行人管理层长期从事半导体分立器件业务，看好相关业务的发展，拟受让相关股权。因管理层自有资金不足以单独受让，故联合财务投资者上海半导体、南京瑞联设立长晶有限，收购长电科技分立器件销售业务。

本次收购构成发行人的重大资产重组。该项收购为发行人设立初期提供了必要的经营条件，有效整合了长电科技分立器件销售业务的子公司深圳长晶，以及本部的分立器件自销业务相关人员团队、客户关系。基于此，发行人不断通过内生式与外延式发展，逐步成为一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，主营产品涵盖分立器件及其晶圆、电源管理 IC 等领域。

（二）其他资产收购情况

发行人自成立以来，发行人涉及的其他资产收购事件包括：（1）收购海德半导体 100%股权；（2）收购新顺微控股权及少数股东权益；（3）收购长芯检测 50%股权，具体情况如下：

1、收购海德半导体 100%股权

（1）收购的背景及原因

为了提升公司在封测产能方面的自给能力，进一步控制和优化封测成本，公司于 2020 年 10 月完成了对海德半导体 100%股权的收购。海德半导体的基本情

况参见本节之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（一）重要子公司”之“4、海德半导体”。

（2）所履行的法定程序

2020 年 8 月 13 日，长晶有限与卞敏龙、钟义鑫、孙权和杨吉明 4 名自然人签订《股权转让协议》，约定该等 4 名自然人股东将其持有的海德半导体合计 100%股权转让给长晶有限，交易对价为 3,643.78 万元。

2020 年 9 月 21 日，长晶有限召开股东会，一致同意长晶有限收购海德半导体 100%的股份。

立信对海德半导体 2020 年 1-5 月的财务报表进行了审计。本次收购的交易对价系基于定价基准日（2020 年 5 月 31 日）的净资产 4,100.79 万元，扣除交割前的分红安排 1,000.00 万元后，结合资产增值情况协商确定。

2020 年 12 月 30 日，海德半导体就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。

（3）对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

海德半导体在收购前一个会计年度/末（即 2019 年度/2019 年 12 月 31 日）的资产总额、资产净额、营业收入、利润总额占收购前发行人相应项目的具体比例如下：

单位：万元

项目	发行人	海德半导体	占比
资产总额	89,090.79	7,422.43	8.33%
资产净额	40,526.47	3,755.57	9.27%
营业收入	107,206.48	10,458.92	9.76%
利润总额	13,429.18	1,241.52	9.24%

注：上表为海德半导体未扣除与发行人交易后的数据。

发行人通过收购海德半导体 100%股权，实现了上游部分封测产能的供应链整合，成本控制能力得到提升，经营业绩未因上述重组受到重大不利影响。收购前后，发行人的管理层和实际控制人均未发生变化。

2、收购新顺微控股权及少数股东权益

（1）2022 年 3 月，收购新顺微控股权

① 收购的背景及原因

为提升公司供应链整合能力和成本控制能力，加强对晶圆制造产能的储备和掌控，公司于 2022 年 3 月完成了对新顺微控股权的收购。截至 2022 年 3 月末，发行人合计持有新顺微 67.11%直接或间接股权并控制新顺微 89.28%表决权。新顺微的基本情况参见本节之“六、发行人控股及参股公司情况”之“（一）重要子公司”之“3、新顺微”。

② 所履行的法定程序

2022 年 1 月 7 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购江苏新顺微电子股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

2022 年 1 月 10 日，子公司长芯顺联作为受让方分别与新顺微原股东冯东明、安吉璟升、盈进智能、闻勤新顺签订《股权转让协议》，公司及其子公司长芯顺联作为受让方分别与江阴澄芯、江阴澄顺签订了《股权转让协议》，约定前述 6 名股东将其持有的新顺微合计 15.39%股权转让给公司及其子公司长芯顺联，转让对价合计为 28,225.42 万元。

2022 年 1 月 17 日，公司及其子公司长芯顺联与上海半导体签订《股权转让协议》，约定上海半导体将其持有的新顺微股东南京顺芯 70.00%股权转让给长芯顺联，转让对价为 54,158.31 万元。

2022 年 1 月 17 日，公司及其子公司长芯顺联与南京瑞联及华杉瑞联基金管理有限公司签订《股权转让协议》，约定南京瑞联及华杉瑞联基金管理有限公司将其持有的新顺微股东南京芯联合计 70.00%的实缴合伙份额转让给长芯顺联，转让对价为 40,669.57 万元。

2022 年 3 月 3 日，发行人取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2022]161 号），同意公司从即日起实施集中。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新顺微 2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月的财务数据进行了审计。

根据中联评估以 2021 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中

联评报字[2021]第 4072 号），截至 2021 年 9 月 30 日，新顺微的股东全部权益评估值为 187,270.00 万元，考虑到新顺微交割日前现金分红金额 10,000.00 万元后，经交易各方协商，截至评估基准日，新顺微 100%股权整体作价 18 亿元。

截至 2022 年 3 月末，发行人合计持有新顺微 67.11%直接或间接股权并控制新顺微 89.28%表决权，实现对新顺微的控制，将其纳入合并报表范围。本次收购完成后，新顺微的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	南京顺芯	4,509.17	42.20%
2	南京芯联	3,386.11	31.69%
3	长芯顺联	1,226.50	11.48%
4	长晶科技	418.51	3.92%
5	宝辰投资	285.10	2.67%
6	上海汇付	237.59	2.22%
7	金浦新兴	213.83	2.00%
8	金浦创业	213.83	2.00%
9	澄芯二号	109.17	1.02%
10	澄顺二号	86.44	0.81%
合计		**10,686.25**	**100.00%**

③ 对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

新顺微在收购前一个会计年度/末（即 2021 年度/2021 年 12 月 31 日）的主要财务数据及占发行人的比例情况如下：

单位：万元

项目	发行人	新顺微	占比
资产总额	256,552.36	81,152.45	31.63%
资产净额	167,423.30	56,935.08	34.01%
营业收入	190,243.70	64,908.99	34.12%
利润总额	28,976.75	12,772.39	44.08%

注 1：上述项目的占比均为新顺微相应项目的 100%的金额作为分子计算所得；
注 2：新顺微的数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

新顺微和发行人同属于半导体分立器件行业，为发行人的晶圆供应商，被收购前主营业务与发行人业务具有高度相关性。发行人收购新顺微后，进一步提升了公司的供应链整合能力和成本控制能力，加强了对晶圆产能的储备和掌控，在

部分二极管、三极管产品领域具备了 IDM 全产业链能力。本次收购不会导致发行人主营业务发生重大变化。收购前后，发行人的管理层和实际控制人均未发生变化。

（2）2022 年 6 月，收购新顺微少数股东权益

① 收购的背景及原因

发行人于 2022 年 3 月完成对新顺微控股权的收购后，经交易各方协商，新顺微其他股东宝辰投资、上海汇付、金浦新兴、金浦创业有意出售其合计持有的新顺微 8.89%股权。

② 所履行的法定程序

2022 年 6 月 1 日，公司及其子公司长芯顺联与宝辰投资、上海汇付、金浦新兴、金浦创业签订《股权转让协议》，约定前述 4 名股东将其持有的新顺微合计 8.89%股权转让给长芯顺联，转让对价合计为 16,306.20 万元。

本次收购的审计、评估情况，与发行人收购新顺微控股权一致，具体情况参见本节之“三、发行人成立以来重要事件”之“（二）其他资产收购情况”之“2、收购新顺微控股权及少数股东权益”之“（1）2022 年 3 月，收购新顺微控股权”。本次新顺微部分少数股东权益收购完成后，发行人合计持有新顺微 76.00%直接或间接股权并控制新顺微 98.17%表决权，新顺微的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	南京顺芯	4,509.17	42.20%
2	南京芯联	3,386.11	31.69%
3	长芯顺联	2,176.85	20.37%
4	长晶科技	418.51	3.92%
5	澄芯二号	109.17	1.02%
6	澄顺二号	86.44	0.81%
合计		**10,686.25**	**100.00%**

③ 对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

本次收购完成后，发行人进一步巩固了对新顺微的控制地位，进一步提升了公司的供应链整合能力和成本控制能力。收购前后，发行人的管理层和实际控制人均未发生变化。

（3）2025 年，收购新顺微少数股东权益

① 收购的背景及原因

为实现对新顺微的全资控股，经交易各方协商，发行人于 2025 年陆续完成收购上海半导体、南京瑞联、澄芯二号、澄顺二号直接或间接持有的新顺微 24%股权。

② 所履行的法定程序

2024 年 12 月 23 日，公司及其子公司长芯顺联与南京瑞联签订《股权转让协议》，约定南京瑞联将其持有的新顺微股东南京芯联 30%的实缴合伙份额转让给公司，转让对价为 15,209.57 万元。

2025 年 4 月 28 日，公司与新顺微股东澄芯二号、澄顺二号签订了《股权转让协议》，约定澄芯二号、澄顺二号将其持有的新顺微合计 1.83%股权转让给公司，转让对价合计为 2,928.77 万元。

2025 年 6 月 30 日，公司与上海半导体及其执行事务合伙人上海半导体装备材料产业投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定上海半导体将其持有的新顺微股东南京顺芯 30%股权转让给公司，转让对价为 19,770.00 万元。

本次收购南京瑞联、澄芯二号、澄顺二号直接或间接持有的新顺微少数股权对应的新顺微整体估值为 16.00 亿元，收购上海半导体间接持有的新顺微少数股权对应的新顺微整体估值约 15.62 亿元，较前次收购控制权时，估值有所下调，系结合市场环境、经营情况及行业估值水平等因素，经交易各方协商确定。

此次收购完成后，发行人合计直接或间接持有新顺微 100.00%股权，新顺微的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	持股比例
1	南京顺芯	4,509.17	42.20%
2	长晶科技	6,177.08	57.80%
合计		**10,686.25**	**100.00%**

注 1：新顺微原股东长芯顺联系长晶科技的全资子公司，长芯顺联已于 2024 年 4 月被母公司长晶科技吸收合并，将所持新顺微 20.37%股权转给长晶科技，并于 2025 年 1 月注销；

注 2：新顺微原股东南京芯联系长晶科技的全资子公司，南京芯联已于 2025 年 6 月将所持新顺微 31.69%股权转给长晶科技，并于 2025 年 9 月注销。

③ 对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

本次收购完成后，发行人实现对新顺微的全资控股，在部分二极管、三极管产品领域具备了 IDM 全产业链能力。收购前后，发行人的管理层和实际控制人均未发生变化。

3、收购长芯检测 50%股权

① 收购的背景及原因

长芯检测为长晶科技和芯德半导体于 2021 年 9 月成立的各自持股 50%的合资公司，主要从事功率器件和 IC 产品的可靠性检测和失效分析业务。为了进一步提升公司自产产品的检测分析能力，加强产品质量把控，公司于 2024 年 9 月完成收购芯德半导体持有的长芯检测 50%的股权。

② 所履行的法定程序

2024 年 8 月 30 日，公司与芯德半导体签署了《股权转让协议》，公司按照人民币 1,000 万元的价格受让芯德半导体所持长芯检测 50%股权（其中实缴出资 1,000 万元）。该等股权转让定价参照股东实缴投资额、长芯检测净资产等由交易双方协商确定。

③ 对管理层、控制权、业务发展及经营业绩的影响

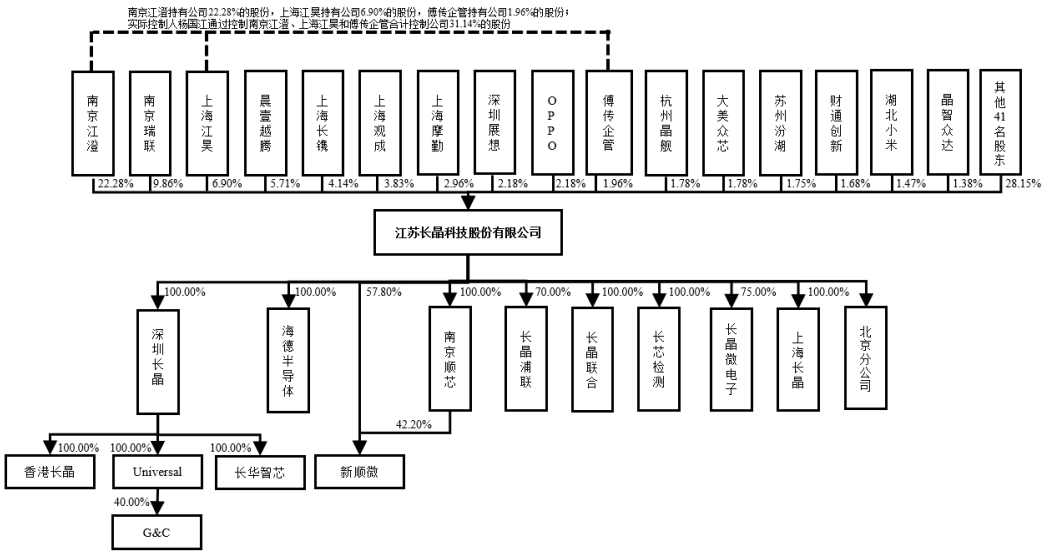
本次收购完成后，发行人实现对参股子公司长芯检测的全资控股，具备了分立器件和电源 IC 产品的可靠性检测和失效分析能力。收购前后，发行人的管理层和实际控制人均未发生变化。

四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况

发行人自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。

五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：



六、发行人控股及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 12 家控股公司和 1 家参股公司。截至 2025 年 12 月 31 日，各控股及参股公司具体情况如下：

（一）重要子公司

1、深圳长晶

公司名称	深圳长晶半导体有限公司
成立时间	2007 年 9 月 27 日
注册资本	5,000.00 万元人民币
实收资本	5,000.00 万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道文心三路 9 号中洲控股金融中心 B 座 19 楼 E-L
主要生产经营地	深圳市南山区粤海街道文心三路 9 号中洲控股金融中心 B 座 19 楼 E-L
主营业务情况	主要负责半导体产品的设计和销售
在发行人业务板块中定位	主要为发行人执行半导体产品的设计和销售，是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人持股 100.00%
主要财务数据（单位：万元）	

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	44,241.80	27,149.66	125,691.09	2,901.49

注：以上数据经审计，下同

2、长晶浦联

公司名称	江苏长晶浦联功率半导体有限公司
成立时间	2020 年 11 月 13 日
注册资本	100,000.00 万元人民币
实收资本	60,000.00 万元人民币
注册地址	南京市浦口区云实路 28 号
主要生产经营地	南京市浦口区云实路 28 号
主营业务情况	主要负责半导体产品的封装测试
在发行人业务板块中定位	主要为发行人执行半导体产品的封装测试，是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人持股 70.00%，浦口产业 30.00%

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	106,152.02	60,111.13	30,273.00	280.42

3、新顺微

公司名称	江苏新顺微电子股份有限公司
成立时间	2002 年 7 月 30 日
注册资本	10,686.2522 万元人民币
实收资本	10,686.2522 万元人民币
注册地址	江阴市长山大道 78 号
主要生产经营地	江阴市长山大道 78 号
主营业务情况	主要负责半导体分立器件晶圆的研发、制造和销售
在发行人业务板块中定位	主要为发行人执行半导体分立器件晶圆的研发、生产和销售，是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人全资子公司南京顺芯持股 42.20%，发行人持股 57.80%

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	109,687.12	81,080.25	68,267.06	12,461.37

4、海德半导体

公司名称	江苏海德半导体有限公司
成立时间	2013 年 12 月 12 日

注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	1,000.00 万元人民币
注册地址	江阴市申港街道东徐路 3 号
主要生产经营地	江阴市申港街道东徐路 3 号
主营业务情况	主要负责二极管产品的研发、设计、生产（封测）和销售
在发行人业务板块中定位	主要为发行人执行部分二极管产品的生产、封测和销售，是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人持股 100.00%

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	14,757.45	8,199.21	22,763.24	1,421.20

（二）其他子公司及参股公司

序号	公司名称	股权结构	出资金额（万元）	持股比例	入股时间	控股方	主营业务
1	长晶微电子	发行人持股 75.00%，刘宗贺持股 25.00%	375.00	75%	2019 年 4 月 8 日	发行人	主要负责可控硅和大功率 TVS 二极管的销售
2	长华智芯	发行人全资子公司深圳长晶持股 100%	100.00	100%	2020 年 11 月 20 日	发行人全资子公司深圳长晶	主要负责部分半导体产品的设计
3	香港长晶	发行人全资子公司深圳长晶持股 100.00%	1.00 万港币	100%	2009 年 12 月 24 日	发行人全资子公司深圳长晶	主要负责半导体产品的境外及港澳台地区销售
4	南京顺芯	发行人全资子公司	28,231.31	100%	2022 年 3 月 21 日	发行人	未开展实际经营业务
5	长芯检测	发行人全资子公司	2,000.00	100%	2021 年 9 月 6 日	发行人	主要负责功率器件和 IC 产品的可靠性检测和失效分析业务
6	上海长晶	发行人全资子公司	50.00	100%	2024 年 9 月 27 日	发行人	主要负责分立器件的销售
7	Universal	发行人全资子公司深圳长晶持股 100%	1.00 万新币	100%	2024 年 11 月 19 日	发行人全资子公司深圳长晶	主要负责分立器件的销售
8	长晶联合	发行人全资子公司	1,000.00	100%	2025 年 11 月 20 日	发行人	主要负责电阻的开发、制造和销售

序号	公司名称	股权结构	出资金额（万元）	持股比例	入股时间	控股方	主营业务
9	G&C	发行人全资孙公司 Universal 持股 40.00%，Công ty cổ phần Geleximco số 1 持股 60%	400,000.00 万越南盾	40%	2026 年 1 月 9 日	Công ty cổ phần Geleximco số 1 持股 60%	主要负责分立器件的销售

注：香港长晶入股时间系深圳长晶投资入股香港长晶的时间。

上述其他子公司及参股公司的具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、其他子公司及参股公司简要情况”。

（三）注销的子公司

报告期初至本招股说明书签署日，公司注销的子公司为长芯顺联、南京芯联和南京海德，具体情况如下：

1、长芯顺联

公司名称	南京长芯顺联电子有限公司
成立时间	2022 年 1 月 4 日
注册资本	50,000.00 万元
实收资本	50,000.00 万元
注册地址	南京市浦口区浦口经济开发区双峰路 69 号 A-57
股东构成	长晶科技持股 100%
主营业务情况	长芯顺联原为新顺微的持股平台，已于 2024 年 4 月被母公司长晶科技吸收合并，并于 2025 年 1 月注销

2、南京芯联

公司名称	南京芯联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 11 月 27 日
注册资本	31,300.00 万元
实收资本	21,200.00 万元
注册地址	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1086 室
股东构成	长晶科技持股 99.30%，深圳长晶持股 0.70%
主营业务情况	南京芯联原为新顺微的持股平台，已于 2025 年 9 月注销

3、南京海德

公司名称	海德半导体（南京）有限公司

成立时间	2025 年 3 月 21 日
注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	0 万元人民币
注册地址	江苏省南京市浦口区浦口经济开发区百合路 111 号-224
股东构成	长晶科技持股 100%
主营业务情况	报告期内无实际经营，已于 2026 年 3 月注销

七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人的基本情况

1、发行人控股股东情况

截至本招股说明书签署日，上海江昊直接和间接合计控制公司 31.14%的表决权，是发行人的控股股东，其中直接持股比例为 6.90%，并担任公司员工持股平台南京江澄、傅传企管的唯一执行事务合伙人。根据南京江澄、傅传企管的合伙协议约定，上海江昊有权且无需取得其他合伙人同意即可行使南京江澄、傅传企管作为公司股东的股东权利。

（1）上海江昊

截至本招股说明书签署日，上海江昊的基本情况如下：

公司名称	上海江昊企业管理咨询有限公司	
成立时间	2020 年 8 月 19 日	
注册资本	50.00 万元	
实收资本	50.00 万元	
注册地和主要生产经营地	上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号	
股东构成	**股东**	**持股比例**
	杨国江	99.00%
	夏昊天	1.00%
	合计	**100.00%**
主营业务及其与发行人主营业务的关系	持有发行人股权并持有发行人员工持股平台南京江澄、傅传企管的普通合伙份额，与发行人不存在同业竞争或上下游关系	

主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	3,021.30	721.30	-	-0.29

注：以上数据经审计。

（2）南京江澄

南京江澄的基本情况如下：

公司名称	南京江澄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 12 月 6 日
出资额	9,693.32 万元人民币
实缴资本	9,693.32 万元人民币
注册地和主要生产经营地	南京江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 D 座 1686 室
执行事务合伙人	上海江昊企业管理咨询有限公司
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台

主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	9,956.40	9,953.41	-	-10.26

注：以上数据未经审计。

截至本招股说明书签署日，南京江澄持有发行人 9,693.32 万股股份，占发行人股本总额的比例为 22.28%。

截至本招股说明书签署日，南京江澄合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	杨国江	有限合伙人	3,316.32	34.21%
2	范荣定	有限合伙人	3,180.00	32.81%
3	杨澄平	有限合伙人	700.00	7.22%
4	陈益忠	有限合伙人	350.00	3.61%
5	陈炜	有限合伙人	210.00	2.17%
6	徐伟	有限合伙人	200.00	2.06%
7	向荣	有限合伙人	200.00	2.06%
8	刘健	有限合伙人	200.00	2.06%
9	俞大铮	有限合伙人	150.00	1.55%
10	吴伟	有限合伙人	120.00	1.24%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
11	吴伟成	有限合伙人	120.00	1.24%
12	袁霞红	有限合伙人	100.00	1.03%
13	姜新芳	有限合伙人	100.00	1.03%
14	杨吉明	有限合伙人	70.00	0.72%
15	李澄	有限合伙人	60.00	0.62%
16	王海波	有限合伙人	50.00	0.52%
17	汤振凯	有限合伙人	50.00	0.52%
18	徐初惠	有限合伙人	50.00	0.52%
19	缪国平	有限合伙人	50.00	0.52%
20	罗仕旺	有限合伙人	40.00	0.41%
21	汪阳	有限合伙人	40.00	0.41%
22	杨立新	有限合伙人	40.00	0.41%
23	王俊杰	有限合伙人	40.00	0.41%
24	刘宗贺	有限合伙人	30.00	0.31%
25	许福龙	有限合伙人	30.00	0.31%
26	毛嘉云	有限合伙人	30.00	0.31%
27	刘丹萍	有限合伙人	30.00	0.31%
28	王嘉诚	有限合伙人	30.00	0.31%
29	叶阿娇	有限合伙人	30.00	0.31%
30	孙陶	有限合伙人	30.00	0.31%
31	黄海健	有限合伙人	20.00	0.21%
32	王松鹤	有限合伙人	20.00	0.21%
33	上海江昊	普通合伙人	7.00	0.07%
合计			**9,693.32**	**100.00%**

（3）傅传企管

截至本招股说明书签署日，傅传企管的基本情况如下：

公司名称	舟山傅传企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 9 月 27 日
出资额	4,272.96 万元人民币
实缴资本	4,272.96 万元人民币
注册地和主要生产经营地	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港综合保税区企业服务中心 305-64504 室

执行事务合伙人	上海江昊企业管理咨询有限公司
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	8,234.84	7,999.98	-	4,899.41

注：以上数据未经审计。

截至本招股说明书签署日，傅传企管持有发行人 854.59 万股股份，占发行人股本总额的比例为 1.96%。

截至本招股说明书签署日，傅传企管合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	长晶佳瑞	有限合伙人	1,377.25	32.23%
2	长晶企达	有限合伙人	1,275.00	29.84%
3	周宏恩	有限合伙人	250.00	5.85%
4	郭智	有限合伙人	250.00	5.85%
5	钱帅	有限合伙人	75.00	1.76%
6	芮强	有限合伙人	75.00	1.76%
7	杨国江	有限合伙人	74.71	1.75%
8	王海波	有限合伙人	50.00	1.17%
9	李澄	有限合伙人	50.00	1.17%
10	刘辉军	有限合伙人	40.00	0.94%
11	陈平晶	有限合伙人	40.00	0.94%
12	李宇	有限合伙人	40.00	0.94%
13	陈少聪	有限合伙人	40.00	0.94%
14	张俊鹏	有限合伙人	40.00	0.94%
15	刘文杰	有限合伙人	40.00	0.94%
16	章江华	有限合伙人	40.00	0.94%
17	夏昊天	有限合伙人	30.00	0.70%
18	韩雪	有限合伙人	30.00	0.70%
19	王靖	有限合伙人	30.00	0.70%
20	李雅	有限合伙人	30.00	0.70%
21	高军明	有限合伙人	25.00	0.59%
22	刘亚	有限合伙人	25.00	0.59%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
23	许秋菊	有限合伙人	25.00	0.59%
24	戈江涛	有限合伙人	25.00	0.59%
25	吴涛	有限合伙人	25.00	0.59%
26	段之刚	有限合伙人	25.00	0.59%
27	徐东明	有限合伙人	25.00	0.59%
28	许清	有限合伙人	25.00	0.59%
29	罗姿稳	有限合伙人	25.00	0.59%
30	沈敏华	有限合伙人	25.00	0.59%
31	游嫣梦	有限合伙人	25.00	0.59%
32	何征海	有限合伙人	25.00	0.59%
33	张锐	有限合伙人	25.00	0.59%
34	唐宏奎	有限合伙人	20.00	0.47%
35	徐佰慧	有限合伙人	20.00	0.47%
36	李青蓝	有限合伙人	15.00	0.35%
37	刘琴芳	有限合伙人	15.00	0.35%
38	上海江昊	普通合伙人	1.00	0.02%
合计			**4,272.96**	**100.00%**

注：截至本招股说明书签署日，钱帅、许清因离职，已将其持有的傅传企管合伙份额转让给杨国江，因工商变更手续尚在办理中，本表列示转让前出资信息。本招股说明书所列杨国江持有的傅传企管合伙份额及其通过该平台间接持有发行人股权比例，均已包含前述钱帅、许清转让的合伙份额。

2、发行人实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人杨国江通过南京江澄、上海江昊、傅传企管和晶智众达合计间接持有公司 15.04%的股份，合计控制公司 31.14%的股份，其基本情况如下：

杨国江先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，身份证号码为 320219197109******，清华大学研究生。2002 年 6 月至 2007 年 12 月，曾任江苏长电科技股份有限公司深圳分公司总经理；2007 年 9 月至今，历任深圳长晶董事、董事长、执行董事、总经理；2018 年 11 月至 2019 年 8 月，曾任新申弘达总经理；2020 年 8 月至今，任上海江昊执行董事；2021 年 9 月至今，任长芯检测执行董事；2022 年 1 月至 2025 年 1 月，曾任长芯顺联执行董事兼总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，曾任长晶有限董事长兼总经理；2022 年 3 月至今，

任新顺微董事长；2022 年 5 月至今，任新顺微总经理；2020 年 11 月至今，任长晶浦联执行董事；2021 年 12 月至今，任发行人董事长兼总经理；2022 年 3 月至今，任江苏省半导体行业协会副理事长。

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）其他持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄、傅传企管外，其他持有发行人 5%以上股份的主要股东及其一致行动人为南京瑞联、晨壹越腾和晨壹佰赢。上海江昊、南京江澄、傅传企管的基本情况参见本节之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、发行人控股股东情况”。

1、南京瑞联

截至 2025 年 12 月 31 日，南京瑞联基本情况如下：

企业名称	南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110000MA006XHD4U
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	南京市建邺区白龙江东街 9 号 B2 幢北楼 401-114 室
执行事务合伙人	南京华杉瑞联咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈志杰）
出资额	252,300 万元人民币
成立日期	2016 年 7 月 13 日
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集基金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
营业期限	2016 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 12 日

截至本招股说明书签署日，南京瑞联持有发行人 4,289.71 万股股份，占发行人股本总额的比例为 9.86%，为发行人股东。

截至 2025 年 12 月 31 日，南京瑞联合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	江苏省广播电视集团有限公司	有限合伙人	50,000.00	19.82%
2	华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）	有限合伙人	25,000.00	9.91%
3	三峡资本控股有限责任公司	有限合伙人	25,000.00	9.91%
4	北京光控浦益创业投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	7.93%
5	阳光人寿保险股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	7.93%
6	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	7.93%
7	华泰证券（上海）资产管理有限公司	有限合伙人	13,900.00	5.51%
8	嘉兴丰彤股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,500.00	4.95%
9	江苏新华报业传媒集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.96%
10	上海兴瀚资产管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.96%
11	博时资本管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	3.96%
12	西藏瑞盈企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,600.00	3.41%
13	西藏泰盈企业管理有限责任公司	有限合伙人	8,000.00	3.17%
14	上海溪尔资产管理有限公司	有限合伙人	6,300.00	2.50%
15	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.98%
16	西藏智晟投资咨询有限公司	有限合伙人	4,000.00	1.59%
17	南京华杉瑞联咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	4,000.00	1.59%
合计			**252,300.00**	**100.00%**

2、晨壹越腾

截至 2025 年 12 月 31 日，晨壹越腾基本情况如下：

企业名称	嘉兴晨壹越腾股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA2JHEBK2L
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 173 室-5
执行事务合伙人	晨壹红启（北京）咨询有限公司
出资额	50,100 万元
成立日期	2021 年 5 月 28 日
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

营业期限	2021 年 5 月 28 日至 2041 年 5 月 27 日

截至本招股说明书签署日，晨壹越腾持有发行人 2,481.93 万股股份，占发行人股本总额的比例为 5.71%，为发行人股东。

截至 2025 年 12 月 31 日，晨壹越腾合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	北京晨壹并购基金（有限合伙）	有限合伙人	40,000.00	79.84%
2	北京嘉元咨询管理有限公司	有限合伙人	5,950.00	11.88%
3	大家人寿保险股份有限公司	有限合伙人	4,050.00	8.08%
4	晨壹红启（北京）咨询有限公司	普通合伙人	100.00	0.20%
合计			**50,100.00**	**100.00%**

3、晨壹佰赢

截至 2025 年 12 月 31 日，晨壹佰赢基本情况如下：

企业名称	嘉兴晨壹佰赢股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402MA2JHEBH85
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 173 室-4
执行事务合伙人	晨壹红启（北京）咨询有限公司
出资额	50,100 万元
成立日期	2021 年 5 月 28 日
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2021 年 5 月 28 日至 2041 年 5 月 27 日

截至本招股说明书签署日，晨壹佰赢持有发行人 387.80 万股股份，占发行人股本总额的比例为 0.89%，为发行人股东。

截至 2025 年 12 月 31 日，晨壹佰赢合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	中英人寿保险有限公司	有限合伙人	50,000.00	99.80%
2	晨壹红启（北京）咨询有限公司	普通合伙人	100.00	0.20%
合计			**50,100.00**	**100.00%**

八、特别表决权或类似安排

发行人设立以来，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

九、协议控制架构的情况

发行人设立以来，公司不存在协议控制架构的情况。

十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十一、发行人股本情况

（一）本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前的总股本为 435,031,732 股，如本次公开发行股票数量为 50,000,000 股，占发行后总股本的 10.31%，本次发行前后股本结构预计如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
1	南京江澄	9,693.32	22.28	9,693.32	19.98
2	南京瑞联	4,289.71	9.86	4,289.71	8.84
3	上海江昊	3,000.00	6.90	3,000.00	6.19
4	晨壹越腾	2,481.93	5.71	2,481.93	5.12
5	上海长镌	1,801.33	4.14	1,801.33	3.71
6	上海观成	1,666.67	3.83	1,666.67	3.44
7	上海摩勤	1,288.24	2.96	1,288.24	2.66
8	深圳展想	950.00	2.18	950.00	1.96
9	OPPO	950.00	2.18	950.00	1.96
10	傅传企管	854.59	1.96	854.59	1.76

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
11	杭州晶舰	775.60	1.78	775.60	1.60
12	大美众芯	775.60	1.78	775.60	1.60
13	苏州汾湖	760.46	1.75	760.46	1.57
14	财通创新	729.08	1.68	729.08	1.50
15	湖北小米	639.99	1.47	639.99	1.32
16	晶智众达	600.00	1.38	600.00	1.24
17	东方富海	558.44	1.28	558.44	1.15
18	宁波汉途	542.92	1.25	542.92	1.12
19	瑞芯晶云	504.14	1.16	504.14	1.04
20	海通创新	465.36	1.07	465.36	0.96
21	通达信	465.36	1.07	465.36	0.96
22	上海瑞芯	422.22	0.97	422.22	0.87
23	华业天成	394.23	0.91	394.23	0.81
24	泰亚富国	387.80	0.89	387.80	0.80
25	上海斯瑞	387.80	0.89	387.80	0.80
26	南京创鼎	387.80	0.89	387.80	0.80
27	格金六号	387.80	0.89	387.80	0.80
28	越秀智创	387.80	0.89	387.80	0.80
29	广州国资产业	387.80	0.89	387.80	0.80
30	越秀金蝉	387.80	0.89	387.80	0.80
31	晨壹佰赢	387.80	0.89	387.80	0.80
32	领益基石	372.64	0.86	372.64	0.77
33	江阴澄芯	371.84	0.85	371.84	0.77
34	节能环保战新	362.53	0.83	362.53	0.75
35	芜湖信晶	333.00	0.77	333.00	0.69
36	苏州聚源	316.67	0.73	316.67	0.65
37	财富趋势	310.24	0.71	310.24	0.64
38	服务贸易基金	310.24	0.71	310.24	0.64
39	季学庆	286.78	0.66	286.78	0.59
40	广东广祺	275.52	0.63	275.52	0.57
41	宁波烈焰	249.74	0.57	249.74	0.51
42	远智先行	240.44	0.55	240.44	0.50

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
43	常州红土	232.68	0.53	232.68	0.48
44	广州科导	232.68	0.53	232.68	0.48
45	虹润科技	229.92	0.53	229.92	0.47
46	苏州广祺	217.52	0.50	217.52	0.45
47	聿泉金环	217.52	0.50	217.52	0.45
48	江阴澄顺	185.12	0.43	185.12	0.38
49	江苏聿泉	155.12	0.36	155.12	0.32
50	厦门建发	155.12	0.36	155.12	0.32
51	蓝天投资	145.01	0.33	145.01	0.30
52	宁波美橙	138.06	0.32	138.06	0.28
53	泉州海丝	132.08	0.30	132.08	0.27
54	君众睿华	116.34	0.27	116.34	0.24
55	清石晶晟	116.34	0.27	116.34	0.24
56	深创投	77.56	0.18	77.56	0.16
57	陈位平	10.88	0.03	10.88	0.02
58	公司新股预计发行数量	-	-	5,000.00	10.31
合计		**43,503.17**	**100.00**	**48,503.17**	**100.00**

（二）本次发行前的前十名股东情况

本次发行前，本公司前十名股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	南京江澄	9,693.32	22.28
2	南京瑞联	4,289.71	9.86
3	上海江昊	3,000.00	6.90
4	晨壹越腾	2,481.93	5.71
5	上海长镌	1,801.33	4.14
6	上海观成	1,666.67	3.83
7	上海摩勤	1,288.24	2.96
8	深圳展想	950.00	2.18
9	OPPO	950.00	2.18
10	傅传企管	854.59	1.96

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
合计		**26,975.79**	**62.01**

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况

截至本招股说明书签署日，发行人的自然人股东为季学庆和陈位平，分别直接持有发行人 286.78 万股、10.88 万股股份，持股比例分别为 0.66%、0.03%，均未在发行人及其子公司处任职。

（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况

1、国有股份

截至本招股说明书签署日，公司国有股东如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	财通创新	7,290,750	1.68
2	海通创新	4,653,624	1.07
3	蓝天投资	1,450,105	0.33
4	深创投	775,604	0.18
合计		**14,170,083**	**3.26**

根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三条：”本办法所称国有股东是指符合以下情形之一的企业和单位，其证券账户标注“SS”：（一）政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业；（二）第一款中所述单位或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过 50%，且其中之一为第一大股东的境内企业；（三）第二款中所述企业直接或间接持股的各级境内独资或全资企业。”第七十四条：“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理。”

根据前述规定，财通创新、海通创新、蓝天投资及深创投为国有实际控制的股东，需进行“CS”证券账户标识。截至本招股说明书签署日，根据财通创新、海通创新、蓝天投资、深创投出具的说明，上述股东证券账户已在中国证券登记结算有限责任公司标识为“CS”。

除上述情况外，发行人其他未上市股份中不存在国有股份。

2、外资股份

截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股份。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

发行人申报前 12 个月内，因股权转让方式新增 5 名新股东，分别为虹润科技、季学庆、广东广祺、苏州广祺、陈位平，因增资新增 4 名新股东，分别为节能环保战新、聿泉金环、蓝天投资、晶智众达。

1、股权转让方式

申报前 12 个月，发行人以股权转让方式新增股东的情况如下：

序号	入股时间	受让方	转让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	入股原因	入股价格及定价依据
1	2026 年 2 月	虹润科技	南京江澄	206.68	2,679.48	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 56.4 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 12.96 元/股
2	2026 年 2 月	虹润科技	泉州海丝	23.24	320.51	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 13.79 元/股
3	2026 年 2 月	季学庆	泉州海丝	154.93	2,136.77	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 13.79 元/股
4	2026 年 2 月	季学庆	东方富海	131.85	1,818.52	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 13.79 元/股
5	2026 年 3 月	广东广祺	湖北小米	275.52	3,800.00	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 13.79 元/股

序号	入股时间	受让方	转让方	转让出资额（万元）	转让金额（万元）	入股原因	入股价格及定价依据
6	2026年3月	苏州广祺	湖北小米	217.52	3,000.00	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 13.79 元/股
7	2026年3月	陈位平	湖北小米	10.88	150.00	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经双方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次股权转让单价为 13.79 元/股

2、增资方式

申报前 12 个月，发行人以增资方式新增股东情况如下：

序号	入股时间	增资方	认缴注册资本（万元）	增资总额（万元）	入股原因	入股价格及定价依据
1	2025 年 6 月	节能环保战新	362.53	5,000.00	因看好发行人的发展，希望通过投资发行人而获取投资收益	经各方协商一致，确定长晶科技的估值约 60 亿元人民币，并据此确定本次增资的入股单价为 13.79 元/股。
2		聿泉金环	217.52	3,000.00		
3		蓝天投资	145.01	2,000.00		
4		晶智众达	600.00	3,120.00	晶智众达系发行人的员工持股平台，因实施员工股权激励，发行人向晶智众达增发股票	综合考虑发行人投资者近期入股价格、成长性和对员工的激励效果等因素，确定入股价格为 5.20 元/股

3、新增股东基本情况

（1）节能环保战新

截至本招股说明书签署日，节能环保战新直接持有公司 0.83%的股份。截至 2025 年 12 月 31 日，节能环保战新的基本情况如下：

企业名称	江苏省节能环保战新产业基金（有限合伙）			
成立时间	2025-03-13			
注册资本	300,000.00 万元人民币			
注册地址	南京江北新区探秘路 73 号树屋十六栋 A-4 栋 1 层 101-2 室			
股东构成	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	江苏省环保集团有限公司	87,000.00	29.00	有限合伙人
	江苏省战略性新兴产业母基金有限公司	75,000.00	25.00	有限合伙人

	南京江北新区高质量发展产业投资基金（有限合伙）	60,000.00	20.00	有限合伙人
	无锡市环保集团有限公司	45,000.00	15.00	有限合伙人
	南京高新创业投资有限公司	30,000.00	10.00	有限合伙人
	江苏金环投资管理有限公司	3,000.00	1.00	普通合伙人
	合计	**300,000.00**	**100.00**	-

节能环保战新的普通合伙人为江苏金环投资管理有限公司。截至 2025 年 12 月 31 日，江苏金环投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	**江苏金环投资管理有限公司**		
统一社会信用代码	91320105MA22P4XE4G		
注册资本	2,000.00 万元人民币		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
住所	南京市建邺区江心洲宏俊街 33 号 1 幢 4 层南侧		
法定代表人	王昌盛		
实际控制人	江苏省政府国有资产监督管理委员会		
成立日期	2020-10-15		
经营期限	2020-10-15 至无固定期限		
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东构成	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例（%）**
	江苏省环保集团投资有限公司	2,000.00	100.00
	合计	**2,000.00**	**100.00**

（2）聿泉金环

截至本招股说明书签署日，聿泉金环直接持有公司 0.50%的股份。截至 2025 年 12 月 31 日，聿泉金环的基本情况如下：

企业名称	**江苏聿泉金环土壤污染防治股权投资合伙企业（有限合伙）**			
成立时间	2021-11-17			
注册资本	100,000.00 万元			
注册地址	江苏省南京市建邺区江心洲宏俊街 33 号 1 幢 4 楼			
股东构成	**合伙人名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类型**
	泰州三水投资开发有限	40,000.00	40.00	有限合伙人

	公司			
	江苏省环保集团投资有限公司	29,000.00	29.00	有限合伙人
	江苏省政府投资基金（有限合伙）	25,000.00	25.00	有限合伙人
	江苏长三角环境科学技术研究院有限公司	5,000.00	5.00	有限合伙人
	江苏金环投资管理有限公司	1,000.00	1.00	普通合伙人
	合计	**100,000.00**	**100.00**	**-**

聿泉金环的普通合伙人为江苏金环投资管理有限公司。截至 2025 年 12 月 31 日，江苏金环投资管理有限公司的基本情况参见前述。

（3）蓝天投资

截至本招股说明书签署日，蓝天投资直接持有公司 0.33%的股份。截至 2025 年 12 月 31 日，蓝天投资的基本情况如下：

名称	**南京蓝天投资有限公司**		
统一社会信用代码	91320102MA1YK1YU3J		
注册资本	50,000.00 万元		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
住所	南京市玄武区大钟亭 8 号		
法定代表人	许建		
实际控制人	南京市人民政府国有资产监督管理委员会		
成立日期	2019-06-17		
经营期限	2019-06-17 至无固定期限		
经营范围	投资管理及其相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	**股东名称**	**出资额（万元）**	**持股比例（%）**
	南京证券股份有限公司	50,000.00	100.00
	合计	**50,000.00**	**100.00**

（4）晶智众达

截至本招股说明书签署日，晶智众达直接持有公司 1.38%的股份。截至 2025 年 12 月 31 日，晶智众达的基本情况如下：

企业名称	**南京晶智众达企业管理合伙企业（有限合伙）**
成立时间	2025-05-20

注册资本	3,120.00 万元人民币			
注册地址	江苏省南京市江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 D 座 1668 室			
股东构成	**合伙人名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**	**合伙人类型**
	杨国江	1,040.00	33.33	有限合伙人
	彭松林	520.00	16.67	有限合伙人
	杨波	260.00	8.33	有限合伙人
	夏昊天	156.00	5.00	普通合伙人
	黄乃仪	130.00	4.17	有限合伙人
	何增谊	104.00	3.33	有限合伙人
	邓巍	104.00	3.33	有限合伙人
	李澄	104.00	3.33	有限合伙人
	周明	78.00	2.50	有限合伙人
	纪宠明	78.00	2.50	有限合伙人
	陈平晶	62.40	2.00	有限合伙人
	芮强	52.00	1.67	有限合伙人
	张鑫	52.00	1.67	有限合伙人
	刘锋	52.00	1.67	有限合伙人
	高新明	52.00	1.67	有限合伙人
	刘永锋	52.00	1.67	有限合伙人
	刘琴	41.60	1.33	有限合伙人
	赖松	26.00	0.83	有限合伙人
	王歆悦	26.00	0.83	有限合伙人
	金琼	26.00	0.83	有限合伙人
	田潇	26.00	0.83	有限合伙人
	刘辉军	26.00	0.83	有限合伙人
	赵亚飞	26.00	0.83	有限合伙人
	皮孟月	26.00	0.83	有限合伙人
	合计	**3,120.00**	**100.00**	**-**

（5）季学庆

截至本招股说明书签署日，季学庆直接持有公司 0.66%的股份，季学庆的基本情况如下：

季学庆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

321025197107******。1994 年 7 月至 1996 年 4 月，就职于中国高科技创业投资集团任项目经理；1996 年 4 月至 2009 年 12 月就职于用友网络科技股份有限公司，历任江苏分公司任部门经理、江苏分公司总经理和华东大区总经理兼高级副总裁；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，就职于南京青和投资集团有限公司任董事、总裁；2010 年 12 月至 2020 年 5 月，任南京苏和企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁。现任南京苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京联迪信息系统股份有限公司独立董事、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

（6）虹润科技

截至本招股说明书签署日，虹润科技直接持有公司 0.53%的股份，虹润科技的基本情况如下：

企业名称	**虹润（杭州）科技有限公司**		
统一社会信用代码	91330108710946319X		
注册资本	2,242.74 万美元		
类型	有限责任公司（外国法人独资）		
住所	浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 6 楼 E1 室（自主申报）		
法定代表人	邓晖		
实际控制人	邓晖		
成立时间	1998-8-25		
经营期限	1998 年 8 月 25 日至 2048 年 8 月 25 日		
经营范围	技术服务、技术咨询：电子产品；服务：投资管理（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。		
股东构成	**股东名称**	**出资额（万元）**	**出资比例（%）**
	虹润资本管理有限公司	2,242.74	100.00
	合计	**2,242.74**	**100.00**

（7）广东广祺

截至本招股说明书签署日，广东广祺直接持有公司 0.63%的股份，广东广祺的基本情况如下：

企业名称	广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2025-5-23			
注册资本	150,000.00 万元人民币			
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报，集群登记）			
股东构成	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
	广汽资本有限公司	149,900.00	99.93	有限合伙人
	广州盈蓬私募基金管理有限公司	100.00	0.07	普通合伙人
	合计	**150,000.00**	**100.00**	-

广东广祺的普通合伙人为广州盈蓬私募基金管理有限公司，广州盈蓬私募基金管理有限公司的基本情况如下：

名称	广州盈蓬私募基金管理有限公司		
统一社会信用代码	91440101MA59KWAF77		
注册资本	10,000.00 万元人民币		
类型	有限责任公司（法人独资）		
住所	广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 405 房 R05-A031		
法定代表人	谭民爱		
实际控制人	广州市人民政府国有资产监督管理委员会		
成立日期	2017-03-28		
经营期限	2017-03-28 至无固定期限		
经营范围	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）		
股东构成	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
	广汽资本有限公司	10,000.00	100.00
	合计	**10,000.00**	**100.00**

（8）苏州广祺

截至本招股说明书签署日，苏州广祺直接持有公司 0.50%的股份，苏州广祺的基本情况如下：

企业名称	苏州广祺智行产业投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2025-4-21
注册资本	30,100.00 万元人民币
注册地址	江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1807 室-051 工位（集群登记）

	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
股东构成	广汽资本有限公司	7,900.00	26.25	有限合伙人
	越秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）	7,200.00	23.92	有限合伙人
	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	3,000.00	9.97	有限合伙人
	苏州高铁新城环秀湖产业引导基金合伙企业（有限合伙）	3,000.00	9.97	有限合伙人
	苏州市相城二期新兴产业创业投资中心（有限合伙）	3,000.00	9.97	有限合伙人
	苏州国发苏创二期知识产权创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	9.97	有限合伙人
	众诚汽车保险股份有限公司	2,900.00	9.63	有限合伙人
	广州盈蓬私募基金管理有限公司	100.00	0.33	普通合伙人
	合计	**30,100.00**	**100.00**	**-**

苏州广祺的普通合伙人为广州盈蓬私募基金管理有限公司，广州盈蓬私募基金管理有限公司的基本情况参见前述。

（9）陈位平

截至本招股说明书签署日，陈位平直接持有公司 0.03%的股份，陈位平的基本情况如下：

陈位平，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 4113241987112******。2009 年 7 月至 2010 年 3 月，就职于中国移动通信集团河南有限公司任储备干部；2010 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于广州广汽交通运输服务有限公司财务部任主办会计；2012 年 3 月至 2013 年 10 月，就职于广州广汽租赁有限公司财务部任会计主管；2013 年 11 月至 2024 年 1 月，就职于广汽传祺汽车有限公司财务部任科室负责人；2024 年 2 月至今，就职于广州盈蓬私募基金管理有限公司投资部任副总监。

4、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系

经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系如下：

（1）新增股东与发行人其他股东之间的关联关系，参见本节之“十一、发行人股本情况”之“（六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系”；

（2）发行人董事长兼总经理杨国江持有晶智众达 33.33%有限合伙份额，董事会秘书兼财务负责人李澄持有晶智众达 3.33%有限合伙份额，监事王歆悦持有晶智众达 0.83%有限合伙份额。

除以上情形之外，上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关联关系

经核查，上述新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

6、新增股东是否存在股份代持情形

经核查，上述新增股东不存在股份代持的情形。

（六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系

截至本招股说明书签署日，本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	关联关系、一致行动关系
1	南京江澄	9,693.32	22.28	上海江昊为南京江澄、傅传企管的执行事务合伙人
	上海江昊	3,000.00	6.90	
	傅传企管	854.59	1.96	
	合计	**13,547.91**	**31.14**	
2	晨壹越腾	2,481.93	5.71	晨壹越腾和晨壹佰赢的执行事务合伙人均为晨壹红启（北京）咨询有限公司；晨壹越腾和晨壹佰赢的基金管理人均为晨壹基金管理（北京）有限公司
	晨壹佰赢	387.80	0.89	
	合计	**2,869.73**	**6.60**	
3	上海摩勤	1,288.24	2.96	上海摩勤直接持有苏州汾湖 37.50%合伙份额
	苏州汾湖	760.46	1.75	
	合计	**2,048.70**	**4.71**	
4	越秀智创	387.80	0.89	越秀智创、广州国资产业和越秀金蝉的执行事务合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
	广州国资产业	387.80	0.89	
	越秀金蝉	387.80	0.89	
	合计	**1,163.41**	**2.67**	

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	关联关系、一致行动关系
5	苏州汾湖	760.46	1.75	苏州汾湖和清石晶晟的基金管理人均为清石资产管理（上海）有限公司
	清石晶晟	116.34	0.27	
	合计	**876.80**	**2.02**	
6	通达信	465.36	1.07	通达信为财富趋势的全资子公司
	财富趋势	310.24	0.71	
	合计	**775.60**	**1.78**	
7	常州红土	232.68	0.53	深创投直接持有常州红土 29.70%合伙份额、直接持有江苏聿泉 34.62%合伙份额
	江苏聿泉	155.12	0.36	
	深创投	77.56	0.18	
	合计	**465.36**	**1.07**	
8	节能环保战新	362.53	0.83	节能环保战新和聿泉金环的执行事务合伙人均为江苏金环投资管理有限公司
	聿泉金环	217.52	0.50	
	合计	**580.04**	**1.33**	
9	广东广祺	275.52	0.63	广东广祺和苏州广祺的执行事务合伙人均为广州盈蓬私募基金管理有限公司
	苏州广祺	217.52	0.50	
	合计	**493.04**	**1.13**	

（七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次股票发行不涉及发行人股东公开发售股份的情形。

（八）申报时存在私募投资基金等金融产品股东的情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 57 名股东。其中，上海江昊为实际控制人杨国江控制的企业；南京江澄、上海观成、傅传企管、晶智众达共计 4 名股东为发行人的员工持股平台；江阴澄芯和江阴澄顺为发行人子公司新顺微的员工持股平台；上海长镌、上海摩勤、深圳展想、OPPO、财通创新、宁波汉途、海通创新、通达信、瑞芯晶泽、上海斯瑞、财富趋势、泉州海丝、宁波烈焰、广州科导、蓝天投资、宁波美橙、君众睿华、虹润科技、泰亚富国共计 19 名股东系以自有或自筹资金向公司投资，不存在以公开或非公开的方式向投资者募集资金的情形，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规定的私募基金，无需办理登记备案；季学庆、陈位平为自然人股东；其余 29 名股东属于《证券投资基金法》、

《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等规定的基金均已完成备案，其基金管理人亦均已完成登记，具体情况如下：

序号	股东名称	备案编号	基金管理人	登记编号
1	南京瑞联	S32431	华杉瑞联基金管理有限公司	P1002025
2	晨壹越腾	STE955	晨壹基金管理（北京）有限公司	P1070356
3	湖北小米	SEE206	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司	P1067842
4	杭州晶舰	STF525	杭州本坚私募基金管理有限公司	P1072224
5	大美众芯	SSQ010	南京大美众成创业投资合伙企业（有限合伙）	P1072288
6	苏州汾湖	SLX616	清石资产管理（上海）有限公司	P1070825
7	东方富海	STL413	深圳市东方富海创业投资管理有限公司	P1020765
8	瑞芯晶云	STE957	北京瑞芯私募基金管理有限公司	P1072501
9	华业天成	SGW727	深圳华业天成投资有限公司	P1068886
10	南京创鼎	SEX575	国创中鼎（上海）股权投资管理有限公司	P1068243
11	格金六号	SQS788	珠海格力股权投资基金管理有限公司	P1065730
12	越秀智创	SEY649	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	P1000696
13	广州国资产业	SD2030	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	P1000696
14	越秀金蝉	SNR943	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司	P1000696
15	晨壹佰赢	STL308	晨壹基金管理（北京）有限公司	P1070356
16	节能环保战新	SASA77	江苏金环投资管理有限公司	P1071601
17	信晶长腾	SAVN76	信达资本管理有限公司	P1000639
18	苏州聚源	SJT590	中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司	P1003853
19	服务贸易基金	SCE724	招商局资本管理（北京）有限公司	P1064462
20	广东广祺	SBCA61	广州盈蓬私募基金管理有限公司	P1063917
21	远智先行	STF138	广东远智先行股权投资基金管理有限公司	P1070716
22	常州红土	SCE149	鹰潭红土优创投资管理有限合伙企业	P1065991
23	苏州广祺	SBCY99	广州盈蓬私募基金管理有限公司	P1063917
24	聿泉金环	STF381	江苏金环投资管理有限公司	P1071601
25	江苏聿泉	SCJ892	江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）	P1067093
26	领益基石	SQZ879	基石资产管理股份有限公司	P1002245
27	厦门建发	SS4724	厦门建发新兴创业投资有限公司	P1029366
28	清石晶晟	SQV334	清石资产管理（上海）有限公司	P1070825
29	深创投	SD2401	深圳市创新投资集团有限公司	P1000284

十二、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

（一）董事会成员

公司董事由股东大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司本届董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。

现任董事基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的董事职务	提名人	本届董事会任职期限
1	杨国江	董事长	上海江昊	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日
2	陈益忠	董事	上海江昊	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日
3	王楚璇	董事	晨壹越腾、晨壹佰赢	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日
4	邓德强	独立董事	上海江昊	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日
5	张金隆	独立董事	上海江昊	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日

上述各位董事简历如下：

杨国江先生，参见本节之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、发行人实际控制人情况”的相关内容。

陈益忠先生，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，江南大学本科、无线电专业，复旦大学工商管理硕士。1989 年 9 月至 2009 年 1 月，曾任江苏长电科技股份有限公司测试分厂厂长；2009 年 1 月至 2018 年 12 月，曾任江苏长电科技股份有限公司器件销售部总监；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，曾任江苏长晶科技有限公司副总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，曾任江阴新申弘达半导体销售有限公司董事长、总经理；2022 年 3 月至今，任江苏新顺微电子股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司董事兼副总经理，主要管理销售业务。

王楚璇女士，中国国籍，1998 年出生，无境外永久居留权，美国宾夕法尼亚大学硕士学历。2021 年至今，任晨壹投资有限公司投资经理；2024 年 1 月至今，任芯德半导体董事；2024 年 6 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司董事。

邓德强先生，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历、会计学专业。2007 年 6 月至 2021 年 2 月，历任南京理工大学经济管理学院教师、MBA 中心主任、会计学系主任；2018 年 5 月至 2024 年 7 月，任江苏美思德化学股份有限公司独立董事；2019 年 2 月至 2020 年 12 月，任神雾节能股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，历任南京林业大学经济管理学院教师、副院长；2022 年 12 月至 2025 年 9 月，任江苏肯立科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任江苏征途技术股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司独立董事。

张金隆先生，中国国籍，1952 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历、管理科学与工程专业。1975 年 12 月至 1977 年 8 月，曾任华中科技大学无线电系教师；1977 年 9 月至 1985 年 8 月，曾任华中科技大学计算机系教师；1985 年 8 月至 2011 年 12 月，历任华中科技大学管理学院讲师、副教授、教授、系主任、院长；2012 年 1 月至今，任华中科技大学管理学院教授（目前已退休）；2020 年 6 月至 2024 年 6 月，任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任波睿达（武汉江夏）生物医药有限公司监事；2023 年 4 月至今，任湖北华商科技投资集团有限公司董事；2025 年 8 月至今，任湖北华商鲲池科创服务集团有限公司董事；2021 年 12 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司独立董事。

（二）董事会审计委员会成员

2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东大会，决议取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

现任董事会审计委员会人员构成情况如下：

序号	姓名	职务	任职期限
1	邓德强	董事会审计委员会主任委员	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日
2	张金隆	董事会审计委员会委员	2024 年 12 月 4 日-2027 年 12 月 3 日
3	王楚璇	董事会审计委员会委员	2026 年 3 月 24 日-2027 年 12 月 3 日

上述各位审计委员会委员的简历情况请参见本节上述“十二、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”相关内容。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的职务
1	杨国江	总经理
2	范荣定	副总经理
3	陈益忠	副总经理
4	李澄	财务负责人、董事会秘书

上述各位高级管理人员简历如下：

杨国江先生，参见本节之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“2、发行人实际控制人情况”的相关内容。

范荣定先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，电子科技大学本科学历、电器材料与器件专业。1994 年 7 月至 2003 年 5 月，曾任江苏长电科技股份有限公司生产部部长；2003 年 5 月至 2007 年 10 月，曾任江苏长电科技股份有限公司市场总监；2007 年 11 月至今，任深圳长晶半导体有限公司副总经理；2019 年 5 月至 2021 年 12 月，曾任江苏长晶科技有限公司监事；2019 年 4 月至今，任深圳长晶微电子有限公司监事；2021 年 12 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司副总经理。

陈益忠先生，参见本节之“十二、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”的相关内容。

李澄女士，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，南京审计大学本科学历、国际审计专业，国际注册会计师，国际注册内审师。2006 年 7 月至 2009 年 7 月，曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2009 年 8 月至 2010 年 12 月，曾任南京扬子石化碧辟乙酰有限责任公司财务部内审员；2011 年 1 月至 2011 年 3 月，曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2011 年 4 月至 2011 年 9 月，曾任南京途牛科技有限公司财务部内控员；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任南京同仁堂健康药业集团有限公司财务副总监；2015 年 8 月至 2019 年 7 月，曾任南京恒生制药有限公司财务总监；2019 年 8 月至 2021 年 12 月，曾任江苏长晶科技有限公司财务负责人；2020 年 10 月至今，任江苏

海德半导体有限公司监事；2021 年 12 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司财务负责人；2022 年 9 月至今，任江苏长晶科技股份有限公司董事会秘书。

（四）其他核心人员

公司其他核心人员基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的职务
1	芮强	功率器件研发总监
2	杨波	电源管理 IC 事业部总经理
3	王海波	电源管理 IC 研发总监

上述各位其他核心人员简历如下：

芮强先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，电子科技大学微电子科学与工程专业，本科学历。2004 年 8 月至 2006 年 5 月，任无锡华润华晶微电子有限公司工程师；2006 年 5 月至 2012 年 12 月，任无锡华润上华科技有限公司高级工程师；2013 年 1 月至 2021 年 9 月，任无锡华润华晶微电子有限公司功率半导体研发中心研发经理、IGBT 研发部研发高级经理。2021 年 9 月至 2023 年 5 月，任长晶浦联工程设备中心工艺工程师；2023 年 5 月至今，任长晶科技功率器件研发总监。

杨波先生，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，电子科技大学微电子与固体电子学专业，硕士学历。2010 年 7 月至 2011 年 3 月，曾任香港威龙半导体有限公司成都分公司模拟集成电路设计工程师；2011 年 3 月至 2021 年 3 月，曾任德州仪器半导体技术（上海）有限公司电路设计工程师、经理、市场总监；2021 年 5 月至 2024 年 3 月，曾任深圳市必易微电子股份有限公司市场总监；2024 年 4 月至今，任长晶科技电源管理 IC 事业部总经理。

王海波先生，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，吉林大学微电子与固体电子学专业，硕士学历。2007 年 1 月至 2020 年 1 月，曾任南京微盟电子有限公司研发部消费类产品线研发经理兼产品经理；2020 年 2 月至 2021 年 12 月，曾任江苏长晶科技有限公司研发副总监；2021 年 12 月至今，任长晶科技电源管理 IC 研发总监。

（五）董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员在除公司及其控股子公司以外的其他单位兼职情况如下：

姓名	在发行人所任职务	兼职单位	兼职职务	与本公司的关联关系
杨国江	董事长兼总经理	上海江昊	执行董事	关联方
		江苏省半导体行业协会	副理事长	非关联方
		长晶企达	执行事务合伙人	关联方
		长晶佳瑞	执行事务合伙人	关联方
王楚璇	董事	芯德半导体	董事	关联方
邓德强	独立董事、董事会审计委员会主任委员	江苏征途技术股份有限公司	独立董事	非关联方
		南京林业大学经济管理学院	副院长、教授（已退休）	非关联方
张金隆	独立董事、董事会审计委员会委员	华中科技大学	教授	非关联方
		湖北华商科技投资集团有限公司	董事	关联方
		波睿达（武汉江夏）生物医药有限公司	监事	非关联方
		湖北华商鲲池科创服务集团有限公司	董事	关联方

（六）董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。

（七）最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

根据深圳证券交易所于 2025 年 6 月 13 日出具的《关于对江苏长晶科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证审纪【2025】21 号），依据深圳证券交易所《审核规则》第七十三条、第七十四条第三项的规定，对江苏长晶科技股份有限公司实际控制人、董事长兼总经理杨国江，财务负责人李澄给予通报批评的处分。

除上述情况外，公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

十三、发行人与董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况

在公司担任行政职务的董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员和其他核心人员均与公司签署了劳动合同，独立董事与公司签署了聘任协议，公司高级管理人员、其他核心人员与公司签署了保密协议、竞业限制协议。上述协议履行情况正常，不存在违约情形。

除上述协议外，公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员和其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

十四、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份不存在股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况，具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务或亲属关系	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合并持股比例
1	杨国江	董事长兼总经理	-	15.04%	南京江澄、上海江昊、傅传企管、晶智众达、长晶佳瑞、长晶企达	15.04%
2	陈益忠	董事兼副总经理	-	0.80%	南京江澄	0.80%
3	范荣定	副总经理	-	7.31%	南京江澄	7.31%
4	李澄	财务负责人、董事会秘书	-	0.21%	南京江澄、傅传企管、晶智众达	0.21%
5	杨波	电源管理 IC 事业部总经理	-	0.11%	晶智众达	0.11%
6	芮强	功率器件研发总监	-	0.10%	傅传企管、晶智众达、长晶企达	0.10%
7	王海波	电源管理 IC 研发总监	-	0.14%	南京江澄、傅传企管	0.14%

序号	姓名	职务或亲属关系	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合并持股比例
合计						**23.72%**

十五、董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况

（一）董事变动情况

最近三年，公司董事变动情况如下：

序号	变动时间	变动前	变动后	变动原因
1	2024 年 6 月 25 日	杨国江、陈益忠、孔晓明、邓德强、张金隆	杨国江、陈益忠、王楚璇、邓德强、张金隆	原董事孔晓明因个人原因辞去公司董事职务

（二）监事变动情况

最近三年，公司监事变动情况如下：

序号	变动时间	变动前	变动后	变动原因
1	2024 年 12 月 4 日	王歆悦、徐牧之、徐佰慧	王歆悦、张宇诗、徐佰慧	原监事徐牧之因个人原因辞去公司监事职务
2	2026 年 5 月 15 日	王歆悦、张宇诗、徐佰慧	-	根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司取消监事会，并由董事会审计委员会行使原监事会相关职权

（三）董事会审计委员会成员变动情况

最近三年，公司董事会审计委员会成员变动情况如下：

序号	变动时间	变动前	变动后	变动原因
1	2026 年 3 月 24 日	邓德强、张金隆、杨国江	邓德强、张金隆、王楚璇	根据公司发展需要，进一步规范公司治理结构，杨国江辞任董事会审计委员会成员，公司聘任王楚璇为董事会审计委员会成员

（四）高级管理人员变动情况

最近三年，公司高级管理人员不存在变动。

（五）其他核心人员变动情况

最近三年，公司其他核心人员变动情况如下：

序号	变动时间	变动前	变动后	变动原因
1	2023 年 3 月	于世珩、王海波	王海波	原研发总监于世珩因个人及家庭原因主动离职
2	2023 年 5 月	王海波	芮强、王海波	公司任命芮强为长晶科技功率器件研发总监，进一步提高产品研发能力
3	2024 年 4 月	芮强、王海波	芮强、杨波、王海波	公司为了进一步提高产品研发能力，并开拓更多产品线，公司引入更多的优秀研发人才

综上所述，最近三年，公司董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员、其他核心人员未发生重大变动，少量变动主要是因个人原因辞任及公司业务与战略发展需要而进行调整。公司经营未因上述调整受到重大不利影响，因此公司最近三年董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员和其他核心人员变动不构成重大不利变化。

十六、董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及其业务相关的其他对外投资情况。除持有公司股权外，本公司董事（含董事会审计委员会成员）、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下：

姓名	职务	投资单位	主营业务	注册资本（万元）	投资金额（万元）	持股比例（%）
杨国江	董事长兼总经理	上海江昊	股权投资	50.00	49.50	99.00
		南京江澄	员工持股平台	9,693.32	3,316.32	34.21
		晶智众达	员工持股平台	3,120.00	1,040.00	33.33
		长晶企达	员工持股平台	1,275.00	45.00	3.53
		长晶佳瑞	员工持股平台	1,377.25	37.25	2.70
		傅传企管	员工持股平台	4,272.96	174.71	4.09
陈益忠	董事兼副总经理	南京江澄	员工持股平台	9,693.32	350.00	3.61
范荣定	副总经理	南京江澄	员工持股平台	9,693.32	3,180.00	32.81
		深圳市皓文电子股份有限公司	混合集成电路、模块集成电路、微电路模块、电力电子产品的开发及销售	4,303.86	253.24	5.88
		四川维优科技有	批发业	1,000.00	20.00	2.00

姓名	职务	投资单位	主营业务	注册资本（万元）	投资金额（万元）	持股比例（%）
		限责任公司				
李澄	财务负责人、董事会秘书	南京江澄	员工持股平台	9,693.32	60.00	0.62
		傅传企管	员工持股平台	4,272.96	50.00	1.17
		晶智众达	员工持股平台	3,120.00	104.00	3.33
杨波	电源管理 IC 事业部总经理	晶智众达	员工持股平台	3,120.00	260.00	8.33
芮强	功率器件研发总监	傅传企管	员工持股平台	4,272.96	75.00	1.76
		长晶企达	员工持股平台	1,275.00	100.00	7.84
		晶智众达	员工持股平台	3,120.00	52.00	1.67
王海波	电源管理 IC 研发总监	南京江澄	员工持股平台	9,693.32	50.00	0.52
		傅传企管	员工持股平台	4,272.96	50.00	1.17

除上述对外投资外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员无其他重大对外投资情况，上述人员的对外投资均未与发行人业务产生利益冲突。

十七、董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序

董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

公司董事（含董事会审计委员会成员）、监事及高级管理人员薪酬政策如下：（1）公司非独立董事、监事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事、监事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬，未在公司任职的非独立董事、监事无薪酬或津贴；（2）公司独立董事领取独立董事津贴，每年人民币 8 万元（含税）；（3）公司高级管理人员薪酬依据所处岗位、工作成绩、工作年限等方面根据公司内部相关薪酬管理制度综合确定。

（二）报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比例

报告期内，公司董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及

其他核心人员薪酬总额及其占公司利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	1,641.90	1,500.69	1,449.13
利润总额	40,780.90	29,018.41	19,643.99
占比	4.03%	5.17%	7.38%

（三）最近一年薪酬具体情况

董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业获得收入情况如下：

单位：万元

姓名	在发行人所任职务	2025 年度薪酬	2025 年是否在实际控制人控制的其他企业领薪
杨国江	董事长、总经理	534.29	否
陈益忠	董事、副总经理	162.81	否
王楚璇	董事	-	否
邓德强	独立董事、董事会审计委员会主任委员	8.00	否
张金隆	独立董事、董事会审计委员会委员	8.00	否
王歆悦	曾任监事会主席、职工代表监事	34.09	否
张宇诗	曾任监事	-	否
徐佰慧	曾任监事	20.13	否
范荣定	副总经理	219.33	否
李澄	财务负责人、董事会秘书	155.49	否
杨波	电源管理 IC 事业部总经理	195.95	否
芮强	功率器件研发总监	175.97	否
王海波	电源管理 IC 研发总监	127.83	否

注 1：董事王楚璇是股东委派的外部董事，监事张宇诗是股东委派的外部监事，上述两位未从公司处领薪；

注 2：公司独立董事邓德强、张金隆领取独立董事津贴，每年人民币 8 万元（含税）

发行人薪酬包括工资总额（含年终奖金）、社会保险、住房公积金。以上与公司建立劳动关系的董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、失业、工伤、生育等保险及住房公积金。除此以外，公司董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员未在公司享受其他待遇和退休金

计划等。

十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排

截至本招股说明书签署日，发行人不存在已经制定或实施的期权激励。报告期内，发行人已经制定或实施的股权激励情况如下：

（一）员工持股平台基本情况

截至本招股说明书签署日，南京江澄、上海观成、傅传企管、长晶佳瑞、长晶企达、晶智众达系发行人实施股权激励的员工持股平台。

发行人为稳定核心团队和业务骨干，激励中高层管理人员和核心骨干员工，进一步提高公司凝聚力，通过设立有限合伙企业作为员工持股平台，以此提高业务骨干团队的稳定性和工作积极性。全部激励对象通过持有有限合伙企业的出资份额间接持有发行人股份。

1、南京江澄

南京江澄的基本情况参见本节之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、发行人控股股东情况”。

2、上海观成

截至本招股说明书签署日，上海观成基本情况如下：

企业名称	上海观成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 10 月 28 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	向荣
住所	上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号（上海玉海棠科技园区）
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，上海观成的合伙人出资构成如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	夏昊天	有限合伙人	830.00	49.79

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
2	杨澄平	有限合伙人	830.00	49.79
3	向荣	普通合伙人	7.00	0.42
合计			**1,667.00**	**100.00**

3、傅传企管

傅传企管的基本情况及合伙人出资构成参见本节之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”之“1、发行人控股股东情况”。

4、长晶佳瑞

截至本招股说明书签署日，长晶佳瑞基本情况如下：

企业名称	扬州长晶佳瑞投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022 年 5 月 23 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杨国江
住所	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 6 号楼 14 室
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，长晶佳瑞的合伙人出资构成如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	顾中平	有限合伙人	155.25	11.27
2	叶超	有限合伙人	143.75	10.44
3	王刚	有限合伙人	132.25	9.60
4	高善明	有限合伙人	126.50	9.18
5	金建兴	有限合伙人	57.50	4.17
6	杨毅中	有限合伙人	40.25	2.92
7	李建立	有限合伙人	40.25	2.92
8	杨国江	普通合伙人	37.25	2.70
9	董振雷	有限合伙人	34.50	2.50
10	沈晓东	有限合伙人	34.50	2.50
11	刘志刚	有限合伙人	30.00	2.18
12	张磊	有限合伙人	30.00	2.18

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
13	朱瑞	有限合伙人	28.75	2.09
14	王鑫花	有限合伙人	28.75	2.09
15	许柏松	有限合伙人	28.75	2.09
16	吴丹	有限合伙人	28.75	2.09
17	李彩亚	有限合伙人	23.00	1.67
18	孙斌	有限合伙人	23.00	1.67
19	陈建标	有限合伙人	17.25	1.25
20	顾军魏	有限合伙人	17.25	1.25
21	王伟	有限合伙人	17.25	1.25
22	贾云波	有限合伙人	17.25	1.25
23	王金富	有限合伙人	17.25	1.25
24	吴坚	有限合伙人	17.25	1.25
25	龚宇科	有限合伙人	17.25	1.25
26	陶勇	有限合伙人	17.25	1.25
27	陈尚利	有限合伙人	17.25	1.25
28	蒋燕琴	有限合伙人	17.25	1.25
29	刘晓燕	有限合伙人	17.25	1.25
30	黄澄栋	有限合伙人	17.25	1.25
31	杨蓉蓉	有限合伙人	17.25	1.25
32	蒋亚东	有限合伙人	17.25	1.25
33	王法华	有限合伙人	17.25	1.25
34	蒋樱子	有限合伙人	17.25	1.25
35	王润波	有限合伙人	17.25	1.25
36	任涛	有限合伙人	11.50	0.83
37	朱雪琴	有限合伙人	11.50	0.83
38	卞小剑	有限合伙人	11.50	0.83
39	刘拯	有限合伙人	11.50	0.83
40	龚佳炜	有限合伙人	10.00	0.73
41	欧应辉	有限合伙人	5.00	0.36
合计			**1,377.25**	**100.00**

5、长晶企达

截至本招股说明书签署日，长晶企达基本情况如下：

企业名称	扬州长晶企达投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022 年 5 月 23 日
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	杨国江
住所	扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路 195 号花都汇商务中心 6 号楼 15 室
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，长晶企达的合伙人出资构成如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	何增谊	有限合伙人	150.00	11.76
2	徐林海	有限合伙人	150.00	11.76
3	张文辉	有限合伙人	100.00	7.84
4	于圣武	有限合伙人	100.00	7.84
5	芮强	有限合伙人	100.00	7.84
6	田潇	有限合伙人	75.00	5.88
7	张淑真	有限合伙人	75.00	5.88
8	李全	有限合伙人	50.00	3.92
9	杨国江	普通合伙人	45.00	3.53
10	罗飞	有限合伙人	40.00	3.14
11	李文强	有限合伙人	40.00	3.14
12	孙瑞	有限合伙人	30.00	2.35
13	戴亮	有限合伙人	30.00	2.35
14	张鑫	有限合伙人	25.00	1.96
15	徐海军	有限合伙人	25.00	1.96
16	李兴海	有限合伙人	25.00	1.96
17	刘琴	有限合伙人	25.00	1.96
18	黄伟	有限合伙人	25.00	1.96
19	蒋敏军	有限合伙人	25.00	1.96
20	芮聪	有限合伙人	20.00	1.57
21	孙杰	有限合伙人	20.00	1.57
22	李胜兵	有限合伙人	20.00	1.57
23	程晓云	有限合伙人	17.50	1.37
24	张丽萍	有限合伙人	17.50	1.37

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
25	韩宝新	有限合伙人	15.00	1.18
26	侯立磊	有限合伙人	15.00	1.18
27	张正贵	有限合伙人	10.00	0.78
28	周琦	有限合伙人	5.00	0.39
合计			**1,275.00**	**100.00**

6、晶智众达

截至本招股说明书签署日，晶智众达基本情况如下：

企业名称	南京晶智众达企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2025-05-20
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	夏昊天
住所	江苏省南京市江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 D 座 1668 室
经营范围	一般项目：企业管理；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，晶智众达的合伙人出资构成如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨国江	有限合伙人	1,040.00	33.33
2	彭松林	有限合伙人	520.00	16.67
3	杨波	有限合伙人	260.00	8.33
4	夏昊天	普通合伙人	156.00	5.00
5	黄乃仪	有限合伙人	130.00	4.17
6	何增谊	有限合伙人	104.00	3.33
7	邓巍	有限合伙人	104.00	3.33
8	李澄	有限合伙人	104.00	3.33
9	周明	有限合伙人	78.00	2.50
10	纪宠明	有限合伙人	78.00	2.50
11	陈平晶	有限合伙人	62.40	2.00
12	芮强	有限合伙人	52.00	1.67
13	张鑫	有限合伙人	52.00	1.67
14	刘锋	有限合伙人	52.00	1.67
15	高新明	有限合伙人	52.00	1.67
16	刘永锋	有限合伙人	52.00	1.67

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
17	刘琴	有限合伙人	41.60	1.33
18	赖松	有限合伙人	26.00	0.83
19	王歆悦	有限合伙人	26.00	0.83
20	金琼	有限合伙人	26.00	0.83
21	田潇	有限合伙人	26.00	0.83
22	刘辉军	有限合伙人	26.00	0.83
23	赵亚飞	有限合伙人	26.00	0.83
24	皮孟月	有限合伙人	26.00	0.83
合计			**3,120.00**	**100.00**

（二）股权激励计划的基本内容

1、南京江澄

（1）基本内容

根据南京江澄《合伙协议》的约定，在发行人完成首次公开发行股份并上市前，除非得到执行事务合伙人的同意，有限合伙人不得向发行人员工以外的任何第三方转让其持有的合伙权益。在发行人完成首次公开发行、且在南京江澄的法定锁定期届满后，有限合伙人可以通过南京江澄转让其间接持有的发行人权益。

（2）锁定期

持股平台的锁定期以南京江澄出具的承诺函以及相关法律法规的要求为准。南京江澄关于股份锁定的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（3）员工离职后的股份处理

有限合伙人发生离职或被普通合伙人认定视为离职的情形（“离职转让”），普通合伙人有权要求该等有限合伙人在离职转让事由发生日的三十（30）天内签署所有必要的协议、进行所有必要的行为，将其所持全部或部分合伙权益转让与普通合伙人或其指定的主体。

2、上海观成

（1）基本内容

根据上海观成《合伙协议》的约定，在发行人完成首次公开发行股份并上市前，除非得到执行事务合伙人的同意，有限合伙人不得向发行人员工以外的任何第三方转让其持有的合伙权益。在发行人完成首次公开发行、且在上海观成的法定锁定期届满后，有限合伙人可以通过上海观成转让其间接持有的发行人权益。

（2）锁定期

持股平台的锁定期以上海观成出具的承诺函以及相关法律法规的要求为准。上海观成关于股份锁定的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（3）员工离职后的股份处理

有限合伙人发生离职或被普通合伙人认定视为离职的情形（“离职转让”），普通合伙人有权要求该等有限合伙人在离职转让事由发生日的三十（30）天内签署所有必要的协议、进行所有必要的行为，将其所持全部或部分合伙权益转让与普通合伙人或其指定的主体。

3、傅传企管、长晶企达

（1）基本内容

根据傅传企管和长晶企达《合伙协议》的约定，在发行人完成首次公开发行股份并上市前，除非得到执行事务合伙人的同意，有限合伙人不得向发行人员工以外的任何第三方转让其持有的合伙权益。在发行人完成首次公开发行、且在有限合伙企业所持发行人股份的法定锁定期（如有）届满后，有限合伙人可以通过有限合伙企业转让其间接持有的发行人权益。

（2）锁定期

持股平台的锁定期以傅传企管和长晶企达出具的承诺函以及相关法律法规的要求为准。傅传企管和长晶企达关于股份锁定的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持

股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（3）员工离职后的股份处理

有限合伙人持有本合伙企业合伙份额期间，发生下列情形之一的，执行事务合伙人有权要求该等有限合伙人在强制退伙事由发生日的十（10）天内签署所有必要的协议、进行所有必要的行为：①自然人合伙人不再和目标公司（含其下属子公司）具有劳动合同关系或聘用关系的；②合伙人不具备法律、法规规定的间接持有发行人股份的股东资格；③自然人合伙人 2022 年、2023 年、2024 年考核结果未能达到发行人预期目标的，执行事务合伙人或其指定第三方有权根据目标公司考核结果及指令按照本条约定价格进行回购；④若发行人为了遵守适用法律的目的（包括但不限于由于发行人启动上市计划或上市方案调整等）或其他合理目的（包括但不限于经发行人有权机关批准的股权架构调整、重大资产重组等原因）需对本合伙企业架构进行调整的，具体以发行人认定为准，但发行人应当说明具体情形及原因。

4、长晶佳瑞

（1）基本内容

根据长晶佳瑞《合伙协议》的约定，在发行人完成首次公开发行股份并上市前，除非得到执行事务合伙人的同意，有限合伙人不得向发行人员工以外的任何第三方转让其持有的合伙权益。在发行人完成首次公开发行、且在长晶佳瑞的法定锁定期届满后，有限合伙人可以通过长晶佳瑞转让其间接持有的发行人权益。

（2）锁定期

持股平台的锁定期以长晶佳瑞出具的承诺函以及相关法律法规的要求为准。长晶佳瑞关于股份锁定的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（3）员工离职后的股份处理

有限合伙人持有本合伙企业合伙份额期间，发生下列情形之一的，执行事务合伙人有权要求该等有限合伙人在强制退伙事由发生日的十（10）天内签署所有

必要的协议、进行所有必要的行为：①自然人合伙人不再和目标公司（含其下属子公司）具有劳动合同关系或聘用关系的；②合伙人不具备法律、法规规定的间接持有发行人股份的股东资格；③若发行人为了遵守适用法律的目的（包括但不限于由于发行人启动上市计划或上市方案调整等）或其他合理目的（包括但不限于经发行人有权机关批准的股权架构调整、重大资产重组等原因）需对本合伙企业架构进行调整的，具体以发行人认定为准，但发行人应当说明具体情形及原因。

5、晶智众达

（1）基本内容

根据晶智众达《合伙协议》的约定，在发行人完成首次公开发行股份并上市前，除非得到执行事务合伙人的同意，有限合伙人不得向发行人员工以外的任何第三方转让其持有的合伙权益。在发行人完成首次公开发行、且在有限合伙企业所持发行人股份的法定锁定期（如有）届满后，有限合伙人可以通过有限合伙企业转让其间接持有的发行人权益。

（2）锁定期

持股平台的锁定期以晶智众达出具的承诺函以及相关法律法规的要求为准。晶智众达关于股份锁定的承诺参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

（3）员工离职后的股份处理

有限合伙人持有本合伙企业合伙份额期间，发生下列情形之一的，执行事务合伙人有权要求该等有限合伙人在强制退伙事由发生日的十（10）天内签署所有必要的协议、进行所有必要的行为：①自然人合伙人不再和目标公司（含其下属子公司）具有劳动合同关系或聘用关系的；②合伙人不具备法律、法规规定的间接持有发行人股份的股东资格；③自然人合伙人 2025 年、2026 年、2027 年考核结果未能达到发行人预期目标的，执行事务合伙人或其指定第三方有权根据目标公司考核结果及指令按照本条约定价格进行回购；④若发行人为了遵守适用法律的目的（包括但不限于由于发行人启动上市计划或上市方案调整等）或其他合理目的（包括但不限于经发行人有权机关批准的股权架构调整、重大资产重组等原

因）需对本合伙企业架构进行调整的，具体以发行人认定为准，但发行人应当说明具体情形及原因。

（三）发行人股权激励计划实施情况及对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

1、对公司经营状况的影响

通过实施股权激励，公司建立、健全了激励机制，充分调动了公司中高层管理人员及骨干员工的工作积极性，有利于稳定核心团队和业务骨干，进一步提高公司凝聚力。

2、对公司财务状况的影响

公司根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《股份支付准则应用案例》《监管规则适用指引——发行类第 5 号》等相关规定，就股权激励事项按照股份支付进行会计处理。公司以历次股权激励最近一次外部投资者增资价格为依据确定权益工具的公允价值，并将股份支付费用在等待期内进行分期摊销。

报告期内，公司对员工实施股权激励所确认的股份支付费用分别为 1,561.99 万元、4,880.38 万元和 3,387.99 万元，不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

3、对公司控制权的影响

股权激励实施前后，公司控制权未发生变化。

（四）上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，发行人不存在本次发行申报前已经制定并将于上市后行权的股权激励计划。

十九、发行人员工情况

（一）发行人员工构成情况

1、员工人数及其变化情况

2023 年末、2024 年末和 2025 年末，发行人及其子公司员工人数合计分别为 1,590 人、1,767 人和 1,967 人。

2、员工结构

截至报告期末，发行人员工结构情况如下：

（1）专业结构

专业类别	人数（人）	占总人数的比例（%）
管理及行政人员	318	16.17
销售人员	241	12.25
研发人员	305	15.51
生产人员	1,103	56.08
合计	**1,967**	**100.00**

（2）学历结构

学历	人数（人）	占总人数的比例（%）
硕士及以上	82	4.17
本科	626	31.83
专科	488	24.81
高中、中专及以下	771	39.20
合计	**1,967**	**100.00**

（3）年龄结构

年龄	人数（人）	占总人数的比例（%）
30 及 30 岁以下	695	35.33
31 岁至 40 岁	871	44.28
41 岁至 50 岁	342	17.39
50 岁以上	59	3.00
合计	**1,967**	**100.00**

（二）发行人执行社会保障制度、住房公积金制度情况

公司已按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方政府的有关规定，与员工签订劳动合同，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家及各地市的有关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。

发行人及其子公司在报告期内的社保和住房公积金的缴纳情况如下：

单位：人

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
员工总人数	1,967	1,767	1,590
社会保险缴纳人数	1,963	1,753	1,568
住房公积金缴纳人数	1,944	1,747	1,570
缴纳社保人数占员工总人数比例	**99.80%**	**99.21%**	**98.62%**
缴纳住房公积金人数占员工总人数比例	**98.83%**	**98.87%**	**98.74%**

报告期内，发行人及其子公司未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的主要原因为：（1）新入职员工待办理相关手续后于次月补缴当月社会保险或住房公积金，或其当月社会保险或住房公积金已由前任职单位缴纳；（2）退休返聘的员工，无需缴纳社会保险或住房公积金；（3）少量员工自愿放弃缴纳社会保险或住房公积金；（4）外籍员工无需在中国大陆缴纳住房公积金。

（三）合法合规证明和实际控制人出具的承诺

1、合规证明情况

报告期内，发行人及其子公司未因社会保险和住房公积金缴纳事宜受到相关主管部门处罚，并取得了发行人及子公司专项信用报告（无违法违规版）和境外律师事务所出具的境外法律意见书。

2、实际控制人承诺

发行人实际控制人杨国江已出具承诺：“（1）公司及其控制的境内子公司、分支机构未曾就社会保险金及住房公积金缴纳事宜受到社会保障部门、住房公积金部门的行政处罚，亦未就该等事宜与其员工发生任何争议、纠纷；（2）本人将敦促公司及其控制的境内子公司、分支机构按照法律、法规及其所在地政策规定，为全体符合要求的员工开设社会保险金账户及住房公积金账户，缴存社会保险金及住房公积金；（3）若公司及其控制的境内子公司、分支机构被有关政府部门司法机关依法认定或被公司及其控制的境内子公司、分支机构的员工本人合法要求补缴或者被追缴本次发行及上市前应缴而未缴、未足额为其全体员工缴纳和代扣代缴各项社会保险金及住房公积金，或因此被有关部门处以罚款、滞纳金或被追究其他法律责任，本人将承担所有补缴款项、罚款、滞纳金及其他支出，并承诺此后不向公司及其控制的境内子公司、分支机构追偿，保证公司及其控制的境内

子公司、分支机构不会因此遭受损失，确保公司及其控制的境内子公司、分支机构免受任何损失和损害。”

第五节 业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

（一）公司经营的主要业务和主要产品或服务

1、主营业务基本情况

长晶科技是一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。公司具备上万种规格型号产品的量产能力，是国内产品门类最齐全、系列最丰富的分立器件与电源管理 IC 企业之一。公司自设立以来，以半导体产品研发、设计与销售为基础，凭借内生发展与外延并购双轮驱动，逐步实现了从 Fabless 模式到“Fabless+IDM”模式的演变，部分产品具备从产品定义设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。公司顺应全球半导体行业演进规律，在分立器件、电源管理 IC 领域确立了“平台化”、“一体化”战略发展宗旨。

分立器件是指具有单独功能且功能不能拆分的基本电子元件，属于半导体产业的基础元素；电源管理 IC 是将分立器件与其控制/接口/保护等电路集成在同一芯片的集成电路，是系统信号处理部分和执行部分的桥梁。

分立器件和电源管理 IC 是电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，主要承担电能的转换、分配、调节与保护等核心功能，在电路系统中发挥着不可替代的物理支撑作用，广泛渗透于国民经济与生产生活的各个应用领域，与负责信息处理的数字集成电路协同，共同构成了现代电子工业的硬件基础。我国作为世界第一制造大国和全球最大的能源市场，分立器件和电源管理 IC 的国产化直接关系能源利用效率和高端装备制造能力，分立器件和电源管理 IC 的快速发展对于国民经济和社会发展具有重大意义。近年来，随着新能源汽车、人工智能、机器人等行业的蓬勃发展，分立器件和电源管理 IC 作为电子信息产业的基石，产业支撑作用及价值重要性愈发提升。

当前，全球贸易摩擦与技术封锁持续加剧，地缘政治冲突对产业链供应链安全构成严峻挑战。2024 年 12 月，美国商务部将全球功率半导体龙头安世半导体

母公司闻泰科技列入“实体清单”；2025 年 9 月，在外部地缘政治升级及出口管制规则传导下，荷兰政府依托本国产业安全相关法规出台限制性行政命令，造成闻泰科技对安世半导体境外主体经营管控权利受限，引发全球分立器件产能供给波动，并对全球汽车等关键产业链造成阶段性扰动。在此背景下，推动我国分立器件与电源管理 IC 产业加速自主化进程，实现供应链自主可控、保障产业链安全稳定的战略意义愈发重大。

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”，是国内分立器件行业具有代表性的企业。公司主要产品及市场占有率在行业细分市场具有领先地位：（1）公司是国内二三极管产品的市场领先企业，根据中国半导体行业协会的证明，2024 年，公司二三极管合计销售规模在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 2 名，处于国内龙头地位；（2）在 MOSFET 产品领域，公司近年来收入快速增长，打造了第二增长曲线，自主研发的 CSP MOSFET 产品经江苏省工信厅鉴定为国内领先、国际先进水平，系公司实现国产自主创新的代表性产品。根据中国半导体行业协会证明，2024 年，公司 CSP MOSFET 市场占有率在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 1 名。

发行人始终注重技术研发与创新，具备独立的分立器件和电源管理 IC 设计能力，具有自主工艺技术平台。截至本招股说明书签署日，公司被评定为江苏省企业技术中心，设有江苏省工程技术研究中心、国家博士后工作站。同时，公司参与起草《半导体器件 金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的可动离子试验》等 7 项国标，以及《IGBT 器件结构及制备工艺通用技术要求》等 4 项团标，覆盖 MOSFET、IGBT、二三极管及第三代半导体等不同种类、不同材料的半导体分立器件。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有专利 244 项，其中发明专利 85 项，同时拥有主营产品相关集成电路布图设计 130 项。

经过多年的积累，公司已经成为一家综合性的半导体企业，具备以下优势：第一，产品体系完备，公司拥有上万种规格型号的丰富产品线，能够为下游客户提供系统级解决方案，满足不同客户的一站式采购需求；第二，应用领域广泛，公司产品成功应用于消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等数十个行业领域，积累了深厚的跨行业应用经验，减小对单一产品和单一市场

的依赖性；第三，客户基础深厚，公司产品已应用于国内外上千家下游终端厂商，覆盖多行业、领域代表性企业，如小米、三星、荣耀、传音控股、华勤技术、立讯精密、石头科技、格力电器、海尔智家、欣旺达、新能德、德赛电池、安克创新、麦格米特、创科实业（TTI）、泉峰控股、大疆创新、影石创新、中兴通讯、比亚迪、埃泰克、安瑞光电、德业股份、固德威等，多次被小米、传音控股、海尔智家、飞毛腿、德业股份、麦田能源等公司授予“优秀合作伙伴奖”、“卓越合作伙伴”、“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”等荣誉。



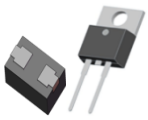
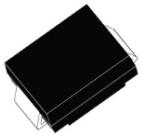
2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人营业收入分别为 22.60 亿元、26.78 亿元和 29.85 亿元，扣非后归母净利润分别为 1.24 亿元、2.18 亿元和 3.34 亿元，销售规模和盈利水平逐年上升。

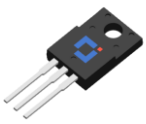
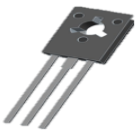
2、主要产品的基本情况

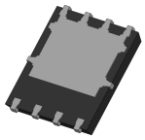
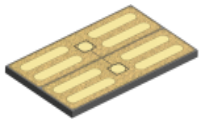
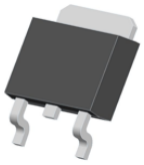
报告期内，公司营业收入主要来源于分立器件及其晶圆、电源管理 IC 产品，具体情况如下：

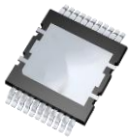
（1）分立器件

公司的分立器件包括二极管、三极管、MOSFET 和 IGBT 等，产品系列齐全，下游应用领域广泛，具体分类情况如下：

细分产品	型号规格	产品图示	功能用途	应用领域	具体典型应用
二极管	开关二极管		为在电路中实现“开”、“关”功能而特殊设计制造的一类二极管，主要用于信号控制、脉冲和开关电路中	消费电子、网络通讯、家电、安防、汽车电子、工业控制等	实现信号通断控制，典型用于手机信号控制、家电按键电路、汽车车灯信号等场景，用于完成信号切换与脉冲指令传输
	整流二极管		是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件，主要应用于家用电器、电力传输、无线充电等各类中低频整流电路中	电源、家电、电动工具、工业控制、汽车电子等	实现交流至直流的电能转换，典型用于充电器电源、空调供电板、车载电源等场景，为各类设备提供稳定直流供电
	稳压二极管		利用 PN 结反向击穿时电压基本不随电流变化而变化的特性来达到稳压目的的二极管，主要被作为稳压器或电压基准元件使用	电源、家电、安防、网络通讯、汽车电子等	稳定电路工作电压，典型用于路由器供电、行车记录仪、家电主板等场景，抑制电压波动，保障电子元器件稳定运行
	肖特基二极管（SBD）		以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管，具有反向恢复时间极短（可以小到几纳秒），正向导通压降更低（仅 0.4V 左右）的特点，在电源供应器、变频器辅源等中比较常见，主要承担高频整流、续流及防反接保护等功能	消费电子、家电、电源、电动工具、储能、光伏、汽车电子等	实现高频整流与防反接保护，典型用于手机快充、储能电源、汽车电路防护等场景，提升充电效率，规避电源反接导致的器件损坏
	瞬态电压抑制二极管（TVS）		是一种二极管形式的高效能保护器件。吸收瞬间大电流，将两端电压箝制在一个预定的数值上，从而对后面的电路进行保护	电源、家电、安防、网络通讯、汽车电子等	实现瞬态浪涌电压防护，典型用于汽车电源端口、安防电源模块、工业供电线路等场景，吸收瞬时高压冲击，实现电路安全防护
	静电保护二极管（ESD）		属于瞬态电压抑制器的一种，具有极快的响应时间和很低的结	消费电子、笔记本电脑、	实现静电与浪涌防护，典型用于手机充电口、电

细分产品	型号规格	产品图示	功能用途	应用领域	具体典型应用
			电容特性，实现静电防护、浪涌吸收等防过电压功能，对电源线、信号线、输入输出端口等进行保护	通讯接口、汽车电子等	脑接口、车载电子线路等场景，释放静电电荷，避免静电击穿电子元器件
	快恢复二极管（FRD）		属于 PIN 结型二极管，是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的二极管，主要应用于开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器等电子电路中，作为高频整流二极管、续流二极管使用	大功率电源、变频家电、光伏逆变器、充电桩、汽车电子等	实现高频整流与电流续流，典型用于快充电源、光伏逆变器、汽车电源模块等场景，适配高频供电环境，保障电流回路稳定
	碳化硅肖特基二极管（SiC SBD）		采用JBS/MPS两种结构基于第三代半导体材料重新定义的肖特基二极管，相较传统硅基 SBD 具备更高的击穿电压，更低的恢复损耗	功率电源、变频家电、光伏逆变器、电源、充电桩等	实现高压高频整流与低损耗续流，典型用于光伏逆变器、储能变流器、车载充电机、快充电源等场景，降低系统损耗，提升转换效率与功率密度
三极管	小信号三极管		采用小型平面结构，芯片尺寸小，依托低功耗结构实现小信号线性放大、电子开关控制、信号调制解调、阻抗匹配与信号整形，多用于毫安级微弱信号处理	消费电子、家电、工控、医疗等	实现微弱传感信号与音频信号放大，典型应用于便携数码、智能家居、工控采样板等
	功率三极管		大电流功率开关与功率放大器件，承载中大功率电能变换，兼顾线性放大与硬开关驱动，可实现负载通断与功率驱动	消费电子、家电、通信、工控、汽车、新能源电源等	实现大功率回路通断与功率变换，典型应用于变频白电、车载音响、工业焊机、无人机等
	数字晶体管		内置集成分压电阻，简化外围电路，专用于数字逻辑开关、电平匹配、数字信号缓冲	消费电子、工控、通信等	实现电平转换与逻辑通断，典型应用于机顶盒、智能仪表、工控板、通信模块等
	达林顿晶体管		两级晶体管复合结构，电流放大倍数极高，具备超大驱动能力，实现大负载低速	消费、工控、通信、医疗、新能源电源	实现小信号驱动大功率负载，典型应用于舞台功放、工业变频器、

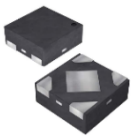
细分产品	型号规格	产品图示	功能用途	应用领域	具体典型应用
			开关与线性功率放大	等	车载负载驱动等
MOSFET	沟槽型MOSFET（Trench MOSFET）		中低压通用型高效功率开关。采用垂直沟道设计，提升沟道密度、缩小芯片尺寸，显著降低导通电阻与栅漏电荷密度，导通损耗、开关损耗更低，开关响应更快，适配中低压功率转换场景	消费电子、电源、安防、家电、电机、工控、手机通讯、AI服务器、汽车电子	实现中低压低损耗电源开关控制，典型用于手机快充、电机驱动、车载电源等场景，管控电源通断，降低功耗与发热损耗
	CSP MOSFET		采用芯片尺寸封装（CSP），显著减小器件体积，实现极低的热阻和寄生参数，优化导通电阻（RSS（on）），支持大功率充放电的电流回路开断，主要用于手机、可穿戴设备、移动电源等锂电池保护及便携快充场景	手机、可穿戴设备、移动电源等锂电池保护	实现小型化电池充放电保护，典型用于手机电池、穿戴设备、充电宝等场景，管控电池充放电过程，规避过充、过放风险
	屏蔽栅MOSFET（SGT MOSFET）		中低压高性能高频功率开关器件。基于屏蔽栅沟槽（Shield Gate Trench）技术，沟槽深度更深，特别适用于30V~300V电压应用领域，具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点。常用于中低压功率MOSFET领域，如手机快充、电机驱动、电源管理系统、汽车电子等	无人机、机器人、AI服务器、电动工具、家电、电源、安防、消费电子、汽车电子等	实现高频低损耗电源切换，典型用于无人机电机、手机快充、汽车电控等场景，完成高频电源开关，适配高频功率设备运行需求
	超结MOSFET（SJ MOSFET）		高压大功率高效功率开关器件。基于超级结（Super Junction）技术的MOSFET，基于电荷平衡技术理论，特别适用于500V~900V高压应用领域，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点。主要用于高压功率MOSFET领域，如光伏逆变器、	电源、充电桩、光伏逆变器、AI服务器等	实现高压大功率电源开关控制，典型用于新能源充电桩、光伏逆变器、服务器电源等场景，管控高压电路通断，适配高压大功率工况

细分产品	型号规格	产品图示	功能用途	应用领域	具体典型应用
			充电桩、电动汽车以及储能等领域		
	平面MOSFET（Planar MOSFET）		采用平面结构设计，工艺较为简单、制造工艺成熟。电压范围宽，可覆盖30V-1700V的电压段。具有耐压范围宽、易于驱动、安全工作区宽、抗雷击浪涌能力强的特点，但芯片面积较大，损耗较高，适配低成本、高可靠的基础功率场景	电源、工业控制、安防、消费电子等	实现高压耐压供电管控，典型用于工业电源、安防设备、大功率家电等场景，适配高压应用环境，保障设备供电稳定性
	碳化硅MOSFET（SiC MOSFET）		采用碳化硅材料制造的第三代半导体功率器件，采用3.0/3.5μm pitch平面栅结构设计，达到与Trench工作接近的功率密度，同时具备更强的抗冲击能力。电压覆盖650V-2300V，是中高频电源、储能等能源转系统未来的主要应用选择	服务器电源、充电桩、工业/消费电源、储能等	实现高效高压功率转换与高频控制，典型应用于新能源汽车、光伏逆变器、储能变流器、服务器电源等场景，适配高效、高频、高功率密度的应用需求
IGBT	绝缘栅双极型晶体管（IGBT）		中高压功率转换与变频控制核心器件，由栅极、集电极和发射极构成的三端复合型半导体器件，结合三极管与MOSFET的优势，具有高输入阻抗和低导通损耗特性，可广泛应用于小功率家用电器、分布式新能源设备及工业及车载小功率电机变频等	光伏逆变器、储能、充电桩、电源、汽车电子、家电、变频伺服等	实现中高压功率转换与变频调压，典型用于光伏逆变器、充电桩、空调变频板等场景，调节高压电流，完成设备变频控制

（2）电源管理 IC

公司电源管理 IC 产品包括线性稳压器、电压基准源、DC-DC 等产品。电源管理 IC 广泛应用于各类电子产品中，由于电子产品内部各电路模块的供电需求多样，需要使用电源管理 IC 将输入电源转换为与其匹配的电压。因此，电源管理 IC 的性能优劣对整机的性能及可靠性有直接影响。

公司主要电源管理 IC 分类情况如下：

细分产品	型号规格	产品图示	功能用途	应用领域	具体典型应用
电源管理 IC	线性稳压器		线性稳压器，应用于直流电路工作环境，起到线性降压的作用，并有效滤除噪音	手机、电池管理系统、家电，电动工具、工控机床、传感器、安防、汽车电子等	实现直流电压线性降压、滤除电路噪声，典型用于手机供电模块、家电控制主板、汽车电子传感电路等场景，为后端元器件提供低噪声稳定直流供电
	电压基准源		提供基准电压源的模拟 IC，具有不受电源和温度影响的功能，在电路中能提供稳定的电压	工业电源、适配器、AD/DA 转换器、仪器仪表、汽车电子等	输出不受电源、温度干扰的精准基准电压，典型用于工业电源采样、仪器仪表校准、汽车电控检测电路等场景，保障电压测量与信号采集精度
	DC-DC 开关转换器		利用电感和电容的储能特性，将输入电能通过开关变换和储能元件将能量传递到输出端，为负载提供能量	家电、机顶盒、网通、服务器、安防、手机、机器人，电池管理系统等	实现电能高效开关变换与能量传递，典型用于手机快充系统、服务器电源单元、机器人动力供电模块等场景，为各类负载高效供给稳定工作电能

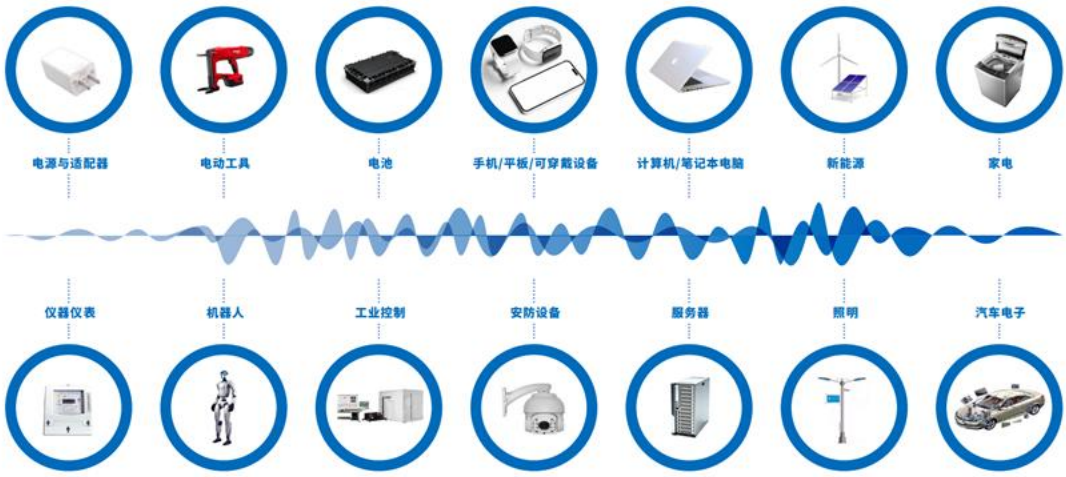
（3）晶圆

晶圆是根据设计出的电路版图使用专业制造设备，通过氧化扩散、光刻、刻蚀、薄膜生长、离子注入等工艺步骤，制造形成的具有特定功能的圆形晶片。

发行人子公司新顺微深耕晶圆制造领域二十余年，提供 16 大系列 1,000 多种不同规格、型号的产品，包括快恢复、沟槽肖特基、平面肖特基等各类二极管晶圆，高反压双极功率晶体管、集成电阻的功率晶体管、外延晶体管等三极管晶圆，以及 VDMOS 晶圆等，产品种类多、系列全，年产能约 180 万片，除满足发行人自身分立器件的部分晶圆制造需求外，同时对外形成一定规模的销售收入。

3、主要产品的下游应用领域

公司主营的分立器件和电源管理 IC 产品下游应用领域广泛，包括消费电子（具体包括手机、平板、可穿戴设备、笔记本电脑、家电等）、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等数十个行业领域。



公司产品在部分主要领域及重点发展领域应用的示意图如下：

（1）手机领域

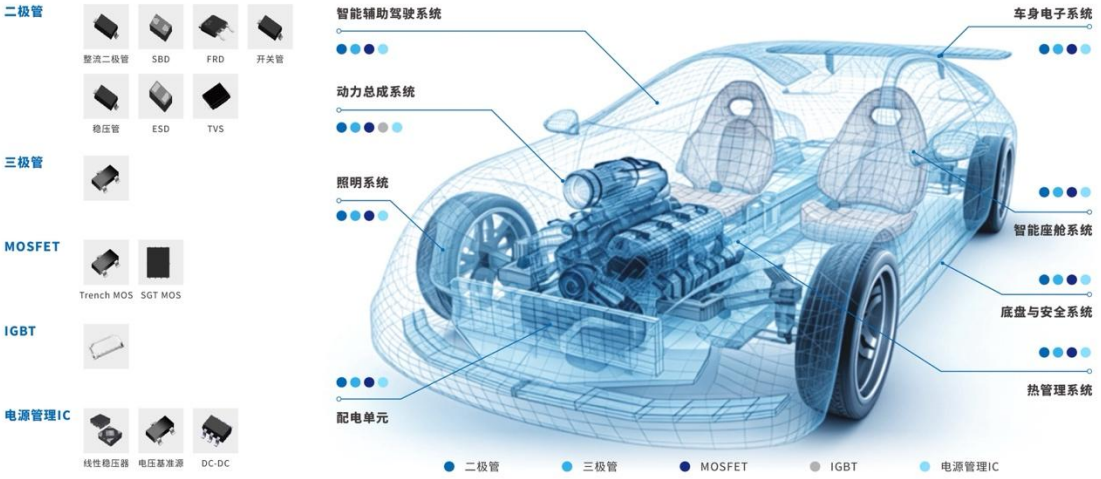


（2）家电领域





（3）汽车电子领域



（4）新能源领域



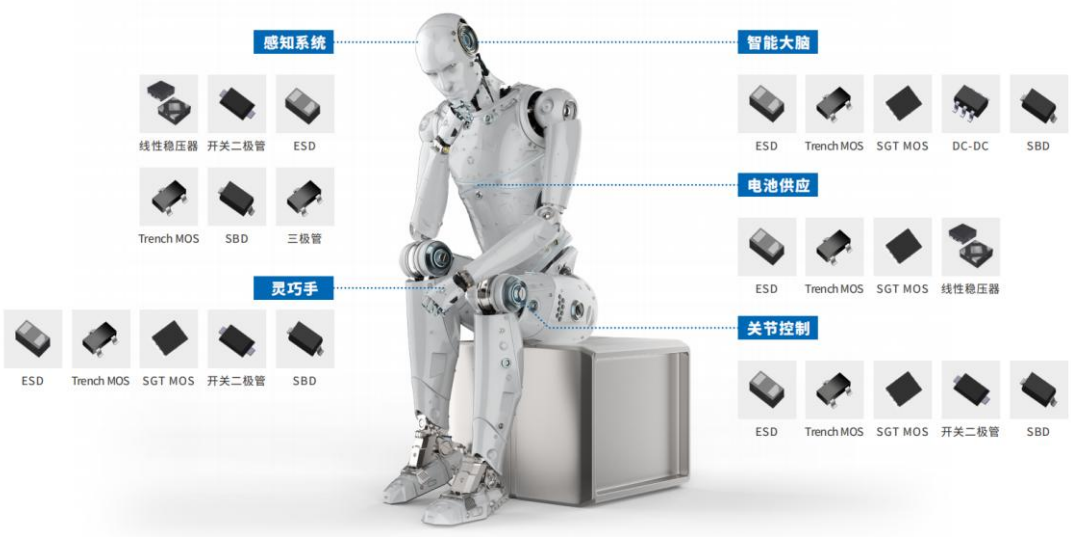
（5）电动工具领域



（6）服务器领域



（7）机器人领域



4、主营业务收入构成及特征

2023 年度至 2025 年度，公司主营业务收入主要来源于分立器件及其晶圆、电源管理 IC 产品，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分立器件	222,281.41	75.70%	194,327.57	73.59%	161,058.91	72.35%
其中：二极管	76,274.26	25.98%	67,688.36	25.63%	56,706.47	25.47%
三极管	60,650.34	20.65%	56,618.92	21.44%	48,377.15	21.73%
MOSFET	81,321.96	27.69%	65,383.41	24.76%	50,982.77	22.90%
其他分立器件	4,034.84	1.37%	4,636.88	1.76%	4,992.53	2.24%
电源管理 IC	23,877.36	8.13%	23,104.78	8.75%	20,521.30	9.22%
晶圆	46,634.34	15.88%	46,157.11	17.48%	40,670.55	18.27%
其他	844.62	0.29%	491.12	0.19%	369.77	0.17%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

2024 年以来，随着半导体产品库存去化，消费电子等下游需求量回暖，叠加新能源、汽车电子、人工智能等新兴应用持续扩容，功率半导体景气度持续提升，同时公司通过自主研发不断丰富产品种类，并拓展下游应用领域与客户群体，公司分立器件、晶圆、电源管理 IC 等产品的收入均呈增长趋势。

报告期各期，公司主营业务收入分别为 222,620.53 万元、264,080.57 万元和 293,637.74 万元，呈稳固增长趋势，主要系公司二三极管收入和 MOSFET 等分立器件产品收入增长所致：（1）对于二三极管产品，一方面，公司在二三极管领域处于国内龙头地位，产品品类齐全，基本覆盖所有二三极管品类，因此优先受益于市场整体回暖；另一方面，公司积极开发拓展肖特基二极管、快恢复二极管等产品，推动二三极管收入持续增长；（2）对于 MOSFET 产品，公司推出的 CSP MOSFET 产品实现技术突破和国产自主创新，销售收入快速增长，推动公司 MOSFET 收入持续增长。

（二）公司主要经营模式

报告期内，公司采用 Fabless 与 IDM 并行的模式开展业务，Fabless 和 IDM 均是半导体行业成熟的经营模式。

采用 Fabless 模式的半导体企业仅负责半导体产品的设计和销售，将制造、封测环节交由专业的半导体制造企业、封测企业完成，在资本投入、灵活性、市场适应性等方面具有优势，在追求先进制程迭代的逻辑芯片（如 CPU、GPU、SoC）领域占据核心地位，代表企业如英伟达、高通、AMD 等；而采用 IDM 模式的半导体企业同时拥有半导体设计部门、晶圆厂、封测厂，业务涵盖半导体设计、制造、封测以及后续的产品销售等环节，在工艺控制、供应链稳定性、利润空间和成本等方面具有优势，主要应用于分立器件、模拟芯片及存储芯片等对工艺定制化要求极高的领域，代表企业如英飞凌、安森美、安世半导体等。

报告期内，公司采用 Fabless 与 IDM 并行的模式开展业务，兼具灵活性与工艺稳定性，充分发挥两种模式的优势。

1、盈利模式

发行人是一家专业从事半导体产品研发、生产和销售的企业，主要通过向下游终端厂商或经销商等客户销售分立器件、电源管理 IC 和晶圆实现收入和盈利。

2、采购模式

报告期内，发行人采用 Fabless 与 IDM 并行的经营模式，两种模式下的采购形式如下：

（1）Fabless 模式下的采购模式

Fabless 模式下，公司同时存在“分别委托”和“集中委托”两种采购形式：“分别委托”主要为向晶圆制造商采购晶圆，向封测厂商采购封测服务，最终形成成品；“集中委托”主要为向同时具备晶圆、封测资源的供应商进行一站式采购，直接交付成品，从而有效减轻发行人供应链组织压力。

公司建立了标准化的采购流程，并制定了芯片采购计划编制及采购作业规范、封测服务采购制度、采购付款管理制度等程序文件对采购流程进行严格管理：

① 分别委托

晶圆采购：公司采购部门根据产品规划和销售计划编制采购计划，并基于晶圆供应商（含发行人晶圆子公司）的报价、品质、工艺、交货期分配采购比例、下单实施采购。晶圆供应商根据公司的产品设计要求、参数指标，按确认的交期

计划，将晶圆直接发往公司指定的外协封测厂商。封测厂商核对晶圆实物后，与公司采购部门确认并安排晶圆入库。采购部门根据入库信息与晶圆供应商定期对账、按合同约定支付货款。

封测采购：公司企划运营部门根据产品规划和销售计划，向封测厂商（含发行人封测子公司）提出委托加工计划、下达订单。封测厂商根据订单要求，领用公司提供的晶圆，组织封测生产工作。企划运营部门与封测厂商定期对账，根据生产加工数据、合同约定价款支付相应的封测服务费用。

② 集中委托

根据销售部门提出的销售计划，发行人采购部门负责向合格供应商执行“集中委托”采购。采购实施前，采购部门会与供应商签署相关协议，约定“集中委托”所涉及的产品参数、原辅料来源、生产工艺标准、产品构成成分等关键要素，并要求供方对发行人所提供的技术文件、工艺文件、设计文件、数据资料等信息予以保密。“集中委托”成品交付后，发行人质量部门会对产品的质量情况予以验证认定，经确认合格后安排入库，后由财务部根据合同约定支付采购价款。

（2）自产模式下的采购模式

此外，公司自产模式下（包含 IDM 模式及部分环节自产），公司晶圆制造子公司新顺微直接采购硅片等晶圆制造材料，封测子公司长晶浦联、海德半导体直接采购引线框架、塑封料等封测材料。公司已与合作供应商建立了紧密的合作机制，实现了生产采购计划的衔接和物流的顺畅对接。

3、生产模式

报告期内，发行人采用 Fabless 与 IDM 并行的经营模式，两种模式下的生产模式如下：

Fabless 模式下，公司主要将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给内外部的晶圆制造企业或封测企业完成。在委托外协生产中，公司企划运营部门根据合作外协厂商的产能情况分配订单，并监控外协生产计划的执行情况，具体参见本节之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（二）公司主要经营模式”之“2、采购模式”的相关内容。报告期内，公司持续深化与长电科技、芯联集成、力积电等重点供应商的合作关系，同时积极拓展新供应商，提升供应

链持续交付能力与生产组织能力。

自产模式下（包含 IDM 模式及部分环节自产），发行人生产型子公司新顺微、长晶浦联、海德半导体均采用“以销定产”与“安全库存”相结合的生产模式。其中，长晶浦联、海德半导体为发行人封测子公司，根据生产计划实施晶圆磨划、装片、焊线、包封、电镀、切筋/成型、测试等封测工序；新顺微作为发行人晶圆制造子公司，根据生产计划，以班组为单位执行清洗、扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长等晶圆制造工序。

4、销售模式

结合公司长期发展规划以及行业特点，公司目前采用买断式经销和直销相结合的销售模式。

（1）经销模式

公司采用买断式的经销模式，与经销商属于买卖关系。采取经销模式为半导体行业的通行惯例。公司主要产品分立器件、电源管理 IC 为国民经济的多个领域所必不可缺，下游应用领域十分广泛，面向的客户群体具有数量多、分布广、规模不一、需求变动大、订单较为零散等特点。经销商可凭借快速响应能力以及销售网络优势，迅速进入各细分行业和客户，有利于加速产品市场推广，使得公司集中优势资源进行新产品开发、技术创新和品质提升等。

（2）直销模式

公司面向部分终端厂商客户采取直销模式。通过面向下游品牌厂商的直销，公司可更好把握市场终端的趋势，提升面向终端客户的系统级产品开发能力和响应效率，提高服务的时效性，同时强化公司的品牌价值；通过与终端客户的直接合作，公司可为其提供前置化、专业化的技术支持，有利于增强客户粘性。

5、研发模式

（1）需求分析

发行人密切关注半导体行业和下游客户需求的发展趋势，结合市场未来需求，对新技术、新产品的开发需求进行确认，并执行可行性分析，判断是否执行新技术、新产品的开发任务。

（2）项目立项

公司研发项目主要采取项目负责人负责制。公司组建产品开发小组，编制项目立项报告，明确产品开发目标、创新点、技术指标、经费支出预算和未来量产效益测算。项目研发立项申请经审批通过后，产品正式进入设计和开发阶段。

（3）产品设计和开发

本阶段目标主要在于确定产品定义和设计方案。产品开发小组主导定义产品方案，初步确定产品设计文件。公司依照设计文件进行样品流片，并根据流片情况，执行失效分析与方案验证，持续修正产品设计方案，直至确认工程产品方案。

（4）产品验证

本阶段主要针对已经工程批功能验证通过的产品进行可靠性验证，并针对验证结果进行必要的分析和修正，确保产品设计理念以及客户需求能够在新设计产品当中得到最优体现。

（5）试生产与量产导入

本阶段目标主要在于量产前确认。公司通过试生产确定产品定义文件、生产控制计划后，正式执行量产导入。

（三）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司自成立以来的业务发展沿革演变如下：

1、业务继承与奠基阶段（2018 年末至 2020 年中期）

2018 年 12 月，长晶科技收购整合了原长电科技的分立器件自销业务，承继了其分立器件销售业务体系。在发展初期，公司以 Fabless 模式为起点，将核心资源集中于产品设计与销售环节。在此阶段，公司主要产品涵盖二极管、三极管、中低压沟槽 MOSFET 等分立器件，以及 LDO、三端稳压 IC、电压基准源等电源管理 IC 产品。

在业务继承与奠基阶段，公司顺利完成了人员团队、客户关系、供应链资源以及产品体系的过渡，为后续的组织架构建设、产业链整合、产品矩阵搭建奠定了基础。

2、产业链纵向整合与产品矩阵搭建阶段（2020 年中期至 2022 年）

随着市场需求的升级，产业链自主可控的必要性显现。为进一步强化对产业链的掌控力，2020 年 10 月及 11 月，公司先后收购海德半导体并投资成立长晶浦联，组建自主封装产线；2021 年，长晶浦联通线投产，SOT/SOD/TO/DFN/PDFN 等十余条封测产线相继建成。这一布局使公司经营模式从纯半导体设计延伸至封装领域，具备了部分产品的自主封测能力，形成了“研发设计+自主封测”的协同格局。2022 年 3 月，长晶科技收购拥有二十多年工艺积累的核心晶圆供应商新顺微，成功补齐了晶圆制造能力。至此，公司经营模式实现了从 Fabless 模式到“Fabless+IDM”模式的演变。

在产品维度，公司在保持二极管、三极管等传统产品优势的基础上，不断提升 FRD、SBD 等功率二极管的占比，并开发了 CSP MOSFET、SGT MOSFET、SJ MOSFET 等 MOSFET 产品，以及 DC-DC、锂电保护 IC 等集成电路产品，打开了新的业绩增长点。同时，依托新顺微的制造平台，公司业务版图进一步向产业链上游延伸，增加了晶圆产品的研发与销售。此外，公司开始研发布局 IGBT、第三代半导体等产品，进一步扩大产品矩阵。

在应用领域方面，公司开始加快向汽车电子等新兴领域的拓展，组建了专业的汽车电子事业部，加快二三极管、MOSFET 产品的车规化升级，并逐步导入比亚迪等知名汽车厂商。

在这一阶段，公司通过向晶圆制造、封装测试上游产业链延伸，实现了从 Fabless 模式到“Fabless+IDM”模式的演变；同时在保持二三极管优势的基础上，积极开发 MOSFET、IGBT、电源管理 IC 等产品，产品矩阵逐步扩展，为后续的快速增长奠定基础。

3、持续深化与业绩稳步增长阶段（2023 年至今）

在这一时期，公司持续深化 Fabless+IDM 的业务模式。2024 年，长晶浦联总占地 148 亩、总建筑面积约 12.9 万平方米的智能化封测工厂正式建成投用，车规级功率器件产能进一步扩充，同时新建 IGBT 功率模块产线，封装测试环节自主可控能力进一步提升。公司不断强化从产品设计、晶圆制造、封装测试全产业链的业务协同，提升了研发效率和工艺水平，降低了生产成本，市场竞争力进

一步增强。

组织架构方面，公司员工人数从成立初期以销售团队为主的 127 人发展至 2025 年 12 月 31 日的 1,967 人，逐步搭建了完善的组织架构，包括研发体系（包括器件研发部、IC 研发部等）、市场体系（包括二极管事业部、中低压事业部、高压事业部、IC 事业部、汽车电子事业部等）、营销体系（包括终端销售部、渠道销售部、海外销售部）、生产运营体系，以及质量、行政、财务、人事、IT 等支持部门。公司高度重视人才培养和团队建设，从国内外半导体龙头公司引进了一批核心人员，为公司持续发展提供充足的人才保障。

在产品维度，公司目前已拥有上万种规格型号的丰富产品线：

①公司 MOSFET 产品凭借自主创新实现收入快速增长，成为公司第一大收入来源。其中公司自主研发的 CSP MOSFET 于 2022 年实现规模化量产并持续迭代，成功应用于小米、三星、荣耀、传音等终端手机厂商，2024 年市场占有率达到全国第三、大陆品牌第一；公司 SGT MOSFET 产品于 2021 年实现大规模量产并持续迭代，2024 年至 2025 年相继发布第二代 SGT MOSFET（30V/40V/60V/85V/150V）平台，产品核心性能达到国际一线厂商水平，在中低压 MOSFET 细分市场建立起技术壁垒。

②公司二三极管通过工艺提升、成本优化、深化 IDM 模式，不断巩固市场地位；同时通过开发迭代功率 FRD 产品、功率 SBD 产品，不断扩大在电源、家电、新能源、服务器等领域的市场占有率。SBD 产品方面，公司于 2023 年实现平面 SBD、结势垒 SBD、沟槽 SBD 全系列量产，并于 2025 年发布 SiC SBD 产品；FRD 产品方面，公司与子公司新顺微协同研发，于 2024 年发布第四代 FRD 产品，产品性能大幅提升，达到国际一线厂商水平。

③公司于 2024 年发布第三代 IGBT 产品，部分产品性能可对标国际品牌最新代次产品，实现国产品牌大功率单管的突破，得到光伏储能等行业头部客户充分认可。

④IC 产品方面，公司在线性稳压器领域实现了通用类产品的全面覆盖，DC-DC 产品覆盖 5V-100V 并全面量产，同时布局 DrMOS、驱动芯片、运放与比较器、逻辑 IC 等产品线。

在应用领域方面，公司除了在消费电子、工业控制等领域持续深耕，提升市场占有率外，还积极开拓汽车电子、新能源、机器人及服务器等相关高端应用领域。例如，在汽车电子领域，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已推出超过 3,000 款通过 AEC-Q 认证的车规级产品，产品导入比亚迪、吉利、大众等整车厂，以及埃泰克（603293）、富特科技（301607）、安瑞光电、安波福（APTV）、安闻科技等汽车零部件厂商。在新能源领域，公司产品已在光伏储能、充电桩领域实现规模化量产，导入麦格米特（002851）、德业股份（605117）、麦田能源等知名客户。

在这一阶段，公司通过深化 Fabless+IDM 的业务模式，二极管、三极管、MOSFET、IGBT、电源管理 IC 等产品线多点开花，下游应用领域持续拓展并向高端化升级，实现了营业收入、毛利率、净利润的稳步增长。

（四）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况

发行人的主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。同时，公司依托 IDM 模式，具备晶圆和封测的全产业链经营能力。2023 年至 2025 年，发行人主营业务收入分别为 222,620.53 万元、264,080.57 万元和 293,637.74 万元，收入规模持续增长。

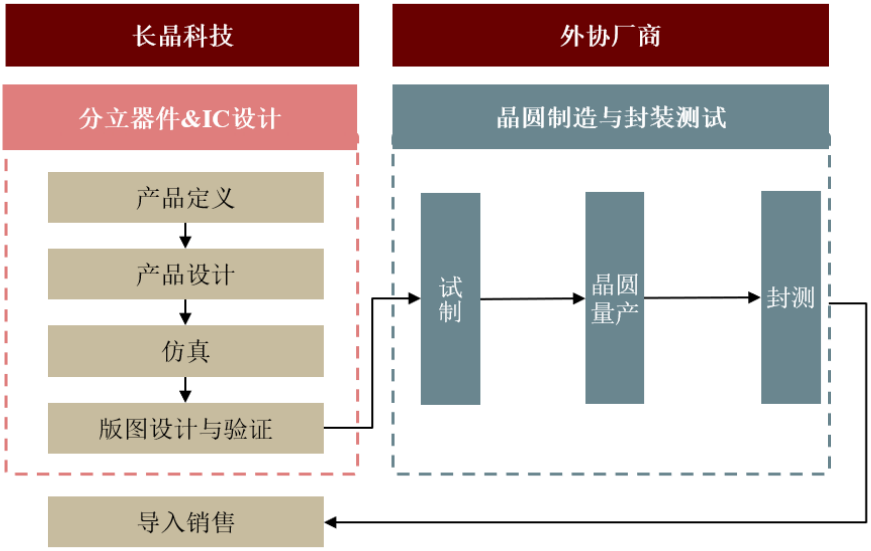
发行人高度重视核心技术的成果转化。公司以客户需求为导向、以市场趋势为基础推进研发工作，并以技术可行性、商业经济性为原则贯穿于研发活动的始终，从源头为核心技术产业化落地提供保障。公司的核心技术聚焦主营业务，具有较强的实用性和应用性，其产业化情况参见本节之“六、发行人的核心技术及研发情况”之“（一）核心技术情况”之“3、核心技术相关产品收入占营业收入比例”。

（五）公司主要产品的工艺流程图或服务的流程图

1、成品工艺流程

（1）Fabless 模式下工艺流程

Fabless 模式下，公司的主要经营活动为分立器件、电源管理 IC 的产品设计和销售，将晶圆制造、封装测试委托给外部第三方工厂执行，具体流程如下：



（2）IDM 模式下工艺流程

报告期内，公司在部分分立器件产品领域采用 IDM 模式经营，主要涉及主体及流程如下：

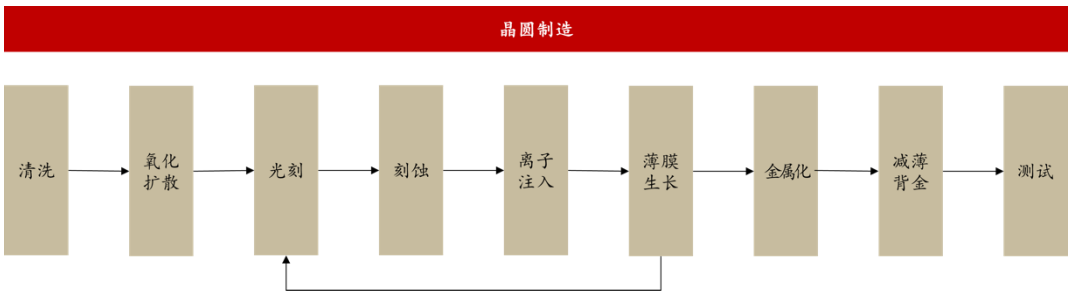


除上图列示的流程外，公司在实际经营过程中，会根据不同产品的型号、品质、产能、交期需求，灵活选择不同业务流程，如：向第三方购买晶圆并由长晶

浦联封装，或新顺微生产晶圆由外部封测厂进行封测等。

2、晶圆产品工艺流程

发行人子公司新顺微根据生产计划，以班组为单位对晶圆产品的生产执行以下工序：



3、核心技术的具体使用情况和效果

经过多年的发展，公司具备从半导体产品设计、晶圆制造到封装测试等全产业链的核心技术能力，有力地支撑了公司业务的发展，具体参见本节之“六、发行人的核心技术及研发情况”之“（一）核心技术情况”。

（六）报告期各期具有代表性的业务指标变动情况及原因

报告期内，公司专注于分立器件、电源管理 IC 的研发、生产和销售。报告期内，公司的产量销量、收入规模、盈利水平等代表性业务指标均得到较好的发展，相关业务指标情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”的相关内容。

（七）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

半导体产业作为现代信息技术产业的核心，是现代产业体系的重要组成部分，在国民经济中具有基础性、战略性地位，对推动其他产业的升级和发展起着关键作用。公司主营的分立器件和电源管理 IC 作为电子、电力设备中电能转换与电路控制的核心，是不可替代的基础性电子元器件，直接关系到一个国家能源利用效率和高端装备制造能力。

分立器件和电源管理 IC 与新质生产力的内涵要求高度契合。新质生产力是以科技创新为主导，实现关键性颠覆性技术突破，推动产业深度转型升级的新型生产力形态。在这一框架下，分立器件和电源管理 IC 通过提升能源转换效率、

支撑智能化转型和促进产业升级，成为新质生产力发展中的关键使能技术。近年来，随着新能源汽车、AI、机器人等行业的蓬勃发展，消费电子在 AI 技术革命和“两新”政策驱动下也在快速复苏，分立器件和电源管理 IC 作为电子信息产业的基石，其需求和重要性愈发显现，市场规模保持持续增长趋势。

发行人主营的分立器件和电源管理 IC 产品对应《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》电子核心产业中的新型元器件。同时，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确，为加快建设“数字中国”的目标，支持提升核心电子元器件的产业水平。“十五五”规划立足新型工业化建设与数字中国提质升级，聚焦关键半导体元器件国产突破，持续强化基础电子器件产业扶持力度。

二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

发行人是一家国内领先的综合型半导体企业，报告期内，公司主营业务收入以分立器件及其晶圆产品为主。根据上市公司行业分类相关规定，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017 年修订）》（GB/T4754-2017），公司所属行业为半导体分立器件制造，行业代码为“C3972”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”下属“电子核心产业”下属“新型电子元器件及设备制造”。

（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人的主要影响

1、行业主管部门及管理体制

公司所在半导体行业的政府主管部门为国家工业和信息化部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。行业内企业在主管部门的产业宏观调控、行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营和承担市场风险。

国家工业和信息化部主要负责事项包括：电子信息产品制造的行业管理；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技术推广

应用。

中国半导体行业协会作为行业自律组织和协调机构，下设集成电路分会、分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会、半导体支撑业分会等专业机构。半导体行业协会的主要职责包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展半导体产业的国际交流与合作等。

2、主要法律法规及产业政策

半导体产业是我国的国民经济支柱性产业之一，属于国家高度重视和鼓励发展的行业。为进一步鼓励国内半导体产业发展，增强科技竞争力，近年来国家相关部委出台了一系列政策法规来支持和引导半导体行业发展，主要政策如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
1	2026 年	国家发改委	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。 在集成电路领域，做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器。加快宽禁带半导体产业提质升级，推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化发展。
2	2025 年	国家工信部、市场监管总局	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	加强电子信息领域制造业创新中心等创新平台建设，强化行业关键共性技术供给。通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。面向产业实际需求，支持重点高校持续强化集成电路等电子信息重点学科建设。
3	2025 年	国家工信部、国家发展改革委、国家数据局	《电子信息制造业数字化转型实施方案》	重点支持新一代信息通信、集成电路、先进电池材料等作为主导产业的国家高新区及其他重点园区，加快先进计算中心、新一代移动通信、工业互联网等新型基础设施规模化建设应用，建设高标准数字园区。
4	2025 年	人力资源社会保障部等八部门	《关于推动技能强企工作的指导意见》	支持企业数字人才培育。聚焦大数据，人工智能，智能制造，集成电路，数据安全等领域挖掘培育新的数字职业序列。
5	2024 年	中央网信办、市场监管总局、国家工信部	《信息化标准建设行动计划（2024-2027 年）》	围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制，促进产业链协同发展。

序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
6	2024 年	市场监管总局、中央网信办等部门	《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025 年）》	强化关键技术领域标准攻关。在集成电路、半导体材料、生物技术、种质资源、特种橡胶，以及人工智能、智能网联汽车、北斗规模应用等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准。
7	2023 年	国家工信部、教育部、科技部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家能源局	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，支持特高压等新能源供给消纳体系建设。
8	2023 年	国家工信部、财政部	《关于印发电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案的通知》	梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。
9	2023 年	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	将“集成电路”、“新型电子元器件制造”列为鼓励类产业。
10	2023 年	国家工信部等五部门	《制造业可靠性提升实施意见》	重点提升高端通用芯片（如 SOC/MCU/GPU）、宽禁带半导体（如氮化镓/碳化硅）、传感器、射频器件等的可靠性。
11	2023 年	财政部 税务总局	《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》	2023 年至 2027 年，国家将对符合条件的集成电路企业（设计、生产、封测、装备、材料）实行增值税进项税额加计 15%抵减政策，由工信部等部门清单管理。企业需单独核算加计抵减额，不得用于出口业务，且不得与其他增值税优惠叠加享受。违规将依法处理。
12	2022 年	国务院办公厅	《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》	加大基础电子产业研发创新支持力度。统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制造业）升级及关键技术突破的支持力度。
13	2021 年	工信部、科技部、财政部等六部门	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	提出要“提高优质企业自主创新能力，……加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。”
14	2021 年	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	提出“实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。”“重点产品高端提升行动”中明确在电路类元器件中重点发展耐高温、耐高压、低损耗、高可靠分立器件及模块，小型化、高可靠、高灵敏度电子防护器件，高性能、多功能、高密度混合集成电路。

序号	发布时间	发布单位	政策名称	相关内容
15	2021 年	国家发改委	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	纲要指出，需要集中优势资源攻关多领域关键核心技术，其中集成电路领域包括集成电路设计工具开发、重点装备和高纯靶材开发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。
16	2020 年	中共中央办公厅、国务院	《国家信息化发展战略纲要》	制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
17	2020 年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。
18	2020 年	财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部	《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》	国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10%的税率征收企业所得税。

上述政策法规的发布和实践为半导体产业的发展提供了良好的政策环境，推动了近年来半导体产业的快速发展。

3、对发行人经营发展的影响

当前，政府在财税、投融资、研究开发、人才、市场应用等领域对半导体产业提供全方位的政策支持，为公司健康长远发展提供了有力保障。同时，在现有政策环境中，半导体产业链上下游蓬勃发展，进一步完善了我国半导体行业的专业化垂直分工和供应链配套能力，为发行人的发展创造了良好的经营环境。

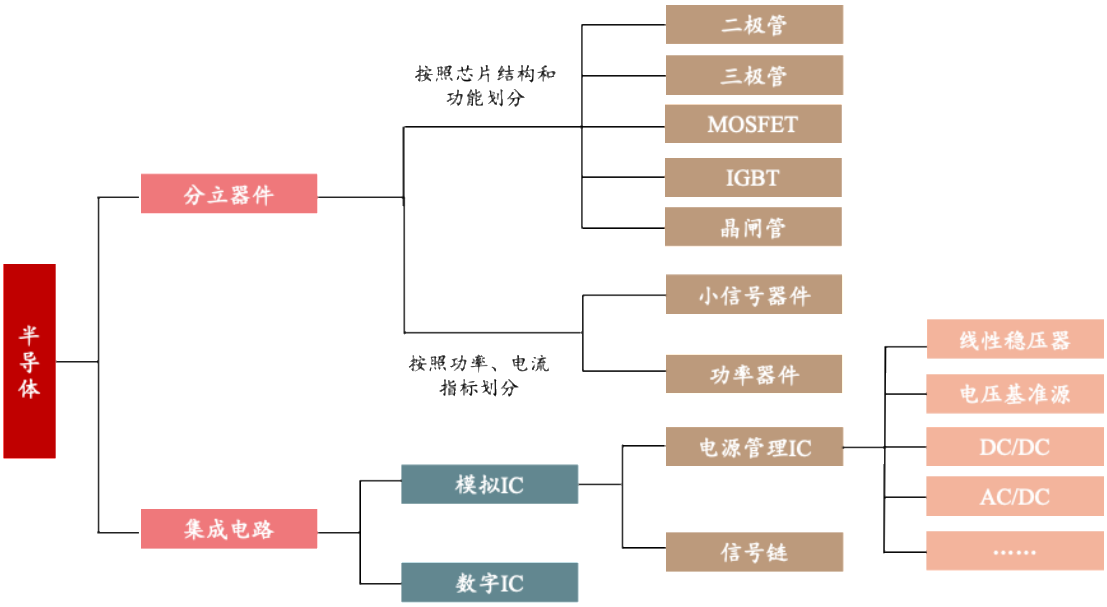
（三）所属细分行业产业链情况，在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

1、所属细分行业的概念和分类

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是众多电子产品的核心组成部分，是整个信息产业的发展基石，应用覆盖国民经济与居民日常生活各个领域。

半导体产业一般可分为集成电路和分立器件两类。集成电路（IC）是指采用

一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，形成特定功能的电路结构。分立器件是指具有单独功能且不能拆分的电子器件。二者有着不同功能特点和适用条件，共同构成半导体产业的基础。



注：长晶科技主要产品覆盖上图所示的分立器件及电源管理IC

半导体分立器件按照芯片结构和功能可区分为二极管、三极管、MOSFET、IGBT、晶闸管等；按照功率、电流指标又可划分为小信号器件及功率器件两大类。世界半导体贸易统计协会（WSTS）将小信号器件定义为耗散功率小于 1W（或者额定电流小于 1A）的分立器件，而耗散功率不小于 1W（或者额定电流不小于 1A）的分立器件则归类为功率器件。功率半导体包含功率器件（属于分立器件）和电源管理 IC（属于集成电路），主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。

（1）分立器件

分立器件是指具有单独功能的电子元件，用于电子、电力设备的整流、稳压、开关、混频等，是构成电力电子变化装置的核心器件之一，在消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等众多国民经济领域均有广泛的应用。

分立器件主要包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等产品，目前，二极管、三极管等分立器件在消费电子、工业控制等常规应用领域国产化率较高，但

在汽车电子等高端应用领域，仍以国际品牌为主导。MOSFET、IGBT 等分立器件产品受技术工艺壁垒影响，对外依存度仍然较高，未来国产自主创新空间广阔。

分立器件不同产品的特性和主要应用如下：

器件类型	核心驱动方式	核心特点	主要作用	市场定位
二极管	不可控型，单向导电	结构简单、可靠性高、成本极低，可实现单向电流导通与反向截止；但无开关控制能力，无法主动调节电路通断	主要实现整流、续流、稳压、静电防护等基础电路功能	全场景通用，是大部分电子电路的必备器件，市场覆盖范围最广
三极管	电流控制型开关器件	导通压降低、通态电流大、成本优势显著；但开关速度慢、工作频率低，存在二次击穿风险	主要实现信号放大、功率驱动、开关控制、稳压调整等电路功能	中小功率、低频场景的线性放大/小功率开关，典型应用于家电控制板、工业开关、汽车车灯控制等场景
MOSFET	电压控制型开关器件	开关速度极快、工作频率高、热稳定性好、无二次击穿风险；但在高压大电流场景效率大幅下降	主要实现高频功率开关、电源管理、信号放大、电机驱动等电路功能	中低压、高频场景的主力功率开关，是消费电子、工业控制、汽车电子的核心开关器件
IGBT	电压控制型开关器件	融合了三极管的低导通压降、高耐压大电流能力，与 MOSFET 的高开关速度、低驱动功耗特点，但在开关速度、低压场景适配性、热稳定性等方面不如 MOSFET	主要实现高压大功率开关、逆变转换、变频控制、功率调节等电路功能	中高压、大功率、中高频场景的核心功率开关/逆变器件，是工业、新能源、电网的核心开关器件

经过多年的发展，二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件不同细分产品并非呈现线性迭代的“替代关系”，而是凭借各自独特的电气性能与成本优势，在不同电压等级、电流容量、工作频率的场景中各司其职，形成长期共存、互补协同的产业格局，共同支撑起电力电子领域从低压小功率到高压大功率、从低频到高频的多元化应用需求。

（2）电源管理 IC

电源管理 IC 作为管理电子设备能量供应的心脏，主要负责电子设备所需电能的变换、分配、检测等管控功能。电源管理 IC 的性能优劣和可靠性对电子设备的性能和可靠性有着直接影响，因此在满足高稳定性、低功耗要求的同时，也需要依据下游应用场景进行定制化开发，因此产品种类繁多。

电源管理 IC 分为线性稳压器（包含 LDO 和三端稳压 IC）、电压基准源、

DC-DC（直流-直流）等类别。具体功能上：LDO 能实现高压转低压变换，其优点在于转化所产生的电压波形较为线性、稳定，可搭配多种元器件使用，用于后端稳定波形；三端稳压 IC，与 LDO 产品性能相似，但由于为双极型工艺制造，使用电流驱动模式，导致产品静态功耗通常高于采用 CMOS 工艺制作的 LDO；电压基准源是一种能提供稳定、精确、不随温度、负载、电源电压变化而波动的电压源，广泛应用于模数转换（ADC）、数模转换（DAC）、稳压电路、传感器电路等；DC-DC，可实现升压、降压、升降压转换，其工作效率较高，但缺点为转换后电压杂波较多，因此多会与 LDO 配合使用。

（3）晶圆

晶圆是根据设计出的电路版图，使用专业制造设备，通过氧化扩散、光刻、刻蚀、薄膜生长、离子注入等工艺步骤，制造形成的具有特定功能的圆形晶片。

2、所属细分行业的产业链情况

半导体产业链可以分为上游支撑、中游制造和下游应用，其中上游支撑主要包含半导体材料、半导体生产设备；中游制造包括芯片设计、晶圆制造和封装测试三大环节；下游应用覆盖消费电子、工业控制、汽车电子等领域。半导体产业链示意图具体如下：



目前半导体产业的经营模式主要可以分为 Fabless 模式和 IDM 模式。其中，在追求先进制程迭代的逻辑芯片（如 CPU、GPU、SoC）领域主要采用 Fabless 模式，而在分立器件、模拟芯片、存储芯片领域，头部厂商多采用 IDM 模式。

（1）Fabless 模式

Fabless 模式是半导体产业链分工细化后的一种经营模式，具体分工为无晶圆厂商（Fabless）、晶圆代工厂商（Foundry）和封装测试厂商。

无晶圆厂商只负责芯片的设计定义，根据下游市场及客户需求设计开发各类芯片产品，将晶圆制造、封装测试等环节外包。Fabless 模式的优势包括：为公司专注于研发创造条件，属于轻资产运营模式。该模式需要厂商与下游晶圆代工厂建立设计和制造方面的协同作用和良好的合作关系。

晶圆代工厂商可同时为多家芯片设计公司提供晶圆代工服务，帮助无晶圆厂商突破晶圆制造产能壁垒。晶圆代工厂商仅从事晶圆代工，不负责芯片设计。

封装测试厂商负责将生产加工后的晶圆进行切割、焊线、塑封，使电路与外部器件实现连接，并为芯片提供机械保护，同时利用专业设备对封装完毕的半导体成品进行功能和性能测试。

（2）IDM 模式

IDM 模式是集芯片设计、晶圆制造和封装测试等生产环节为一体的垂直整合模式。

IDM 模式的主要优势在于，通过公司内部资源的整合，可实现芯片设计、晶圆制造、封装测试等环节协同优化，根据客户需求进行高效的工艺开发，加速新产品研发周期，特别是流片的周期缩短，增强客户粘性。同时，IDM 模式推动公司研发与生产协同发展，更有利于技术积累、工艺沉淀与产品矩阵构建，从而形成更强的市场竞争力。

不同于数字芯片，分立器件及模拟 IC 不单纯追求摩尔定律，不追求先进制程和先进工艺，而强调设计、制造、应用的深度结合，因此更重视设计、晶圆制造和封装测试的一体化，以及专业人才的经验积累。目前，全球排名前列的分立器件或模拟 IC 半导体公司（如英飞凌、安森美、德州仪器等），普遍采用 IDM 模式，通过内部整合资源，形成产业链一体化竞争优势。

3、在产业链中的地位和作用

公司主营的分立器件和电源管理 IC 研发、生产和销售业务，其产业链上游

为半导体材料、半导体设备等支撑性行业，如果其采购价格发生波动，将会对发行人所属行业的利润水平产生影响；其产业链下游则分属于国民经济各个工业部门和社会生活的各个具体的应用场景，如消费电子、工业电子、汽车电子、新能源、数据中心服务器等。

近年来伴随电气化、人工智能趋势发展，全球经济中的“含硅量”持续提升，分立器件和电源管理 IC 行业在产业链中的地位和作用有了较大的提升和扩展，具体体现如下：

（1）消费电子

消费电子行业作为国民经济的重要组成部分，呈现出持续创新与快速迭代的发展态势。随着技术的不断进步，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等产品日益普及，且功能不断升级，从高清摄像、快速充电到 5G 通信、人工智能交互等，极大地丰富了消费场景。同时，消费者对产品的便携性、续航能力、智能化水平要求不断提高，推动着消费电子市场向更高质量、更个性化的方向发展。目前，消费电子行业已形成庞大的产业链体系，市场规模稳步增长，且新兴产品品类不断涌现，为行业持续注入活力。2024 年以来，伴随着 AI 技术的广泛应用、屏幕和电池续航等方面的进步，国内消费电子市场迅速回暖，以手机和平板电脑为例，2024 年中国智能手机市场出货量约 2.86 亿台，同比增长 5.6%，时隔两年触底反弹，2025 年中国智能手机市场出货量约 2.85 亿台，较 2024 年保持稳定；2024 年中国平板电脑全年出货量达 2,985 万台，同比增长 4.3%。家电领域，受到智能家居需求带动以及以旧换新政策推动，国家统计局数据显示，2025 年家电类商品零售额达 11,695 亿元，创历史新高。

分立器件和电源管理 IC 在消费电子领域应用广泛，核心是实现电能的转换、控制与保护，具体应用领域包括手机、平板、笔记本电脑、便携式设备、充电器、家电等，下游消费电子领域的复苏使得对分立器件和电源管理 IC 产品的需求量进一步上升。

（2）工业控制

工业控制行业是推动制造业转型升级的关键领域，随着新型工业化、智能制造等战略的深入实施，工业自动化、智能化水平不断提升。工业控制领域涵盖了

工业机器人、电动工具、自动化生产线、智能传感器、变频器等众多设备和系统，其核心是通过精准的控制和高效的运作，提高生产效率、降低能耗、提升产品质量。目前，行业正朝着数字化、网络化、智能化方向快速发展，对控制精度、响应速度、可靠性的要求日益提高，市场规模持续扩大。根据思瀚产业研究院预测，2024 年全球和我国工业自动化市场规模将分别达到 5,095.9 亿美元和 3,531 亿元人民币，较 2023 年分别同比增长约 6.0%、13.4%。

智能机器人产业正以前所未有的速度革新生产与生活方式。依托政策支持、技术创新及庞大内需市场，我国智能机器人产业已跻身全球竞争前列。据国际数据公司（IDC）最新预测，2026 年全球智能机器人硬件市场规模将接近 300 亿美元，其中中国市场规模有望突破 110 亿美元。智能机器人应用场景持续拓宽，已广泛覆盖工业制造、医疗服务、家庭服务、特种作业等领域，渗透深度不断提升。

分立器件和电源管理 IC 作为工业自动化控制产品内含的变频器、电机控制、逆变焊机、工业电源等组件中必备的电子部件，其市场规模将随着工业自动化的深化发展而快速增长。工业自动化控制行业发展为半导体产业的发展提供了广阔的下游市场空间。

（3）汽车电子

汽车电子行业随着汽车产业的电动化、智能化、网联化转型而迎来快速发展期。汽车电子涵盖了动力控制系统、车身控制系统、智能驾驶系统、车载信息娱乐系统等多个领域，其技术水平直接影响汽车的性能、安全性和智能化程度。目前，汽车电子在整车成本中的占比不断提高，且随着 5G、人工智能等技术的融入，汽车正逐渐成为一个移动的智能终端，行业发展前景广阔。

新能源汽车行业的迅速发展，为功率半导体行业带来大量新增需求。一方面，新能源汽车的渗透率不断提升，内部功率半导体使用数量快速增加；另一方面，随着电气化程度的提升，单车功率半导体价值量也不断增长。据 Strategy Analytics 数据统计，纯电动车型中的功率半导体价值占整体半导体价值比例约为 55%。2022 年新能源汽车的单车功率半导体价值量达 458.7 美元，约为传统燃油车的 5 倍。根据中国汽车工业协会的数据，2025 年，我国汽车产销量均突破 3,400 万辆，再创历史新高。其中新能源汽车产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比

分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车国内新车销量占比突破 50%，新能源汽车的快速发展将拉动对功率半导体的需求。

（4）新能源（光伏、储能、充电桩）

在全球能源转型战略深入推进的背景下，以光伏、储能、充电桩代表的新能源产业迎来历史性发展机遇。我国能源安全保障能力持续增强，绿色低碳转型步伐不断加快，为功率半导体市场开辟了广阔的增长空间。

光伏方面，我国为全球最大光伏市场，行业整体稳健发展。2025 年，全国光伏新增装机 3.17 亿千瓦，同比增长 14%；光伏发电量 1.17 万亿千瓦时，同比增长 40%。“十五五”期间，国内年均光伏新增装机预计可达 238GW 至 287GW，全球年均装机预计可达 725GW 至 870GW。伴随行业“反内卷”政策落地，光伏产业链价格企稳，行业迈入高质量发展阶段。

储能方面，全球储能行业呈爆发式增长，驱动逻辑由单一新能源消纳，升级为 AI 算力基建、能源转型刚需、电网阻塞改善三重驱动。预计 2026 年全球储能新增装机突破 438GWh，同比增长 62%，其中中国市场预计 2026 年装机达 250GWh，同比增长 67%。当前储能行业供需格局显著改善，行业景气度持续上行。

充电桩方面，国内充电基础设施体系持续完善，2025 年国内整体充电基础设施总功率约 3 亿千瓦，行业逐步向超快充、大功率方向迭代，对充电设备的转换效率、功率密度、运行可靠性提出更高要求。根据 QYResearch 数据，2025 年全球充电桩用功率器件市场规模 2 亿美元，预计 2032 年达 7.9 亿美元，2026-2032 年年复合增长率 22.0%，行业长期成长空间充足。

IGBT、MOSFET、碳化硅等功率半导体是光伏逆变器、储能变流器、充电桩设备的核心元器件，承担功率变换、能量传输核心功能，直接决定设备运行效率、稳定性及使用寿命。下游新能源领域（光伏、储能、充电桩）持续高景气，将持续拉动功率半导体产品的市场需求。

（5）数据中心服务器

在云计算、大数据与人工智能技术快速迭代的推动下，智慧城市、数字政府、工业互联网等应用场景加速普及，数据中心作为核心数字基础设施的建设需求持

续旺盛。伴随 AI 算力需求呈指数级增长，AI 服务器及数据中心已成为功率半导体领域增长最快的下游赛道之一。高算力芯片功耗不断上升、机柜功率密度持续提高，对供电系统架构提出更高要求，为功率半导体带来广阔的增量空间。

服务器作为数据中心的核心算力载体，负责执行具体的计算和存储任务，当前市场呈现传统服务器、云服务器、AI 服务器与边缘服务器协同发展的格局。目前，国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求高速增长，共同驱动算力革命，并助推 AI 服务器市场及出货量高速增长。根据 IDC 和浪潮信息发布的《2025 年中国人工智能计算力发展评估报告》，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1,251 亿美元，2025 年将增至 1,587 亿美元，2028 年有望达到 2,227 亿美元。其中，生成式人工智能服务器占比将从 2025 年的 29.6%提升至 2028 年的 37.7%。

以 SGT MOSFET、SJ MOSFET 为代表的分立器件在服务器电源供电、CPU/GPU 主板供电、同步整流、PFC、LLC、散热等服务器重要部件中有广泛应用，服务器电源对硅的替代也取得了进展。目前国产服务器厂商在全球市场份额占比超 35%，其市场规模及占有率的提升给中高端国产分立器件带来广阔空间。

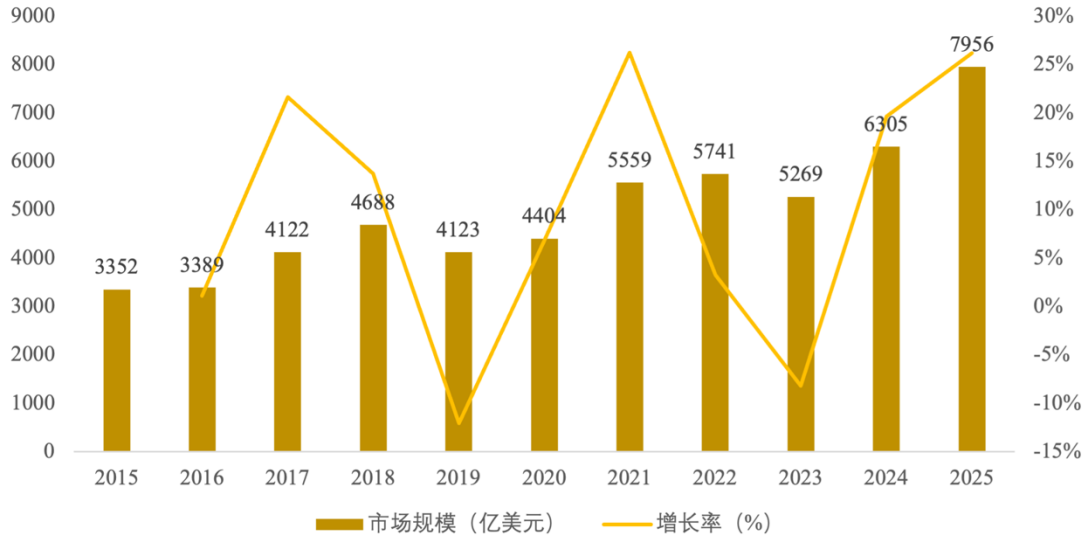
（四）半导体行业发展概况及发展态势

1、全球半导体市场基本情况

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2025 年全球半导体市场受到数据中心、AI 等领域的驱动，市场规模达到 7,956 亿美元，同比大幅增长 26.2%，创历史新高，WSTS 预测 2026 年全球半导体销售额将持续增长，超过万亿美元。

随着 AI、机器人等新一轮科技逐渐走向产业化，消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快，下游市场的革新升级将带动半导体市场规模持续增长。

2015-2025 年全球半导体市场规模及增速



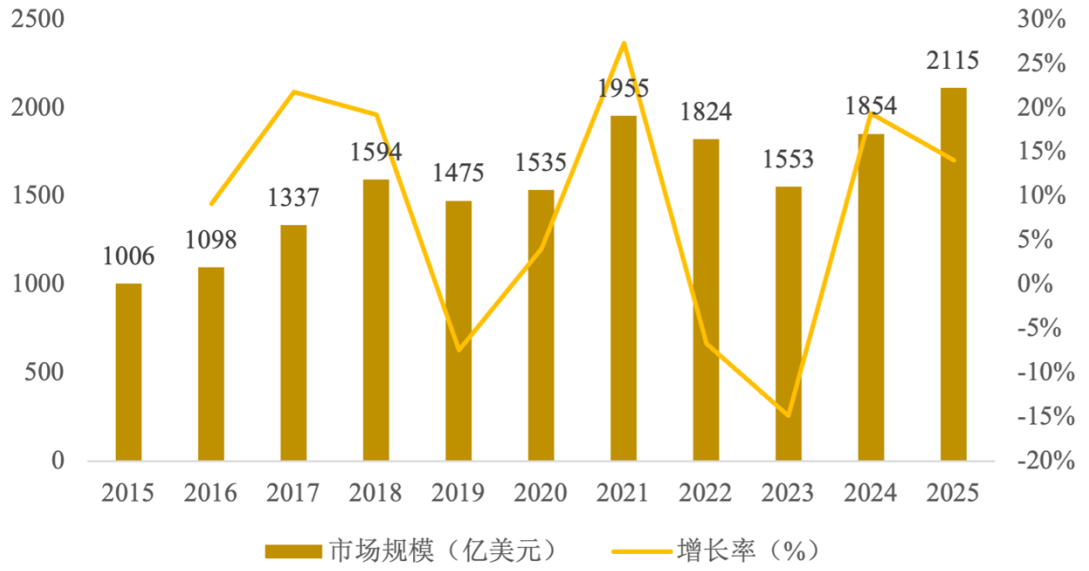
数据来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS）

目前半导体产业集中度较高。据 Gartner 统计，2025 年前十大半导体厂商的市场份额占比为 62.4%，其中主导企业为海外头部企业，包括英伟达、三星、SK 海力士、英特尔、美光、高通、博通等。海外企业布局半导体产业时间较早，行业内具备先发优势，同时通过收购整合的方式不断抢占市场份额，目前半导体市场主要由海外头部企业占据。

2、中国半导体市场基本情况

随着全球电子制造业产能向亚太地区集中，中国半导体产业持续保持高速增长。“十四五”期间政策红利持续释放，叠加“十五五”开局新质生产力培育要求，我国云计算、人工智能、物联网、大数据、智能电网、汽车电子、移动智能终端、网络通信等领域应用加速落地，带动半导体需求持续扩容，产业进入规模扩张与自主突破并行的关键发展期。根据世界集成电路协会（WICA）数据，2024 年中国半导体市场规模达到 1,854 亿美元，同比增长 19.4%，占全球半导体市场的比例约 30%。

2015-2025 年中国半导体市场规模及增速



数据来源：世界集成电路创新联盟（WICA）

目前我国的芯片设计、晶圆制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，产业集聚效应明显。随着新能源汽车、5G 等下游行业领域的市场销售稳定增长，加之 AI、机器人等新一轮技术革命和新应用驱动半导体市场需求急剧扩大，中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

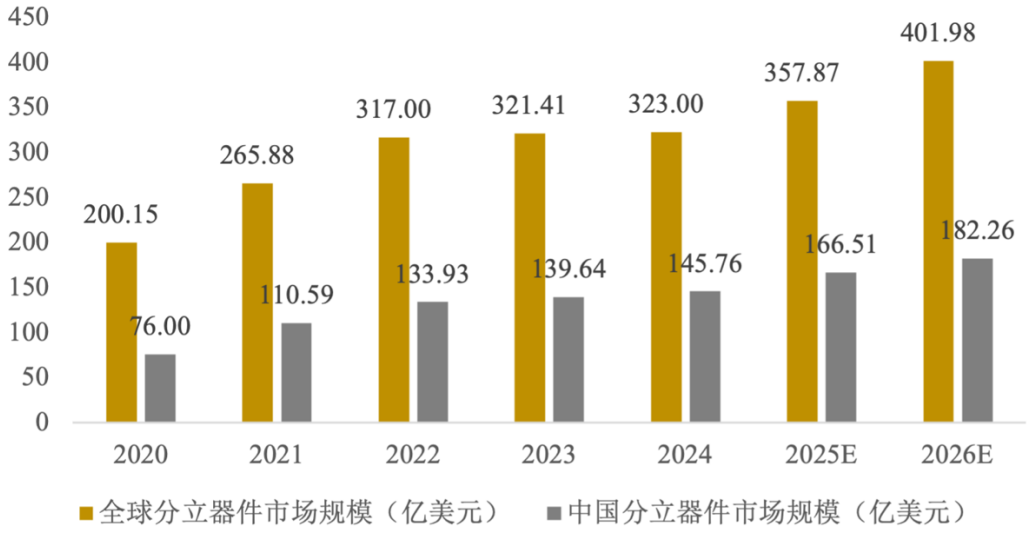
（五）所属细分行业发展概况及发展态势

发行人主营产品为分立器件、电源管理 IC 和晶圆，具体行业概况如下：

1、分立器件

分立器件市场前景广阔，根据芯谋研究数据，2024 年全球分立器件市场规模为 323.00 亿美元；中国分立器件市场规模为 145.76 亿美元，占全球比例为 45.13%，系全球第一大市场。近年来，受益于新能源汽车等下游市场的爆发，叠加国产自主创新趋势，中国分立器件市场规模持续增长。

2020-2026 年全球及中国分立器件市场规模



数据来源：WSTS、芯谋研究

从分立器件产品构成来看，市场主流分立器件包括 MOSFET、IGBT、二极管、三极管等。从需求端来看，分立器件受益于 AI、新能源、汽车电子、5G 通信射频等市场的发展，具有较大的发展前景。随着我国分立器件企业产品技术的不断提升，叠加地缘政治因素，国内的终端应用客户也更加趋向于实施国产化采购，给国内半导体分立器件企业带来更多的发展机遇。

随着国际电子制造产业的转移以及下游应用行业需求的拉动，我国分立器件行业近年持续保持较快的发展态势，后续市场空间广阔，增长潜力较大。从应用市场来看，分立器件在消费类电子、物联网终端、5G 商用、新能源、汽车电子等应用领域应用前景广阔。同时，在国际贸易摩擦和地缘政治等因素影响下，供应链自主可控的战略意义愈发凸显。中国分立器件企业凭借自身的优势，抓住契机，扩大市场份额，代表性企业包括华润微、士兰微、扬杰科技以及长晶科技等。

应用领域方面，经过多年持续发展，我国分立器件在消费级产品上正快速形成国产自主创新，但在高端工业、汽车等应用领域，还与国际领先水平存在一定的差距；产品类型方面，MOSFET、IGBT 等分立器件产品由于其技术及工艺的复杂性，我国与国际领先水平仍存在较大差距。

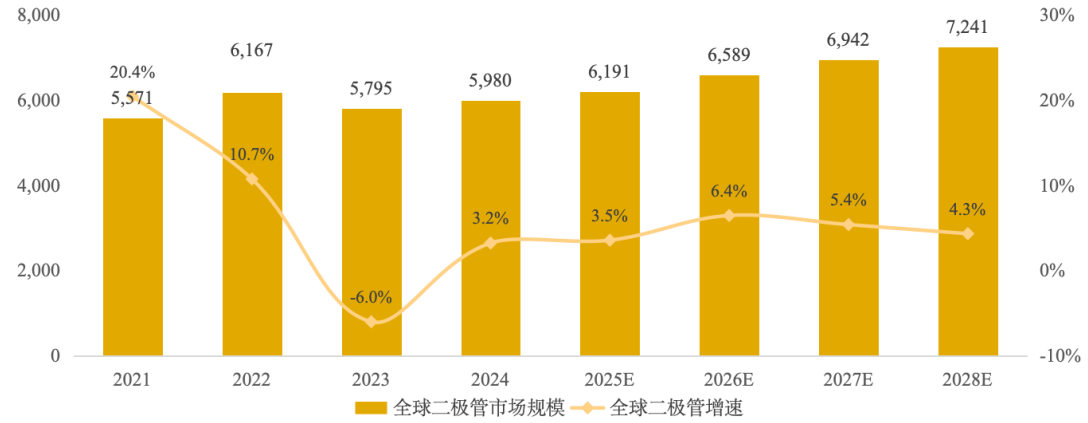
（1）二极管市场

二极管作为最基础的半导体分立器件，凭借单向导电的核心特性具备不可替代性，是各类电子设备、电力电子系统不可或缺的基础元件。其制造技术相对成

熟，但要求厂商具备大规模生产能力和稳定的质量保证，且在汽车电子、新能源、工业控制等特定细分领域，对产品的性能指标及电性参数提出了精细化、高可靠性需求。近年来，国内二极管厂商凭借成本较低、供给充足、质量稳定等优势，持续提升市场份额，在该领域率先完成国产自主创新和突破。

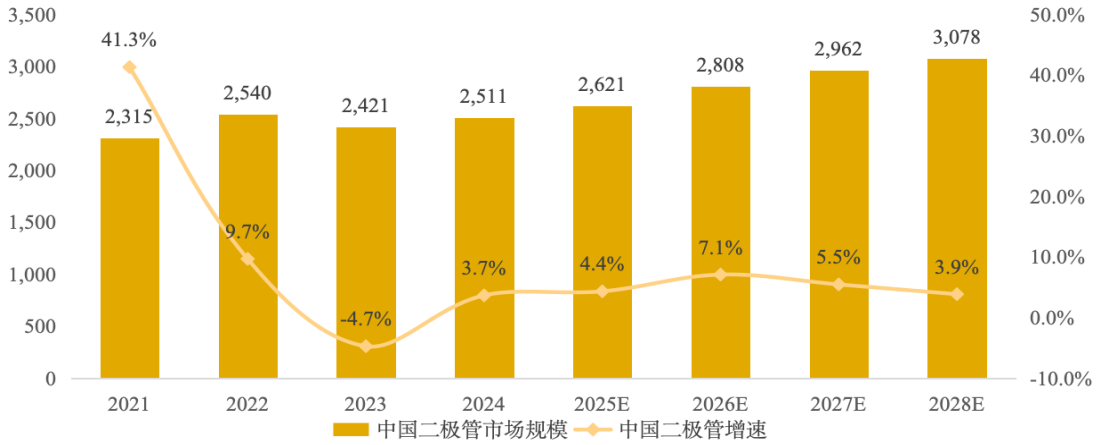
芯谋研究数据显示，2024 年度全球二极管市场规模达到 59.80 亿美元，其中中国二极管市场规模为 25.11 亿美元。未来四年内，全球及国内二极管市场规模则将呈现出稳步增长的趋势。

2021-2028 年全球二极管市场规模及预测（单位：百万美元）



数据来源：芯谋研究

2021-2028 年中国二极管市场规模及预测（单位：百万美元）



数据来源：芯谋研究

（2）三极管市场

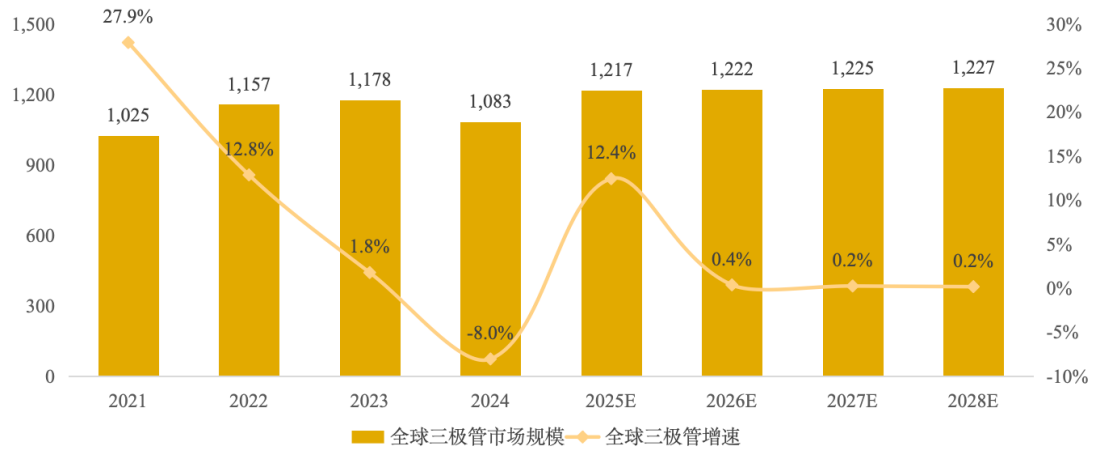
三极管作为一种传统分立器件，其产品结构简单、工艺成熟。由于三极管市场竞争充分，对厂商的规模生产、质量管理、成本控制、客户配套、品牌口碑等各方面的综合竞争力，提出了较高的要求。因此，新进入厂商在短期内难以形成

规模优势及客户优势。经过多年发展与积累，国内三极管厂商已取得较高的市场份额，并形成较充分的国产自主创新。

三极管作为电流控制型分立器件，核心优势是性价比突出、适配性强、驱动简单，尤其适合各类价格敏感的感性负载场景；虽然在超高频率、超低功耗的高端工况中不占优势，但凭借成熟稳定的电流驱动能力、高可靠性以及适配中低频大电流工作的特性，在消费电子、网络通讯、工业控制、安防设备等传统刚需领域，依旧拥有稳固的应用价值和稳定市场需求。

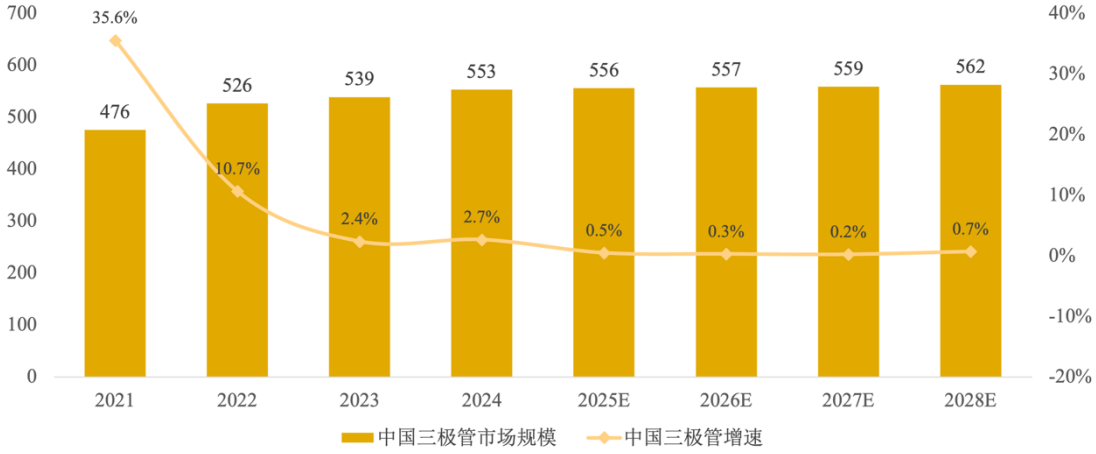
芯谋研究数据显示，2024 年度全球三极管市场规模达到 10.83 亿美元，其中中国三极管市场规模为 5.53 亿美元。未来四年内，全球及国内三极管市场规模整体处于平稳状态。

2021-2028 年全球三极管市场规模及预测（单位：百万美元）



数据来源：芯谋研究

2021-2028 年中国三极管市场规模及预测（单位：百万美元）



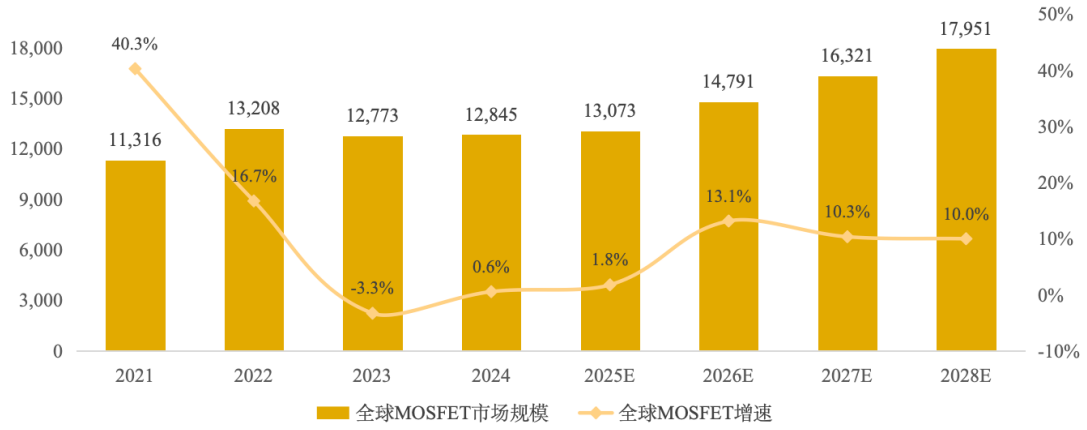
数据来源：芯谋研究

（3）MOSFET 市场

MOSFET 有着广阔的应用市场及发展前景。在消费电子领域，手机、穿戴式设备、智能家居等市场的发展持续带动 MOSFET 器件的市场需求；在汽车电子领域，MOSFET 器件在电动马达辅助驱动、电动助力转向及电机驱动等动力控制系统，以及电池管理系统等功率变换模块领域均发挥重要作用。MOSFET 作为分立器件中最核心的产品品类之一，其市场规模及占比均位居分立器件市场首位。

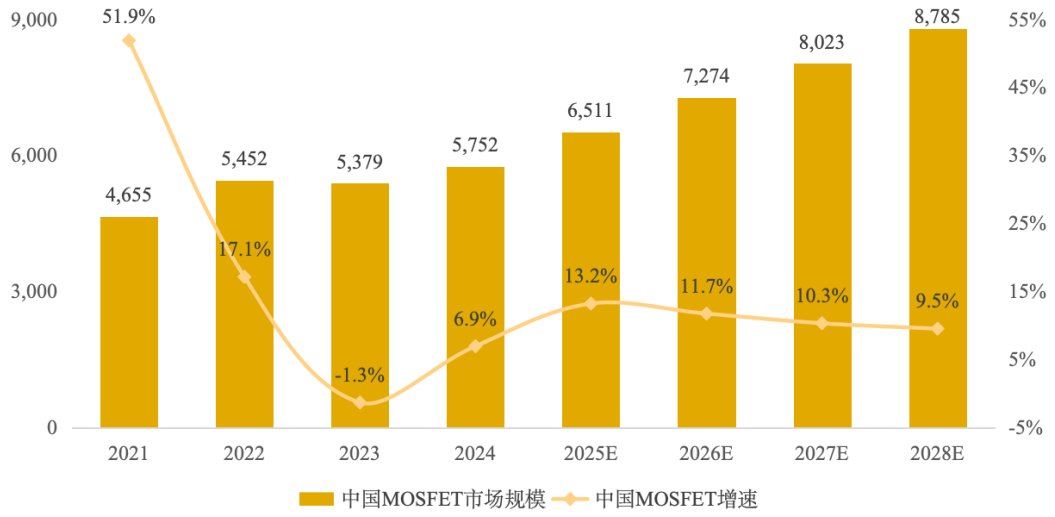
芯谋研究数据显示，2024 年度全球 MOSFET 市场规模高达 128.45 亿美元，在分立器件市场中占比高达 39.8%。其中中国 MOSFET 市场规模为 57.52 亿美元，占全球 MOSFET 市场规模的比例为 44.78%。未来市场趋势方面，芯谋研究预测，2025 年至 2028 年期间，全球和中国 MOSFET 市场规模将稳步攀升。受国产自主创新趋势带动，国内厂商在该领域有较大的发展空间。

2021-2028 年全球 MOSFET 市场规模及预测（单位：百万美元）



数据来源：芯谋研究

2021-2028 年中国 MOSFET 市场规模及预测（单位：百万美元）



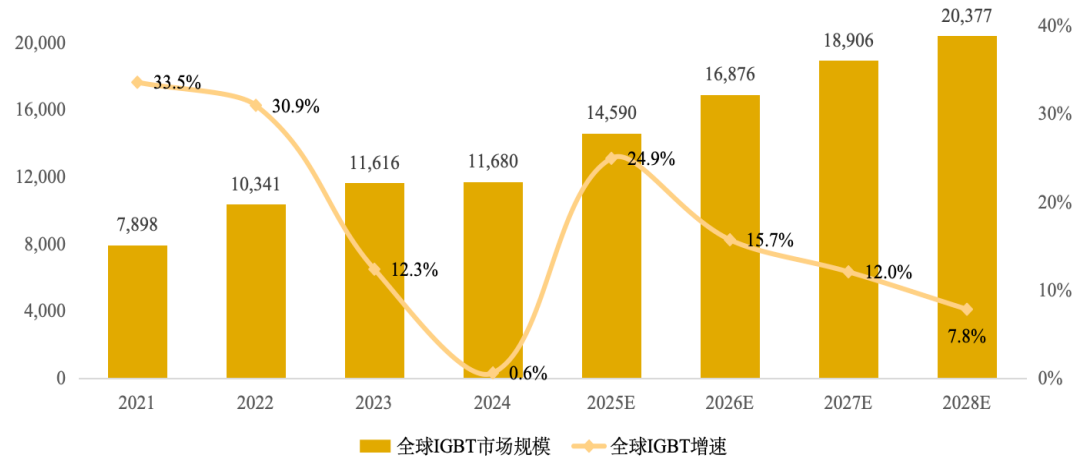
数据来源：芯谋研究

（4）IGBT 市场

IGBT 兼具 MOSFET 驱动便捷与三极管大电流优势，开关速度快、通态损耗低，可高效控制电能转换。在光伏逆变、工控变频、新能源汽车动力系统等场景应用广泛，是电力电子变换核心器件。伴随新能源产业爆发，近年来 IGBT 市场规模快速增长，其市场规模与 MOSFET 相当。

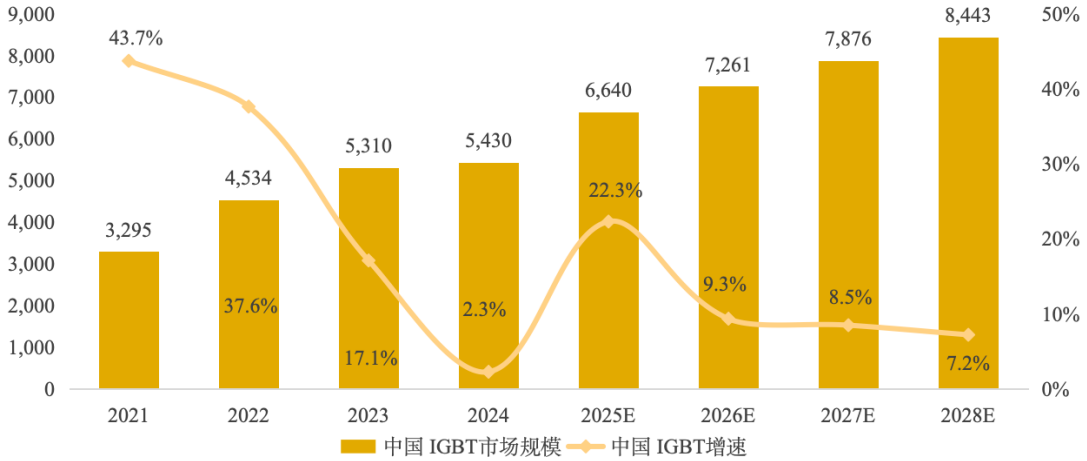
芯谋研究数据显示，2024 年度全球 IGBT 市场规模高达 116.80 亿美元，在分立器件市场中占比高达 36.2%。其中中国 IGBT 市场规模为 54.30 亿美元，占全球 IGBT 市场规模的比例为 46.49%。未来市场趋势方面，芯谋研究预测，2025 年至 2028 年期间，全球和中国 IGBT 市场规模将持续增长。

2021-2028 年全球 IGBT 市场规模及预测（单位：百万美元）



数据来源：芯谋研究

2021-2028 年中国 IGBT 市场规模及预测（单位：百万美元）



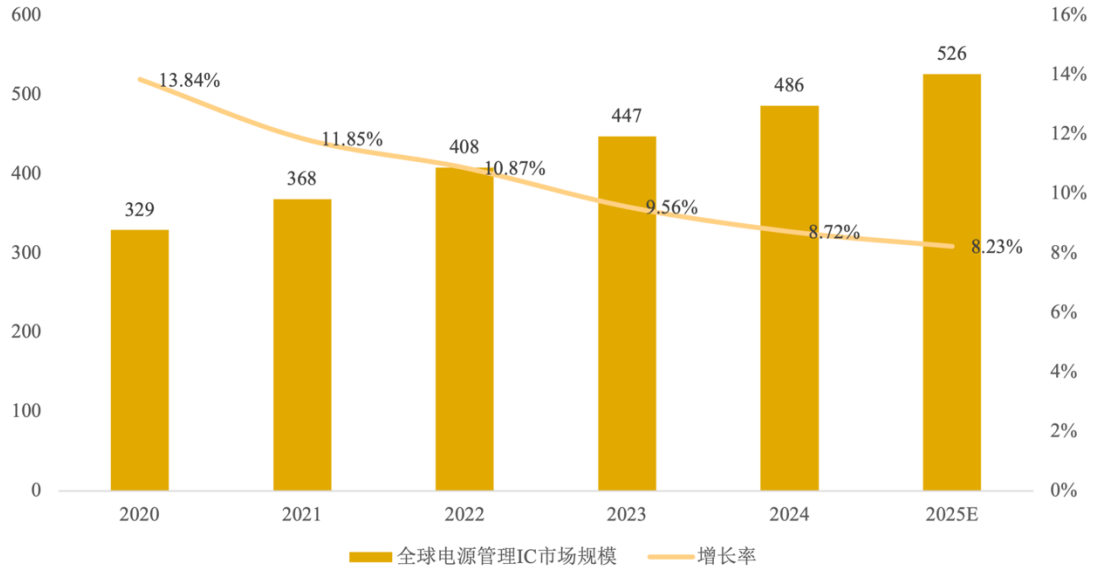
数据来源：芯谋研究

2、电源管理 IC

随着消费电子、新能源汽车和汽车智能化、5G 通讯等下游市场的发展，电子设备数量及种类持续增长，对于电能应用效能管理的重要性愈发凸显，从而带动电源管理 IC 的下游市场需求增长。

中商产业研究院数据显示，2024 年全球电源管理芯片市场规模达到约 486 亿美元，近五年年均复合增长率达 10.2%。未来全球电源管理 IC 市场规模将保持持续增长，其中以大陆为主的亚太地区将成为未来最大成长动力，2025 年全球电源管理 IC 市场规模将达到 526 亿美元。

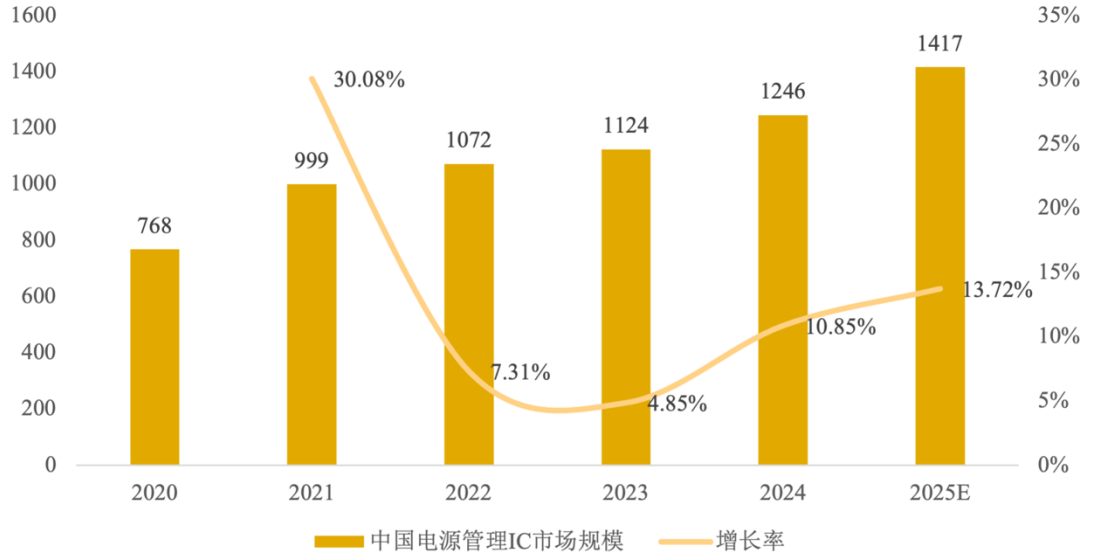
2020-2025 年全球电源管理 IC 市场规模（亿美元）



数据来源：中商产业研究院

中商产业研究院数据显示，随着 5G 通信、新能源汽车、物联网等新兴领域的快速发展，中国电源管理 IC 市场规模从 2020 年的 768 亿元增至 2024 年的 1,246 亿元，实现了 12.9%的复合年增长率，2025 年中国电源管理 IC 市场规模将达到 1,417 亿元。

2020-2025 年中国电源管理 IC 市场规模（亿元）



数据来源：中商产业研究院

电源管理 IC 市场竞争格局方面，欧美一流厂商如英飞凌、德州仪器等，在产品线的完整性及整体技术水平上保持领先优势。国内产业现状相对分散，缺乏国际级的龙头企业，本土厂商自给率依然偏低。而随着国内集成电路市场的不断扩大以及半导体国产自主创新趋势的发展，给国内的诸多半导体企业带来了发展机遇，部分本土企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起，整体技术水平和国外一流设计公司的差距正不断缩小，代表性企业如圣邦股份、矽力杰等。

3、晶圆

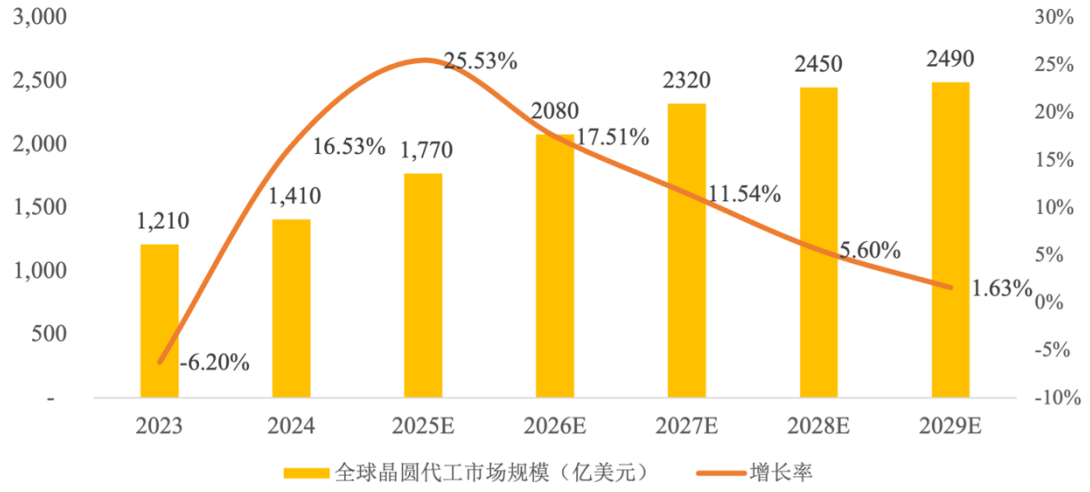
晶圆制造业属于科技型重资产行业，产线投入金额大、技术门槛要求高、产能爬坡周期长，拥有较高的产业壁垒。

根据 Yole 统计，2024 年，全球晶圆代工行业市场规模达到 1,410 亿美元，同比增长 16.53%，预计 2029 年全球晶圆代工市场规模将达到 2,490 亿美元，2024-2029 年均复合增长率达 12.05%。未来随着人工智能、智能驾驶、智慧工业、新一代移动通讯及物联网等行业的发展与相关技术升级，预计全球晶圆代工行业景气度将进一步提升。

根据 SEMI 等机构统计，2024 年中国晶圆代工行业市场规模提升至 143 亿美元，同比增长 20.17%；预计 2029 年将达到 266 亿美元，2024-2029 年均复合增长率预计为 13.22%。

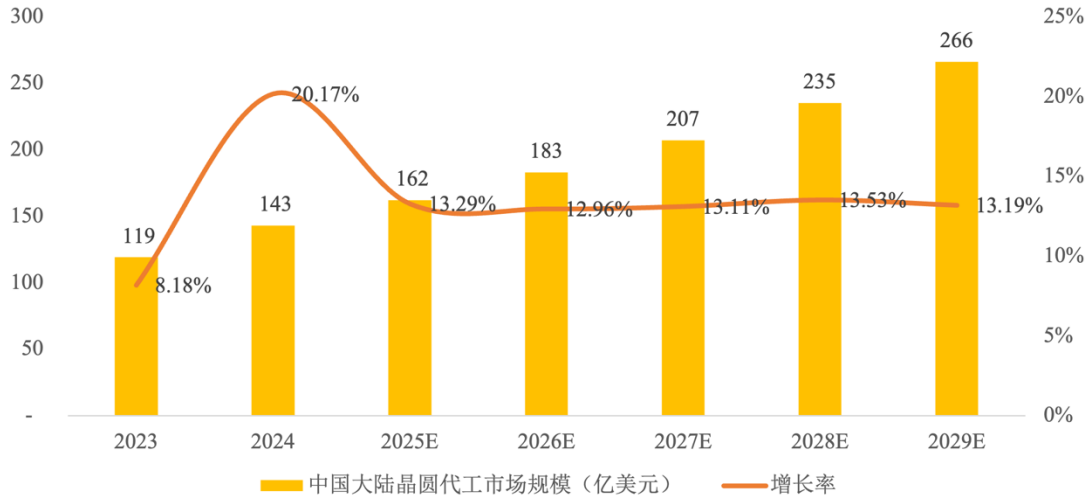
在近年国际贸易摩擦日益加剧的情况下，一方面，提高晶圆代工行业国产化的重要性日益凸显，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展；另一方面，部分境内集成电路设计企业亟需寻找可以满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证其生产安全，预计未来中国晶圆代工市场规模将持续增长。

2023-2029 年全球晶圆代工市场规模（亿美元）



数据来源：Yole

2023-2029 年中国晶圆代工市场规模（单位：亿美元）



数据来源：SEMI、Omdia、Frost&Sullivan

（六）所属细分行业的技术水平及特点

分立器件和电源管理 IC 的技术水平及特点取决于结构、工艺、材料等多个维度，且各维度相互联动、综合优化：

1、产品结构：多种产品共存，向更高功率密度、更小体积、更低功耗升级

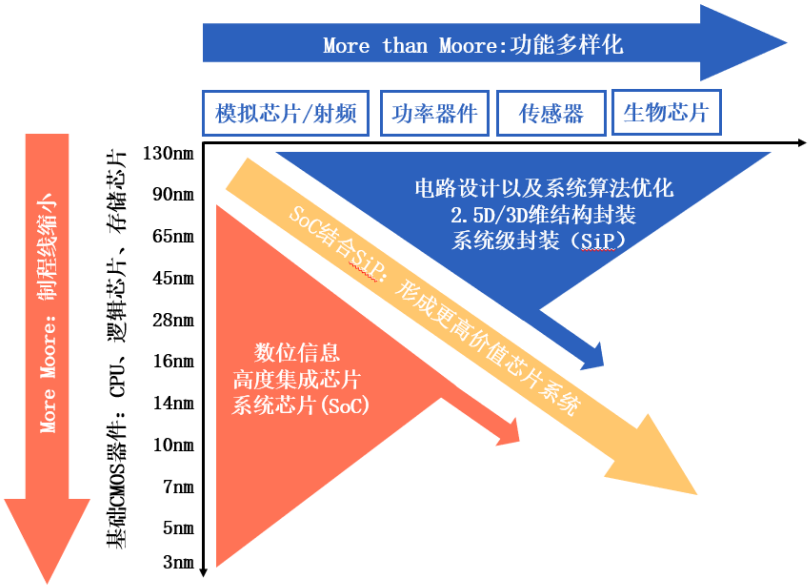
与数字 IC 的发展逻辑不同，分立器件和电源管理 IC 的典型特征是不依赖于先进工艺制程的迭代，而是基于产品内在结构的改进、优化、制造工艺升级，实现更高的功率密度、更小的体积、更低的功耗。分立器件和电源管理 IC 具有结构类型众多、下游应用广泛、生命周期长的典型特征，二极管、三极管与 MOSFET、IGBT 等产品共存于市场。形成该市场特征的主要原因在于，分立器件的下游应用繁多、细分需求多样化，从产品系列具体到料号、规格、电压、电流、面积、导通电阻、封装、技术特点及应用领域，可交叉组合形成上万种产品型号。不同结构的分立器件电学性能和成本各有差异，在不同的应用场景中各具优势，可满足电池、市电和工业用电等不同电压等级、应用端不同工作电流的功率变换和驱动控制需求，因此不同结构的产品之间并非互相替代的关系，而是各自拥有对应的市场应用需求，处于长期并存的状态。

因此，“平台化”是分立器件企业构筑竞争壁垒、打造竞争优势的核心武器，产品种类越丰富、工艺平台越强大的企业，其在技术经验、服务能力和特殊化开发能力方面越具有深厚的优势。以英飞凌、安森美、安世半导体为代表的国际主流龙头企业均遵循“平台化”的发展模式，依托持续的研发投入与产业整合，构建起涵盖多材料、多结构的分立器件与模拟芯片产品矩阵。此类“多品类、全场景覆盖”的平台化战略，高度契合了下游客户对一站式解决方案的采购诉求，是确立全球行业领先地位的核心商业范式。

2、特色工艺：不遵循摩尔定律，由应用需求驱动、侧重于产品功能多样化

根据 IRDS 发布的国际半导体技术发展路线图，半导体的工艺路径主要为两大方向：一类是先进工艺，遵循摩尔定律（More Moore），不断缩小制程线宽，主要运用于 CPU、逻辑芯片、存储芯片等细分市场，其核心是沿着摩尔定律的道路，通过特征尺寸不断缩小，在一个芯片上拥有更多的电路，目前 12 英寸硅片在这个领域占据主导地位；另一类是特色工艺，超越摩尔定律（More than Moore），其工艺相对成熟，不依赖于线宽的缩小，主要运用于分立器件、模拟芯片、传感器等细分市场，由应用需求驱动、侧重于产品功能的多样化，其核心是在一个芯片上拥有更多的功能。超越摩尔定律不再单纯依靠缩小晶体管尺寸和硅片尺寸的放大，而是高度依赖于特色工艺平台、半导体材料特性、器件物理结

构设计（如沟槽结构、屏蔽栅结构、超结结构等）以及定制化封装散热技术的深度融合，以综合提升产品性能。同时，根据应用场景来实现芯片功能的多样化，满足新能源、AI、机器人等各新兴领域的发展应用需求。



资料来源：IRDS 国际半导体技术发展路线图

“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中，首次将特色工艺与先进工艺技术一并提出，对我国特色工艺及分立器件产业的发展具有重大意义。“十五五”规划中，进一步提出“做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力”，明确了成熟制程与先进制程并重的发展思路，为我国分立器件、电源管理 IC 等特色工艺产品的高质量发展提供了持续的政策指引与战略保障。

分立器件产品的下游应用环境极为丰富，细分场景众多。为匹配不同的需求，分立器件厂商运用特色工艺平台对产品进行针对性优化，在不断的试错中积累经验、改进性能。为此，分立器件企业需要将产品与特色工艺平台紧密结合，因此 IDM 模式是行业主流发展趋势，以英飞凌、安森美、安世半导体为代表的国际主流龙头企业均采用 IDM 模式。IDM 模式下，分立器件厂商既能通过自有特色工艺平台对产品进行灵活调试，也能根据下游产品的技术要求和工艺要求及时上溯反馈调整、优化工艺平台和技术参数，从而实现产业链上下游之间的双向增益，缩短了产品从设计定义到大规模量产的周期，还伴随着增厚了企业的特色工艺技术储备。

3、衬底材料：第三代半导体在新能源汽车、AI 等驱动下成为发展趋势

半导体衬底材料主要包含硅（Si）、锗（Ge）等元素半导体，砷化镓（GaAs）等化合物半导体，以及碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等第三代宽禁带半导体材料，不同材料体系各具性能特点，共同构成功率半导体行业的重要基础。

其中，硅基材料凭借技术成熟、资源丰富、成本可控等优势，长期占据半导体衬底的主导地位，全球 90%以上的芯片基于硅材料制造，是集成电路与分立器件的核心基础材料。

近年来，新能源汽车高压化（800V 平台普及）、AI 服务器兆瓦级算力爆发、光伏/储能规模化并网，正强力拉动功率半导体需求升级，催生对更高效率、更低损耗、更高功率密度器件的迫切需求。以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体具备禁带宽度大、击穿场强高、热导率优异、开关损耗极低等核心优势，与高端功率半导体的应用诉求高度契合。其中，SiC 适配新能源汽车主逆变器、车载充电机、AI 数据中心高压电源、储能变流器（PCS）等高压大功率场景；GaN 则在高频工作场景性能突出，主要应用于高频快充、通信射频、中小功率高频电源等领域。

在新能源汽车、AI 算力基础设施、新型电力系统三重驱动下，以 SiC、GaN 为代表的第三代半导体已成为功率半导体的热门发展方向。

（七）行业进入壁垒

1、技术壁垒

分立器件产业交叉融合了数学、物理、化学、材料、机械、信息和计算机等多门学科的技术，为典型的技术密集、知识密集的高科技行业。分立器件企业通过对产品结构改进、材料创新和性能参数调试，使分立器件产品的功率密度、功耗水平、驱动控制能力和经济效益达到最优平衡，以满足不同应用场景下的各种细分需求。因此，分立器件行业的技术壁垒较高。

2、人才壁垒

分立器件同时也属于人才密集型行业，人才团队是保持企业技术创新能力的核心资源。分立器件的产品类型繁多、多种结构并存，其性能并非单纯依靠降低

线宽来提升，而是与应用环境密切相关，需要针对性的优化调试以实现更优效果。对于从业人员而言，往往需要在长期的实践和试错中积累产品经验和工艺诀窍（Know-how）。对于分立器件企业而言，培养出一支专业的、经验丰富的、创新能力强的人才团队，需要一定的周期。

3、产品及下游应用壁垒

分立器件和电源管理 IC 产品是电力电子的基础。国民经济中涉及电气化的领域几乎都会用到相关产品，因此其应用场景极为丰富，覆盖消费电子、工业控制、汽车电子、新能源等各类下游领域。下游客户往往同时有多种功率半导体的采购需求，为了降低供应链管理复杂度、提升产品研发和量产效率，一般倾向于选择可以满足一揽子采购需求的厂商。因此，具备丰富产品组合、下游应用经验积累丰富的分立器件厂商能够较好满足客户的多样化需求，从而形成一定的产品壁垒。

4、销售渠道壁垒

销售渠道是分立器件企业的核心竞争力之一。分立器件产品面向的客户群体具有数量多、分布广、规模不一、需求变动大、订单较为零散等特点。而经销商可凭借快速响应能力以及销售网络优势，迅速进入各细分行业和客户，有利于加速产品市场推广，使得分立器件企业能够集中优势资源进行新产品开发、技术创新和品质提升等。

分立器件企业往往需要长时间的持续投入与积累才能够建立起有效的覆盖全国甚至全球的销售网络。因此先进入的企业有明显的先发优势，对后进入的企业形成一定的销售渠道壁垒。

5、客户认证壁垒

分立器件和电源管理 IC 是构成电力电子转换装置的核心组件，其性能、可靠性和稳定性对下游产品质量和使用寿命有较大影响。因此，下游客户通常对供应商有较严格的认证条件，要求供应商具备行业内较领先的技术、可靠的质量、优质的服务以及稳定的量产能力。客户认证过程通常要经过样品监测、小批量试用、稳定性监测、批量生产及体系审核等多轮环节，通过认证后还需通过定期考核。根据产品的功能特性与下游应用领域的不同，公司产品的认证周期通常在 6

个月至 2 年不等，汽车电子等部分高认证要求产品认证周期可达数年。分立器件厂商在通过客户验证后，其产品将进入客户的物料体系，通过持续采购深化合作关系，形成较高的客户黏性，对后续的市场进入者形成一定的壁垒。

6、供应链壁垒

分立器件产业链涵盖产品定义、晶圆制造、封装测试等多个环节，具备多环节高度协同的特征。其中，晶圆制造、封装测试属于典型资本密集型领域，具有前期固定资产投入规模大、投资回报周期长、行业投资风险较高的特点。

为降低重资产投入压力，行业新进入企业大多采用 Fabless 轻资产运营模式，依托外部晶圆代工、封测厂商搭建外协供应链体系。而晶圆及封测厂商经营策略偏稳健，需综合评估订单体量、工艺难度、产能规划，以及 Fabless 企业下游市场拓展实力等多重因素，才会与其开展合作；同时功率半导体制造工艺参数繁杂，Fabless 企业还需与外协厂商长期打磨工序工艺、持续技术磨合，方能实现产品稳定规模化量产，外协供应链本身已对新进入者形成准入门槛。

与此同时，拥有自建晶圆厂、封装测试厂的 IDM 厂商，实现了设计、制造、封测全产业链垂直整合，无需依赖外部外协产能供给，工艺研发与生产制造深度协同，产能规划、产品迭代及量产交付节奏自主可控，不受外部供应链合作限制。全流程自主布局的 IDM 模式，进一步构筑了显著的技术、产能与供应链壁垒，也进一步抬高了行业整体进入门槛。

（八）行业周期性特征

分立器件和电源管理 IC 行业存在一定的周期性，主要由三重周期的嵌套影响：第一重周期是产品周期，即下游应用的需求更迭以及下游产品所处生命周期的变迁；第二重周期是产能周期，由于产能变化具有滞后性，会沿着“价格上升→产能扩张→价格下降→产能收缩”的路径往复运动；第三重周期是库存周期，从供不应求到供过于求，往往也会经历“被动去库存→主动补库存→被动补库存→主动去库存”的周期循环。

从近几年的变化看，2020 年四季度至 2021 年，数字经济、新能源应用需求爆发，叠加功率半导体“缺芯潮”，出现了周期性波峰；2022 年至 2023 年，受消费电子需求下滑、产能供应恢复、下游库存去化的影响，功率半导体整体行情

出现阶段性调整；2024 年至今，受消费电子需求回暖、新能源汽车普及、光伏储能需求重启、AI 服务器需求爆发、下游库存去化基本完成等因素影响，功率半导体行情持续提升。

供需关系的变化是主导分立器件和电源管理 IC 行业周期的核心因素。就需求端而言，分立器件和电源管理下游需求较分散，大多时间呈稳态增长，主要受宏观经济、科技周期扰动，如金融危机、新能源浪潮、AI 需求爆发等。就供给端而言，其改变较为集中，具有“阶跃”的特征。尤其是晶圆制造产能，从规划到落地通常需经历厂房建设、设备调试、产能爬坡等一系列过程，与需求变动存在一定程度的错配。未来随着分立器件和电源管理 IC 下游应用场景的拓展，以及全球贸易摩擦下国产自主创新加速，我国分立器件和电源管理 IC 产业的成长属性或能够一定程度上平抑行业周期。

（九）行业面临的主要机遇和挑战

1、面临的机遇

（1）国家政策支持

半导体行业是我国重点鼓励和支持的产业之一，分立器件和电源管理 IC 在实现电能高效利用、建设资源节约型社会方面发挥着不可替代的作用。随着全球能源结构转型、终端应用持续向智能化升级，功率半导体技术加速迭代演进。分立器件与电源管理 IC 作为基础性、关键性战略元器件，既影响下游支柱行业的技术发展空间，也关乎产业链供应链安全，其重要性日益凸显。为推动节能减排、促进电力电子技术和产业的发展，国家发改委等有关部门陆续出台利好政策，支持新型电力电子器件产业发展。未来国家产业政策的支持将会不断推动半导体行业的技术进步，形成先进技术的自有知识产权，优化国产半导体的产品结构。

（2）贸易摩擦背景下国产自主创新的市场机遇

由于分立器件和电源管理 IC 应用场景广泛、下游市场需求庞大，而目前仍由国际厂商主导，因此国产自主创新空间十分广阔。在分立器件领域，国内企业在 MOSFET、IGBT 等高附加值产品类型上距离国外一流厂商尚存在显著差距。未来随着国内企业逐步突破行业内高端产品的核心技术，我国功率半导体对进口的依赖将会减弱，国产自主创新的市场机遇逐渐显现。

同时，受贸易摩擦与技术封锁影响，供应链自主可控的战略意义愈发凸显。2025 年 9 月，在外部地缘政治升级及出口管制规则传导下，荷兰政府依托本国产业安全相关法规出台限制性行政命令，造成闻泰科技对安世半导体境外主体经营管控权利受限，引发全球分立器件产能供给波动，并对全球汽车等关键产业链造成阶段性扰动。在此背景下，推动我国分立器件与电源管理 IC 产业加速自主化进程，实现供应链自主可控、保障产业链安全稳定的战略意义愈发重大。

（3）新能源、人工智能带来的新兴市场机遇

在新能源浪潮与 AI 时代推动下，“电气化”趋势带动分立器件和电源管理 IC 需求激增。新能源汽车领域，功率半导体是电控系统等核心部件的关键，IGBT、MOSFET 等器件支撑电机驱动、能源回收等功能。单车功率半导体价值量为燃油车的 5 倍，叠加新能源汽车销量增长，将拉动功率半导体市场持续增长。

在新型电力系统建设加速落地背景下，光储充市场迎来高速发展，持续打开功率半导体增量空间。光储充领域中，功率半导体是光伏逆变器、储能变流器、新能源充电桩的核心支撑器件，MOSFET、IGBT、整流桥等产品承担电能转换、功率调控、并网适配等关键功能。伴随国内光伏储能装机规模持续扩容、充电桩配套建设稳步推进，光储充高景气赛道将持续拉动功率半导体市场需求增长。

AI 服务器方面，因大模型和云计算需求，其电源系统对功率半导体的稳定性、高效性要求更高，单台用量远超普通服务器。全球 AI 服务器市场年增速超 30%，2025 年出货量预计达 150 万台，推动功率半导体在数据中心领域需求快速释放。

工业及人形机器人领域，成为功率半导体新兴增长极。机器人伺服驱动、运动控制、电源管理等核心环节均需搭载功率半导体，MOSFET、IGBT 等器件保障设备精准调速、平稳运行与可靠控制。国内工业机器人装机量维持稳健增长，人形机器人产业化进程持续提速，将进一步带动功率半导体在高端装备领域的需求快速释放。

（4）国民经济增长为行业奠定盈利基础

分立器件和电源管理 IC 产品是电子信息产业的基石，国民经济中涉及电气化的领域几乎都会用到相关产品，其技术进步和应用领域的拓宽既能够促进工业

的产业结构升级，也为居民生活带来更多便利和舒适。我国经济水平稳步上升，产业结构调整有序开展，居民对生活质量的要求也越来越高，为行业创造了巨大的盈利空间。行业内优秀企业依托自主创新能力提高产品附加值，在国民经济持续发展这一稳固的基础上不断提升盈利水平。

2、面临的挑战

（1）国际竞争力有待提升

在分立器件和电源管理 IC 领域，国际领先企业经历了较长时期的发展积累，技术实力强、品牌知名度高，占据了全球主要市场份额。而我国本土厂商虽在技术工艺方面已取得了长足进步，也具备了一定的竞争力，但与国际领先企业相比在技术实力、产品广度等方面仍存在较大差距，国际竞争力有待进一步提升。

（2）专业人才储备相对不足

分立器件和电源管理 IC 行业属于技术密集型行业，对人才的知识背景、研发能力及经验积累均具有较高要求。我国半导体产业起步相对较晚，具有完备知识储备、具备丰富技术和经营经验、能胜任相应工作岗位的人才仍较为稀缺。

（3）国内具备特色工艺的 IDM 企业相对不多

分立器件和电源管理 IC 的下游应用环境极为丰富，细分场景众多。为匹配不同的需求，分立器件厂商运用特色工艺平台对产品进行针对性优化，在不断的试错中积累经验、改进性能。为此，分立器件企业需要将产品定义、设计与特色工艺平台（晶圆制造、封装测试）紧密结合，故 IDM 模式是行业发展趋势，也是国际主流分立器件厂商的经营模式。而目前国内的分立器件企业，大部分只从事特定环节的业务，而拥有特色工艺平台的 IDM 企业尚不多，未来需要进一步提升。

（十）所属细分行业竞争格局、行业内主要企业，发行人产品或服务的市场地位

1、所属细分行业竞争格局

分立器件产业起源于欧美，日韩后续不断形成其自身竞争优势，目前全球分立器件市场仍以欧美日企业为主导，如英飞凌、安森美、安世半导体、意法半导

体等。根据芯谋研究统计，2024 年度全球分立器件市场规模为 323.00 亿美元，全球分立器件市场前十大市场份额占比达到 61.6%，前十大厂商均为国外品牌。

国内市场方面，我国作为全球最大的分立器件消费市场，近年来受益于“智能制造”、“新基建”、“碳达峰、碳中和”等国家政策和战略深入推进，叠加半导体、能源电子等产业政策扶持，我国分立器件市场增速高于全球平均水平，本土厂商越来越多地参与到全球市场的供应体系，部分本土优秀企业已逐步积累了较为丰富的半导体研发和生产技术经验，取得了一定的知名度和市场占有率，但在 MOSFET、IGBT 等细分产品，以及汽车等高端应用市场，仍以国际一流半导体企业为主导。根据中国半导体行业协会的评定，发行人与华润微、扬杰科技、士兰微、捷捷微电等“中国半导体行业功率器件十强企业”，组成了本土分立器件企业的第一梯队。

未来，随着逐步突破高端产品的技术瓶颈，我国本土分立器件厂商的市场竞争力将会进一步提升，从而改变产业竞争格局。

2、行业内的主要企业

公司产品涵盖分立器件及其晶圆、电源管理 IC。按照公司产品及国内外维度，列举国内外同行业可比公司情况如下。需要说明的是，国外竞争对手普遍具有强大的产品开发能力，经过多年的发展，形成了多产品、多领域的覆盖，其产品宽度和深度明显优于发行人。

（1）国际厂商

① 英飞凌（Infineon）（股票代码：IFX）

英飞凌成立于 1999 年，是全球领先的半导体公司之一。其前身是西门子集团的半导体部门，于 1999 年独立，2000 年上市。英飞凌是全球功率半导体龙头企业，掌握功率半导体高端技术，其产品主要包括 MOSFET、IGBT、智能功率器件及功率集成电路等产品。

② 安森美半导体（Onsemi）（股票代码：ON）

安森美半导体于 1999 年自摩托罗拉半导体部门分拆独立，2000 年于美国纳斯达克上市，主要产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件，产品

广泛应用于汽车、工业、通信、计算机、消费电子等领域。

③ 安世半导体（Nexperia）

安世半导体前身为恩智浦（NXP）集团标准产品部门，于 2017 年初独立，2019 年被闻泰科技收购。安世半导体是全球领先的分立器件、逻辑器件的专业制造商，目前已切入全球汽车、通信、计算机、消费电子等应用领域多家头部公司的供应链。

④ 意法半导体（ST）（股票代码：STM）

意法半导体创立于 1987 年，是全球最大的半导体公司之一，于纽约证券交易所、泛欧证券交易所及意大利米兰证券交易所上市。意法半导体产品线广，在分立器件、车用集成电路领域居世界前列，也是各工业领域的主要供应商。

⑤ 东芝半导体（Toshiba）

东芝半导体创立于 1875 年 7 月，是日本最大的半导体制造商、第二大综合电机制造商，隶属于三井集团。主营产品包括集成电路和功率半导体，产品主要应用于汽车、工业及消费电子领域。

（2）国内厂商

① 扬杰科技（股票代码：300373.SZ）

扬杰科技成立于 2006 年，于 2014 年 1 月在深交所创业板上市。扬杰科技采用 IDM 与 Fabless 并行的商业模式运营，主要产品为各类电力电子器件芯片、二极管、三极管、MOSFET、IGBT 及第三代半导体等，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子等诸多领域。

② 士兰微（股票代码：600460.SH）

士兰微成立于 1997 年，于 2003 年 3 月在上交所主板上市。士兰微主要采用 IDM 模式运营，主要产品包括集成电路、分立器件、LED、功率模块、MEMS 等，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子等领域。

③ 新洁能（股票代码：605111.SH）

新洁能成立于 2013 年，2020 年 9 月于上交所主板上市。目前，新洁能主要

采用 Fabless+封测模式运营，主营沟槽型 MOSFET、超结 MOSFET、SGT MOSFET 以及 IGBT 等产品，产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子等领域。

④ 捷捷微电（股票代码：300623.SZ）

捷捷微电成立于 1995 年，于 2017 年 3 月在深交所创业板上市。捷捷微电业务模式以 IDM 模式为主，主营产品为晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（包括：TVS、放电管、ESD、集成放电管、贴片 Y 电容、压敏电阻等）、二极管器件和芯片（包括：整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、IGBT 器件及组件、碳化硅器件等。

3、发行人的行业地位

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被中国半导体行业协会评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”，系江苏省半导体行业协会副理事长单位。

细分市场来看，在分立器件领域，公司处于行业领先地位，其中二三极管产品处于国内龙头地位，MOSFET 产品处于高速发展阶段，IGBT 具备未来快速发展的潜力，参见本招股说明书“第二节 概览”之“五、发行人符合主板定位”之“（三）公司具有行业代表性”之“2、公司在分立器件行业处于领先地位，属于行业代表性企业”。

在晶圆领域，子公司新顺微深耕晶圆制造领域二十余年，在二三极管晶圆领域具有较强的竞争优势。根据江苏省半导体行业协会发布的《2024 年度集成电路产品研究发展报告》，2024 年，新顺微在江苏省集成电路晶圆制造企业销售收入排名第 6，仅次于 SK 海力士半导体（中国）有限公司、台积电（南京）有限公司、华润微电子有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司等国内外晶圆制造龙头企业。

（十一）发行人的竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）技术和研发优势

公司以“研发驱动”为核心发展战略。报告期内，公司持续引入优秀的研发

技术人员，并拥有众多曾在国内外知名半导体企业任职多年的复合型人才。公司构建了专业化分工、体系化协同的研发体系，覆盖二三极管、MOSFET、IGBT、电源管理 IC 等多种产品类别，贯穿半导体产品定义、晶圆制造、成品封测三大产业环节，并能对消费级、工业级、车规级不同需求类型提供有力的保障。公司凭借对半导体行业的深刻理解，充分发挥各项核心技术优势，增强产品的市场竞争力。

报告期内，公司一方面推动存量产品的车规化升级，另一方面还积极开发新产品，掌握了 SGT MOSFET、CSP MOSFET、超结 MOSFET、IGBT、第三代半导体等产品关键技术，其开发的部分新产品在技术水平上处于国内前列，具有较强的市场竞争力。例如，公司凭借自主研发，掌握 CSP MOSFET 技术平台并完成迭代储备，使得产品在更小的芯片面积内实现更高的功率输出，实现了国产自主创新；公司研发并推出的大功率 IGBT 单管及模块，部分产品性能可对标国际一线品牌最新代次产品，技术实力位居国内品牌前列。

另外，公司重视研发知识体系建设，通过申请专利、集成电路布图设计等形成了对公司产品的技术保护。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有已授权的专利 244 项（其中发明专利 85 项），以及集成电路布图设计专有权 130 项，建立了自主知识产权体系。

（2）产品品类和客户优势

公司主营的分立器件和电源管理 IC 作为一种基础的电子元器件，为国民经济的多个领域所必不可缺的产品。下游客户通常需要多种系列和规格的产品，为了确保产品性能的稳定性，客户倾向于选择同一品牌的一站式服务。

公司已具备上万种规格型号产品的量产能力，是国内产品门类最齐全、系列最丰富的分立器件与电源管理 IC 企业之一。截至目前，公司已开发出二极管、三极管、MOSFET、IGBT、电源管理 IC 等多种产品系列。其中，在二三极管领域，公司具备 SBD、FRD、TVS、ESD、Zener、BJT 等多种产品类型的规模化量产交付能力；在 MOSFET 领域，公司涵盖 Trench MOSFET、SGT MOSFET、CSP MOSFET、SJ MOSFET 等多种产品类型；在 IGBT 领域，公司开发的大功率 IGBT 单管及模块产品，覆盖 650V 至 1,700V 的电压范围；在电源管理 IC 领

域，公司已构建了线性稳压器（包含 LDO、三端稳压 IC）、DC-DC 等产品条线。公司在上述领域已形成从低频到高频、从小信号到大功率的多规格产品格局。公司多品种、专业化、规模化的产品供应能力，使得公司具备优秀的一站式供应能力，能够为客户提供一揽子产品解决方案，有效降低客户供应链管理及品质管理的难度。

公司产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子、新能源等领域，覆盖小米、三星、荣耀、传音控股、华勤技术、立讯精密、石头科技、格力电器、海尔智家、欣旺达、新能德、德赛电池、安克创新、麦格米特、创科实业（TTI）、泉峰控股、大疆创新、影石创新、中兴通讯、比亚迪、埃泰克、安瑞光电、德业股份、固德威等多家行业龙头企业，多次被小米、传音控股、海尔智家、飞毛腿、德业股份、麦田能源等公司授予“优秀合作伙伴奖”、“卓越合作伙伴”、“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”等荣誉。

（3）供应链优势

公司自建了技术对标全球领先水平的分立器件封测产线，子公司长晶浦联和海德半导体已具备合计约 160 亿颗/年的封测产能，实现从芯片划片到测试包装的自主全流程生产。公司封测设备采购自全球顶尖的设备供应商，凭借优异的产品品质，公司自主封测的产品获得客户的广泛认可。长晶浦联自设立之初，便以车规级产品的标准进行生产，质量、良率、一致性、稳定性行业领先。长晶浦联封装类型齐全，已实现量产的产品覆盖 SOD/SOT/DFN 小信号系列、PDFN/TO/DFN 功率器件系列、功率二极管 SMA/SMB/SMC 系列等 8 大系列、37 个类型。

公司整合了晶圆制造公司新顺微，晶圆产能约 180 万片/年，在分立器件领域形成全产业链核心技术自主可控的能力。新顺微深耕晶圆制造领域二十余年，拥有特色工艺平台，具备性能优异、高稳定性等优势，在二三极管晶圆领域具有较强的竞争优势。

除了公司自有供应链外，公司还与全球第三大封测厂商长电科技，与行业知名晶圆制造厂商芯联集成、力积电建立了长期、稳定的合作关系，保障了公司产能供应，并为公司扩大 MOSFET、IGBT 等产品的研发、生产提供有力的产能支

撑，进一步加强了公司供应链优势。

（4）Fabless+IDM 模式的优势

凭借内生发展与外延并购双轮驱动，公司逐步实现了从 Fabless 模式到“Fabless+IDM”模式的演变。报告期内，公司采用 Fabless 与 IDM 模式并行的模式开展业务。

Fabless 和 IDM 均是半导体行业成熟的经营模式。采用 Fabless 模式的半导体企业仅负责半导体产品的设计和销售，将制造、封测环节交由专业的半导体制造企业、封测企业完成，代表企业如英伟达、高通、AMD 等；而采用 IDM 模式的半导体企业同时拥有半导体设计部门、晶圆厂、封测厂，业务涵盖半导体设计、制造、封测以及后续的产品销售等环节，代表企业如英飞凌、安森美、安世半导体、华润微、士兰微等。

IDM 模式和 Fabless 模式各有优势，IDM 模式在工艺控制、供应链稳定性、利润空间和成本等方面具有优势；Fabless 模式在资本投入、灵活性、市场适应性等方面具有优势，企业一般根据产品特性、自身资金实力、市场定位选择适配模式。目前，公司构建了 Fabless+IDM 模式，公司 IDM 模式主要应用于二极管、三极管等相对成熟产品，可以充分发挥 IDM 模式供应链稳定、降低成本、加快技术和产品迭代速度的优势；而针对 MOSFET、电源管理 IC 等仍在快速成长期的产品而言，公司主要通过 Fabless 模式或封测环节自产的方式进行生产，可以发挥 Fabless 模式在资本投入小、灵活性高、市场适应性强的优势。

（5）营销及服务网络优势

公司组建了完善的营销服务网络，通过自有销售团队和经销商渠道相结合的方式，覆盖国内外主要电子产品市场。

公司在华东、华南、华北等重点区域、重点城市开设子公司等分支机构，组建专业销售服务团队，为重要终端客户提供属地化营销服务。

公司通过经销商渠道覆盖国内主要的电子产品市场，以及不同应用领域的终端客户，在保证营销服务时效性和持续性的同时，也有效提高了公司的营销管理效率。公司建有完善的渠道管理体系，注重对经销商渠道的管理、培训和支持，不断提升经销商渠道的整体营销服务能力。

公司在中国香港设立香港长晶，在新加坡设立 Universal，作为自有产品外销出口的平台，开拓港台、日韩、东南亚和欧美等全球重要市场。报告期内，公司出口总体规模保持稳定。

公司各级营销管理人员、经销商渠道管理人员，大多具有多年的半导体产品销售和客户服务经验，能够为客户提供专业化、系统化服务。

2、竞争劣势

（1）与国际竞争对手相比，公司目前规模尚小

目前，公司虽然在分立器件和电源管理 IC 设计方面形成了较为完整的技术路线和产品布局，在部分产品上取得了差异化优势，但相比同行业国际竞争对手，在核心技术积淀、高端产品研发实力上仍存在差距，同时产品矩阵丰富度不足、规格料号覆盖广度有限。公司整体规模仍然相对较小，在整个半导体行业的产品类别和供应量上仍有待进一步提升。

（2）融资渠道单一，资金实力有待加强

伴随着下游汽车电子、新能源、人工智能等应用市场的大力推广带来的市场机遇，公司在未来发展和抢占市场机遇的过程中需要投入大量的资金来进行产品的研发、人才的引进以及产能的提升。公司的资金主要依赖于股东投入、银行借款及自有资金积累，融资手段有限，公司的经营规模、渠道拓展和品牌建设等受到一定的限制。公司亟需拓展融资渠道，增强资金实力，进一步提高公司竞争力。

（十二）发行人与同行业可比公司的比较情况

公司结合业务结构、经营模式、业务重叠性等，选择扬杰科技、士兰微、新洁能、捷捷微电作为可比公司。上述公司相关经营情况与发行人比较情况如下：

公司名称	主营业务	财务数据	市场地位	主要经营模式	专利情况	研发费用及占比
扬杰科技	主营产品主要分为三大板块，具体包括器件板块（MOSFET、IGBT、SiC 系列产品、整流器件、保护器件、小信号及其他产品系列）、材料板块（单晶硅棒、硅片、外延片）、晶圆板块（5 吋、6 吋、8 吋硅基及 6 吋碳化硅	2025 年营业收入 71.30 亿元，净利润 12.45 亿元	（1）整流桥、光伏二极管产品市场全球领先；（2）“中国半导体行业功率器件十强企业”	IDM、Fabless 并行	截至 2025 年末，累计获授知识产权 716 件，其中发明 132 件、实用新型 492 件、集成电路布图设计 70 件、软件著作 9 件、外观设计 13 件	2025 年研发费用 4.7 亿元，占收入比例 6.61%

公司名称	主营业务	财务数据	市场地位	主要经营模式	专利情况	研发费用及占比
	等）					
士兰微	主要产品包括集成电路、分立器件、化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）三大类，其中分立器件以 MOSFET、二极管、IGBT 为主	2025 年营业收入 130.52 亿元，净利润 1.38 亿元	（1）“中国半导体行业功率器件十强企业”；（2）在中国家用电器研究院发布的《自有品牌空调整机国产芯片用量排行榜》中，跻身国产芯片用量综合前五	IDM	截至 2025 年末，拥有授权专利 1,303 件，其中发明专利 627 件，集成电路布图设计专有权 45 件，软件著作权 28 件	2025 年研发费用 10.91 亿元，占比 8.36%
新洁能	主要产品包括 MOSFET、IGBT、集成功率器件及模块	2025 年营业收入 18.77 亿元，净利润 3.92 亿元	（1）“中国半导体行业功率器件十强企业”；（2）国内 MOSFET 市场占有率排名前列的本土企业	Fabless+封测	截至 2025 年末，共有专利 249 项，其中发明专利 130 项，集成电路布局图 47 项，软件著作权 1 项	2025 年研发费用 1.18 亿元，占收入比例 6.28%
捷捷微电	主要产品包括晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片（TVS、放电管、ESD 等）、二极管器件和芯片（整流二极管、快恢复二极管、肖特基二极管等）、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、IGBT 器件及组件、碳化硅器件等	2025 年营业收入 34.94 亿元，净利润 4.76 亿元	（1）“中国半导体行业功率器件十强企业”；（2）国内晶闸管器件、芯片领域的领先企业	IDM 为主，部分 Fabless+封测	截至 2025 年末，获得授权专利 332 件，其中发明专利 117 项，实用新型专利 211 项，外观专利 4 项	2025 年研发费用 2.02 亿元，占收入比例 5.77%
发行人	主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品	2025 年营业收入 29.85 亿元，净利润 3.49 亿元	（1）自 2019 年以来连续六年名列“中国半导体行业功率器件十强企业”；（2）2024 年，二三极管合计销售规模位于中国大陆企业第 2 名；CSP MOSFET 销售规模位于中国大陆企业第 1 名	Fabless 与 IDM 并行	截至 2025 年末，公司拥有已授权的专利 244 项，其中发明专利 85 项，实用新型专利 159 项，以及集成电路布图设计专有权 130 项	2025 年研发费用 1.46 亿元，占收入比例 4.88%

注：上述数据及信息来源于同行业上市公司公告的年度报告等其他公开信息。

三、销售情况和主要客户

（一）主要产品的规模

1、产量和销量统计

（1）分立器件及电源管理 IC

报告期内，发行人采用 Fabless 与 IDM 并行的经营模式，其中 Fabless 模式下的晶圆制造、芯片封测系委托外部第三方厂商制造完成。因此，发行人的分立器件及电源管理 IC 产量包含委外加工数量，以及本节“产能利用率统计”中长晶浦联、海德半导体各期的自产产量。报告期各期，发行人分立器件及电源管理 IC 的产量和销量情况如下：

单位：万颗

产品	年份	产量	销量	产销率
分立器件	2025 年度	3,698,455.88	3,570,156.52	96.53%
	2024 年度	3,000,248.43	3,041,296.05	101.37%
	2023 年度	2,391,343.88	2,354,105.72	98.44%
电源管理 IC	2025 年度	158,632.18	146,872.97	92.59%
	2024 年度	138,189.91	131,353.16	95.05%
	2023 年度	118,031.94	106,721.39	90.42%

注：产销率=销量/产量

（2）晶圆

发行人子公司新顺微主要从事晶圆的生产与销售。报告期各期，新顺微晶圆的产量和销量情况如下：

单位：万片

年份	产量	销量	产销率
2025 年度	180.95	174.05	96.19%
2024 年度	155.70	153.59	98.64%
2023 年度	131.26	125.76	95.81%

注 1：产销率=销量/产量

注 2：为与产量口径匹配，上表中的销量包含新顺微对发行人及其子公司的销量

2、产能利用率统计

公司生产型子公司包括长晶浦联、海德半导体和新顺微。报告期各期，长晶浦联、海德半导体和新顺微的产能利用率情况如下：

（1）长晶浦联

单位：万颗

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长晶浦联产量	1,363,500.53	1,115,100.71	866,423.04
长晶浦联产能	1,417,160.00	1,195,100.00	1,106,400.00

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长晶浦联产能利用率	96.21%	93.31%	78.31%

注：产能利用率=产量/产能

2023 年，长晶浦联产能利用率较低，主要系当年产能持续爬坡，导致整体产量增长低于产能增长。

（2）海德半导体

单位：万颗

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
海德半导体产量	203,123.78	170,337.90	133,612.02
海德半导体产能	208,217.86	198,874.37	191,778.05
海德半导体产能利用率	97.55%	85.65%	69.67%

注：产能利用率=产量/产能

报告期内，随着下游消费电子市场复苏，海德半导体的产能利用率逐年提升。

（3）新顺微

单位：万片

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
新顺微产量	180.95	155.70	131.26
新顺微产能	175.80	155.00	136.60
新顺微产能利用率	102.93%	100.45%	96.09%

注：产能利用率=产量/产能

报告期内，新顺微的产能利用率维持在较高水平，2024 年和 2025 年略超 100%，主要系新顺微优化生产工艺、提高生产效率，并根据下游市场需求调整排产结构所致。

（二）主要产品的销售收入

1、分产品类别的销售收入情况

报告期各期，公司主营业务收入分产品类别的销售情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分立器件	222,281.41	75.70%	194,327.57	73.59%	161,058.91	72.35%
其中：二极管	76,274.26	25.98%	67,688.36	25.63%	56,706.47	25.47%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
三极管	60,650.34	20.65%	56,618.92	21.44%	48,377.15	21.73%
MOSFET	81,321.96	27.69%	65,383.41	24.76%	50,982.77	22.90%
其他分立器件	4,034.84	1.37%	4,636.88	1.76%	4,992.53	2.24%
电源管理 IC	23,877.36	8.13%	23,104.78	8.75%	20,521.30	9.22%
晶圆	46,634.34	15.88%	46,157.11	17.48%	40,670.55	18.27%
其他	844.62	0.29%	491.12	0.19%	369.77	0.17%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

2、分销售模式的销售收入情况

报告期各期，公司主营业务收入分销售模式的销售情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销	170,216.68	57.97%	146,450.12	55.46%	118,751.63	53.34%
直销	123,421.06	42.03%	117,630.46	44.54%	103,868.89	46.66%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

（三）产品的主要客户群体

报告期内，公司主要产品包括分立器件和电源管理 IC 等半导体产品。作为电子信息产业的基石，分立器件和电源管理 IC 广泛应用于国民经济建设和社会生活各环节领域，公司客户群体涵盖消费电子、工业控制、汽车电子、新能源等领域的知名企业。

（四）销售价格的总体变动情况

报告期内，发行人主要产品的平均销售价格变动情况如下：

单位：元/千颗

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价	同比变动	单价	同比变动	单价
分立器件：	62.26	-2.56%	63.90	-6.61%	68.42
二极管	43.72	-3.21%	45.17	-7.40%	48.78
三极管	46.95	-7.81%	50.93	-7.69%	55.17
MOSFET	156.37	-1.42%	158.63	-8.87%	174.07

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	单价	同比变动	单价	同比变动	单价
其他分立器件	295.63	20.10%	246.15	7.36%	229.27
电源管理 IC	162.57	-7.58%	175.90	-8.52%	192.29
晶圆	28.79	-3.70%	29.89	-10.20%	33.29

报告期内，公司主要产品的平均销售价格略有下降，主要系公司结合市场供求情况调整部分产品价格，与行业总体产品价格变动趋势相符。

（五）向主要客户的销售情况

1、报告期内公司向前五大客户的销售情况

报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

2025 年度				
序号	客户名称	客户类型	销售金额	占比
1	深圳海格微电子有限公司	经销	34,773.44	11.65%
2	深圳翰世宇科技有限公司	经销	10,839.25	3.63%
3	南京高上美电子有限公司	经销	9,810.85	3.29%
4	欣旺达电子股份有限公司	直销	9,279.44	3.11%
5	深圳市联盛电子有限公司	经销	9,037.83	3.03%
合计		-	**73,740.80**	**24.70%**
2024 年度				
序号	客户名称	客户类型	销售金额	占比
1	深圳海格微电子有限公司	经销	23,852.67	8.91%
2	欣旺达电子股份有限公司	直销	10,889.29	4.07%
3	深圳翰世宇科技有限公司	经销	9,339.18	3.49%
4	深圳市联盛电子有限公司	经销	8,842.11	3.30%
5	南京高上美电子有限公司	经销	8,462.49	3.16%
合计		-	**61,385.74**	**22.93%**
2023 年度				
序号	客户名称	客户类型	销售金额	占比
1	深圳海格微电子有限公司	经销	17,181.76	7.60%
2	深圳市联盛电子有限公司	经销	8,925.66	3.95%
3	欣旺达电子股份有限公司	直销	7,324.23	3.24%

4	南京高上美电子有限公司	经销	6,666.52	2.95%
5	深圳市广丰盛电子有限公司	经销	5,611.88	2.48%
合计		**-**	**45,710.05**	**20.23%**

注：同一控制下的客户已合并计算

报告期各期，公司前五大客户的销售占比分别为20.23%、22.93%和24.70%，公司不存在对单个客户的销售比例超过销售总额50%的情形，亦不存在严重依赖于少数客户的情形。

公司与上述客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方均未在上述客户中持有任何权益。

2、报告期内新增前五大客户情况

2024 年度，深圳翰世宇科技有限公司新增成为公司前五大客户，该客户在成为公司当期前五大客户前本身已与公司形成了长期稳定的合作关系，新增成为公司前五大客户主要系业务量变动原因，不存在异常的情况。

四、采购情况和主要供应商

（一）主要采购情况

1、主要采购情况

报告期内，发行人采用 Fabless 与 IDM 并行的经营模式，其中 Fabless 模式下的公司将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给外部供应商完成，主要采购的内容包括晶圆、封测服务、集中委托成品采购等。报告期内，公司采购的材料及服务情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比
封测服务	45,245.20	25.27%	45,734.38	28.97%	38,742.60	30.45%
晶圆	46,943.31	26.22%	37,975.30	24.06%	30,224.46	23.76%
集中委托成品采购	46,128.29	25.76%	39,221.18	24.85%	25,789.62	20.27%
晶圆制造材料	24,032.71	13.42%	22,221.48	14.08%	22,604.50	17.77%
封测材料	16,709.73	9.33%	12,693.55	8.04%	9,857.87	7.75%
合计	**179,059.25**	**100.00%**	**157,845.89**	**100.00%**	**127,219.05**	**100.00%**

注：集中委托成品采购指发行人通过向该厂商采购成品的方式完成晶圆和封装测试服务的采购。

（1）主要原材料采购价格情况

公司的晶圆供应商主要为芯联集成、格瑞宝、力积电、北京伊泰克电子有限公司等厂商。公司进行晶圆采购时，由公司提供电路设计文件，或工艺要求、产品参数等关键信息，由晶圆供应商进行供货。

晶圆采购价格主要由晶圆尺寸、工艺复杂程度、产品结构和市场供求变化等因素决定。报告期各期，发行人晶圆采购单价分别为 0.0348 元/颗、0.0312 元/颗、0.0344 元/颗，平均单价整体保持稳定。

（2）主要服务采购价格情况

封测服务的价格主要由芯片封装的耗材、封装形式等因素决定。报告期内，发行人封测服务的采购单价分别为 0.0290 元/颗、0.0276 元/颗和 0.0221 元/颗，整体呈下降趋势，主要系发行人降低封测供应商集中度、优化供应商体系所致。

2、能源采购情况

报告期内，发行人体系内生产型子公司包括新顺微、长晶浦联、海德半导体，涉及生产能源采购；其余经营主体均不涉及生产加工，所消耗的能源为日常办公生活用水用电，未纳入本次统计。

报告期内，发行人生产加工所涉及的能源主要为水、电和蒸汽，采购情况如下：

种类	项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电	数量（万度）	7,787.39	6,142.79	5,242.84
	金额（万元）	4,742.65	4,058.20	3,432.17
	平均单价（元/度）	0.61	0.66	0.65
水	数量（万方）	150.71	119.30	79.51
	金额（万元）	640.55	521.78	355.94
	平均单价（元/方）	4.25	4.37	4.48
蒸汽	数量（万吨）	2.08	1.73	1.76
	金额（万元）	431.69	396.93	447.39
	平均单价（元/吨）	207.27	229.77	253.85

（二）向前五名供应商采购情况

1、报告期内发行人向前五大供应商的采购额及其占比

报告期各期，公司向前五大供应商的采购情况如下：

单位：万元

2025 年度				
序号	供应商名称	主要采购类型	采购金额	占当期采购总额的比例
1	芯联集成电路制造股份有限公司	晶圆、封测服务、集中委托成品采购	42,529.31	23.75%
2	江苏长电科技股份有限公司	封测服务	19,757.28	11.03%
3	江阴市州禾电子科技有限公司	封测服务	14,043.44	7.84%
4	上海格瑞宝电子有限公司	晶圆、集中委托成品采购	8,068.15	4.51%
5	北京伊泰克电子有限公司	晶圆	6,342.89	3.54%
合计			**90,741.06**	**50.68%**
2024 年度				
序号	**供应商名称**	**主要采购类型**	**采购金额**	**占当期采购总额的比例**
1	芯联集成电路制造股份有限公司	晶圆、封测服务、集中委托成品采购	29,889.46	18.94%
2	江苏长电科技股份有限公司	封测服务	28,221.99	17.88%
3	江阴市州禾电子科技有限公司	封测服务	10,183.70	6.45%
4	上海格瑞宝电子有限公司	晶圆、集中委托成品采购	8,043.13	5.10%
5	北京伊泰克电子有限公司	晶圆	6,686.67	4.24%
合计			**83,024.94**	**52.60%**
2023 年度				
序号	**供应商名称**	**主要采购类型**	**采购金额**	**占当期采购总额的比例**
1	江苏长电科技股份有限公司	封测服务	26,965.64	21.20%
2	芯联集成电路制造股份有限公司	晶圆、封测服务、集中委托成品采购	13,760.25	10.82%
3	江阴市州禾电子科技有限公司	封测服务	6,835.97	5.37%
4	上海格瑞宝电子有限公司	晶圆、集中委托成品采购	6,122.69	4.81%
5	北京伊泰克电子有	晶圆	5,442.70	4.28%

	限公司			
合计			**59,127.23**	**46.48%**

注：同一控制下的企业已合并计算。

公司供应商主要为长电科技、芯联集成等行业知名封测厂商或晶圆代工厂商。报告期各期，公司前五大供应商占各期采购总额的比例分别为 46.48%、52.60%和 50.68%，公司不存在对单一供应商采购比例超过 50%的情况，亦不存在严重依赖于少数供应商的情形。

报告期各期的前五大供应商中，格瑞宝为发行人副总经理范荣定的亲属任董事兼高级管理人员的企业。格瑞宝是行业知名从事 MOSFET 研发、设计应用、销售的半导体公司，与华虹宏力等知名晶圆厂长期合作。报告期内，公司主要向格瑞宝采购 MOSFET 晶圆及少量成品，公司向格瑞宝采购晶圆后进行封装，形成成品后对外销售，或由格瑞宝协调产业链资源，直接根据公司产品定义和需求交付成品。公司与格瑞宝的采购定价系参考市场价格经协商确定，交易价格公允。

除上述情形外，发行人、发行人控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上其他供应商不存在关联关系。

2、报告期内新增前五大供应商情况

报告期内，发行人的前五大供应商较为稳定，不存在新增前五大供应商情况。

五、发行人的主要固定资产和无形资产

（一）发行人拥有的固定资产

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产的总体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	45,791.63	5,101.34	-	40,690.29	88.86%
运输设备	1,341.16	938.68	-	402.48	30.01%
机器设备	109,582.92	37,367.51	-	72,215.41	65.90%
办公及其他设备	1,535.45	926.16	-	609.29	39.68%
合计	**158,251.17**	**44,333.69**	**-**	**113,917.48**	**71.99%**

1、房屋建筑物

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已经取得权属证书的房屋建筑物情况如下：

序号	证书号	权利人	房屋坐落	建筑面积（㎡）	用途
1	粤（2022）深圳市不动产权第 0018071 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19E	63.36	办公
2	粤（2022）深圳市不动产权第 0018076 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19F	162.06	办公
3	粤（2022）深圳市不动产权第 0018073 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19G	133.74	办公
4	粤（2022）深圳市不动产权第 0018092 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19H	162.06	办公
5	粤（2022）深圳市不动产权第 0018086 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19I	69.03	办公
6	粤（2022）深圳市不动产权第 0018099 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19J	73.48	办公
7	粤（2022）深圳市不动产权第 0018113 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19K	73.48	办公
8	粤（2022）深圳市不动产权第 0018120 号	深圳长晶	深圳市南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19L	69.11	办公
9	苏（2017）江阴市不动产权第 0048523 号	海德半导体	申港街道东徐路 3 号	5,059.63	生产
10	苏（2017）江阴市不动产权第 0048527 号	海德半导体	申港街道东徐路 3 号	2,179.18	生产
11	粤（2024）深圳市不动产权第 0088626 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19M	162.06	办公
12	粤（2024）深圳市不动产权第 0088635 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19N	136.76	办公
13	苏（2026）宁浦不动产权第 0002501 号	长晶浦联	浦口区云实路 28 号	66,331.63	生产

注：第 13 项长晶浦联的房屋建筑物及其相应的土地使用权已依据长晶浦联与中国工商银行股份有限公司签订的《抵押合同》抵押给中国工商银行股份有限公司，已办理最高额抵押登记，债权确定期限为 2022 年 11 月 33 日至 2037 年 9 月 20 日，最高额抵押项下担保责任的最高限额为 3,479 万元。

2、租赁的房产

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人与生产、办公相关的主要租赁房产的具体情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁位置	租赁面积（㎡）	租赁价格（元/月）	租赁期限	用途
1	南京力合创展科技服务有限公司	长晶科技	南京市江北新区研创园江淼路腾飞大厦 C 座 13 楼、18 楼	3,064.00	160,764.25	2025-4-1 至 2026-3-31	办公、研发
2	无锡市河埒经济发展投资有限公司	长晶科技	无锡市滨湖区梁清路 88 号 707 室	316.63	23,113.99	2024-12-15 至 2027-12-14	办公
3	南京力合创展科技服务有限公司	长晶科技	南京江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 D 座 501 室	641.14	33,009.55	2025-9-1 至 2026-3-31	办公、研发

序号	出租方	承租方	租赁位置	租赁面积（㎡）	租赁价格（元/月）	租赁期限	用途
4	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司	长晶科技	上海市浦东新区东育路 221 弄 11 号前滩世贸中心三期 B 栋 7 层 04 单元	538.36	91,700.65	2025-3-16 至 2028-3-15	办公
5	北京国泰阳光投资管理股份有限公司	长晶科技	北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 707-2	164.73	22,732.74	2025-6-14 至 2027-6-13	办公
6	深圳市圣廷苑物业管理有限公司	深圳长晶	中洲控股金融中心地下室-B3 仓库	87.00	8,700.00	2024-6-1 至 2026-5-31	仓库
7	深圳市万佳供应链有限公司	深圳长晶	深圳市宝安区福永街道怀德翠岗工业二区 26 栋 4 楼（东侧半幅）	1,700.00	94,500.00	2024-5-1 至 2026-6-30	仓库
8	刘旸	深圳长晶	深圳市南山区中洲控股金融中心 B 座商务公寓 19A、B	231.17	34,675.00	2024-10-1 至 2029-9-30	办公
9	深圳中安云谷物业管理有限公司	长晶微电子	深圳市龙岗区布吉街道广场路中安大厦 18 层 1811 室	/	17,000.00	2024-4-1 至 2027-3-31	办公
10	深圳艺晶发展有限公司	长晶微电子	深圳市南山区西丽街道松白路 1008 号 F 栋 7 楼 704 室	/	9,800.34	2025-6-1 至 2027-5-31	办公、生产、研发
11	深圳艺晶发展有限公司	长晶微电子	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1008 号 E 栋 1 楼 101C 室	/	11,449.00	2025-6-1 至 2027-5-31	办公、生产、研发
12	万晖国际有限公司	香港长晶	沙田火炭坳背湾街 2-12 号威力工业中心 6A	/	32,300.00 港币/月	2025-2-1 至 2028-1-31	办公、仓库
13	PROMANINVESTMENTLTD	香港长晶	火炭坳背湾街 2-12 号威力工业中心 6A1	/	25,900.00 港币/月	2025-2-1 至 2028-1-31	办公、仓库
14	南京芯福绪科技发展有限公司	长芯检测	南京市浦口经济开发区中科创新产业园-A7-2F 房间	2,792.93	首年租金为 1,005,454.80 元，自第 1 年后每 1 年租金在上一年费用总额的基础上递增 3%	2021-10-22 至 2026-10-21	生产
15	长电科技	新顺微	江阴市澄江街道长山路 78 号长电科技城东厂区内高脚位集成电路生产项目主厂房 JKL 区及辅助用房	26,977.80	522,700.00	2023-1-1 至 2029-12-31	生产

序号	出租方	承租方	租赁位置	租赁面积（㎡）	租赁价格（元/月）	租赁期限	用途
16	浦建华	海德半导体	苏州市人民路 3188 号 8 幢 904 室	96.92	3,600.00	2025-8-25 至 2026-8-24	办公
17	北京国泰阳光投资管理股份有限公司	北京分公司	北京市海淀区北四环西路 67 号中关村国际创新大厦 707-2 号	164.73	22,732.74	2025-6-14 至 2027-6-13	办公
18	陈龙	海德半导体	深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 座 6I	69.21	20,899.50	2025-6-3 至 2028-6-12	办公

注 1：截至本招股说明书签署日，表中序号 1、3 所涉到期房产租赁合同已依法续期。租赁期限为：2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。

注 2：截至本招股说明书签署日，表中序号 6 所涉到期房产租赁合同已依法续期。租赁期限为：2026 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日。

注 3：截至本招股说明书签署日，表中序号 7 所涉即将到期房产租赁合同已依法续期。租赁期限为：2026 年 5 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日。

（二）发行人拥有的无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有土地使用权 13 项，具体情况如下：

序号	证书号	使用权人	土地坐落	宗地面积（㎡）	取得方式	用途	终止日期
1	粤（2022）深圳市不动产权第 0018071 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19E	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日
2	粤（2022）深圳市不动产权第 0018076 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19F	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日
3	粤（2022）深圳市不动产权第 0018073 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19G	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日
4	粤（2022）深圳市不动产权第 0018092 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19H	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日
5	粤（2022）深圳市不动产权第 0018086 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19I	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日
6	粤（2022）深圳市不动产权第 0018099 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19J	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日
7	粤（2022）深圳市不动产权第 0018113 号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心 B 座 19K	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056 年 3 月 16 日

序号	证书号	使用权人	土地坐落	宗地面积（㎡）	取得方式	用途	终止日期
8	粤（2022）深圳市不动产权第0018120号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心B座19L	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056年3月16日
9	苏（2017）江阴市不动产权第0048523号	海德半导体	申港街道东徐路3号	9,643.60	出让	工业用地	2054年3月2日
10	苏（2017）江阴市不动产权第0048527号	海德半导体	申港街道东徐路3号	1,351.90	出让	工业用地	2054年3月2日
11	粤（2024）深圳市不动产权第0088626号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心B座19M	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056年3月16日
12	粤（2024）深圳市不动产权第0088635号	深圳长晶	南山区后海大道东中洲控股金融中心B座19N	25,727.80	出让	商业用地，服务业用地	2056年3月16日
13	苏（2026）宁浦不动产权第0002501号	长晶浦联	浦口区云实路28号	98,829.41	出让	工业用地/工业（配套），工业，仓储（危），仓储	2072年6月29日

注1：第13项长晶浦联的房屋建筑物及其相应的土地使用权已依据长晶浦联与中国工商银行股份有限公司签订的《抵押合同》抵押给中国工商银行股份有限公司，已办理最高额抵押登记，债权确定期限为2022年11月33日至2037年9月20日，最高额抵押项下担保责任的最高限额为3,479万元。

注2：第13项土地使用权自2022年6月30日生效，本项列示证书号系证书换发变更。

2、专利权

截至2025年12月31日，发行人及其子公司拥有85项发明专利、159项实用新型专利，具体参见本招股说明书“第十三节 附表”之“附表一：专利权”。

3、集成电路布图设计

截至2025年12月31日，发行人及其子公司拥有130项集成电路布图设计，具体参见本招股说明书“第十三节 附表”之“附表二：集成电路布图设计”。

4、商标专用权

截至2025年12月31日，发行人及其子公司拥有23项注册商标，具体参见本招股说明书“第十三节 附表”之“附表三：商标专用权”。

5、软件著作权

截至2025年12月31日，发行人及其子公司合计持有33件软件著作权，具体参见本招股说明书“第十三节 附表”之“附表四：软件著作权”。

6、美术作品著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合计持有 9 项美术作品著作权，具体参见本招股书“第十三节 附表”之“附表五：美术作品著作权”。

7、域名

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司合计持有 4 项域名，具体情况如下：

序号	权属人	网站名称	网址	域名	许可证号	到期日期
1	长晶科技	江苏长晶科技有限公司官网	www.jscj-elec.com	jscj-elec.com	苏 ICP 备 19025516 号-1	2028-12-20
2	海德半导体	江苏海德半导体有限公司官网	www.h-diode.com	h-diode.com	苏 ICP 备 19001349 号-1	2027-04-04
3	新顺微	江苏新顺微电子股份有限公司	www.xinshun.cn	xinshun.cn	苏 ICP 备 05082642 号-1	2028-03-03
4	新顺微	江苏新顺微电子股份有限公司	www.xinshun.cn	xs-elec.com	苏 ICP 备 05082642 号-1	2027-11-01

8、主要经营资质及认证

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司持有的现行有效的主要经营资质及认证等证书情况如下：

序号	资质名称	发证单位	有效期	权属主体
1	质量管理体系认证证书（ISO9001）	奥邦检验认证集团有限公司	2025-07-18 至 2028-08-14	长晶科技
2	中国职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）	奥邦检验认证集团有限公司	2025-07-18 至 2028-08-14	长晶科技
3	企业知识产权管理体系认证证书（GB/T29490）	北京万坤认证服务有限公司	2025-11-26 至 2028-11-02	长晶科技
4	环境管理体系认证证书（ISO14001）	奥邦检验认证集团有限公司	2025-07-18 至 2028-07-25	长晶科技
5	信息安全管理体系认证证书（ISO27001）	中标华信（北京）认证中心有限公司	2023-06-26 至 2026-06-25	长晶科技
6	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2023-11-06 至 2026-11-05	长晶科技
7	对外贸易经营者备案	江苏省南京市江北新区行政审批局	2019-01-22 起	长晶科技
8	有害物质过程管理体系认证证书	华认标准技术服务（苏州）有限公司	2025-9-8 至 2028-9-7	长晶科技
9	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税	2024-12-24 至 2027-12-23	海德半导体

序号	资质名称	发证单位	有效期	权属主体
		务局		
10	汽车行业质量管理体系认证证书（IATF16949）	上海恩可埃认证有限公司	2024-11-07 至 2027-11-06	海德半导体
11	质量管理体系认证证书（ISO9001）	北京航协认证中心有限责任公司	2024-09-04 至 2027-09-16	海德半导体
12	环境管理体系认证证书（ISO14001）	北京航协认证中心有限责任公司	2024-09-04 至 2027-09-16	海德半导体
13	固定污染源排污登记回执	-	2025-08-24 至 2030-08-23	海德半导体
14	汽车行业质量管理体系认证证书（IATF16949）	上海恩可埃认证有限公司	2025-05-06 至 2028-05-05	长晶浦联
15	固定污染源排污登记回执	-	2022-05-14 至 2027-05-13	长晶浦联
16	排污许可证	南京市生态环境局	2025-03-05 至 2030-03-04	长晶浦联
17	食品经营许可证	南京市浦口区市场监督管理局	2025-05-20 至 2030-05-19	长晶浦联
18	对外贸易经营者备案	江苏省南京市浦口区行政审批局	2020-11-23 起	长晶浦联
19	环境管理体系认证证书（ISO14001）	赛瑞认证有限公司	2026-01-22 至 2029-01-10	长晶浦联
20	中国职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）	赛瑞认证有限公司	2026-01-22 至 2029-01-10	长晶浦联
21	有害物质过程管理体系认证证书	华认标准技术服务（苏州）有限公司	2025-9-8 至 2028-9-7	长晶浦联
22	静电防护管理体系认证证书	上海恩可埃认证有限公司	2025-12-22 至 2026-12-21	长晶浦联
23	质量管理体系认证证书（ISO9001）	北京新纪源认证有限公司	2025-3-27 至 2028-8-4	长晶浦联
24	对外贸易经营者备案	深圳市龙岗区工业和信息化局	2019-05-09 起	长晶微电子
25	质量管理体系认证证书（ISO9001）	华亿认证中心有限公司	2024-10-16 至 2027-10-15	长晶微电子
26	职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）	华亿认证中心有限公司	2024-10-16 至 2027-10-15	长晶微电子
27	环境管理体系认证证书（ISO14001）	华亿认证中心有限公司	2024-10-16 至 2027-10-15	长晶微电子
28	固定污染源排污登记回执	-	2022-7-25 至 2027-7-24	长芯检测
29	CNAS 实验室认可证书	中国合格评定国家认可委员会	2023-09-14 至 2029-09-13	长芯检测
30	CMA 检验检测机构资质认定证书	江苏省市场监督管理局	2023-02-22 至 2029-02-21	长芯检测
31	排污许可证	无锡市生态环境局	2023-10-11 至 2028-10-10	新顺微
32	质量管理体系认证证书（ISO9001）	广州赛宝认证中心服务有限公司	2024-05-23 至 2027-05-22	新顺微
33	知识产权管理体系认证证书	中规（北京）认证有	2025-10-14 至	新顺微

序号	资质名称	发证单位	有效期	权属主体
	（GB/T29490）	限公司	2026-10-11	
34	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2023-11-06 至 2026-12-05	新顺微
35	环境管理体系认证证书（ISO14001）	奥邦检验认证集团有限公司	2025-03-31 至 2028-03-30	新顺微
36	IECQ 证书有害物质过程管理（QC080000）	奥邦检验认证集团有限公司	2025-03-31 至 2028-03-30	新顺微
37	质量管理体系认证证书（IATF16949）	北京九鼎国联认证有限公司	2024-07-03 至 2027-07-02	新顺微

六、发行人的核心技术及研发情况

（一）核心技术情况

1、产品相关核心技术

序号	产品类别	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征	知识产权保护	技术先进程度	技术所处阶段	技术来源
1	分立器件（MOSFET）	高密度沟槽 MOS 产品及技术	（1）更高密度的沟道密度，精细化孔设计，极大的降低了器件的导通电阻，Rsp 较上代产品降低 8%以上；（2）采用独特 ESD 设计，提升器件的可靠性，满足 2KV 以上的 ESD 需求；（3）采用特殊后段减薄与厚金属工艺，克服因超薄工艺可能导致的晶圆翘曲，来实现超低导通阻抗产品。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
2	分立器件（MOSFET）	低导通阻抗 CSP MOS 产品及技术	（1）特殊设计的 MOS 结构，工艺简单、易实现封装；（2）高密度沟槽结构结合先进的背面减薄和背金工艺，能够实现更高的电流密度和更低的导通阻抗；（3）先进的封装以及检测技术，器件可靠性得到保障。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
3	分立器件（MOSFET）	高可靠性 SGT MOS 技术及产品	（1）采用精细的结构设计，优异的单位面积导通电阻 Rsp 和优值系数 FOM 的表现，Rsp 降低 25%以上；（2）器件应用可靠性高；器件结温能够达到 175℃。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
4	分立器件（MOSFET）	FRMOS 开发和平台建立、集成自充电电阻的 VDMOS 的开发和平台	（1）在兼具 VDMOS 产品抗浪涌能力特点的同时，有效降低产品的 Qg 值，实现损耗少、温升低的效果，现有 VDMOS 产品型号已覆盖了多种电流和电压标准，电压规格最高到 1500V；（2）系列 FRMOS 产品具备卓越开关特性的 FRMOS 技术，显著提升了电力转换效率与系统的整体可靠性。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
5	分立器件（IGBT）	高密度 IGBT 技术及产品	（1）采用精细化沟槽工艺与超薄晶圆加工技术，器件具有优异的导通电压和开关损耗折中，导通压降降低 0.2V 以上；（2）高可靠性终端结构，器件耐压稳定，应用可靠性高，器件能够达到 175℃的结温；（3）特殊的结构和工艺	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发

序号	产品类别	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征	知识产权保护	技术先进程度	技术所处阶段	技术来源
			设计，实现了高短路的器件能力，器件通用性强。				
6	分立器件（SiC）	高可靠 SiC 技术及产品	（1）采用先进的衬底减薄技术和新颖的结构设计，产品具有优异的单位面积导通电阻 Rsp 和优良的栅氧可靠性；（2）优化的芯片布局，具有极低的寄生参数，能够极大的体现 SiC 的高速特性；（3）高可靠性和改善性封装，结合器件优良的终端设计，能够使器件在高温下稳定工作。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
7	分立器件（二极管）	Trench SBD 产品的 45-200V 产品平台技术	该技术平台形成了电压从 45V 到 200V 的全电压 Trench SBD 产品，采用多种金属化工艺技术匹配不同的封装要求，系列平台显著的提升了产品的 PCT（高压蒸煮测试）适应性、H3TRB（高温反偏可靠性测试标准）可靠性通过率、在降低了肖特基的正向导通压降的同时，全面的提升产品的 ESD 水平，代表产品 10A100V 由原来的 12KV 提升到 30KV 以上。采用自有专利空穴复合技术的沟槽产品导通损耗降低 5%。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
8	分立器件（二极管）	Planar SBD 产品的 20-300V 的产品平台 技术	涵盖 20V~300V 的工作电压范围，按工作电流大小分为 3A 以下（20mA~3A）的小功率产品、3A 及以上（3A~50A）的中大功率产品。具有较强的正反向浪涌能力，同时采用了新工艺，相比同类产品具有较低的正向压降。采用了多种的势垒金属以实现客户对不同结温、不同 VF 的个性需求。代表产品 S1XSH 系列产品全部实现了 175℃的结温考核。同时典型产品已经实现了上车批量应用。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
9	分立器件（二极管）	高可靠的快恢复二极管技术	（1）漏电特别小，高温性能强；（2）具有 VF-Qrr 折中特性好，降低产品应用功耗；（3）多层外延结构，使得恢复更软，有利于 EMI（电磁干扰）设计；（4）通过平台化的发展，实现产品 175℃结温考核、额定电流的正温度系数产品的平台完善，150A650V 产品已经实现在模块上应用。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
10	分立器件（二极管）	低压单向及高对称性高 IPP（峰值脉冲电流）水平的 TVS 二极管技术平台	（1）研发出基区穿通和沟槽隔离等多种结构；（2）具有钳位低，浪涌能力强、响应时间快、瞬态功率大、漏电低、击穿电压偏差小等特点；（3）量产了低容带回扫功能的 TVS 器件。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
11	分立器件（二极管）	多终端技术整流二极管技术	（1）具有场板结构、SiPOS 结构、场限环结构、JTE 结构等多种结构设计能力；（2）击穿电压高，反向漏电流小，高温性能良好；（3）丰富的封装及产品电压覆盖多种应用场合。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
12	分立器件（二极管）	高精度稳压二极管技术	（1）在宽的电压调试范围，精准的掺杂技术及稳定的炉管工艺，保证量产芯片各电压档位都具有高的稳压值一致性，动态阻抗小的特点；（2）复合的正面金属工艺，减小了金属的电迁移对芯片 PN 结的影响，提高产品对封装的适应能力；（3）采用氮化硅钝化工艺减少	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发

序号	产品类别	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征	知识产权保护	技术先进程度	技术所处阶段	技术来源
			了芯片划伤的同时，提高了芯片的防潮能力。				
13	分立器件（三极管）	高频高可靠小信号放大三极管技术	（1）具备齐备的 NPN 或 PNP 小信号系列，种类多品种全，涵盖 12V~400V 的工作电压范围，各种 hFE 档位均齐备；（2）通过精确的结深控制技术降低了小信号三极管的饱和压降；（3）频率范围从 10MHz 到 300MHz 可调；（4）有阻达林顿、无阻达林顿系列具备较宽工艺适应性、较大电流增益、较广电压范围的优势。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
14	分立器件（三极管）	音频、功率放大用三极管产品系列	（1）音响中大功率三极管采用了基区、发射区镇流电阻技术，使得芯片具备了较高的二次击穿耐量；（2）大电流特性、频率特性均与进口原装管一致；（3）采用了缓变集电区的技术增强了芯片的抗冲击能力；（4）较高的 hFE 均匀性技术使得芯片具备了良好的高、低音音质。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
15	分立器件（三极管）	高耐压、高可靠三极管技术平台	（1）通过自有场限环、结终端延伸及偏移场板技术，实现芯片电压 500V-1700V 宽范围可调；（2）采用自主终端保护设计与氮化硅加聚酰亚胺双层钝化技术，解决超结温应用时的击穿特性问题并降低封装要求；结合独特高温保护技术，显著提升产品高温击穿稳定性；（3）运用特色双基区工艺，大幅改善产品 hFE 均匀性；（4）高温工作的 SOP-7 组合封装高反压晶体管（AC-DC 功率开关），其 BVCBO 稳定性影响产品可靠性。通过恒温烘箱内施加恒定集电极-基极电流、监控电压变化，分析高温击穿退化根源，经 MPW（多项目晶圆，即将多个具有相同工艺的芯片设计放在同一晶圆片上流片加工）流片验证优化全系列产品，提升可靠性。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
16	分立器件（三极管）	集成启动电阻的高反压晶体管系列平台	（1）减小芯片尺寸与降低成本：在结终端扩展结构的终端上集成可调（1.7MΩ～20MΩ）启动电阻，省去外置电阻空间，有效减小芯片面积；（2）提升集成度与可靠性：将高压启动电阻直接集成到功率晶体管芯片上，解决了传统 AC-DC 方案中外置高压电阻（需≥1.7MΩ）易烧毁的问题，显著提高系统集成度、简化封装、并增强整体可靠性；（3）产品优势显著：该系列产品具备高压、小尺寸、高集成、高可靠性和终端设计简洁等优势，节能效果突出。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
17	电源管理 IC	线性稳压器的高电源抑制比和低功耗优化技术	在线性稳压器电路中，提升运放的第一级、第二级驱动能力的基础上，引入动态补偿来保证全范围环路稳定性，可以明显提升 LDO 的环路带宽和增益，增强抗噪声能力。同时针对高压 LDO，加入耗尽管，将耗尽管基准和运放合二为一，减少启动电路，减小其偏置电流，在实现电路性能的基础上，节省了运放的偏置电流，优化芯片静态功耗并优化成本	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发

序号	产品类别	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征	知识产权保护	技术先进程度	技术所处阶段	技术来源
			从而实现性能和成本的最佳结合。				
18	电源管理IC	应用于三端稳压器件的强防浪涌电流和宽频的高电源抑制比技术	突破性采用优化的内部软启动电路和折返电流限制电路，在最大限度减小输入电容的同时，减小启动的浪涌电流，增强器件抗浪涌能力；同时优化内部运算放大器结构，最大限度降低高带宽PSRR性能，在120Hz时大于70dB，减少输入电源噪声对输出电压的影响，最大限度减少后置稳压器滤波压力，提高电源抑制能力。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
19	电源管理IC	优化的多级驱动和抖频的低噪声DC-DC技术	DC-DC 通过自动检测的多级驱动技术，加速开关导通速率的同时，减小输出噪声，从而确保高开关频率下的高转换效率，低噪声，并配合优化抖频技术，以优化 EMI 特性（电磁干扰），完善的FB断路保护，过压过流等功能，满足不同系统应用的极致要求。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发
20	电源管理IC	基于COT（恒定导通时间）控制架构的优化动态纹波补偿的宽输出电压范围DC-DC技术	针对不同的应用场景，开发自适应高精度纹波斜坡补偿技术，根据系统不同输出电压和不同占空比，自适应调整芯片内部斜坡补偿幅度大小，确保在宽输入和输出电压条件下，确保系统稳定性同时，输出负载跳变的纹波满足终端应用需求。	已获授权专利	国内领先	批量生产阶段	自主研发

2、生产制造相关核心技术

序号	工艺类别	核心技术名称	核心技术先进性及具体表征	知识产权保护	技术先进程度	技术所处阶段	技术来源
1	晶圆制造技术	高密度多样化封装的背面金属化工艺技术	（1）高可靠性多层复合金属化结构； （2）具有高润湿性、良好的导热/导电性特点，封装后的成品空洞率＜3%； （3）适宜高密度等多样化新封装形式，不同的工艺适应于6排、12排、18排、27排的高密度封装； （4）适配产业化的环保型背面金属化工艺。	已获授权专利	国内领先	批量生产	自主开发
2	晶圆制造技术	低正向肖特基二极管沟槽刻蚀工艺技术	（1）刻蚀后的硅沟槽角度87-88°，改善多晶硅的填充效果； （2）刻蚀片内均匀性较好，片内均匀性可以满足±0.1微米要求，提高产品参数一致性； （3）刻蚀后的去Polymer（除刻蚀残留聚合物）工艺，提高产品良率、可靠性。	已获授权专利	国内领先	批量生产	自主开发
3	封装技术	高密度阵列式框架设计和封装结构设计技术	框架设计多排化使每条框架产品数增加，同时提高单位面积内的产品数，提高生产效率及降低材料消耗。以SOT-23为例，使用该技术使每平方厘米产品数提高约78%。	已获授权专利	国内领先	批量生产	自主研发
4	封装技术	装片锡膏工艺技术	采用甲酸高导电导热锡膏工艺，响应国家绿色发展理念，降低对环境的影响，烧结后无助焊剂残留，提高焊线质量降低分层风险，烧结后空洞能力可达单个<1%、累计<3%（行业标准：单个<5%、累计<15%），位于行业领先水平。	已获授权专利	国内领先	批量生产	自主研发

3、核心技术相关产品收入占营业收入比例

报告期内，公司应用核心技术的业务包括分立器件及其晶圆、电源管理 IC，前述产品形成的收入占公司营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术相关产品收入	292,793.12	263,589.45	222,250.76
营业收入	298,523.51	267,765.34	225,989.82
占营业收入的比例	**98.08%**	**98.44%**	**98.35%**

注：核心产品收入包括报告期内主营业务收入中的分立器件、电源管理 IC 和晶圆收入。

（二）科研实力和成果情况

1、获奖情况

（1）公司获得的荣誉情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司获得的主要荣誉情况如下：

序号	荣誉/奖励名称	颁发时间	获奖主体	颁发机构
一、国家级证书				
1	国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年 8 月（2025 年 10 月复审通过）	长晶科技	工业和信息化部
2	国家级专精特新“小巨人”企业	2023 年 7 月	新顺微	工业和信息化部
二、行业级证书				
3	连续六年被评为“中国半导体行业功率器件十强企业”	2020 年 8 月、2021 年 6 月、2022 年 7 月、2023 年 7 月、2024 年 7 月、2025 年 7 月	长晶科技	中国半导体行业协会
4	中国半导体行业协会理事单位	2025 年 5 月	长晶科技	中国半导体行业协会
5	中国电源学会常务理事单位	2024 年 12 月	长晶科技	中国电源学会
6	江苏省半导体行业协会 副理事长单位	2025 年 8 月	长晶科技	江苏省半导体行业协会
7	江苏省半导体行业协会常务理事单位	2025 年 8 月	新顺微	江苏省半导体行业协会
8	2025 中国汽车芯片优秀供应商	2025 年 11 月	长晶科技	21IC 电子网
9	中国半导体市场领军企业	2023 年 7 月	长晶科技	赛迪顾问股份有限公司
三、省级证书				
10	江苏省专精特新中小企业	2021 年 12 月（2024 年 12 月复审通过）	长晶科技	江苏省工业和信息化厅

序号	荣誉/奖励名称	颁发时间	获奖主体	颁发机构
11	江苏省专精特新中小企业	2022 年 12 月（2025 年 12 月复审通过）	新顺微	江苏省工业和信息化厅
12	江苏瞪羚企业	2024 年 12 月	长晶科技	江苏省生产力促进中心
13	江苏省智能制造示范车间	2023 年 12 月	新顺微	江苏省工业和信息化厅、江苏省财政厅
14	江苏省示范智能车间	2020 年 12 月	海德半导体	江苏省工业和信息化厅、江苏省财政厅
15	江苏省民营科技企业	2024 年 6 月	新顺微	江苏省民营科技企业协会
四、市级证书				
16	连续六年被评为“南京制造业企业 100 强”	2020 年 12 月、2021 年 11 月、2022 年 11 月、2023 年 11 月、2024 年 11 月、2025 年 11 月	长晶科技	南京市企业联合会、南京市企业家协会
17	南京成长型企业 50 强	2022 年 11 月、2024 年 11 月	长晶科技	南京市企业联合会、南京市企业家协会
18	南京市百强高新技术企业	2023 年 1 月、2024 年 2 月	长晶科技	南京市科学技术局、江苏省科学技术发展战略研究院、南京市科技信息研究所
19	南京市培育独角兽企业	2021 年 6 月、2022 年 8 月	长晶科技	南京市发展改革委
20	南京市创新型领军企业	2021 年 11 月	长晶科技	南京市科学技术局
21	江阴市重点骨干企业	2023 年、2024 年	新顺微	中共江阴市委江阴市人民政府
22	百强明星企业	2023 年 5 月、2024 年 3 月、2025 年 4 月	新顺微	中共江阴市委江阴市人民政府
23	无锡市智能制造标杆	2022 年 8 月	海德半导体	无锡市工业和信息化局

（2）公司产品、项目获得荣誉情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司产品、项目获得的主要荣誉情况如下：

序号	奖项	获奖项目	颁发机构	获奖主体	获奖时间
1	江苏省专精特新产品	功率晶体管	江苏省工业和信息化厅	长晶科技	2021 年
2	江苏省工信厅新产品新技术鉴定验收证书	低阻值 WLCSP MOSFET（鉴定委员会认为该产品总体处于国内领先，国际先进）	江苏省工业和信息化厅	长晶科技	2022 年
3	江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（2024 年）	CSP MOSFET、IGBT	江苏省工业和信息化厅	长晶科技	2025 年
4	南京市首批创新产品	CSP MOSFET	南京市工业和信息化局创新产品	长晶科技	2020 年

序号	奖项	获奖项目	颁发机构	获奖主体	获奖时间
			推广办公室		
5	南京市创新产品	低导通电阻屏蔽栅沟槽型 MOSFET	南京市工业和信息化局创新产品推广办公室	长晶科技	2022 年

2、重大科研项目

报告期内，公司参与的重大科研项目如下：

序号	项目类别	项目名称	项目周期	项目来源
1	江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）	低功耗高可靠超结 MOS 器件关键技术研发	2020 年至 2023 年	江苏省科学技术厅
2	2020 年度南京江北新区重点研发计划	超低内阻晶圆级封装功率 MOS 器件	2020 年至 2023 年	江北新区管委会科技创新局
3	江苏省工程技术研究中心项目	江苏省（长晶）功率半导体工程技术研究中心（开展 IGBT、CSP、SGT MOS 等高性能功率器件研究）	2023 年 6 月至 2026 年 6 月	南京江北新区管理委员会科技创新和大数据管理局
4	江苏省科技成果转化专项资金项目	新能源汽车超高功率密度模块电源用车规级芯片的研发及产业化	2023 年 1 月至 2026 年 6 月	无锡市科学技术局

3、行业标准起草情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司参与制定的国家或团体行业标准如下：

序号	标准类型	标准名称	标准编号	发布日期
1	国标	《半导体器件金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的可动离子试验》	GB/T 46789-2025	2025 年 12 月
2	国标	《半导体器件 机械和气候试验方法 第 28 部分：静电放电（ESD）敏感度测试 带电器件模型（CDM） 器件级》	GB/T 4937.28-2026	2026 年 2 月
3	国标	《半导体器件机械和气候试验方法第 20-1 部分：对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输》	GB/T 4937.201-2026	2026 年 4 月
4	国标	《半导体器件 金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的偏置温度不稳定性试验 第 1 部分：MOSFETs 的快速偏置温度不稳定性试验》	GB/T 45716.1-2026	2026 年 4 月
5	国标	《半导体分立器件 第 2 部分：整流二极管》	20232773-T-339	正在批准，暂未发布
6	国标	《半导体器件 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）可靠性试验方法 第 1 部分：偏置温度不稳定性试验方法》	20242747-T-339	正在批准，暂未发布
7	国标	《汽车用分立器件应力试验要求》	20242787-T-339	正在批准，暂未发布
8	团标	《质量分级及“领跑者”评价要求 半导	T/CSTE 0144-2022	2022 年 9 月

序号	标准类型	标准名称	标准编号	发布日期
		体二极管》		
9	团标	《IGBT 器件结构及制备工艺通用技术要求》	T/UNP 126-2024	2024 年 8 月
10	团标	《氮化镓电子产品生产流程要求》	T/CAQI 419-2025	2025 年 3 月
11	团标	《氮化镓功率器件质量分级》	T/CAQI 420-2025	2025 年 3 月

（三）公司研究开发情况

1、研发机构的设置及职责

公司研发活动以行业发展趋势和市场需求为导向，结合对行业发展趋势的前瞻性判断，组织开展技术研发。

公司设立产品研发部统筹负责公司研发项目的整体规划，主要成员公司亦下设专门的研发机构。发行人产品研发部主要职责包括：负责收集和整理国内外同类产品的开发技术信息，结合企业实际和未来业务发展规划，组织新产品评估论证和研发立项；组织实施新产品研发过程，与内外部供应链协同开展研发工作；组织实施工程批产品的实验、分析、认证；负责新产品固化及转量产的交付；负责企业标准和专利规划布局，实施相关标准及专利申请；规划组织现有产品的改进优化研发（如车规级论证升级等）。

2、研发机构认证情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司主要科研平台如下：

研发中心名称	认证机构	所属主体	认定时间
南京市功率器件工程技术研究中心	南京市科学技术局	长晶科技	2022 年
南京市博士后创新实践基地	南京市人力资源和社会保障局	长晶科技	2022 年
2022 年南京市企业技术中心	南京市工业和信息化局	长晶科技	2023 年
江苏省工程技术研究中心	江苏省科学技术厅	长晶科技	2023 年
国家博士后科研工作站	人力资源和社会保障部	长晶科技	2023 年
省级企业技术中心	江苏省工业和信息化厅	长晶科技	2025 年
江苏省硅半导体功率器件芯片工程技术研究中心	江苏省科技厅	新顺微	2016 年
江苏省认定企业技术中心	江苏省经信委、科技厅等	新顺微	2016 年
南京市工程技术研究中心	南京市科学技术局	长晶浦联	2023 年

3、合作研发和委托研发情况

报告期内，发行人主要合作研发的情况如下：

序号	合作方	合作项目	主要内容	权利义务划分规定	合作期限
1	长晶科技、电子科技大学	共建功率半导体联合实验室	主要从事功率半导体领域的核心技术、关键技术、系统集成与控制技术的研究开发，产业化技术的验证测试，以及产品孵化与市场培育。以实验室为载体，作为双方技术研发、人才培养基地，也作为双方申请科研项目、申报科研成果的基地	实验室立项完成的合作项目研究成果知识产权，归双方共有；双方均有权使用。但转让或许可第三方使用需事前取得双方书面同意，相关收益平均分配	2024 年 11 月至 2027 年 10 月
2	长晶科技、电子科技大学	低功耗高可靠超结 MOS 器件关键技术研究	超结 MOS 的设计研发、理论研究与论证、成果总结和发布等。本合作项目系 2020 年度江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）项目	一方独立创造的项目成果归该方所有；双方共同创造的项目成果归双方共同所有	2020 年 2 月至 2023 年 6 月
3	长晶科技、电子科技大学	超低容 TVS 芯片技术研究	超低容 TVS 芯片技术研发	长晶科技支付完所有款项后，全部研发成果归长晶科技所有；未支付完毕所有款项前，前述权利属于电子科技大学所有	2025 年 3 月至 2026 年 3 月
4	长晶科技、电子科技大学	功率半导体 Spice 模型研发	MOS 等功率半导体的 Spice 模型的建立	长晶科技按约履行付款义务后，全部合同成果及全部知识产权归长晶科技所有；按约履行付款义务前，前述权利属于电子科技大学所有	2025 年 1 月至 2026 年 12 月
5	长晶浦联、电子科技大学	高可靠性功率电器及封测技术的研发	高可靠性功率器件电路及相关封测制备技术研发	论文由长晶浦联和电子科技大学共同署名，专利归长晶浦联所有	2021 年 6 月至 2023 年 6 月
6	新顺微、江南大学	高压高性能沟槽 IGBT 产品的研发、新能源汽车超高功率密度模块电源用车规级芯	高压高性能沟槽 IGBT 产品的研发、新能源汽车超高功率密度模块电源用车规级芯片的研发	本合同履行中产生的新的技术成果及知识产权的权属由双方协商所有	2025 年 11 月至 2026 年 12 月

序号	合作方	合作项目	主要内容	权利义务 划分规定	合作期限
		片的研发			

4、正在从事的研发项目及进展情况

报告期内，公司围绕分立器件和电源管理 IC 产品定义、晶圆制造、封装测试等方面，在核心技术人员的带领下，开展了大量的研发项目。截至 2025 年 12 月 31 日，正在从事的主要研发项目及其进展情况如下：

序号	项目名称	研发产品	所处阶段	研发目标
1	超低能耗高可靠性二代 SGT MOSFET 研发	SGT MOSFET	试生产	（1）超低能耗：降低器件特征导通电阻以降低器件导通损耗，增大电流能力，降低器件成本；降低 FOM 值，降低反向恢复电荷 Qrr，使得器件适于高频应用并降低器件高频应用条件下的损耗； （2）高可靠性：降低 Qgd/Qgs 比值以降低栅极电压尖峰，增强意外导通的鲁棒性；优化雪崩击穿能力和短路能力，增强器件在极限电应力条件下的安全性；改善封装热应力，增强封装体散热能力，提高器件耐热性及在高温，高湿，高压，高电压下的可靠性
2	深沟槽刻蚀填充型超结 MOS 产品的研发	SJ MOSFET	产品验证	（1）采用深沟槽刻蚀填充的工艺，生成 P 柱区域，再通过调节 P 柱区域的结构参数，与 EPI 的 N 柱区达到严格的电荷平衡，形成类本征半导体的超结结构，在实现高耐压的同时可降低器件导通电阻； （2）通过电子辐照技术，用高能粒子照射器件引起体原子位移产生深能级的复合中心，通过调整电子辐照的剂量、能量、退火时间及温度等条件，达到控制器件载流子寿命的目的，进而提升器件反向恢复特性
3	高性能高可靠性沟槽栅 FS-IGBT 产品研发	IGBT	试生产	本项目主要内容为进行精细化微沟槽元胞结构设计和背面注氢缓冲层调控技术研究，开发 12 英寸 IGBT 产品工艺平台
4	面向手机应用的四合一多路 LDO 产品研发	LDO	产品设计和开发	这是一款专为多摄像头应用而设计的高性能 LDO，该电路拥有 4 通道输出，其中包括 2 通道默认电压 1.2V，提供 800mA 大电流输出，2 通道默认 2.8V，提供常规 300mA 输出。其拥有 400kHz 高速 12C 接口，功能设置灵活，如启动顺序，输出电压，输出放电，每个通道的电流限制。简单的应用外围为客户节省成本，合理的管脚排列为客户的 PCB 布线提供方便
5	低内阻高功率密度 Trench MOS 产品研究	Trench MOSFET	产品设计和开发	本项目开发的低内阻高功率密度 Trench MOSFET 具有尺寸小、导通电阻低，开关速度快的特点。与现有的 MOSFET 相比，新产品有着更先进的制程工艺，更高的功率

序号	项目名称	研发产品	所处阶段	研发目标
				密度以及更低的生产成本。同时针对器件的寄生三极管进行专门的设计优化，抑制 BJT 闩锁效应的发生
6	第三代半导体器件和封装的研究	第三代半导体器件	产品设计和开发	本项目基于小尺寸元胞（低于 5um）、低比导通电阻（低于 3mΩ·cm²）的设计理念，应用最新的低温封装技术，对标国内外先进水平，开发出低功耗、低制造成本及高可靠性的 SiC MOSFET 功率器件
7	一种超低内阻的晶圆级封装 MOS 产品的研发	CSP MOSFET	产品设计和开发	当前 CSP trench MOS 器件中，电流需纵向贯穿整个硅衬底，使得芯片厚度成为制约导通电阻（Ron）的关键瓶颈——理论分析与实验表明，硅衬底厚度每降低 20%，Ron 可显著减少 10%-20%。本项目通过攻克超小 Cell Pitch 设计、超薄衬底制备及超厚背面金属工艺，在降低 Ron、提升功率密度的同时，抢占国产 CSP MOS 技术先机，推动高密度功率器件在快充等高端市场的国产自主创新
8	高性能高良率高压 FRD 快恢复二极管的研发	快恢复二极管	试生产	通过工艺优化和技术创新，提高生产过程的稳定性和可控性，使高压 FRD 生产在保证质量的前提下实现规模化、低成本化，提升产品良率，能够更好地满足客户的需求
9	高 HTRB 可靠性、耐老化三极管产品的研发	三极管	试生产	旨在提高公司三极管产品在 HTRB 方面的可靠性能，而三极管在电路中被广泛应用，提高三极管器件的可靠性在一定程度上可以提高电路的可靠性能。目前公司具备成熟的钝化工艺与铝下 CVD 工艺，能够加强对器件表面的保护
10	直流转直流 BUCK 变换器芯片平台研发	DC-DC	产品设计和开发	设计 5V/17V/30V/40V/60V/100V 的低成本高性能同步降压变换器，覆盖通用的消费与工业应用。针对应用要求，按行业发展的趋势，分项目在低静态电流、强电磁兼容性、低噪声、抗干扰、高暂态响应性能等方面进行优化，实现高性价比
11	高可靠性、高导热性封装工艺研发	封装工艺	试生产	（1）完成 TO-220 系列/TO-247 封装的焊料匹配、BLT 厚度 DOE 试验及塑封料优化，验证封装热阻改善；TO-220F 重新设计框架结构降低热阻，相关技术已用于工程验证产品，推动产业化进程； （2）通过优化装片工艺、调整塑封材料配方，结合热阻测试设备升级，提升测试精度与热阻改善效果；技术成果融入工程验证环节，支撑热阻降低目标及行业领先水平达成
12	SOT-223 表面贴装晶体管封装产品防线弧塌陷技术开发研究	封装工艺	产品设计和开发	杜绝 SOT-223 BCP56 在芯片封装过程中的 sagging wire（线弧塌陷）问题,实现产品的稳定物理保护（保护芯片免受机械冲击、振动、灰尘、湿气等外部环境的影响，避免物理损伤或腐蚀）和电性能（确保芯片与外部电路的电连接（如焊点、引线）在长期使用

序号	项目名称	研发产品	所处阶段	研发目标
				中保持低电阻、无断路或短路）
13	SOT-23-CU 高散热能力、机械强度和电性能封装工艺开发	封装工艺	产品设计和开发	针对效率低、成本居高不下、产品散热性能不足等挑战，计划开发宽排框架，提高生产效率，形成规模化效应，摊低单颗产品生产成本，同时提升产品散热性能，增强产品可靠性，提高产品在不同环境下的适用性
14	SOT-23-3L/5L/6L 宽排高密度低成本高电性能封装工艺研究	封装工艺	产品设计和开发	推动制造与供应链革新，统一封装设计（JEDEC 标准），减少客户验证周期，加速产品上市，通过成熟工艺（如 SMT 兼容性）实现全球多源供应，规避地缘政治风险，采用无铅（Sn-Ag-Cu）和无卤材料，满足欧盟 RoHS 3.0/WEEE 指令

5、研发投入情况

报告期内，公司研发投入构成及占比情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发费用	14,567.59	12,362.83	11,274.07
营业收入	298,523.51	267,765.34	225,989.82
占比	4.88%	4.62%	4.99%

发行人的研发投入构成情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”之“（五）期间费用分析”之“3、研发费用”的相关内容。

（四）研发人员情况

1、研发人员认定依据

发行人的研发人员是指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员。主要包括：在研发部门及相关职能部门中直接从事研发项目的专业人员；具有相关技术知识和经验，在专业人员指导下参与研发活动的技术人员等。公司存在部分兼职研发人员。由于晶圆制造、封装测试工艺涉及的较多研发项目需要在产线中进行流片及设备、工艺调试，以开展实验、工艺、质量验证等活动，因此，部分制造、质量部门人员存在兼职研发工作的情况，相关人员研发工时超过 50%的，发行人根据《监管规则适用指引——发行类第 9 号：研发人员及研发投入》，认定其为研发人员。

2、研发人员的数量及占比

报告期各期末，公司研发人员的数量及占比如下：

单位：人

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
研发人员数量	305	258	238
员工人数	1,967	1,767	1,590
占员工人数比例	**15.51%**	**14.60%**	**14.97%**

3、研发人员的学历结构

报告期各期末，公司研发人员的学历构成如下：

单位：人

项目	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
硕士及以上	49	16.07%	39	15.12%	29	12.18%
本科	209	68.52%	167	64.73%	142	59.66%
专科及以下	47	15.41%	52	20.16%	67	28.15%
总计	**305**	**100.00%**	**258**	**100.00%**	**238**	**100.00%**

（五）技术创新机制、技术储备及技术创新的安排

1、技术创新机制及安排

（1）高度重视研发创新，完善激励机制

公司始终奉行“研发驱动”的发展战略，高度重视基础科学的研究和产品工艺的创新，大力投入研发资源，设立多层次研发机构，对技术创新实施针对性奖励。

（2）建立健全人才管理体系，加强研发队伍建设

公司坚持“以人为本”的企业文化，通过建立管理与技术双重体系，为研发技术人员提供完善的职业发展通道。公司高度重视人才引入和培养，一方面通过校园招聘、社会招聘不断引进专业人才，不断壮大研发队伍；另一方面，公司针对不同级别人员制定了完善的人才培养计划，并根据员工业务需要举行定期或不定期的教育及培训，不断提高员工专业素质，为公司发展提供人才保障。

2、技术储备

在半导体产品设计方案方面，发行人已储备：高密度沟槽 MOS 产品及技术、低导通阻抗 CSP MOS 产品及技术、高可靠性 SGT MOS 技术及产品、高密度 IGBT 技术及产品、Trench SBD 产品的 45-200V 产品平台技术、高可靠的快恢复二极管技术、线性稳压器的高电源抑制比和低功耗优化技术等。目前，公司正在针对各类 MOSFET 产品的开关性能进行提升和优化，开发对标国际厂商的产品；公司在 IGBT 产品方面已实现技术突破，部分产品性能可对标国际品牌最新代次产品；此外，公司在第三代半导体领域，已有碳化硅产品实现陆续产出，且在氮化镓的产品领域已完成产品设计并拟进行流片试验。

在半导体晶圆制造工艺方面，发行人已储备：高密度多样化封装的背面金属化工艺技术、低正向肖特基二极管沟槽刻蚀工艺技术等。目前，公司正持续对沟槽肖特基势垒二极管、高压快恢复二极管等高附加值晶圆产品进行优化与匹配，提升产品效率与性能，扩大与终端客户合作，推升产品渗透板块与营业规模。

在半导体封装工艺方面，发行人已储备：高密度阵列式框架设计和封装结构设计技术、装片锡膏工艺技术。目前，公司一方面扩大二三极管封测的产能，另一方面将封装品类逐步拓展至 MOSFET 产品、IGBT 产品和电源管理 IC 产品，不断提升封装测试环节自主可控能力。

公司凭借 IDM 经营架构的优势，在半导体设计、制造、封测等环节同步推进、协同研发，为公司未来的发展提供持续的动能。

七、发行人环境保护与安全生产情况

（一）发行人生产经营中涉及的主要环境污染物

发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。报告期内，发行人快速发展，通过内生拓展和外延并购，初步构建了 IDM 模式，其中生产型子公司新顺微、长晶浦联、海德半导体在实施晶圆制造或成品封测的过程中会产生一定的污染物，主要包括废气、废水、固废、噪音等，具体如下：

1、废气

在晶圆制造过程中，新顺微会产生无机废气和有机废气，无机废气产自晶圆生产过程中清洗、刻蚀、氧化扩散、离子注入等工序；有机废气产自晶圆生产过程中光刻等工序。其中，无机废气主要为酸性废气，新顺微采用酸雾洗涤塔对产生的酸性废气进行酸碱中和处理，经过洗涤达标后排放；新顺微采用有机塔对产生的有机废气进行活性炭吸附浓缩、催化燃烧进行处理，经过处理后达标排放。

在成品封测过程中，海德半导体生产车间焊线等过程中会产生少量粉尘，晶圆磨划、包封以及后固化过程中会产生少量非甲烷总烃。其中，粉尘收集后经袋式除尘装置处理，尾气经排气筒引至高空经过处理达标后排放；非甲烷总烃经稀释扩散后达标排放。长晶浦联生产过程中打印、装片、塑封、后固化等工序及危废仓库产生的挥发性有机物经二级活性炭吸附处理，产生的少量粉尘经脉冲震荡器进行处理，镀锡工艺产生的酸性废气经二级碱洗塔处理、碱性废气经一级酸洗塔处理、废水处理站废气经酸洗塔+碱洗塔＋活性炭吸附处理；废气采用集气罩收集的方式。

2、废水

在晶圆制造过程中，新顺微在氧化扩散、清洗、光刻、刻蚀等工序会产生氮磷废水、含氟废水、划磨废水、酸碱清洗废水等生产废水。新顺微将含氟废水、划磨废水、酸碱清洗废水等委托第三方污水处理厂处理达到排放标准后通过水处理公司尾水排放口排放，氮磷废水经第三方污水处理厂处理后全部闭路循环回用，不对外排放。

封测环节，长晶浦联、海德半导体在晶圆磨划、切割、镀锡等工序会产生生产废水，海德半导体委托园区工业废水处理厂集中处理后排放，长晶浦联经厂内污水处理站预处理后，接入南京浦口经济开发区工业废水处理厂集中处理。

此外，公司生产运营过程中产生的生活污水，经公司预处理达标后委托污水处理厂处理后排入市政管网。

3、固体废弃物

在晶圆制造、分立器件封测环节，新顺微、长晶浦联、海德半导体产生的固体废物包括：一般工业固体废物和危险废物。其中，一般工业固体废物包括废包

装材料、废膜、废滤料和废石英制品等，通过委托第三方进行处理；危险废物主要包括酸洗废液、废清洗碱液、废有机溶剂等，通过委托具有危险废物经营许可证的专业单位合法处理。

4、噪声

新顺微、长晶浦联、海德半导体优先选用低噪声设备，通过合理布局车间、加强设备保养，并采取适当隔音、消音、吸声等降噪措施，对周围环境造成影响较小。

（二）主要污染处理设施运行运转情况

报告期内，发行人及其子公司在生产过程中根据环保要求配置了相应的环保设施并采取了必要的控制措施，环保设施运行正常，并定期进行检测及维护保养，确保生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物、噪声能够达到国家相关排放标准。发行人及其子公司主要的环保设施及其处理能力如下：

污染物类别	生产经营中涉及环境污染的具体环节	主要污染物名称	主要环保设备处理设施及处理能力
废气	晶圆制造/封装测试/可靠性检测	挥发性有机物	有机废气处理设施处置
	晶圆制造：CVD、等刻、清洗、扩散、腐蚀	氮氧化物、氨、氯化氢、颗粒物	酸性或碱性废气处理设施处置
	封装测试：装片、包封、打印	挥发性有机物、颗粒物、锡及其化合物	前置过滤器+二级活性炭
	封装测试：电镀、软化、除油	硫酸雾、氯化氢、甲基磺酸雾、硝酸雾、碱雾、氨	酸性或碱性废气处理设施处置
废水	封装测试：磨划	pH、COD、悬浮固体、氨氮、总铜、总锡	磨划废水处理系统
	封装测试：切割	pH、COD、悬浮固体、氨氮	切割废水处理系统
	封装测试：软化、除油、中和	pH、COD、悬浮固体、氨氮、总氮	有机废水处理系统
	封装测试：去氧化、预浸	pH、COD、悬浮固体、氨氮、总氮、总铜、LAS	含铜废水处理系统
	封装测试：电镀、退镀、水洗	pH、COD、悬浮固体、总氮、总磷、总锡	含锡废水处理系统
	其他	pH、COD、悬浮固体、氨氮、总氮、总磷、总铜、总锡、LAS	综合废水处理系统
	晶圆制造：清洗环节	COD、总氮、氨氮、总磷、氟化物、悬浮物	委托第三方废水处理公司集中处理
噪声	晶圆制造/封装测试/可靠性检测：空压机、冷却塔等运转	机械性噪声	减震、隔音、吸音措施

污染物类别	生产经营中涉及环境污染的具体环节	主要污染物名称	主要环保设备处理设施及处理能力
固废	晶圆制造/封装测试	危险废物： 酸洗废液、废清洗碱液、废有机溶剂、废溶剂空桶、废清洗碱液、废滤布、废活性炭、废催化剂、含汞废灯管、废污泥	委托危废处置单位处置
	晶圆制造/封装测试	一般工业固废： 废包装材料、废膜、废滤料、废靶材、废炉管、废五金材料、废二氧化硅粉、废保温材料、废干燥剂、废胶、废砂纸、废抛光布、废树脂、废污泥、废硅渣等	委托一般固废处置单位收集处置
	其他	一般废物：厨余、泔脚、废油等	由食堂承包方处理
	其他	一般废物：生活垃圾	由环卫清运

（三）公司环保投入情况

发行人自成立以来，积极建立健全环保管理体系，完善落实环保管理规章制度，加强对生产污染物排放与监测工作的监管。报告期内，发行人及其子公司环保费用支出主要包括废水处理、废气处理、危险固废处理、一般固废处理等日常运营费用，环保设备投入主要系污水站建设相关投入，具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
环保费用支出	2,211.77	2,004.84	1,809.17
环保设备投入	1,000.74	905.33	121.23
环保投入合计	**3,212.52**	**2,910.17**	**1,930.40**

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司未发生过因违反环境保护规定而受到行政处罚的情况，并取得了环保合规证明和专项信用报告（无违法违规版）。

（四）募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额

本次募投项目仅“年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目”涉及生产加工环节和污染物，公司拟采取的环保措施及相应的资金来源和金额如下：

序号	主要污染物类型	拟采取环保措施	金额（万元）	资金来源
1	废气	采用“布袋除尘+二级活性炭吸附”处理，酸性和碱性废气分别采用二级碱喷淋和一级酸喷淋处理，粉尘经布袋除尘后达标排放	258.00	本次 IPO 募集资金
2	废水	实行分类收集、分质预处理后接管至园区工业废水处理厂，生活污水经隔油池+化粪池预处理后接管至城镇污水处理厂		
3	固废	危险废物委托有资质单位处置，一般固废外售综合利用，生活垃圾由环卫清运		
4	噪音	选用低噪声设备、隔声减振等措施控制噪声		

八、发行人的境外经营及境外资产情况

截至本招股说明书签署日，发行人全资控股香港长晶，并设有新加坡全资公司 Universal 以及其在越南参股的 G&C，用于开展产品出口销售活动。Universal、G&C 和香港长晶的基本情况参见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、其他子公司及参股公司简要情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为金额达到利润总额的 5%，或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告、审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	513,658,642.15	527,781,742.45	358,396,550.18
交易性金融资产	5,620,196.13	-	-
应收票据	255,397,819.31	286,725,355.93	223,721,224.28
应收账款	634,782,985.75	559,221,694.07	518,355,330.21
应收款项融资	163,421,134.82	166,160,276.42	169,986,386.68
预付款项	14,828,141.44	8,636,770.91	15,819,597.34
其他应收款	1,079,956.76	4,515,420.14	19,934,063.90
存货	642,473,271.73	561,038,587.47	578,956,332.57
其他流动资产	17,864,208.92	14,875,113.12	3,107,928.62
流动资产合计	**2,249,126,357.01**	**2,128,954,960.51**	**1,888,277,413.78**
非流动资产：			
长期股权投资	-	-	11,121,152.73
固定资产	1,139,174,751.68	1,107,011,130.02	596,924,825.70
在建工程	81,846,565.82	65,026,644.84	262,603,651.96
使用权资产	36,791,498.43	48,123,707.93	56,225,609.21
无形资产	142,239,440.17	160,868,220.49	180,092,680.23
商誉	826,667,487.07	826,667,487.07	826,667,487.07

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
长期待摊费用	44,274,418.39	38,678,479.39	63,751,862.03
递延所得税资产	30,711,508.28	31,441,392.94	27,549,546.40
其他非流动资产	6,630,527.92	9,409,403.96	14,383,555.89
非流动资产合计	**2,308,336,197.76**	**2,287,226,466.64**	**2,039,320,371.22**
资产总计	**4,557,462,554.77**	**4,416,181,427.15**	**3,927,597,785.00**
流动负债：			
短期借款	121,968,517.99	114,254,376.47	58,054,480.55
应付票据	26,813,131.55	83,525,167.55	93,830,452.02
应付账款	670,220,950.52	638,673,718.50	463,894,763.08
合同负债	4,887,162.56	8,497,549.70	5,783,464.77
应付职工薪酬	77,192,674.69	68,608,374.40	58,251,234.52
应交税费	15,999,933.39	32,163,546.44	23,134,231.53
其他应付款	8,005,735.53	9,733,022.92	6,907,286.68
一年内到期的非流动负债	103,591,494.32	94,111,312.46	100,021,239.53
其他流动负债	160,417,387.52	167,076,272.52	106,202,480.19
流动负债合计	**1,189,096,988.07**	**1,216,643,340.96**	**916,079,632.87**
非流动负债：			
长期借款	634,557,200.00	575,836,000.00	651,980,000.00
租赁负债	26,560,527.25	38,021,276.51	45,857,433.85
递延收益	94,381,762.41	103,224,461.22	128,849,986.03
递延所得税负债	19,788,508.75	22,222,621.87	22,973,527.68
其他非流动负债	314,421,957.36	318,287,554.08	313,220,973.72
非流动负债合计	**1,089,709,955.77**	**1,057,591,913.68**	**1,162,881,921.28**
负债合计	**2,278,806,943.84**	**2,274,235,254.64**	**2,078,961,554.15**
股东权益：			
股本	435,031,732.00	421,781,205.00	421,781,205.00
资本公积	957,558,113.85	945,218,131.11	895,774,837.85
其他综合收益	2,717,633.90	3,759,991.15	2,994,091.38
盈余公积	84,469,274.18	46,976,575.13	36,229,050.09
未分配利润	795,539,981.67	497,298,321.59	288,933,847.15
归属于母公司股东权益合计	2,275,316,735.60	1,915,034,223.98	1,645,713,031.47
少数股东权益	3,338,875.33	226,911,948.53	202,923,199.38

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
所有者权益合计	**2,278,655,610.93**	**2,141,946,172.51**	**1,848,636,230.85**
负债和股东权益总计	**4,557,462,554.77**	**4,416,181,427.15**	**3,927,597,785.00**

（二）合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**2,985,235,053.06**	**2,677,653,428.60**	**2,259,898,190.09**
其中：营业收入	2,985,235,053.06	2,677,653,428.60	2,259,898,190.09
二、营业总成本	**2,572,589,369.23**	**2,377,578,046.20**	**2,034,244,511.83**
其中：营业成本	2,050,002,761.28	1,874,282,732.05	1,612,628,154.91
税金及附加	18,543,144.86	14,427,618.45	13,057,939.37
销售费用	124,335,022.22	114,310,955.04	92,985,210.77
管理费用	206,328,852.73	222,228,409.05	166,783,822.39
研发费用	145,675,908.50	123,628,323.24	112,740,681.10
财务费用	27,703,679.64	28,700,008.37	36,048,703.29
其中：利息费用	29,673,865.48	31,947,776.24	38,228,284.24
利息收入	2,784,193.09	3,258,356.29	2,197,866.40
加：其他收益	24,688,352.10	51,770,012.43	37,005,737.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,947.36	2,652,413.69	618,309.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,738,121.36	-10,435,804.51	-16,851,940.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,998,112.81	-56,854,253.60	-50,336,208.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	194,323.05	1,349,915.86	-44,065.02
三、营业利润	**404,185,420.17**	**288,557,666.27**	**196,045,511.58**
加：营业外收入	4,530,016.41	2,626,549.42	788,453.09
减：营业外支出	906,418.21	1,000,149.22	394,039.42
四、利润总额	**407,809,018.37**	**290,184,066.47**	**196,439,925.25**
减：所得税费用	58,801,724.89	47,875,841.41	29,438,540.57
五、净利润	**349,007,293.48**	**242,308,225.06**	**167,001,384.68**
（一）按经营持续性分类	-	-	-
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,007,293.48	242,308,225.06	167,001,384.68
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类	-	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	335,734,359.13	219,111,999.48	153,417,129.34
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,272,934.35	23,196,225.58	13,584,255.34
六、其他综合收益的税后净额	**-1,042,357.25**	**765,899.77**	**463,423.98**
七、综合收益总额	**347,964,936.23**	**243,074,124.83**	**167,464,808.66**
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	334,692,001.88	219,877,899.25	153,880,553.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,272,934.35	23,196,225.58	13,584,255.34
八、每股收益	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.78	0.52	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	0.78	0.52	0.36

（三）合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,310,235,942.84	1,951,067,172.32	1,440,565,797.60
收到的税费返还	1,672,871.71	4,020,533.28	1,424,845.69
收到其他与经营活动有关的现金	25,932,728.17	18,063,590.03	66,246,535.02
经营活动现金流入小计	**2,337,841,542.72**	**1,973,151,295.63**	**1,508,237,178.31**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,869,504.42	916,001,820.08	657,930,505.76
支付给职工以及为职工支付的现金	411,473,103.69	365,791,185.99	318,053,513.90
支付的各项税费	187,981,768.96	131,876,357.77	133,642,241.22
支付其他与经营活动有关的现金	118,170,732.34	105,974,947.39	68,955,498.46
经营活动现金流出小计	**1,945,495,109.41**	**1,519,644,311.23**	**1,178,581,759.34**
经营活动产生的现金流量净额	**392,346,433.31**	**453,506,984.40**	**329,655,418.97**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11,233,898.68	-	-
取得投资收益收到的现金	90,026.34	1,750,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	454,365.56	361,769.92	286,391.82
收到其他与投资活动有关的现金	3,736,801.72	-	2,806,105.66
投资活动现金流入小计	**15,515,092.30**	**2,111,769.92**	**3,092,497.48**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,863,889.37	206,231,502.41	127,506,854.67
投资支付的现金	16,854,094.81	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,734,836.79	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**181,717,984.18**	**213,966,339.20**	**127,506,854.67**
投资活动产生的现金流量净额	**-166,202,891.88**	**-211,854,569.28**	**-124,414,357.19**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	131,338,000.00	132,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,000.00	132,000.00	-
取得借款收到的现金	267,700,000.00	727,490,000.00	135,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,906,056.32	4,167,620.73	12,793,217.00
筹资活动现金流入小计	**430,944,056.32**	**731,789,620.73**	**148,343,217.00**
偿还债务支付的现金	226,129,600.00	757,369,000.00	230,792,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,595,812.10	26,972,869.91	31,044,379.65
支付其他与筹资活动有关的现金	395,989,275.20	14,852,257.80	14,093,022.64
筹资活动现金流出小计	**644,714,687.30**	**799,194,127.71**	**275,929,902.29**
筹资活动产生的现金流量净额	**-213,770,630.98**	**-67,404,506.98**	**-127,586,685.29**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-1,378,289.43**	**749,563.98**	**463,606.04**
五、现金及现金等价物净增加额	**10,994,621.02**	**174,997,472.12**	**78,117,982.53**
加：期初现金及现金等价物余额	497,103,621.48	322,106,149.36	243,988,166.83
六、期末现金及现金等价物余额	**508,098,242.50**	**497,103,621.48**	**322,106,149.36**

（四）审计意见和关键审计事项

1、审计意见

立信审计了长晶科技财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

立信认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长晶科技 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、关键审计事项

立信在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
长晶科技财务报表所示 2023 年度至 2025 年度营业收入项目金额分别为人民币 2,259,898,190.09 元、2,677,653,428.60 元及 2,985,235,053.06 元。 由于营业收入是长晶科技的关键业绩指标之一，可能存在长晶科技管理层通过不恰当的收入确认方法以达到特定目标或预期的固有风险。因此，会计师将收入确认作为关键审计事项。	针对收入确认，会计师实施的审计程序主要包括： （1）了解公司与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； （2）检查公司各报告期销售合同，了解主要合同条款或条件，评价不同合同条款下的收入确认方法是否适当； （3）对公司各报告期营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； （4）对于公司各报告期的内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、物流签收单、对账单等支持性文件；对于各报告期的出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件； （5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期营业收入金额； （6）对公司各报告期资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认； （7）检查公司与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
（二）商誉减值	
截至 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日，长晶科技合并报表商誉账面价值分别为 826,667,487.07 元、826,667,487.07 元、826,667,487.07 元。 长晶科技管理层在报告期各期末对商誉进行减值测试。 由于商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程较为复杂，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，且商誉占长晶科技资产总额比重较大，商誉减值的计提对财务报表影响较大，因此，会计师将商誉减值作为关键审计事项。	针对商誉减值，会计师实施的审计程序主要包括： （1）了解、测试和评价公司与商誉减值相关的内部控制设计和运行的有效性； （2）分析了公司对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性； （3）与公司聘请的评估师进行讨论，了解及评估长晶科技商誉减值测试的合理性，复核评估报告内采用假设的恰当性及相关披露是否适当； （4）复核评价了公司预测时所使用的关键参数：将预测期收入增长率与历史的收入增长率及同行业收入增长率进行对比分析，将预测的毛利率与历史毛利率进行比较，且考虑了市场趋势，分析了管理层所采用的折现率，并利用

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	注册会计师的专家对相关工作进行复核； （5）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表附注中作出恰当列报和披露。

（五）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

1、财务报表编制基础

（1）编制基础

公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（2）持续经营

公司财务报表以持续经营为基础编制。

2、合并财务报表范围及变化情况

报告期各期末，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	股权取得方式	设立或合并时间	注销时间	是否纳入合并范围		
					2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
1	深圳长晶	非同一控制下合并	2019 年 3 月	-	是	是	是
2	新顺微	非同一控制下合并	2022 年 3 月	-	是	是	是
3	长晶浦联	设立	2020 年 11 月	-	是	是	是
4	海德半导体	非同一控制下合并	2020 年 12 月	-	是	是	是
5	长晶微电子	设立	2019 年 4 月	-	是	是	是
6	长芯顺联	设立	2022 年 1 月	2025 年 1 月	-	是	是
7	长华智芯	设立	2020 年 11 月	-	是	是	是
8	南京顺芯	非同一控制下合并	2022 年 3 月	-	是	是	是
9	南京芯联	非同一控制下合并	2022 年 3 月	2025 年 9 月	-	是	是
10	香港长晶	非同一控制下合并	2019 年 3 月	-	是	是	是
11	长芯检测	非同一控制下合并	2024 年 9 月	-	是	是	-

序号	子公司名称	股权取得方式	设立或合并时间	注销时间	是否纳入合并范围		
					2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
12	上海长晶	设立	2024 年 9 月	-	是	是	-
13	南京海德	设立	2025 年 3 月	-	是	-	-
14	Universal	设立	2024 年 11 月	-	是	是	-
15	长晶联合	设立	2025 年 11 月	-	是	-	-

（六）与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收票据、应收账款及其他应收款	单项计提金额大于 300 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额大于 300 万元
重要的应收款项实际核销	单项核销金额大于 300 万元
账龄超过一年的重要预付款项	单项账龄超过 1 年的预付账款金额大于 300 万元
重要的在建工程	单个项目的预算大于 1 亿元或期末账面价值在 1,000 万元以上
账龄超过一年的重要应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款金额大于 300 万元
账龄超过一年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债金额大于 300 万元
重要的非全资子公司	子公司净资产占公司合并净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占公司合并净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占合并净利润的 10%以上

二、主要会计政策和会计估计

本节仅披露报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的主要会计政策和会计估计，其他会计政策和会计估计参见审计报告财务报表附注。

（一）收入

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、收入确认的具体方法

内销非寄售模式下的收入确认原则：按照公司与客户签订的合同或订单约定，将货物运送至客户指定的交货地点，客户签收时确认收入；

内销寄售模式下的收入确认原则：公司与客户签订的销售合同中约定，客户签收货物仅作为受领，在客户实际耗用寄售产品后，根据双方核对无误的对账单确认收入；

外销收入确认原则：针对需要报关的外销业务，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口，完成出口报关手续，根据出库单、出口专用发票和报关文件确认收入。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认

金额。

（三）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

（四）金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。金融工具的具体会计政策参见审计报告财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计”之“（十）金融工具”。

（五）应收款项减值的测试方法及会计处理方法

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收款项融资	银行承兑汇票组合	承兑人为银行。该组合预期信用损失率为零。
	商业承兑汇票组合	承兑人为企业。参照应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同，按照

项目	组合类别	确定依据
		应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
应收款项	合并报表范围内关联方客户组合	纳入合并范围内的关联方。该组合预期信用损失率为零。
	一般客户组合	除对已单项计提坏账准备的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的具有类似信用风险特征的应收款项账龄组合计提损失准备。

应收款项一般客户组合中，账龄与整个存续期预期损失率对照表：

账龄	应收款项计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1－2 年（含 2 年）	10
2－3 年（含 3 年）	50
3 年以上	100

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

（六）存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、半成品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法

（2）包装物采用一次转销法

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（七）固定资产

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命

和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	0-5	4.75-20.00
运输设备	年限平均法	4-8 年	4-5	11.88-24.00
机器设备	年限平均法	5-10 年	0-5	9.50-20.00
办公及其他设备	年限平均法	3-8 年	0-5	11.88-33.33

3、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（八）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

（九）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法

预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50 年	年限平均法	-	土地使用权年限
客户关系	10 年	年限平均法	-	预计受益期
专利	10 年	年限平均法	-	预计受益期
软件	3-10 年	年限平均法	-	预计受益期

3、研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。公司按照研发项目核算研发费用，归集各项支出。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	3-10 年	租赁期与预计可使用年限孰短
其他	在使用期内摊销	预计使用寿命

（十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司无设定受益计划。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（十三）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（十四）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（十五）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

报告期内，不存在对公司有重大影响的会计政策变更。其他会计政策变更具体参见审计报告财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计”之“（三十一）重要会计政策和会计估计的变更”之“1、重要会计政策变更”。

2、重要会计估计变更

报告期内，公司重要会计估计未发生变更。

三、非经常性损益情况

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，公司编制了非经常性损益明细表。申报会计师对公司报告期内非经常性损益进行了鉴证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA13442 号）。

报告期内，公司非经常性损益及对净利润的影响情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5.30	109.89	-19.89

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,741.86	3,218.85	3,234.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8.29	-1.83	-10.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	0.01	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	407.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376.49	-16.45	54.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,942.00	-3,428.44	-47.26
税前非经常性损益	**173.36**	**289.98**	**3,211.79**
所得税影响额	31.26	100.62	278.43
少数股东权益影响额（税后）	2.53	33.93	21.51
归属于母公司股东的税后非经常性损益	**139.56**	**155.43**	**2,911.86**
归属于母公司股东的净利润	33,573.44	21,911.20	15,341.71
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**33,433.87**	**21,755.77**	**12,429.85**
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润的比例	0.42%	0.71%	18.98%

报告期内各期，发行人归属于母公司股东的税后非经常性损益分别为2,911.86 万元、155.43 万元和 139.56 万元，主要为计入当期损益的政府补助及股份支付费用。报告期内，公司部分股权激励人员转让前期授予的股份，视为加速行权，未分摊股份支付金额一次性计入当期损益，属于其他符合非经常性损益定义的损益项目。

报告期各期，发行人扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为12,429.85 万元、21,755.77 万元和 33,433.87 万元，非经常性损益不会对公司的持续经营能力构成重大不利影响。

四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣	13%、6%

税种	计税依据	税率
	的进项税额后，差额部分为应交增值税	
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、17%、8.25%、16.50%及 20%
城市建设维护税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	5%

报告期内，公司及各子公司适用的企业所得税税率情况如下：

序号	子公司名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
1	长晶科技	15%	15%	15%
2	深圳长晶	25%	25%	25%
3	新顺微	15%	15%	15%
4	长晶浦联	25%	25%	25%
5	海德半导体	25%	25%	15%
6	长晶微电子	20%	20%	20%
7	长芯顺联	20%	20%	20%
8	长华智芯	20%	20%	20%
9	南京顺芯	20%	20%	20%
10	香港长晶	200 万港元以内适用 8.25%；超过 200 万港元适用 16.5%	200 万港元以内适用 8.25%；超过 200 万港元适用 16.5%	200 万港元以内适用 8.25%；超过 200 万港元适用 16.5%
11	长芯检测	20%	20%	-
12	上海长晶	20%	20%	-
13	南京海德	20%	-	-
14	Universal	17%	17%	-
15	长晶联合	20%	-	-

（二）税收优惠

1、所得税

根据 2023 年 11 月 6 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332008657），公司从 2023 年度至 2025 年度享受高新技术企业优惠税率，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据 2023 年 11 月 6 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332003974），子公

司新顺微从 2023 年度至 2025 年度享受高新技术企业优惠税率，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据 2021 年 11 月 3 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202132002093），子公司海德半导体 2023 年度享受高新技术企业优惠税率，企业所得税减按 15%的税率征收。

根据国家税务总局《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日起，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。公司、子公司新顺微、子公司海德半导体 2023 年度至 2025 年度享受该政策。

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部 关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（2023 年第 44 号）的规定，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。子公司长晶浦联 2023 年度至 2025 年度享受该政策。

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）、《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部 关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020 年第 45 号）等相关规定，子公司长晶浦联 2022 年度申报享受集成电路封装、测试企业税收优惠，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。子公司长晶浦联 2023 年度免征企业所得税，2024 年度和 2025 年度按 25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》

（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）和《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局 公告 2023 年第 12 号）规定，自 2023 年度至 2025 年度，长晶微电子、长芯检测、长华智芯、南京顺芯、长晶上海、长晶联合、南京海德、长芯顺联为小型微利企业，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

2、增值税

根据《财政部 税务总局 关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。公司 2023 年度及 2024 年度享受该政策。子公司新顺微 2023 年度至 2025 年度享受该政策。

根据《财政部 税务总局 关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。子公司长晶浦联 2023 年度至 2025 年度享受该政策。

（三）报告期内税收政策及税收优惠政策对发行人经营成果的影响

报告期内，发行人主要享受高新技术企业所得税优惠税率、研发费用加计扣除优惠、增值税加计抵减等税收优惠。该等税收优惠政策对报告期内发行人经营成果不构成重大影响，发行人对税收优惠不存在严重依赖。

截至本招股说明书签署日，发行人享受的税收优惠政策未发生重大变化，根据国家现行的有关产业政策、税收政策以及公司的经营情况，发行人未来继续享受税收优惠的可持续性较高。

五、主要财务指标

（一）主要财务指标

主要财务指标	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率	1.89	1.75	2.06

速动比率	1.35	1.29	1.43
资产负债率（母公司）	42.25%	47.60%	37.14%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.23	4.54	3.90
主要财务指标	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
利息保障倍数（倍）	14.74	9.34	6.01
应收账款周转率（次）	4.74	4.72	4.75
存货周转率（次）	3.00	2.91	2.38
息税折旧摊销前利润（万元）	62,471.77	49,070.65	37,297.22
归属于发行人股东的净利润（万元）	33,573.44	21,911.20	15,341.71
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	33,433.87	21,755.77	12,429.85
研发投入占营业收入的比例	4.88%	4.62%	4.99%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.90	1.08	0.78
每股净现金流量（元）	0.03	0.41	0.19

注：指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产－存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末股本总额；

利息保障倍数=息税前利润/利息支出；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额；

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋固定资产折旧＋无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧；

归属于发行人股东的净利润＝归属于母公司股东的净利润；

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润＝归属于母公司股东的净利润－非经常性损益的影响数；

研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入；

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下：

1、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.13%	12.31%	9.83%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.06%	12.22%	7.96%

2、每股收益

单位：元/股

报告期利润	基本每股收益			稀释每股收益		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.52	0.36	0.78	0.52	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.52	0.29	0.78	0.52	0.29

注：（1）加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。由于公司不存在稀释性潜在普通股，故稀释性每股收益的计算与基本每股收益的计算结果相同。

六、经营成果分析

（一）经营情况总体概述

报告期内，公司主要经营成果指标情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	298,523.51	267,765.34	225,989.82
营业成本	205,000.28	187,428.27	161,262.82
毛利	93,523.23	80,337.07	64,727.00
营业利润	40,418.54	28,855.77	19,604.55
利润总额	40,780.90	29,018.41	19,643.99
净利润	34,900.73	24,230.82	16,700.14
归属于母公司股东的净利润	33,573.44	21,911.20	15,341.71
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	33,433.87	21,755.77	12,429.85

报告期各期，公司营业收入分别为 225,989.82 万元、267,765.34 万元和 298,523.51 万元，呈逐年上升趋势，主要原因为：半导体景气度逐步回暖、下游需求复苏，同时，发行人通过自主研发不断丰富产品种类，并拓展下游应用领域与客户群体，产品销量不断增长。

报告期各期，公司净利润分别为 16,700.14 万元、24,230.82 万元和 34,900.73 万元，经营业绩稳步提升。报告期内，公司净利润主要来源于营业利润，营业外收支等其他经营情况对公司利润影响较小。受经营规模效应、毛利率持续提升及其他收益、信用减值损失、资产减值损失等科目变动影响，报告期内，公司净利润增长幅度大于营业收入增长幅度。

（二）营业收入分析

1、营业收入构成及变动分析

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	293,637.74	98.36%	264,080.57	98.62%	222,620.53	98.51%
其他业务收入	4,885.77	1.64%	3,684.77	1.38%	3,369.29	1.49%
合计	**298,523.51**	**100.00%**	**267,765.34**	**100.00%**	**225,989.82**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务为分立器件及其晶圆、电源管理 IC 的研发、生产和销售。报告期各期，公司营业收入分别为 225,989.82 万元、267,765.34 万元和

298,523.51 万元，呈逐年上升趋势。其中，公司主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上，主营业务突出；公司其他业务收入主要为晶振产品收入等，占营业收入的比例较低。

报告期内，随着半导体景气度逐步回暖、下游需求复苏，以及发行人通过自主研发不断丰富产品种类，并拓展下游应用领域与客户群体，公司主营业务收入持续增加，报告期内营业收入复合增长率为 14.93%。具体分析如下：

（1）分立器件行业及下游行业向好是公司业绩增长的基础

公司主营业务收入主要来自于分立器件及其晶圆、电源管理 IC 产品等，作为电子、电力核心功能元器件，广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等领域。公司所处行业存在一定的周期性，2024 年至今，随着消费电子需求回暖、新能源汽车普及、光伏储能需求重启、AI 服务器需求爆发，下游库存去化基本完成，分立器件行业需求不断提升。2024 年度和 2025 年度，同行业可比公司加权平均收入增长率分别为 19.61%和 16.53%。

因此，报告期内，受益于行业景气度影响，公司营业收入呈增长趋势，与同行业趋势一致。

（2）不断拓展下游应用领域及终端客户是公司业绩增长的具体实现路径

公司产品广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等领域。报告期内，随着新能源汽车、储能、机器人、无人机、AI 算力服务器及数据中心等领域需求的持续释放，公司紧抓市场战略机遇，积极开发适配产品，产品终端应用领域持续扩展，推动公司业务规模扩大。

报告期内，凭借高质量的产品与服务，公司获得多个品牌客户的高度认可。公司产品已应用于国内外上千家终端厂商，覆盖多行业、领域代表性企业，如小米、三星、荣耀、传音控股、华勤技术、立讯精密、石头科技、格力电器、海尔智家、欣旺达、新能德、德赛电池、安克创新、麦格米特、创科实业（TTI）、泉峰控股、大疆创新、影石创新、中兴通讯、比亚迪、埃泰克、安瑞光电、德业股份、固德威等，客户资源丰富。

报告期内，公司通过拓展下游应用领域及终端客户，不断提高市场份额，驱动业绩增长。

（3）坚持技术驱动，不断丰富的产品矩阵为公司提供新的业绩增长点

报告期内，公司持续丰富产品系列，在保持二极管、三极管等传统产品优势的基础上，不断开发新产品，其中，公司通过自主创新推出的 CSP MOSFET 产品实现技术突破，推动 MOSFET 产品销售规模迅速扩大，报告期内，公司 MOSFET 产品收入复合增长率达 26.30%，2025 年 MOSFET 收入突破 8.1 亿元，收入占比达 27.69%，成为收入最大的品类，新研发投入的产品为公司业绩提供了新的增长点。

（4）国产替代趋势为公司提供了持续的增长动力

从竞争格局看，分立器件行业集中度相对较低，全球市场仍以欧美日企业为主导。随着国内企业在芯片设计、制造工艺等关键环节不断实现技术突破，逐步填补高端领域技术空白，国产分立器件产品的质量、性能、技术标准不断提升，具备了与国际厂商进行竞争的契机。分立器件是现代电子工业的硬件基础，报告期内，在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度，国内分立器件产业自主化进程加速，为公司提供更多的市场机遇，公司收入规模进一步扩大。

2、主营业务收入按产品构成分析

报告期内，公司主营业务收入按产品分类的构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分立器件	222,281.41	75.70%	194,327.57	73.59%	161,058.91	72.35%
电源管理 IC	23,877.36	8.13%	23,104.78	8.75%	20,521.30	9.22%
晶圆	46,634.34	15.88%	46,157.11	17.48%	40,670.55	18.27%
其他	844.62	0.29%	491.12	0.19%	369.77	0.17%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入主要为分立器件及其晶圆、电源管理 IC 的销售收入，主营业务收入中的“其他”主要为放大器/比较器、电机驱动 IC、达林顿阵列等销售收入。

报告期内，公司分立器件及其晶圆、电源管理 IC 销售收入均呈逐年上升趋

势，且各主要产品收入占比整体保持稳定。具体分析见下：

（1）分立器件

报告期各期，公司分立器件产品收入分别为 161,058.91 万元、194,327.57 万元和 222,281.41 万元，呈快速上升趋势；同时，公司分立器件收入占公司主营业务收入比例分别为 72.35%、73.59%和 75.70%，占比较高，是报告期内的核心收入来源。

报告期内，公司分立器件产品收入变动按照销量及单位价格变动等影响因素分析如下：

分立器件	2025 年度	变动比例	2024 年度	变动比例	2023 年度
收入（万元）	222,281.41	14.38%	194,327.57	20.66%	161,058.91
销量（亿颗）	357.02	17.39%	304.13	29.19%	235.41
单价（元/千颗）	62.26	-2.56%	63.90	-6.61%	68.42
销量变动影响（万元）	**33,792.23**	/	**47,014.94**	/	/
单价变动影响（万元）	**-5,838.39**	/	**-13,746.28**	/	/
销售金额变动（万元）	**27,953.84**	/	**33,268.65**	/	/

注：销量变动影响=（本年度销量-上年度销量）*上年度单价；单价变动影响=（本年度单价-上年度单价）*本年度销量；销售金额变动=单价变动影响+销量变动影响，下同

由上表可见，报告期内，公司分立器件收入规模持续增长，主要系销量驱动。

具体而言，公司分立器件产品主要包括二极管、三极管和 MOSFET 等，分产品收入、销量、单价情况如下：

项目	产品类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度
		金额/数量	变动比例	金额/数量	变动比例	金额/数量
收入（万元）	二极管	76,274.26	12.68%	67,688.36	19.37%	56,706.47
	三极管	60,650.34	7.12%	56,618.92	17.04%	48,377.15
	MOSFET	81,321.96	24.38%	65,383.41	28.25%	50,982.77
	其他分立器件	4,034.84	-12.98%	4,636.88	-7.12%	4,992.53
	合计	**222,281.41**	**14.38%**	**194,327.57**	**20.66%**	**161,058.91**
销量（亿颗）	二极管	174.46	16.43%	149.85	28.90%	116.25
	三极管	129.18	16.19%	111.18	26.78%	87.69
	MOSFET	52.01	26.17%	41.22	40.73%	29.29
	其他分立器件	1.36	-27.55%	1.88	-13.49%	2.18

项目	产品类型	2025 年度		2024 年度		2023 年度
		金额/数量	变动比例	金额/数量	变动比例	金额/数量
	合计	**357.02**	**17.39%**	**304.13**	**29.19%**	**235.41**
单价（元/千颗）	二极管	43.72	-3.21%	45.17	-7.40%	48.78
	三极管	46.95	-7.81%	50.93	-7.69%	55.17
	MOSFET	156.37	-1.42%	158.63	-8.87%	174.07
	其他分立器件	295.63	20.10%	246.15	7.36%	229.27
	合计	**62.26**	**-2.56%**	**63.90**	**-6.61%**	**68.42**

由上表可见，报告期内，公司市场开拓顺利，主要产品销量均呈增长趋势，其中，公司二极管、三极管市场占有率较高，整体增长较为平稳，报告期内销量增长率在 15%-30%之间；MOSFET 产品销量增速较快，报告期销量增长率分别为 40.73%、26.17%，主要为 CSP MOSFET 等新产品投入市场反响较好，推动销量快速增长。上述主要产品单价均有所下降，主要系市场竞争较为激烈，公司结合市场供求情况调整部分产品价格，与行业总体产品价格变动趋势相符。

（2）电源管理 IC

报告期各期，公司电源管理 IC 产品的收入分别为 20,521.30 万元、23,104.78 万元和 23,877.36 万元，呈持续增长趋势，占主营业务收入比例分别为 9.22%、8.75%和 8.13%。

报告期内，公司电源管理 IC 产品收入变动按照销量及单位价格变动等影响因素分析如下：

电源管理 IC	2025 年度	变动比例	2024 年度	变动比例	2023 年度
收入（万元）	23,877.36	3.34%	23,104.78	12.59%	20,521.30
销量（亿颗）	14.69	11.82%	13.14	23.08%	10.67
单价（元/千颗）	162.57	-7.58%	175.90	-8.52%	192.29
销量变动影响（万元）	**2,729.91**	/	**4,736.41**	/	/
单价变动影响（万元）	**-1,957.32**	/	**-2,152.93**	/	/
销售金额变动（万元）	**772.59**	/	**2,583.48**	/	/

由上表可见，报告期内，公司电源管理 IC 产品收入持续增长，主要系产品销量持续增加。随着公司不断丰富电源管理 IC 产品线，叠加下游需求复苏及国产替代趋势，公司电源管理 IC 产品销量持续增加，带动该产品收入规模扩大。

报告期内，电源管理 IC 产品单价有所下降，主要系产品市场竞争较为激烈，公司结合市场供求情况调整部分产品价格。

（3）晶圆

报告期各期，公司晶圆产品的收入分别为 40,670.55 万元、46,157.11 万元和 46,634.34 万元，呈逐年上升趋势，占主营业务收入比例分别为 18.27%、17.48%和 15.88%，占比有所下降主要系公司分立器件产品销售收入增幅相对更高所致。

报告期内，公司晶圆产品收入变动按照销量及单位价格变动等影响因素分析如下：

晶圆	2025 年度	变动比例	2024 年度	变动比例	2023 年度
收入（万元）	46,634.34	1.03%	46,157.11	13.49%	40,670.55
销量（亿颗）	161.99	4.91%	154.41	26.38%	122.18
单价（元/千颗）	28.79	-3.70%	29.89	-10.20%	33.29
销量变动影响（万元）	**2,267.08**	/	**10,727.34**	/	/
单价变动影响（万元）	**-1,789.84**	/	**-5,240.78**	/	/
销售金额变动（万元）	**477.24**	/	**5,486.56**	/	/

晶圆为公司重要产品之一，为分立器件生产的重要原材料，公司晶圆产品销量变动趋势与分立器件一致，销售量逐年上升，带动晶圆产品收入规模持续扩大。

综上所述，报告期内，在下游需求逐步回暖、半导体行业整体复苏的背景下，公司通过推出新产品、加大市场开拓力度等方式，不断提升市场份额，公司主要产品分立器件及其晶圆、电源管理 IC 的销量均逐年增加，推动公司主营业务收入持续增长。

3、主营业务收入按销售区域分析

报告期内，公司主营业务收入分区域构成如下：

单位：万元

地区	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	283,258.45	96.47%	252,661.45	95.68%	214,246.76	96.24%
其中：华南地区	167,148.60	56.92%	147,937.72	56.02%	129,401.45	58.13%
华东地区	96,428.14	32.84%	88,164.17	33.39%	70,235.81	31.55%

地区	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
华中地区	8,597.25	2.93%	7,010.75	2.65%	5,835.90	2.62%
西南地区	6,218.31	2.12%	6,864.00	2.60%	6,493.35	2.92%
华北地区	2,912.98	0.99%	2,195.57	0.83%	1,860.38	0.84%
西北地区	1,667.50	0.57%	326.89	0.12%	266.48	0.12%
东北地区	285.66	0.10%	162.36	0.06%	153.41	0.07%
境外及港澳台	10,379.29	3.53%	11,419.12	4.32%	8,373.76	3.76%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

注：因面向中国香港、中国澳门和中国台湾地区销售也需要履行出口报关相关手续，因此对港澳台地区的收入与境外收入合并统计

公司销售区域以境内为主。报告期各期，公司于境外及港澳台实现的销售收入分别为 8,373.76 万元、11,419.12 万元和 10,379.29 万元，占主营业务收入的比例分别为 3.76%、4.32%和 3.53%，占比相对较低。

4、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销	170,216.68	57.97%	146,450.12	55.46%	118,751.63	53.34%
直销	123,421.06	42.03%	117,630.46	44.54%	103,868.89	46.66%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

公司采用经销与直销兼顾的销售模式，即公司既通过经销商销售产品，又向终端客户直接销售产品。公司经销模式系买断式销售，与经销商属于独立自主决策的买卖关系，采取经销模式为行业的通行惯例；公司对部分规模较大、信用资质较好的终端客户采取直销模式，从而提升合作效率。

报告期各期，公司经销模式的收入占主营业务收入的比例分别为 53.34%、55.46%和 57.97%，经销模式占比逐年上升，主要系：报告期内，发行人处于快速发展时期，且通过自主研发不断丰富产品种类，并拓展下游应用领域与客户群体，经销商拥有渠道资源优势，可以快速扩大公司的销售覆盖范围。

5、主营业务收入按季节性分析

报告期内，公司主营业务收入按照季度分类如下：

单位：万元

季度	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	69,580.12	23.70%	61,453.28	23.27%	45,923.67	20.63%
第二季度	72,338.30	24.64%	66,655.02	25.24%	55,907.86	25.11%
第三季度	74,085.87	25.23%	66,219.81	25.08%	56,222.30	25.25%
第四季度	77,633.45	26.44%	69,752.46	26.41%	64,566.70	29.00%
合计	**293,637.74**	**100.00%**	**264,080.57**	**100.00%**	**222,620.53**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入受到行业周期、下游需求、节日假期等综合因素影响，呈现一定的季节性波动。具体来看，公司第一季度收入占比相对较低，主要受到春节假期影响；第四季度收入占比较高，主要系第四季度为下游消费电子行业的传统销售旺季，同时部分下游客户会在春节假期前进行适当备货，导致第四季度公司收入较高。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成及变动分析

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	201,511.92	98.30%	184,779.17	98.59%	158,722.03	98.42%
其他业务成本	3,488.35	1.70%	2,649.10	1.41%	2,540.78	1.58%
合计	**205,000.28**	**100.00%**	**187,428.27**	**100.00%**	**161,262.82**	**100.00%**

报告期内，公司营业成本分别为 161,262.82 万元、187,428.27 万元和 205,000.28 万元，与营业收入呈现相同的变动趋势。报告期内，公司的主营业务成本占比分别为 98.42%、98.59%和 98.30%，其他业务成本占比较小。

2、营业成本按产品构成分析

报告期各期，公司营业成本按产品类别划分情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

分立器件	148,588.37	72.48%	133,196.78	71.07%	112,645.81	69.85%
电源管理 IC	18,162.92	8.86%	17,470.52	9.32%	15,214.43	9.43%
晶圆	34,124.37	16.65%	33,751.23	18.01%	30,593.44	18.97%
其他	636.26	0.31%	360.64	0.19%	268.36	0.17%
其他业务成本	3,488.35	1.70%	2,649.10	1.41%	2,540.78	1.58%
合计	**205,000.28**	**100.00%**	**187,428.27**	**100.00%**	**161,262.82**	**100.00%**

报告期内，公司各类产品成本的占比和变动趋势与主营业务收入基本一致。

3、营业成本按项目构成分析

报告期内，公司主要成本构成包括晶圆、封测服务、集中委托成品采购、直接材料等，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
封测服务	43,669.85	21.30%	46,305.34	24.71%	38,054.87	23.60%
晶圆	36,171.40	17.64%	34,110.25	18.20%	33,146.87	20.55%
集中委托成品采购	44,914.12	21.91%	34,287.38	18.29%	27,101.20	16.81%
直接材料	42,927.81	20.94%	37,161.25	19.83%	32,894.53	20.40%
直接人工	12,713.31	6.20%	12,277.96	6.55%	9,952.88	6.17%
制造费用	23,426.90	11.43%	22,303.99	11.90%	19,209.25	11.91%
运费	1,176.87	0.57%	982.10	0.52%	903.23	0.56%
合计	**205,000.28**	**100.00%**	**187,428.27**	**100.00%**	**161,262.82**	**100.00%**

注：集中委托成品采购指公司在完成产品设计、定义后，在合格供应商库中筛选出具备规模、管理、品质优势的供方，委托其统一完成晶圆制造、封装测试等制造环节，涉及的供应商包括芯联集成、格瑞宝等。

报告期内，公司成本主要由封测服务、晶圆和集中委托成品采购构成，占营业成本的合计比例分别为 60.96%、61.20%和 60.86%。

报告期内，公司子公司长晶浦联及新顺微产品体系不断丰富、产能增长，公司的晶圆制造和自主封装测试能力不断提升，外购晶圆及封测服务的需求占比降低。另外，公司部分采用集中委托成品采购模式的产品增速较快，此类产品无需单独采购晶圆或封测服务。上述两因素导致成本结构中的晶圆及封测服务占比有所下降，集中委托成品采购成本占比提升。

（四）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及变动分析

（1）综合毛利情况

报告期内，公司综合毛利构成具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	92,125.81	98.51%	79,301.40	98.71%	63,898.49	98.72%
其他业务毛利	1,397.42	1.49%	1,035.67	1.29%	828.51	1.28%
合计	**93,523.23**	**100.00%**	**80,337.07**	**100.00%**	**64,727.00**	**100.00%**

报告期内，公司综合毛利分别为 64,727.00 万元、80,337.07 万元和 93,523.23 万元，主要来源于主营业务毛利。报告期内，随着公司经营规模逐步扩大，公司主营业务毛利金额呈增长趋势。

（2）分产品毛利情况

报告期内，公司各产品的毛利及占比情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分立器件	73,693.04	79.99%	61,130.79	77.09%	48,413.11	75.77%
电源管理 IC	5,714.44	6.20%	5,634.25	7.10%	5,306.87	8.31%
晶圆	12,509.98	13.58%	12,405.88	15.64%	10,077.11	15.77%
其他	208.36	0.23%	130.48	0.16%	101.41	0.16%
合计	**92,125.81**	**100.00%**	**79,301.40**	**100.00%**	**63,898.49**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务毛利主要来自分立器件、电源管理 IC 和晶圆，公司各类产品毛利的占比和变动趋势与主营业务收入基本一致。报告期内，公司主营业务毛利增长幅度大于收入变动幅度，主要系产品毛利率有所提升。

2、毛利率变动分析

（1）综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
主营业务毛利率	31.37%	98.36%	30.03%	98.62%	28.70%	98.51%
其他业务毛利率	28.60%	1.64%	28.11%	1.38%	24.59%	1.49%
综合毛利率	**31.33%**	**100.00%**	**30.00%**	**100.00%**	**28.64%**	**100.00%**

报告期内，公司综合毛利率分别为 28.64%、30.00%和 31.33%，整体呈上升趋势，与主营业务毛利率变动趋势一致，主要系公司逐步向 IDM 模式转变，部分产品封测和晶圆采购成本内化，单位成本下降，毛利率提升。

（2）主营业务分产品毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率分产品情况如下：

项目	2025 年度			2024 年度			2023 年度		
	毛利率	收入占比	毛利率贡献	毛利率	收入占比	毛利率贡献	毛利率	收入占比	毛利率贡献
分立器件	33.15%	75.70%	25.10%	31.46%	73.59%	23.15%	30.06%	72.35%	21.75%
电源管理 IC	23.93%	8.13%	1.95%	24.39%	8.75%	2.13%	25.86%	9.22%	2.38%
晶圆	26.83%	15.88%	4.26%	26.88%	17.48%	4.70%	24.78%	18.27%	4.53%
其他	24.67%	0.29%	0.07%	26.57%	0.19%	0.05%	27.43%	0.17%	0.05%
合计	**31.37%**	**100.00%**	**31.37%**	**30.03%**	**100.00%**	**30.03%**	**28.70%**	**100.00%**	**28.70%**

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 28.70%、30.03%和 31.37%，整体呈上升趋势，主要由分立器件产品贡献。毛利率提升主要原因为：①公司分立器件产品毛利率较高，报告期内，销量增速较快，占比提升，提高了整体毛利率；②公司报告期内自有的晶圆及封装测试产能不断提升，减少了外部晶圆及封装测试采购比例，对应产品单位成本降低，毛利率提升。

① 分立器件

报告期各期，公司分立器件产品毛利率分别为 30.06%、31.46%和 33.15%，呈上升趋势，分产品构成情况如下：

项目	2025 年度			2024 年度			2023 年度		
	毛利率	收入占比	毛利率贡献	毛利率	收入占比	毛利率贡献	毛利率	收入占比	毛利率贡献
二极管	39.44%	34.31%	13.53%	36.97%	32.03%	11.84%	35.01%	32.72%	11.45%
三极管	40.02%	27.29%	10.92%	35.16%	27.56%	9.69%	33.80%	28.43%	9.61%

项目	2025 年度			2024 年度			2023 年度		
	毛利率	收入占比	毛利率贡献	毛利率	收入占比	毛利率贡献	毛利率	收入占比	毛利率贡献
MOSFET	22.72%	36.59%	8.31%	22.78%	37.90%	8.64%	21.51%	35.52%	7.64%
其他分立器件	21.37%	1.82%	0.39%	28.10%	2.50%	0.70%	24.88%	3.33%	0.83%
合计	**33.15%**	**100.00%**	**33.15%**	**31.46%**	**100.00%**	**31.46%**	**30.06%**	**100.00%**	**30.06%**

报告期内，公司分立器件产品毛利率持续增长，主要系二极管、三极管产品毛利率提升所致。

A、二极管

报告期内，公司二极管产品毛利率分别为 35.01%、36.97%和 39.44%，按照单位价格及单位成本变动等影响因素分析如下：

二极管	2025 年度			2024 年度			2023 年度
	金额	变动比例	对毛利率影响	金额	变动比例	对毛利率影响	金额
收入（万元）	76,274.26	12.68%	/	67,688.36	19.37%	/	56,706.47
销量（亿颗）	174.46	16.43%	/	149.85	28.90%	/	116.25
平均单位价格（元/千颗）	**43.72**	**-3.21%**	**-2.09%**	**45.17**	**-7.40%**	**-5.19%**	**48.78**
平均单位成本（元/千颗）	**26.48**	**-7.00%**	**4.56%**	**28.47**	**-10.19%**	**7.15%**	**31.70**
毛利率	**39.44%**	**/**	**2.47%**	**36.97%**	**/**	**1.96%**	**35.01%**

注：平均单位价格变动对毛利率的影响=（当期平均单位价格-上期平均单位成本）/当期平均单位价格-上期毛利率；平均单位成本变化对毛利率的影响=当期毛利率-（当期平均单位价格-上期平均单位成本）/当期平均单位价格，下同。

由上表可见，报告期内，公司二极管产品毛利率逐年上升，主要原因为平均单位成本下降幅度大于平均单位价格下降幅度。

报告期内，行业下游需求整体处于复苏阶段，但供应端竞争仍较为激烈，市场价格下行，导致公司二极管产品报告期内平均销售单价整体下降，2025 年度，降幅有所收窄。

报告期内，公司二极管产品单位成本呈下降趋势，主要原因系：（1）市场降价趋势向上游传导、公司提高供应链管控等因素导致外采晶圆及封测服务的单价整体下降；（2）公司逐步向 IDM 模式转变，部分二极管产品封测和晶圆采购成本内化，产品单位成本有所下降；（3）报告期内，公司二极管产品销量持续增加，

规模效应进一步体现，产品单位成本下降。

B、三极管

报告期内，公司三极管产品毛利率分别为 33.80%、35.16%和 40.02%，按照单位价格及单位成本变动等影响因素分析如下：

三极管	2025 年度			2024 年度			2023 年度
	金额	变动比例	对毛利率影响	金额	变动比例	对毛利率影响	金额
收入（万元）	60,650.34	7.12%	/	56,618.92	17.04%	/	48,377.15
销量（亿颗）	129.18	16.19%	/	111.18	26.78%	/	87.69
平均单位价格（元/千颗）	**46.95**	**-7.81%**	**-5.49%**	**50.93**	**-7.69%**	**-5.51%**	**55.17**
平均单位成本（元/千颗）	**28.16**	**-14.71%**	**10.35%**	**33.02**	**-9.59%**	**6.88%**	**36.52**
毛利率	**40.02%**	**/**	**4.86%**	**35.16%**	**/**	**1.36%**	**33.80%**

由上表可见，报告期内，公司三极管产品毛利率逐年上升，主要系该产品单位成本下降幅度大于单位价格下降幅度所致，单价、成本下降原因与前述二极管产品成本变动原因一致。

C、MOSFET

报告期内，公司 MOSFET 产品毛利率分别为 21.51%、22.78%和 22.72%，基本保持稳定，按照单位价格及单位成本变动等影响因素分析如下：

MOSFET	2025 年度			2024 年度			2023 年度
	金额	变动比例	对毛利率影响	金额	变动比例	对毛利率影响	金额
收入（万元）	81,321.96	24.38%	/	65,383.41	28.25%	/	50,982.77
销量（亿颗）	52.01	26.17%	/	41.22	40.73%	/	29.29
平均单位价格（元/千颗）	**156.37**	**-1.42%**	**-1.12%**	**158.63**	**-8.87%**	**-7.64%**	**174.07**
平均单位成本（元/千颗）	**120.84**	**-1.35%**	**1.06%**	**122.49**	**-10.34%**	**8.91%**	**136.62**
毛利率	**22.72%**	**/**	**-0.06%**	**22.78%**	**/**	**1.27%**	**21.51%**

受到市场因素影响，报告期内公司 MOSFET 产品销售价格下降，公司 MOSFET 产品生产主要采取 Fabless 模式，随着降价趋势向上游传导，公司外采晶圆及封测服务的价格也呈下降趋势，整体来看，MOSFET 产品单价及成本均有所下降，毛利率整体保持稳定。

综上，报告期内，公司分立器件产品毛利率分别为30.06%、31.46%和33.15%，整体呈上升趋势，主要系二极管、三极管等产品毛利率提升及收入结构变动综合影响，符合公司经营情况。

② 电源管理 IC

报告期内，公司电源管理 IC 的毛利率分别为 25.86%、24.39%和 23.93%，整体呈下降趋势，按照单位价格及单位成本变动等影响因素分析如下：

电源管理 IC	2025 年度			2024 年度			2023 年度
	金额	变动比例	对毛利率影响	金额	变动比例	对毛利率影响	金额
收入（万元）	23,877.36	3.34%	/	23,104.78	12.59%	/	20,521.30
销量（亿颗）	14.69	11.82%	/	13.14	23.08%	/	10.67
平均单位价格（元/千颗）	**162.57**	**-7.58%**	**-6.20%**	**175.90**	**-8.52%**	**-6.91%**	**192.29**
平均单位成本（元/千颗）	**123.66**	**-7.02%**	**5.75%**	**133.00**	**-6.70%**	**5.43%**	**142.56**
毛利率	**23.93%**	**/**	**-0.45%**	**24.39%**	**/**	**-1.47%**	**25.86%**

由上表可见，报告期内，公司电源管理 IC 产品毛利率逐年下降，变动幅度较小，主要系报告期内电源管理 IC 产品市场竞争激烈，产品平均单价下降。

③ 晶圆

报告期内，公司晶圆产品的毛利率分别为 24.78%、26.88%和 26.83%，呈上升趋势，按照单位价格及单位成本变动等影响因素分析如下：

晶圆	2025 年度			2024 年度			2023 年度
	金额	变动比例	对毛利率影响	金额	变动比例	对毛利率影响	金额
收入（万元）	46,634.34	1.03%	/	46,157.11	13.49%	/	40,670.55
销量（亿颗）	161.99	4.91%	/	154.41	26.38%	/	122.18
平均单位价格（元/千颗）	**28.79**	**-3.70%**	**-2.81%**	**29.89**	**-10.20%**	**-8.54%**	**33.29**
平均单位成本（元/千颗）	**21.07**	**-3.63%**	**2.75%**	**21.86**	**-12.70%**	**10.64%**	**25.04**
毛利率	**26.83%**	**/**	**-0.05%**	**26.88%**	**/**	**2.10%**	**24.78%**

注：为保证可比性，上表披露的晶圆数量以其能产出的芯片成品数量列示。

报告期内，公司晶圆产品毛利率整体较为稳定，晶圆销售单价随市场价格有所下降，但晶圆产能、产量持续扩大，规模效应进一步体现，同时叠加工艺升级、

良率提升等因素影响，晶圆产品平均单位成本有所下降，毛利率维持稳定。

3、同行业可比上市公司毛利率分析

报告期内，公司毛利率与同行业可比公司毛利率对比情况如下：

公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扬杰科技	34.27%	33.08%	30.26%
士兰微	18.83%	19.09%	22.21%
新洁能	32.86%	36.42%	30.75%
捷捷微电	30.93%	36.34%	34.13%
行业平均值	**29.22%**	**31.24%**	**29.34%**
发行人	**31.33%**	**30.00%**	**28.64%**

注：数据来源为同行业上市公司公开资料

报告期内，公司毛利率与同行业可比公司平均值不存在较大差异，处于同行业可比公司区间内。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	12,433.50	4.16%	11,431.10	4.27%	9,298.52	4.11%
管理费用	20,632.89	6.91%	22,222.84	8.30%	16,678.38	7.38%
研发费用	14,567.59	4.88%	12,362.83	4.62%	11,274.07	4.99%
财务费用	2,770.37	0.93%	2,870.00	1.07%	3,604.87	1.60%
期间费用合计	**50,404.35**	**16.88%**	**48,886.77**	**18.26%**	**40,855.84**	**18.08%**

报告期各期，公司期间费用分别为 40,855.84 万元、48,886.77 万元和 50,404.35 万元，占各期营业收入的比例分别为 18.08%、18.26%和 16.88%，期间费用随着公司规模的扩大而同步增长。

1、销售费用

（1）销售费用构成及变动分析

报告期内，公司销售费用构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	7,823.51	62.92%	7,002.24	61.26%	6,016.33	64.70%
折旧与摊销	1,231.06	9.90%	1,331.48	11.65%	1,299.67	13.98%
差旅与业务招待	1,816.19	14.61%	1,585.98	13.87%	1,198.94	12.89%
样品与检测	387.27	3.11%	141.73	1.24%	143.06	1.54%
股份支付	132.28	1.06%	122.47	1.07%	138.05	1.48%
办公费	293.95	2.36%	260.39	2.28%	234.65	2.52%
广告宣传费	175.34	1.41%	177.56	1.55%	144.73	1.56%
服务费	555.36	4.47%	759.76	6.65%	85.89	0.92%
其他费用	18.54	0.15%	49.49	0.43%	37.20	0.40%
合计	**12,433.50**	**100.00%**	**11,431.10**	**100.00%**	**9,298.52**	**100.00%**

公司销售费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、差旅费与业务招待等构成。报告期内，公司销售费用分别为 9,298.52 万元、11,431.10 万元和 12,433.50 万元，占营业收入的比例分别为 4.11%、4.27%和 4.16%，销售费用规模随着经营规模扩大逐渐增加，占比相对稳定。

① 职工薪酬

报告期内，公司销售费用职工薪酬金额分别为 6,016.33 万元、7,002.24 万元和 7,823.51 万元，占营业收入比例分别为 2.66%、2.62%和 2.62%，金额整体呈增长趋势，占比相对较为稳定。

报告期各期末，公司销售人员数量分别为 213 人、227 人和 241 人，呈增长趋势，与销售费用职工薪酬变动趋势相匹配。

② 折旧与摊销

公司销售费用折旧摊销主要包括办公场所的固定资产折旧、长期待摊费用和使用权资产摊销，收购形成的无形资产（客户关系）摊销等。报告期内，公司销售费用折旧与摊销金额分别为 1,299.67 万元、1,331.48 万元和 1,231.06 万元，金额相对较为稳定。

③ 差旅费与业务招待

报告期内，公司销售费用差旅费与业务招待金额分别为 1,198.94 万元、

1,585.98 万元和 1,816.19 万元，占营业收入比例分别为 0.53%、0.59%和 0.61%。公司差旅费与业务招待费用金额呈逐年增长趋势，主要系随着公司经营规模扩大，销售人员拜访与招待客户相应支出增加所致。

（2）销售费用率与同行业对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司的销售费用率比较情况如下：

公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扬杰科技	4.08%	3.72%	3.85%
士兰微	1.48%	1.59%	1.79%
新洁能	1.53%	1.35%	1.35%
捷捷微电	2.21%	2.33%	3.13%
平均值	**2.33%**	**2.25%**	**2.53%**
发行人	**4.16%**	**4.27%**	**4.11%**
发行人（剔除无形资产-客户关系摊销）	**3.86%**	**3.93%**	**3.71%**

注：数据来源同行业上市公司公开资料，下同。

由上表可见，剔除无形资产-客户关系摊销影响后，公司销售费用率与扬杰科技处于同一水平，高于其他可比公司，主要原因系：与同行业可比公司相比，公司成立于 2018 年末，成立时间较短，报告期内仍处于产品结构优化、规模扩张的阶段，因此保持了较高水平的市场开拓力度；同时，公司产品线丰富，行业覆盖多，客户相对分散，因此销售人员较多，销售人员薪酬等销售费用支出较高。

2、管理费用

（1）管理费用构成及变动分析

报告期内，公司管理费用构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,235.32	49.61%	9,592.44	43.16%	8,094.01	48.53%
服务与咨询	1,129.22	5.47%	821.83	3.70%	2,560.01	15.35%
折旧与摊销	2,695.29	13.06%	4,050.42	18.23%	2,262.06	13.56%
差旅与业务招待	1,811.63	8.78%	1,303.66	5.87%	1,252.12	7.51%
股份支付	2,760.35	13.38%	4,524.57	20.36%	1,196.01	7.17%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
办公费	1,487.74	7.21%	1,548.77	6.97%	986.24	5.91%
其他费用	513.34	2.49%	381.15	1.72%	327.94	1.97%
合计	**20,632.89**	**100.00%**	**22,222.84**	**100.00%**	**16,678.38**	**100.00%**

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销、差旅与业务招待、股份支付等构成。报告期内，公司管理费用分别为 16,678.38 万元、22,222.84 万元和 20,632.89 万元，占营业收入的比例分别为 7.38%、8.30%和 6.91%，金额随着业务规模扩大整体呈增长趋势。

① 职工薪酬

报告期内，公司管理费用职工薪酬金额分别为 8,094.01 万元、9,592.44 万元和 10,235.32 万元，占营业收入比例分别为 3.58%、3.58%和 3.43%，金额整体呈增长趋势，主要系随着公司经营规模扩大，管理人员数量增加所致。报告期各期末，公司管理人员数量分别为 263 人、290 人和 318 人，呈增长趋势，与管理费用职工薪酬金额变动趋势相匹配。

② 折旧与摊销

报告期内，公司管理费用折旧与摊销主要包括办公场所的固定资产折旧及长期待摊费用摊销、收购产生的无形资产（专利权）摊销、租赁产生的使用权资产摊销等。报告期内，公司管理费用折旧与摊销金额分别为 2,262.06 万元、4,050.42 万元和 2,695.29 万元。2024 年度，公司折旧摊销金额大幅增加，主要系当期长晶浦联新厂房启用，原租赁厂房不再使用，装修支出一次性结转，长期待摊费用摊销金额大幅增加所致。

③ 差旅与业务招待

报告期内，公司管理费用差旅与业务招待金额分别为 1,252.12 万元、1,303.66 万元和 1,811.63 万元，占营业收入比例分别为 0.55%、0.49%和 0.61%，金额随着经营规模扩大及管理人员数量增加呈逐年增加趋势。

④ 股份支付

报告期内，公司管理费用股份支付金额分别为 1,196.01 万元、4,524.57 万元

和 2,760.35 万元，主要系公司员工股权激励形成的股份支付。其中，2024 年度和 2025 年度，管理费用股份支付金额相对较高，主要原因为：当期对部分股权激励人员转让其前期股权激励中受让的股权，对应的股份支付作加速行权处理，计入当期费用。

公司管理费用中，服务咨询费用主要系上市相关中介机构服务费以及招聘、法律等咨询服务费用。2023 年度，公司服务与咨询费用相对较高，主要为前次 IPO 申报相关中介机构服务费用。

（2）管理费用率与同行业对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司的管理费用率比较情况如下：

公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扬杰科技	5.47%	5.95%	6.16%
士兰微	3.86%	4.11%	4.05%
新洁能	3.59%	3.03%	2.86%
捷捷微电	5.47%	4.53%	7.48%
平均	**4.59%**	**4.40%**	**5.14%**
发行人	**6.91%**	**8.30%**	**7.38%**
发行人（剔除股份支付和无形资产-专利权摊销）	**5.68%**	**6.27%**	**6.45%**

报告期内，公司管理费用率高于同行业可比公司平均水平，剔除股份支付和无形资产-专利权摊销后的管理费用率与同行业可比公司平均水平接近。其中，2024 年度，公司管理费用率与同行业可比公司平均水平差异较大，主要原因系当期长晶浦联新厂房启用，原租赁厂房不再使用，装修支出一次性结转，长期待摊费用摊销金额大幅增加。

3、研发费用

（1）研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	合计
研发投入	14,567.59	12,362.83	11,274.07	38,204.49
其中：费用化支出	14,567.59	12,362.83	11,274.07	38,204.49

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度	合计
资本化支出	-	-	-	-
营业收入	298,523.51	267,765.34	225,989.82	792,278.67
研发投入占营业收入的比例	4.88%	4.62%	4.99%	4.82%

报告期内，公司研发投入均为费用化支出，各期研发投入分别为 11,274.07 万元、12,362.83 万元和 14,567.59 万元，占营业收入的比例分别为 4.99%、4.62%和 4.88%，最近三年累计研发投入金额为 38,204.49 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 4.82%；2023 年度至 2025 年度，公司研发投入复合增长率为 13.67%。

（2）研发费用构成及变动分析

报告期内，公司研发费用构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	10,037.58	68.90%	8,101.73	65.53%	7,437.34	65.97%
折旧摊销	1,190.19	8.17%	973.19	7.87%	877.43	7.78%
直接投入	2,555.18	17.54%	2,171.10	17.56%	1,395.89	12.38%
股份支付	426.69	2.93%	164.77	1.33%	185.31	1.64%
检测费	70.41	0.48%	693.94	5.61%	1,056.40	9.37%
其他费用	287.54	1.97%	258.10	2.09%	321.70	2.85%
合计	**14,567.59**	**100.00%**	**12,362.83**	**100.00%**	**11,274.07**	**100.00%**

公司研发费用主要由职工薪酬、直接投入、折旧摊销等构成。其中，直接投入主要为流片及检测实验产生的费用，折旧摊销主要为研发相关的实验、测试、分析仪器、研发场所等产生的折旧摊销费用。

报告期内，公司研发费用逐年增长，主要原因为：随着下游客户、产品销量的不断增长，公司加大拓展新产品力度，职工薪酬随研发人员数量逐年增长，同时，研发相关的流片、试验活动增加，耗用材料有所增长。

2024、2025 年度，公司检测费减少，主要原因为收购长芯检测后，相关检测业务纳入合并范围，不再体现为合并报表的检测费。

（3）研发费用率与同行业对比分析

报告期内，公司与同行业可比公司的研发费用率比较情况如下：

公司	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扬杰科技	6.61%	7.02%	6.58%
士兰微	8.36%	9.22%	9.25%
新洁能	6.28%	5.67%	5.91%
捷捷微电	5.77%	9.56%	12.21%
平均	**6.75%**	**7.87%**	**8.49%**
发行人	**4.88%**	**4.62%**	**4.99%**

报告期内，公司研发费用率与同行业平均水平变动趋势基本一致，低于同行业可比公司平均水平，主要系公司成立时间较短，处于业务成长期，对营运资金的需求较大，规模及资金实力相较于同行业上市公司受限，因注重投入效益，研发投入规模相对审慎所致。

（4）研发项目情况

报告期内，公司前五大研发项目研发费用具体情况见下：

单位：万元

期间	项目名称	金额	项目进展
2025 年度	超低能耗高可靠性二代 SGTMOSFET 研发	1,964.58	研发中
	高性能高可靠性沟槽栅 FS-IGBT 产品研发	1,595.35	研发中
	面向手机应用的四合一多路 LDO 产品开发	853.61	研发中
	晶圆级封装的低内阻双通道 MOS 产品的研发	799.87	已结项
	直流转直流 BUCK 变换器芯片平台研发	751.65	研发中
2024 年度	超低能耗高可靠性二代 SGT MOSFET 研发	1,539.69	研发中
	一种低功耗高 PSRR 的高耐压 LDO 产品的研发	1,305.10	已结项
	晶圆级封装的低内阻双通道 MOS 产品的研发	1,070.49	已结项
	高可靠性沟槽 MOSFET 研发	797.58	已结项
	DB 关键工艺协同精进工程等研发	736.23	已结项
2023 年度	中高压功率器件的研发	2,311.23	已结项
	一种低功耗高 PSRR 的高耐压 LDO 产品的研发	768.53	已结项
	高适封性芯片制程工艺研究	561.58	已结项
	低压 TrenchMOS 器件高效制备工艺的研发	521.89	已结项
	高稳定性、低功耗旁路二极管产品的研发	506.01	已结项

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	2,967.39	3,194.78	3,822.83
其中：租赁负债利息费用	192.99	261.73	312.56
减：利息收入	278.42	325.84	219.79
汇兑损益	51.52	-26.49	-40.47
其他	29.88	27.55	42.30
合计	**2,770.37**	**2,870.00**	**3,604.87**

报告期内，公司财务费用分别为 3,604.87 万元、2,870.00 万元和 2,770.37 万元，主要系银行借款利息支出。

（六）其他经营成果分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益分别为 3,700.57 万元、5,177.00 万元和 2,468.84 万元，主要为收到的与企业日常活动相关的政府补助和进项税加计抵减，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	1,741.86	3,218.85	3,234.78
进项税加计抵减	689.30	1,936.03	434.74
代扣个人所得税手续费	37.68	22.12	31.06
合计	**2,468.84**	**5,177.00**	**3,700.57**

报告期内，公司主要政府补助项目情况如下：

单位：万元

项目名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产/收益相关
功率器件、汽车半导体研发制造基地项目补贴	1,070.86	2,341.98	1,182.19	与资产、收益相关
2021 年南京市工业企业技术装备投入财政奖补	185.94	183.73	167.62	与资产相关
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室扶持资金补贴	-	-	460.00	与收益相关
2021 年度南京江北新区（自贸	-	-	455.08	与收益相关

项目名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度	与资产/收益相关
试验区）高层次人才奖补				
南京市江北新区产业技术研创园管理办公室租金补贴	-	89.59	321.05	与收益相关
2023 年南京市工业和信息化发展专项资金项目奖补资金	-	-	221.10	与收益相关
稳岗补贴	60.62	49.45	75.48	与收益相关
江阴市工业和信息化转型升级专项资金	59.01	79.23	17.16	与资产、收益相关
集成电路产业政策扶持补贴	54.77	48.07	43.72	与资产、收益相关
进口贴息专项资金拨款补贴	45.74	47.79	19.72	与资产相关
2023 软选国家重点人才工程 B 类项目奖励资金	-	100.00	-	与收益相关
2022 年度国家级专精特新奖励资金	-	70.00	30.00	与收益相关
江阴高新技术产业开发区经济发展局产业强区专项资金	2.50	50.62	20.00	与资产、收益相关
江阴高新区技术产业开发区经济发展局数字化转型升级专项资金	5.00	50.00	3.00	与收益相关
2023 江北新区博站设站资助	-	-	55.00	与收益相关
其他	257.43	108.38	163.65	与资产、收益相关
合计	**1,741.86**	**3,218.85**	**3,234.78**	/

2、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为 61.83 万元、265.24 万元和-8.29 万元，金额相对较小。2023 年度，公司投资收益主要系以权益法核算的对长芯检测长期股权投资收益；2024 年度，公司投资收益主要系当期收购长芯检测剩余股权，相关资产在购买日前持有份额公允价值与账面价值差异；2025 年度，公司投资收益主要系处置交易性金融资产取得的投资收益以及银行承兑汇票贴现产生的投资损失。

3、信用减值损失、资产减值损失

（1）信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收票据坏账损失	44.02	0.15	-
应收账款坏账损失	637.01	243.63	719.55
其他应收款坏账损失	-1,354.84	799.79	965.65
合计	**-673.81**	**1,043.58**	**1,685.19**

2025 年度，公司其他应收款坏账损失转回主要系收回前期拟购买办公场所支付的保证金所致。

（2）资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,725.15	5,685.43	5,033.62
固定资产减值损失	274.66	-	-
合计	**3,999.81**	**5,685.43**	**5,033.62**

报告期内，公司根据企业会计准则及公司实际情况，制订了谨慎的存货跌价计提政策。公司于每个资产负债表日对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备，计入资产减值损失。

4、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为-4.41 万元、134.99 万元和 19.43 万元，均为非流动资产处置利得，对公司经营成果影响较小。其中，2024 年度资产处置收益主要系部分租赁合同提前终止，租赁负债账面价值高于使用权资产账面价值的部分。

5、营业外收入及支出

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为 78.85 万元、262.65 万元和 453.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
接受捐赠	-	22.50	-
临时厂房装修转让收益	438.53	-	-
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-	204.19	-
其他	14.47	35.96	78.85
合计	**453.00**	**262.65**	**78.85**

2024 年度，公司营业外收入金额较大，主要系收购长芯检测时合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额形成的收益；2025 年度，公司营业外收入主要系转让长晶浦联原租赁厂房装修形成的收益。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出分别为 39.40 万元、100.01 万元和 90.64 万元，具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
对外捐赠	2.00	12.00	2.00
非流动资产毁损报废损失	14.13	25.10	15.49
税收滞纳金	55.93	36.90	18.59
其他	18.57	26.01	3.33
合计	**90.64**	**100.01**	**39.40**

（七）纳税情况分析

1、主要税种纳税情况

报告期内公司及子公司实际缴纳的主要税种的税额如下：

单位：万元

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
企业所得税	期初未交数	2,200.70	1,263.67	711.12
	本期应交	6,054.13	5,463.65	4,215.33
	本期已交	7,389.53	4,526.62	3,662.78
	期末未交数	**865.30**	**2,200.70**	**1,263.67**
增值税	期初未交数	612.95	726.15	742.31

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
	本期应交	9,244.32	7,175.73	8,391.38
	本期已交	9,563.90	7,288.93	8,407.54
	期末未交数	**293.36**	**612.95**	**726.15**

2、会计利润与所得税费用调整过程

报告期内，公司所得税费用与会计利润的关系如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利润总额	40,780.90	29,018.41	19,643.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,117.14	4,352.76	2,946.60
子公司适用不同税率的影响	592.29	669.75	587.69
调整以前期间所得税的影响	-	-	4.58
非应税收入的影响	-	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	803.13	1,141.24	583.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	291.76	549.90	74.59
其他	-1,924.15	-1,926.07	-1,253.07
所得税费用	**5,880.17**	**4,787.58**	**2,943.85**

七、资产质量分析

（一）资产结构总体分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	224,912.64	49.35%	212,895.50	48.21%	188,827.74	48.08%
非流动资产	230,833.62	50.65%	228,722.65	51.79%	203,932.04	51.92%
合计	**455,746.26**	**100.00%**	**441,618.14**	**100.00%**	**392,759.78**	**100.00%**

报告期各期末，公司资产总额分别为 392,759.78 万元、441,618.14 万元和 455,746.26 万元。报告期内，随着公司业务规模的持续扩大，公司资产规模持续

增加。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为48.08%、48.21%和49.35%，流动资产占比逐年上升。

（二）流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	51,365.86	22.84%	52,778.17	24.79%	35,839.66	18.98%
交易性金融资产	562.02	0.25%	-	0.00%	-	0.00%
应收票据	25,539.78	11.36%	28,672.54	13.47%	22,372.12	11.85%
应收账款	63,478.30	28.22%	55,922.17	26.27%	51,835.53	27.45%
应收款项融资	16,342.11	7.27%	16,616.03	7.80%	16,998.64	9.00%
预付款项	1,482.81	0.66%	863.68	0.41%	1,581.96	0.84%
其他应收款	108.00	0.05%	451.54	0.21%	1,993.41	1.06%
存货	64,247.33	28.57%	56,103.86	26.35%	57,895.63	30.66%
其他流动资产	1,786.42	0.79%	1,487.51	0.70%	310.79	0.16%
合计	**224,912.64**	**100.00%**	**212,895.50**	**100.00%**	**188,827.74**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、存货，合计占流动资产比例分别为88.94%、90.88%和90.98%。公司流动资产具体情况如下：

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.71	0.001%	7.71	0.01%	16.93	0.05%
银行存款	50,809.11	98.92%	49,702.66	94.17%	32,193.68	89.83%
其他货币资金	556.04	1.08%	3,067.81	5.81%	3,629.04	10.13%
合计	**51,365.86**	**100.00%**	**52,778.17**	**100.00%**	**35,839.66**	**100.00%**
其中：存放在境外的款项总额	867.98	1.69%	3,045.51	5.77%	946.82	2.64%

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 35,839.66 万元、52,778.17 万元和 51,365.86 万元，占流动资产的比例分别为 18.98%、24.79%和 22.84%。公司货币资金以银行存款为主，报告期内，公司经营活动现金流量情况良好，公司银行存款规模呈现增长趋势。报告期各期末，公司其他货币资金均为票据保证金。

2、交易性金融资产

2025 年末，公司交易性金融资产余额为 562.02 万元，占流动资产的比例为 0.25%，主要系公司为提高资金使用效率购买的银行理财。

3、应收票据及应收款项融资

（1）应收票据和应收款项融资构成情况

报告期内，公司执行新金融工具准则，将 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行和交通银行）和 9 家上市股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行和浙商银行）承兑的银行承兑汇票列示为应收款项融资，其余银行承兑汇票及商业承兑汇票列示为应收票据。

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收票据			
银行承兑汇票	24,700.54	28,669.65	22,372.12
商业承兑汇票	883.41	3.03	-
小计	**25,583.95**	**28,672.69**	**22,372.12**
减：商业承兑汇票坏账准备	44.17	0.15	-
应收票据小计	**25,539.78**	**28,672.54**	**22,372.12**
应收款项融资			
银行承兑汇票	16,342.11	16,616.03	16,998.64
应收款项融资小计	**16,342.11**	**16,616.03**	**16,998.64**
合计	**41,881.90**	**45,288.56**	**39,370.76**

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为 39,370.76 万元、45,288.56 万元和 41,881.90 万元，占流动资产的比例分别为 20.85%、21.27%

和 18.62%。

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资以银行承兑汇票为主，商业承兑汇票金额较小。2025 年末，公司商业承兑汇票余额增加主要系自 2025 年开始，比亚迪采用商业承兑汇票的方式向公司支付部分货款，2025 年末公司商业承兑汇票的出票人均为比亚迪及其下属子公司。

（2）已背书或贴现且尚未到期的应收票据和应收款项融资

报告期各期末，公司已背书或贴现且尚未到期的应收票据和应收款项融资具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收票据			
终止确认金额	-	-	-
未终止确认金额	19,191.28	17,040.39	10,571.39
应收款项融资			
终止确认金额	39,409.06	26,465.87	22,037.06
未终止确认金额	-	-	-

报告期内，为提高资金使用效率，公司将部分票据背书给供应商或进行贴现，针对上述 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制银行承兑的银行汇票，由于其信用较好，银行汇票到期不获支付的可能性较低，公司将已背书或贴现的且尚未到期的部分予以终止确认；针对其他商业银行承兑的银行承兑汇票，基于谨慎性原则，公司待票据到期后终止确认。

4、应收账款

（1）应收账款变动情况

报告期各期末，公司应收账款变动情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
应收账款账面余额	67,113.76	58,930.84	54,612.79
营业收入	298,523.51	267,765.34	225,989.82
应收账款账面价值占当期营业收入的比例	**22.48%**	**22.01%**	**24.17%**

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 54,612.79 万元、58,930.84 万元和 67,113.76 万元，占当期营业收入的比例分别为 24.17%、22.01%和 22.48%，占比较为稳定。

（2）应收账款账龄及坏账准备计提分析

① 应收账款账龄情况

报告期各期末，公司按应收账款的账龄构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	66,764.75	99.48%	58,718.75	99.64%	54,493.36	99.78%
1-2 年	173.59	0.26%	145.18	0.25%	67.30	0.12%
2-3 年	111.03	0.17%	17.39	0.03%	12.56	0.02%
3 年以上	64.39	0.10%	49.52	0.08%	39.57	0.07%
合计	**67,113.76**	**100.00%**	**58,930.84**	**100.00%**	**54,612.79**	**100.00%**

报告期各期末，公司应收账款主要为账龄在 1 年以内的应收账款，占比分别为 99.78%、99.64%和 99.48%，应收账款质量良好。

② 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目		2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
按单项计提坏账准备的应收账款	账面余额	203.41	29.86	29.87
	减：坏账准备	203.41	29.86	29.87
	计提比例	100.00%	100.00%	100.00%
	账面价值	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	账面余额	66,910.35	58,900.98	54,582.91
	减：坏账准备	3,432.05	2,978.81	2,747.38
	计提比例	5.13%	5.06%	5.03%
	账面价值	63,478.30	55,922.17	51,835.53
账面余额合计		**67,113.76**	**58,930.84**	**54,612.79**
减：坏账准备		3,635.46	3,008.68	2,777.25
计提比例		5.42%	5.11%	5.09%

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
账面价值合计	**63,478.30**	**55,922.17**	**51,835.53**

报告期内，公司应收账款分为按单项计提坏账准备的应收账款和按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。报告期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款金额较小，且均已全额计提坏账准备。

③ 应收账款坏账计提情况

报告期内，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款的坏账计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司简称/账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
扬杰科技	5%	10%	50%	100%
士兰微	5%	10%	30%	100%
新洁能	5%	10%	30%	100%
捷捷微电	2.65%-3.15%	53.86%-79.30%	95.93%-99.23%	96.94%-99.63%
发行人	**5%**	**10%**	**50%**	**100%**

综上，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在显著差异。

（3）应收账款主要客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

2025.12.31				
序号	**客户名称**	**应收账款余额**	**占应收账款余额比例**	**坏账准备余额**
1	深圳海格微电子有限公司	6,454.61	9.62%	322.73
2	欣旺达电子股份有限公司	5,033.95	7.50%	251.70
3	深圳翰世宇科技有限公司	3,334.03	4.97%	166.70
4	南京高上美电子有限公司	2,319.68	3.46%	115.98
5	深圳市联盛电子有限公司	2,250.43	3.35%	112.52
合计		**19,392.71**	**28.90%**	**969.64**
2024.12.31				
序号	**客户名称**	**应收账款余额**	**占应收账款余额比例**	**坏账准备余额**
1	欣旺达电子股份有限公司	5,882.50	9.98%	294.13
2	深圳翰世宇科技有限公司	3,732.79	6.33%	186.64
3	比亚迪股份有限公司	2,857.23	4.85%	142.86

4	深圳海格微电子有限公司	2,803.47	4.76%	140.17
5	南京高上美电子有限公司	1,921.31	3.26%	96.07
合计		**17,197.29**	**29.18%**	**859.86**
2023.12.31				
序号	**客户名称**	**应收账款余额**	**占应收账款余额比例**	**坏账准备余额**
1	欣旺达电子股份有限公司	5,757.75	10.54%	287.89
2	深圳海格微电子有限公司	5,280.97	9.67%	264.05
3	比亚迪股份有限公司	1,969.93	3.61%	98.50
4	南京高上美电子有限公司	1,902.77	3.48%	95.14
5	深圳传音控股股份有限公司	1,758.23	3.22%	87.91
合计		**16,669.65**	**30.52%**	**833.48**

报告期各期末，公司应收账款前五名客户与公司主要客户相匹配，主要为知名终端客户或专业从事半导体产品业务的中大型经销商，具有较强的资金实力和良好的商业信誉，应收账款回款风险较低。公司应收账款前 5 名客户与公司均不存在关联关系。

（4）应收账款回款情况

公司期后回款较好，截至 2026 年 4 月 30 日，报告期各期末应收账款回款情况见下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款账面余额	67,113.76	58,930.84	54,612.79
期后回款	62,659.32	58,588.09	54,438.51
回款比例	93.36%	99.42%	99.68%

截至 2026 年 4 月 30 日，2025 年末回款比例较 2023 年末、2024 年末有所下降，主要原因为回款统计截止日与 2025 年末期间间隔仅 4 个月，部分客户未到货款账期，尚未回款。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项的账龄构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	1,455.73	98.17%	847.36	98.11%	1,545.49	97.69%
1-2 年	13.52	0.91%	1.99	0.23%	8.79	0.56%
2-3 年	0.39	0.03%	2.45	0.28%	22.05	1.39%
3 年以上	13.17	0.89%	11.88	1.38%	5.63	0.36%
合计	**1,482.81**	**100.00%**	**863.68**	**100.00%**	**1,581.96**	**100.00%**

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 1,581.96 万元、863.68 万元和 1,482.81 万元，占公司流动资产的比例分别为 0.84%、0.41%和 0.66%，占比相对较低。公司预付款项主要为预付晶圆及封装材料采购款，账龄主要在 1 年以内。

报告期各期末，公司预付款项余额前 5 名情况如下：

单位：万元

2025.12.31			
序号	**名称**	**账面余额**	**占比**
1	力积电	825.51	55.67%
2	东丽国际贸易（中国）有限公司	156.00	10.52%
3	中芯国际集成电路制造有限公司	146.97	9.91%
4	无锡华润上华科技有限公司	113.47	7.65%
5	上海芯巽微电子科技有限公司	33.50	2.26%
合计		**1,275.45**	**86.01%**
2024.12.31			
序号	**名称**	**账面余额**	**占比**
1	力积电	554.01	64.14%
2	Advanced Assembly Materials International	31.64	3.66%
3	南京中燃城市燃气发展有限公司	27.88	3.23%
4	中芯国际集成电路制造有限公司	35.13	4.07%
5	上海新进半导体制造有限公司	23.19	2.69%
合计		**671.85**	**77.79%**
2023.12.31			
序号	**名称**	**账面余额**	**占比**
1	力积电	1,223.26	77.33%
2	CoorsTek INC	95.57	6.04%
3	M-MOS Semiconductor HongKong Limited	34.54	2.18%

4	中芯国际集成电路制造有限公司	20.86	1.32%
5	Advanced Assembly Materials International	18.88	1.19%
合计		**1,393.10**	**88.06%**

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
押金及保证金	920.85	2,257.15	2,967.29
备用金	3.96	5.30	21.30
往来款	1.71	375.43	375.40
账面余额合计	**926.52**	**2,637.87**	**3,363.99**
减：坏账准备	818.52	2,186.33	1,370.59
账面价值合计	**108.00**	**451.54**	**1,993.41**

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,993.41 万元、451.54 万元和 108.00 万元，占流动资产的比例分别为 1.06%、0.21%和 0.05%，占比较小。

公司其他应收款主要为押金及保证金和往来款。押金及保证金主要为：（1）为保证晶圆采购的稳定性，根据协议约定，公司向力积电等知名晶圆生产企业支付的晶圆采购保证金；（2）公司前期拟购买办公场所，向南京软件园科技发展有限公司支付的 1,000 万元保证金，因购买计划取消，相关款项于 2025 年收回。

7、存货

（1）存货构成及变动情况

报告期各期末，公司存货账面余额构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	18,411.87	25.53%	13,857.06	21.42%	14,339.07	22.31%
周转材料	1,385.45	1.92%	1,348.28	2.08%	1,280.29	1.99%
委托加工物资	8,107.86	11.24%	7,601.89	11.75%	6,632.55	10.32%
在产品	4,089.78	5.67%	4,359.34	6.74%	4,644.98	7.23%
库存商品	36,348.12	50.41%	33,964.43	52.50%	34,572.09	53.79%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
半成品	956.21	1.33%	887.28	1.37%	810.53	1.26%
发出商品	2,806.10	3.89%	2,677.71	4.14%	1,995.37	3.10%
合计	**72,105.38**	**100.00%**	**64,695.99**	**100.00%**	**64,274.88**	**100.00%**
减：存货跌价准备	7,858.05	-	8,592.13	-	6,379.25	-
账面价值合计	**64,247.33**	**-**	**56,103.86**	**-**	**57,895.63**	**-**

公司采用 Fabless 与 IDM 并行的模式开展业务。在 Fabless 模式下，公司将部分类别、型号的芯片制造、封装测试环节委托给专业代工厂商完成。在 IDM 模式下，公司自主完成部分类别、型号的芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端销售与服务等产业环节。

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 57,895.63 万元、56,103.86 万元和 64,247.33 万元。公司存货主要由库存商品、委托加工物资、原材料、在产品构成等。

库存商品为生产完工的产成品，如分立器件、晶圆等；委托加工物资为正在供应商处进行封装测试的芯片或晶圆；原材料主要为硅片、封测材料、原材料晶圆等；发出商品主要为寄售模式下，已发往寄售客户仓库尚未实现销售的芯片成品，以及在途商品；在产品为各期末尚在生产过程中的中间产品；周转材料为生产辅料、备品备件等价值较低的存货。

（2）存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		
	账面余额	跌价准备	计提比例
原材料	18,411.87	2,138.09	11.61%
周转材料	1,385.45	13.40	0.97%
委托加工物资	8,107.86	1,008.84	12.44%
在产品	4,089.78	52.87	1.29%
库存商品	36,348.12	4,342.44	11.95%
半成品	956.21	184.20	19.26%

发出商品	2,806.10	118.21	4.21%
合计	**72,105.38**	**7,858.05**	**10.90%**
项目	**2024.12.31**		
	账面余额	**跌价准备**	**计提比例**
原材料	13,857.06	1,406.94	10.15%
周转材料	1,348.28	18.11	1.34%
委托加工物资	7,601.89	624.22	8.21%
在产品	4,359.34	72.96	1.67%
库存商品	33,964.43	6,140.06	18.08%
半成品	887.28	167.74	18.91%
发出商品	2,677.71	162.09	6.05%
合计	**64,695.99**	**8,592.13**	**13.28%**
项目	**2023.12.31**		
	账面余额	**跌价准备**	**计提比例**
原材料	14,339.07	1,094.03	7.63%
周转材料	1,280.29	11.12	0.87%
委托加工物资	6,632.55	785.36	11.84%
在产品	4,644.98	141.44	3.05%
库存商品	34,572.09	4,214.28	12.19%
半成品	810.53	89.86	11.09%
发出商品	1,995.37	43.15	2.16%
合计	**64,274.88**	**6,379.25**	**9.92%**

公司已根据企业会计准则及公司实际情况，制订了谨慎的存货跌价计提政策。公司于每个资产负债表日对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备，计入资产减值损失。

报告期各期末，存货跌价准备分别为 6,379.25 万元、8,592.13 万元和 7,858.05 万元，主要由库存商品和委托加工物资的跌价准备构成。报告期各期末，公司的存货跌价准备计提比例分别为 9.92%、13.28%和 10.90%。

公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司比较情况如下：

公司简称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
扬杰科技	5.02%	5.07%	6.07%
士兰微	9.62%	8.20%	5.81%

公司简称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
新洁能	11.25%	14.95%	7.81%
捷捷微电	5.14%	4.12%	4.74%
平均值	**7.76%**	**8.09%**	**6.11%**
发行人	**10.90%**	**13.28%**	**9.92%**

注：数据来源同行业上市公司公开资料。

报告期各期末，公司存货跌价计提政策较为谨慎，整体计提比例高于同行业可比公司平均值，公司存货跌价准备计提充分。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
增值税留抵税额	1,637.53	1,338.34	106.13
预缴企业所得税	0.88	-	52.81
其他	148.01	149.18	151.86
合计	**1,786.42**	**1,487.51**	**310.79**

报告期各期末，公司其他流动资产账面价值分别为 310.79 万元、1,487.51 万元和 1,786.42 万元，占流动资产的比例分别为 0.16%、0.70%和 0.79%，占比较小，主要为增值税留抵税额。

（三）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	-	-	-	-	1,112.12	0.55%
固定资产	113,917.48	49.35%	110,701.11	48.40%	59,692.48	29.27%
在建工程	8,184.66	3.55%	6,502.66	2.84%	26,260.37	12.88%
使用权资产	3,679.15	1.59%	4,812.37	2.10%	5,622.56	2.76%
无形资产	14,223.94	6.16%	16,086.82	7.03%	18,009.27	8.83%
商誉	82,666.75	35.81%	82,666.75	36.14%	82,666.75	40.54%
长期待摊费用	4,427.44	1.92%	3,867.85	1.69%	6,375.19	3.13%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	3,071.15	1.33%	3,144.14	1.37%	2,754.95	1.35%
其他非流动资产	663.05	0.29%	940.94	0.41%	1,438.36	0.71%
合计	**230,833.62**	**100.00%**	**228,722.65**	**100.00%**	**203,932.04**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，合计占非流动资产比例分别为 91.52%、94.42%和 94.87%。公司非流动资产具体情况如下：

1、长期股权投资

2023 年末，公司长期股权投资金额为 1,112.12 万元，系公司持有的长芯检测 50.00%股权。2024 年 9 月，公司以 1,000 万元对价收购芯德半导体持有的长芯检测 50.00%股权。收购完成后，公司持有长芯检测 100%股权，公司持有的长芯检测纳入合并报表范围，原长期股权投资终止确认，不再作为对外投资列报。报告期内，公司对长芯检测的长期股权投资不存在减值迹象，未计提减值准备。

2、固定资产

（1）固定资产构成及变动情况

报告期各期末，公司固定资产账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	40,690.29	35.72%	39,857.07	36.00%	2,892.04	4.84%
机器设备	72,215.41	63.39%	69,733.44	62.99%	55,760.72	93.41%
运输设备	402.48	0.35%	499.17	0.45%	485.22	0.81%
办公及其他设备	609.29	0.53%	611.43	0.55%	554.51	0.93%
账面价值合计	**113,917.48**	**100.00%**	**110,701.11**	**100.00%**	**59,692.48**	**100.00%**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 59,692.48 万元、110,701.11 万元和 113,917.48 万元，占公司非流动资产的比例分别为 29.27%、48.40%和 49.35%，金额及占比较大，主要系公司采用 Fabless 与 IDM 并行的模式开展业务，自有晶圆制造及封测产能所需的机器设备、厂房等固定资产投入金额较大。2024 年末，公司固定资产较 2023 年末增加 51,008.63 万元，主要系公司子公司长晶浦

联自建的厂房完工，由在建工程转入固定资产所致。

（2）固定资产折旧及减值准备计提情况

报告期各期末，公司固定资产折旧计提情况如下：

单位：万元

2025.12.31					
项目	**账面原值**	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	45,791.63	5,101.34	-	40,690.29	88.86%
机器设备	109,582.92	37,367.51	-	72,215.41	65.90%
运输设备	1,341.16	938.68	-	402.48	30.01%
办公及其他设备	1,535.45	926.16	-	609.29	39.68%
合计	**158,251.17**	**44,333.69**	**-**	**113,917.48**	**71.99%**
2024.12.31					
项目	**账面原值**	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	42,893.90	3,036.83	-	39,857.07	92.92%
机器设备	95,776.89	26,043.45	-	69,733.44	72.81%
运输设备	1,311.09	811.92	-	499.17	38.07%
办公及其他设备	1,339.83	728.41	-	611.43	45.63%
合计	**141,321.71**	**30,620.60**	**-**	**110,701.11**	**78.33%**
2023.12.31					
项目	**账面原值**	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	5,157.56	2,265.52	-	2,892.04	56.07%
机器设备	72,568.55	16,807.83	-	55,760.72	76.84%
运输设备	1,169.33	684.11	-	485.22	41.50%
办公及其他设备	1,123.06	568.55	-	554.51	49.37%
合计	**80,018.50**	**20,326.01**	**-**	**59,692.48**	**74.60%**

2025 年度，公司对未来预计无法使用的机器设备计提减值准备 274.66 万元并报废。除前述计提减值准备情形外，报告期各期末，公司固定资产状况整体良好，不存在减值迹象，除上述减值准备外，报告期内未计提减值准备。

（3）固定资产折旧政策与同行业可比公司比较情况

报告期内，公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：

公司简称/账龄	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他

公司简称/账龄	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他
扬杰科技	10-20 年	3-10 年	4 年	3-5 年
士兰微	30-35 年	5-10 年	5 年	5-10 年
新洁能	20 年	10 年	4 年	3-5 年
捷捷微电	20 年	3-10 年	4-5 年	5-10 年
可比公司折旧年限范围	**10-35 年**	**3-10 年**	**4-5 年**	**3-10 年**
发行人	**5-20 年**	**5-10 年**	**4-8 年**	**3-8 年**

注：公司固定资产类别与可比公司财务报告披露口径存在一定差异，上表按照统一口径披露，对应关系为：①扬杰科技、士兰微机器设备折旧年限为其财务报告披露专用设备的折旧年限，办公设备及其他折旧年限为其财务报告披露通用设备的折旧年限；②新洁能办公设备及其他折旧年限为其财务报告披露电子及其他设备、工具的折旧年限。

公司房屋及建筑物包含房产及车间装修，其中，房产的折旧年限为 20 年，与可比公司不存在差异。

综上，公司固定资产折旧政策与同行业可比公司对比不存在显著差异。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
建筑工程	90.59	253.67	20,524.38
机器设备	7,890.94	6,217.86	5,704.85
装修工程	203.13	31.13	31.13
合计	**8,184.66**	**6,502.66**	**26,260.37**

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 26,260.37 万元、6,502.66 万元和 8,184.66 万元，占非流动资产的比例分别为 12.88%、2.84%和 3.55%，主要系公司为深化 IDM 模式，增加对子公司长晶浦联“年产 200 亿颗新型元器件项目”，以及子公司新顺微“工业、汽车、新能源用快恢复二极管芯片产业化技改项目”、“新型功率器件芯片产业升级智能化数字化技术改造”、“6 英寸硅基半导体芯片技改项目”等项目的投入，以提升公司的封测和晶圆制造产能。

报告期内，公司主要在建工程项目变动情况如下：

单位：万元

2025.12.31					
项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产金额	本期其他减少	期末余额

				金额	
年产 200 亿颗新型元器件项目	2,880.61	11,140.09	8,502.25	233.72	5,284.73
工业、汽车、新能源用快恢复二极管芯片产业化技改项目	2,295.58	93.81	1,831.86	-	557.52
新型功率器件芯片产业升级智能化数字化技术改造	663.72	3,742.67	2,573.54	-	1,832.85
6 英寸硅基半导体芯片技改项目	17.39	-	17.39	-	-
合计	**5,857.29**	**14,976.56**	**12,925.04**	**233.72**	**7,675.10**
2024.12.31					
项目	**期初余额**	**本期增加**	**本期转入固定资产金额**	**本期其他减少金额**	**期末余额**
年产 200 亿颗新型元器件项目	22,733.68	25,913.25	45,766.33	-	2,880.61
工业、汽车、新能源用快恢复二极管芯片产业化技改项目	-	2,543.36	247.79	-	2,295.58
新型功率器件芯片产业升级智能化数字化技术改造	-	663.72	-	-	663.72
6 英寸硅基半导体芯片技改项目	1,928.40	2,608.19	4,519.20	-	17.39
合计	**24,662.08**	**31,728.52**	**50,533.32**	**-**	**5,857.29**
2023.12.31					
项目	**期初余额**	**本期增加**	**本期转入固定资产金额**	**本期其他减少金额**	**期末余额**
年产 200 亿颗新型元器件项目	7,301.79	16,269.06	837.18	-	22,733.68
6 英寸硅基半导体芯片技改项目	474.92	5,719.49	4,266.01	-	1,928.40
合计	**7,776.72**	**21,988.56**	**5,103.19**	**-**	**24,662.08**

2023 年末，公司在建工程金额较高，主要系子公司长晶浦联年产 200 亿颗封测项目尚未达到可使用状态的厂房及设备。2024 年，该项目主体厂房完工，当期由在建工程转入固定资产，因此，当年末在建工程余额下降。“年产 200 亿颗新型元器件项目”存在 233.72 万元其他减少，系公司将完工的绿化部分转入长期待摊费用。

报告期各期末，公司在建工程状态良好，公司未计提在建工程减值准备。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 5,622.56 万元、4,812.37 万元和 3,679.15 万元，占非流动资产的比例分别为 2.76%、2.10%和 1.59%。

5、无形资产

（1）无形资产构成情况

报告期各期末，公司无形资产账面价值构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
专利权	5,649.39	39.72%	6,553.29	40.74%	7,457.19	41.41%
客户关系	3,916.26	27.53%	4,834.06	30.05%	5,751.86	31.94%
土地使用权	3,658.99	25.72%	3,742.96	23.27%	3,826.93	21.25%
软件	999.31	7.03%	956.52	5.95%	973.29	5.40%
账面价值合计	**14,223.94**	**100.00%**	**16,086.82**	**100.00%**	**18,009.27**	**100.00%**

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 18,009.27 万元、16,086.82 万元和 14,223.94 万元，占公司非流动资产的比例分别为 8.83%、7.03%和 6.16%。

公司无形资产主要为专利权和客户关系，系非同一控制下收购深圳长晶 100%股权、新申弘达 100%股权以及新顺微控股权形成。根据非同一控制下会计准则要求，公司聘请第三方专业机构对被收购主体的资产进行了辨认及评估，其中，2018 年 12 月，公司收购深圳长晶及新申弘达形成客户关系 5,600.00 万元，2022 年 3 月，公司收购新顺微形成客户关系 3,900.00 万元、专利 9,400.00 万元。

深圳长晶、新申弘达（2020 年 11 月注销，相关资产纳入公司）主要从事分立器件销售业务，新顺微主要从事晶圆制造及销售业务，分立器件、晶圆产品导入终端客户通常需要较长的验证周期，因此，品牌厂家与下游客户的关系较为紧密，客户粘性较强。前述非同一控制下收购完成后，原有客户关系均保留至相关主体，公司依据评估结果确认客户关系，具有合理性。

此外，新顺微持有的多项专利已应用于其主要生产环节，可确保企业在较长时期内获得稳定收益且能够核算价值，公司依据评估结果确认专利权无形资产，具有合理性。

（2）无形资产摊销及减值准备计提情况

报告期各期末，公司无形资产摊销及减值准备计提情况如下：

单位：万元

2025.12.31				
项目	**账面原值**	**累计摊销**	**减值准备**	**账面价值**
客户关系	9,500.00	5,285.90	297.84	3,916.26
专利权	9,400.00	3,416.70	333.91	5,649.39
土地使用权	4,024.77	365.78	-	3,658.99
软件	2,154.35	1,155.04	-	999.31
合计	**25,079.12**	**10,223.42**	**631.75**	**14,223.94**
2024.12.31				
客户关系	9,500.00	4,368.10	297.84	4,834.06
专利权	9,400.00	2,512.80	333.91	6,553.29
土地使用权	4,024.77	281.81	-	3,742.96
软件	1,931.47	974.95	-	956.52
合计	**24,856.24**	**8,137.67**	**631.75**	**16,086.82**
2023.12.31				
客户关系	9,500.00	3,450.30	297.84	5,751.86
专利权	9,400.00	1,608.90	333.91	7,457.19
土地使用权	4,024.77	197.84	-	3,826.93
软件	1,775.65	802.36	-	973.29
合计	**24,700.42**	**6,059.40**	**631.75**	**18,009.27**

在 2022 年末的无形资产减值测试中，公司考虑期后业绩实现情况及发展趋势，采取审慎假设对无形资产进行了减值测试，于 2022 年末对收购新顺微控股权产生的专利权和客户关系分别计提减值准备 333.91 万元和 297.84 万元。

报告期各期末，公司对无形资产进行减值测试，以无形资产产生的预计未来现金流量现值确定无形资产的可收回金额。除上述计提减值准备情形外，报告期各期末，公司无形资产状况良好，不存在减值迹象，除上述减值准备外，报告期内未计提减值准备。

6、商誉

（1）商誉的形成及变动分析

报告期各期末，公司商誉的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
账面原值：			
收购新顺微控股权	71,723.74	71,723.74	71,723.74
收购深圳长晶 100%股权及新申弘达 100%股权	20,457.02	20,457.02	20,457.02
收购海德半导体 100%股权	64.54	64.54	64.54
账面原值合计	**92,245.29**	**92,245.29**	**92,245.29**
减值准备：			
收购新顺微控股权	9,578.54	9,578.54	9,578.54
账面价值合计	**82,666.75**	**82,666.75**	**82,666.75**

报告期各期末，公司商誉账面价值均为 82,666.75 万元，占非流动资产的比例分别为 40.54%、36.14%和 35.81%。公司商誉系非同一控制企业合并下，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，具体情况如下：

①收购新顺微控股权：2022 年 1 月，江阴澄芯、璟升股权、江阴澄顺、盈进智能、冯东明和闻勤新顺将持有的合计新顺微 15.39%的股权转让给公司及其子公司长芯顺联；2022 年 3 月，南京顺芯及华杉瑞联基金管理有限公司将其持有的南京芯联合计 70.00%的实缴合伙份额转让给子公司长芯顺联。本次股权转让后，长晶科技持有新顺微 67.11%的直接或间接股权，合并成本为 122,767.09 万元，与资产组的可辨认净资产公允价值份额 51,043.35 万元之间的差额确认商誉 71,723.74 万元。

②收购深圳长晶 100%股权及新申弘达 100%股权：2018 年 12 月，长电科技剥离深圳长晶及本部分立器件自销业务相关资产组，将深圳长晶 80.67%股权及新申弘达 100%股权出售给长晶科技，同时杨国江等 9 名自然人将其所持深圳长晶 19.33%股权转让给长晶科技。合并成本为 30,000.00 万元，与资产组的可辨认净资产公允价值份额 9,542.98 万元之间的差额确认商誉 20,457.02 万元。

③收购海德半导体 100%股权：2020 年 10 月，长晶科技收购海德半导体 100%股权，合并成本为 3,643.78 万元，与资产组的可辨认净资产公允价值份额 3,579.24 万元之间的差额确认商誉 64.54 万元。

（2）商誉减值测试

在 2022 年末商誉减值测试中，公司考虑期后业绩实现情况及发展趋势，采取审慎假设对商誉进行了减值测试，于 2022 年末对收购新顺微控股权产生的商誉计提减值准备 9,578.54 万元。

报告期各期末，公司对商誉进行减值测试，以公司管理层批准的财务预算为基准计算出的预计未来现金流量现值确定资产组的可收回金额，并聘请了中联评估对收购新顺微控制权、深圳长晶 100%股权及新申弘达 100%股权相关资产组截至报告期各期末的可回收金额进行了评估。

经减值测试，报告期各期末，公司上述收购的资产组可回收金额均高于其账面价值，商誉不存在减值迹象，除上述减值准备外，报告期内，公司未计提减值准备。

7、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
固定资产装修支出	4,152.89	3,794.39	6,261.00
其他	274.55	73.46	114.18
合计	**4,427.44**	**3,867.85**	**6,375.19**

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 6,375.19 万元、3,867.85 万元和 4,427.44 万元，占公司非流动资产的比例分别为 3.13%、1.69%和 1.92%，主要为公司租赁生产办公场所的装修费用。2024 年末，公司长期待摊费用较 2023 年末减少 2,507.34 万元，主要系 2024 年子公司长晶浦联自建厂房完工，不再向第三方租赁厂房，公司将未摊销完成的装修费用一次性确认为管理费用。

8、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
资产减值损失	2,090.42	2,322.62	1,830.82
内部交易未实现利润	747.76	624.25	750.18
租赁负债	630.45	839.57	863.56

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
递延收益	164.45	119.40	104.16
折旧与摊销	56.60	52.06	22.24
可抵扣亏损	-	3.15	-
未经抵消的递延所得税资产合计	**3,689.67**	**3,961.05**	**3,570.95**
递延所得税资产和负债互抵金额	618.52	816.91	815.99
递延所得税资产金额	**3,071.15**	**3,144.14**	**2,754.95**

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 2,754.95 万元、3,144.14 万元和 3,071.15 万元，占公司非流动资产的比例分别为 1.35%、1.37%和 1.33%，金额和占比均较小，主要为资产减值准备、内部交易未实现利润、租赁负债等形成的可抵扣暂时性差异。

9、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 1,438.36 万元、940.94 万元和 663.05 万元，占公司非流动资产的比例分别为 0.71%、0.41%和 0.29%，金额和占比均较小，均为预付的长期资产款。

八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债结构总体分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	118,909.70	52.18%	121,664.33	53.50%	91,607.96	44.06%
非流动负债	108,971.00	47.82%	105,759.19	46.50%	116,288.19	55.94%
合计	**227,880.69**	**100.00%**	**227,423.53**	**100.00%**	**207,896.16**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 207,896.16 万元、227,423.53 万元和 227,880.69 万元，其中流动负债占比分别为 44.06%、53.50%和 52.18%。2023 年末，公司流动负债金额小于非流动负债金额，主要系公司向银行借款 74,470.00 万元用于新顺微股权收购事项，截至 2023 年末长期借款金额较高所致。2024 年末和 2025 年末，公司业务规模扩大，应付账款余额及其他流动负债金额增加，

期末流动负债金额高于非流动负债。

（二）流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债及构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	12,196.85	10.26%	11,425.44	9.39%	5,805.45	6.34%
应付票据	2,681.31	2.25%	8,352.52	6.87%	9,383.05	10.24%
应付账款	67,022.10	56.36%	63,867.37	52.49%	46,389.48	50.64%
合同负债	488.72	0.41%	849.75	0.70%	578.35	0.63%
应付职工薪酬	7,719.27	6.49%	6,860.84	5.64%	5,825.12	6.36%
应交税费	1,599.99	1.35%	3,216.35	2.64%	2,313.42	2.53%
其他应付款	800.57	0.67%	973.30	0.80%	690.73	0.75%
一年内到期的非流动负债	10,359.15	8.71%	9,411.13	7.74%	10,002.12	10.92%
其他流动负债	16,041.74	13.49%	16,707.63	13.73%	10,620.25	11.59%
总计	**118,909.70**	**100.00%**	**121,664.33**	**100.00%**	**91,607.96**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动负债主要由应付账款、其他流动负债、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他应付款、应付票据等构成，上述各项目合计占流动负债的比例分别为 90.48%、91.02%和 91.75%。

报告期各期末，公司流动负债变动情况如下：

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
信用借款	9,006.25	11,008.77	5,805.45
票据贴现未到期	3,190.61	416.67	-
合计	**12,196.85**	**11,425.44**	**5,805.45**

报告期各期末，公司的短期借款分别为 5,805.45 万元、11,425.44 万元和 12,196.85 万元，短期借款期末余额中不存在逾期借款。公司主要通过信用借款的方式获得银行短期信贷，用于补充流动性。报告期内，公司经营性现金流较好，

短期借款金额较小。

2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	2,681.31	8,352.52	9,383.05
合计	**2,681.31**	**8,352.52**	**9,383.05**

报告期各期末，公司应付票据主要内容为银行承兑汇票，应付票据余额分别为 9,383.05 万元、8,352.52 万元和 2,681.31 万元。报告期内，公司根据自身资金安排及合同要求，适当使用票据结算，以提高资金使用效率。报告期各期末，公司不存在已到期未支付的应付票据。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应付材料款及加工费	45,447.86	40,042.31	31,079.08
应付费用款项	1,381.46	1,243.03	1,833.33
应付长期资产款项	20,192.77	22,582.03	13,477.07
合计	**67,022.10**	**63,867.37**	**46,389.48**

报告期内，公司应付供应商货款主要为应付晶圆、封装测试服务等的应付材料款及加工费。报告期各期末，公司应付账款余额分别为 46,389.48 万元、63,867.37 万元和 67,022.10 万元。公司应付账款增长较快，主要系公司销售规模不断增长，对晶圆及封装测试服务等的采购规模也随之增长，期末应付供应商采购款相应增加。同时，为持续扩大自有晶圆制造、封测产能，长晶浦联、新顺微等子公司增加生产设备采购，应付长期资产款项增加，导致应付账款余额增加。

4、合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
预收货款	488.72	849.75	578.35

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合计	**488.72**	**849.75**	**578.35**

报告期各期末，公司合同负债分别为 578.35 万元、849.75 万元和 488.72 万元，均为预收销售货款。

5、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
短期薪酬	7,716.01	6,857.34	5,813.96
离职后福利-设定提存计划	3.26	3.50	1.76
辞退福利	-	-	9.40
合计	**7,719.27**	**6,860.84**	**5,825.12**

公司应付职工薪酬主要为年末已计提尚未实际发放的短期薪酬。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 5,825.12 万元、6,860.84 万元和 7,719.27 万元，呈增长趋势，主要系公司经营规模逐渐扩大，员工人数增加所致。报告期各期末，公司员工人数分别为 1,590 人、1,767 人和 1,967 人，人员变动趋势与应付职工薪酬变动趋势相匹配。

6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
增值税	293.36	612.95	726.15
企业所得税	865.30	2,200.70	1,263.67
个人所得税	211.05	179.34	174.52
城市维护建设税	55.05	87.56	55.66
房产税	74.45	26.69	2.43
教育费附加	39.32	62.54	39.76
土地使用税	13.18	13.18	13.18
印花税	48.12	30.08	29.18
其他税费	0.16	3.31	8.89
合计	**1,599.99**	**3,216.35**	**2,313.42**

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 2,313.42 万元、3,216.35 万元和 1,599.99 万元，占各期末流动负债的比例分别为 2.53%、2.64%和 1.35%，主要系应交的增值税和企业所得税。

7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证金及押金	41.63	35.12	30.58
费用款项	758.94	938.18	660.14
合计	**800.57**	**973.30**	**690.73**

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 690.73 万元、973.30 万元和 800.57 万元，占各期末流动负债的比例分别为 0.75%、0.80%和 0.67%，主要系期末尚未支付的员工报销款、企业经营费用等。

8、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一年内到期的长期借款	8,065.39	7,776.58	8,370.95
一年内到期的租赁负债	1,393.75	1,634.55	1,631.18
一年内到期的其他非流动负债	900.00	-	-
合计	**10,359.15**	**9,411.13**	**10,002.12**

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 10,002.12 万元、9,411.13 万元和 10,359.15 万元，主要包括一年内到期的租赁负债和一年内到期的长期借款。因公司对子公司长晶浦联少数股东出资具有远期回购及利息支付义务，形成 2025 年末一年内到期的其他非流动负债，系一年以内需支付的利息。

9、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
已背书未终止确认的应收票据对应的货款	16,000.67	16,623.72	10,571.39
预收款项对应的销项税	41.07	83.91	48.86
合计	**16,041.74**	**16,707.63**	**10,620.25**

报告期各期末，公司其他流动负债分别为 10,620.25 万元、16,707.63 万元和 16,041.74 万元，占各期末流动负债的比例分别为 11.59%、13.73%和 13.49%，主要为已背书未终止确认的应收票据对应的货款。

（三）非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债及构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	63,455.72	58.23%	57,583.60	54.45%	65,198.00	56.07%
租赁负债	2,656.05	2.44%	3,802.13	3.60%	4,585.74	3.94%
递延收益	9,438.18	8.66%	10,322.45	9.76%	12,885.00	11.08%
递延所得税负债	1,978.85	1.82%	2,222.26	2.10%	2,297.35	1.98%
其他非流动负债	31,442.20	28.85%	31,828.76	30.10%	31,322.10	26.93%
总计	**108,971.00**	**100.00%**	**105,759.19**	**100.00%**	**116,288.19**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为 116,288.19 万元、105,759.19 万元和 108,971.00 万元，由长期借款、租赁负债、递延收益和递延所得税负债构成。

报告期各期末，公司非流动负债变动情况如下：

1、长期借款

报告期各期末，公司长期借款情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
质押借款	42,500.00	-	-
抵押借款	12,955.72	10,083.60	4,055.00
保证借款	-	-	61,143.00
信用借款	8,000.00	47,500.00	-
合计	**63,455.72**	**57,583.60**	**65,198.00**

报告期各期末，公司的长期借款余额分别为 65,198.00 万元、57,583.60 万元和 63,455.72 万元，主要系公司用于新顺微股权收购等事宜相关并购借款。

2、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 4,585.74 万元、3,802.13 万元和 2,656.05 万元，占各期末非流动负债总额的比例分别为 3.94%、3.60%和 2.44%，主要系根据租赁会计准则，对公司作为承租人的租赁行为确认使用权资产和租赁负债。

3、递延收益

报告期各期末，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2025 年度				
政府补助	10,322.45	405.86	1,290.13	9,438.18
2024 年度				
政府补助	12,885.00	102.10	2,664.65	10,322.45
2023 年度				
政府补助	10,260.30	3,876.72	1,252.01	12,885.00

报告期各期末，公司递延收益分别为 12,885.00 万元、10,322.45 万元和 9,438.18 万元。公司递延收益主要为与资产相关的政府补助。

4、递延所得税负债

报告期各期末，递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
非同一控制企业合并可辨认资产公允价值增值	1,723.18	2,009.17	2,297.35
使用权资产	590.73	768.18	783.07
固定资产加速折旧	283.45	261.83	32.93
小计	**2,597.37**	**3,039.18**	**3,113.35**
递延所得税资产和负债互抵金额	618.52	816.91	815.99
合计	**1,978.85**	**2,222.26**	**2,297.35**

报告期各期末，公司递延所得税负债金额分别为 2,297.35 万元、2,222.26 万元和 1,978.85 万元，主要系非同一控制企业合并可辨认资产公允价值增值导致的应纳税暂时性差异。

5、其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债金额分别为 31,322.10 万元、31,828.76 万元和 31,442.20 万元，主要系公司对子公司长晶浦联少数股东出资股权回购义务形成的负债及利息。

根据公司与南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）签订的投资协议，双方共同出资组建江苏长晶浦联功率半导体有限公司，其中公司出资 7 亿元，占比 70.00%，产业基金出资 3 亿元，占比 30.00%。

公司拥有长晶浦联全部的表决权和利润分配权，产业基金放弃全部表决权和利润分配权。若产业基金资金到位之日起 4 年内，公司或其指定的第三方未能回购投资方所占股权，自第 5 年起，由公司或其指定的第三方按照银行同期贷款基准利率支付利息（单利）直至完成全部股份回购；若产业基金资金全部到位之日起 9 年内公司或其指定的第三方仍未完成回购的，产业基金有权选择继续持有公司股权并享有股东的全部权利（包括但不限于恢复行使股东表决权和按照实缴出资比例分配公司利润）。

因此，报告期内公司将该笔投资款及应付利息作为其他非流动负债进行核算和列报。

（四）偿债能力分析

1、公司偿债能力指标分析

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
流动比率（倍）	1.89	1.75	2.06
速动比率（倍）	1.35	1.29	1.43
资产负债率（母公司）	42.25%	47.60%	37.14%
资产负债率（合并）	50.00%	51.50%	52.93%

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	62,471.77	49,070.65	37,297.22
利息保障倍数（倍）	14.74	9.34	6.01

注 1：流动比率=流动资产/流动负债
注 2：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
注 3：资产负债率=负债总额/资产总额
注 4：息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息费用+折旧+摊销
注 5：利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息支出

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.06 倍、1.75 倍和 1.89 倍，速动比率分别为 1.43 倍、1.29 倍和 1.35 倍，短期偿债能力良好。2024 年末，公司流动比率和速动比率相对较低，主要系期末应付账款金额及其他流动负债金额增加，导致流动负债金额相对较高所致。

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 52.93%、51.50%和 50.00%，整体呈下降趋势，公司偿债能力良好。

报告期内，公司经营状况良好，息税折旧摊销前利润分别为 37,297.22 万元、49,070.65 万元和 62,471.77 万元，利息保障倍数分别为 6.01 倍、9.34 倍和 14.74 倍，整体呈增长趋势，公司偿债能力较强。

2、与同行业可比公司偿债能力指标的对比情况

指标	证券代码	公司简称	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	300373.SZ	扬杰科技	1.48	2.01	2.42
	600460.SH	士兰微	1.92	1.86	2.39
	605111.SH	新洁能	10.49	9.20	6.53
	300623.SZ	捷捷微电	1.27	1.85	1.57
	平均值		**3.79**	**3.73**	**3.23**
	平均值（剔除新洁能影响）		**1.56**	**1.90**	**2.13**
	发行人		**1.89**	**1.75**	**2.06**
速动比率（倍）	300373.SZ	扬杰科技	1.16	1.69	2.00
	600460.SH	士兰微	1.37	1.32	1.73
	605111.SH	新洁能	9.68	8.41	5.71
	300623.SZ	捷捷微电	0.91	1.42	1.23
	平均值		**3.28**	**3.21**	**2.67**

指标	证券代码	公司简称	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日	2023年度/2023年12月31日
	平均值（剔除新洁能影响）		**1.14**	**1.47**	**1.65**
	发行人		**1.35**	**1.29**	**1.43**
资产负债率（合并）	300373.SZ	扬杰科技	40.70%	35.80%	31.21%
	600460.SH	士兰微	52.10%	44.25%	43.87%
	605111.SH	新洁能	9.56%	10.34%	14.03%
	300623.SZ	捷捷微电	26.96%	25.96%	43.07%
	平均值		**32.33%**	**29.09%**	**33.04%**
	平均值（剔除新洁能影响）		**39.92%**	**35.34%**	**39.38%**
	发行人		**50.00%**	**51.50%**	**52.93%**

注 1：数据来源同行业上市公司公开资料，下同；

注 2：新洁能于 2020 年发行上市，上市当年通过发行股份募集资金，货币资金大幅增长，导致其偿债能力指标与同行业其他可比公司存在较大差异。为增加可比性，计算行业平均值剔除新洁能的影响。

由上表可见，报告期内，公司流动比率、速动比率与剔除新洁能影响后的同行业可比公司平均值同一水平，变动趋势基本一致。

3、可预见的未来需偿还的负债金额及利息金额

公司未来需要偿还的负债主要为银行借款等金融负债以及应付账款、应付职工薪酬、租赁负债等经营性负债。报告期内，公司的经营和资产状况良好，主营业务收入整体呈上升趋势，盈利能力及现金流情况良好，偿债能力较强，不存在重大偿债风险，主要体现在以下几个方面：（1）公司可预见的未来需偿还的一年内到期的银行借款余额为 20,262.25 万元，还款压力较小；（2）报告期各期末公司货币资金余额分别为 35,839.66 万元、52,778.17 万元和 51,365.86 万元，为公司的生产经营及债务清偿提供了良好的现金保障；（3）截至报告期末，公司不存在或有负债、大额诉讼或者对外担保等影响偿债能力的情况；（4）公司同银行建立了良好的合作关系。

报告期内，公司营业收入和净利润持续保持良好的经营水平，偿债能力良好，不存在可预见的未来无法偿还负债的风险。

（五）资产周转能力分析

1、公司资产周转能力指标分析

报告期内，公司各期主要资产周转能力指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
应收账款周转率（次）	4.74	4.72	4.75
应收账款周转天数（天）	77.06	77.39	76.79
存货周转率（次）	3.00	2.91	2.38
存货周转天数（天）	121.79	125.58	153.62

注 1：应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款账面余额均值；应收账款周转天数=365/应收账款周转率；

注 2：存货周转率=营业成本/期初期末存货账面余额均值；存货周转天数=365/存货周转率

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.75 次、4.72 次和 4.74 次，相对较为稳定。

报告期各期，公司的存货周转率分别为 2.38 次、2.91 次和 3.00 次，呈增长趋势，公司存货周转情况良好。

2、与同行业可比公司资产周转指标的对比情况

指标	证券代码	公司简称	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次）	300373.SZ	扬杰科技	3.62	3.38	3.77
	600460.SH	士兰微	4.09	4.08	4.04
	605111.SH	新洁能	6.57	7.62	8.64
	300623.SZ	捷捷微电	4.70	4.88	4.42
	平均值		**4.75**	**4.99**	**5.22**
	发行人		**4.74**	**4.72**	**4.75**
存货周转率（次）	300373.SZ	扬杰科技	3.11	3.21	3.04
	600460.SH	士兰微	2.48	2.21	2.04
	605111.SH	新洁能	3.56	2.71	2.17
	300623.SZ	捷捷微电	3.55	3.20	2.71
	平均值		**3.18**	**2.83**	**2.49**
	发行人		**3.00**	**2.91**	**2.38**

报告期各期，公司应收账款周转率处于同行业可比公司区间内，2025 年度

与同行业公司平均值基本一致。报告期各期，公司与同行业可比公司存货周转率基本一致，处于同行业可比公司区间内。各期差异主要受产品种类、业务模式、客户类型等因素的综合影响，具有商业合理性。

（六）报告期股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（七）现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	233,784.15	197,315.13	150,823.72
经营活动现金流出小计	194,549.51	151,964.43	117,858.18
经营活动产生的现金流量净额	**39,234.64**	**45,350.70**	**32,965.54**
投资活动现金流入小计	1,551.51	211.18	309.25
投资活动现金流出小计	18,171.80	21,396.63	12,750.69
投资活动产生的现金流量净额	**-16,620.29**	**-21,185.46**	**-12,441.44**
筹资活动现金流入小计	43,094.41	73,178.96	14,834.32
筹资活动现金流出小计	64,471.47	79,919.41	27,592.99
筹资活动产生的现金流量净额	**-21,377.06**	**-6,740.45**	**-12,758.67**
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137.83	74.96	46.36
现金及现金等价物净增加额	**1,099.46**	**17,499.75**	**7,811.80**

1、经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	231,023.59	195,106.72	144,056.58
收到的税费返还	167.29	402.05	142.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,593.27	1,806.36	6,624.65
经营活动现金流入小计	**233,784.15**	**197,315.13**	**150,823.72**
购买商品、接受劳务支付的现金	122,786.95	91,600.18	65,793.05
支付给职工以及为职工	41,147.31	36,579.12	31,805.35

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
支付的现金			
支付的各项税费	18,798.18	13,187.64	13,364.22
支付其他与经营活动有关的现金	11,817.07	10,597.49	6,895.55
经营活动现金流出小计	**194,549.51**	**151,964.43**	**117,858.18**
经营活动产生的现金流量净额	**39,234.64**	**45,350.70**	**32,965.54**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 32,965.54 万元、45,350.70 万元和 39,234.64 万元。报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润差异的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
净利润	**34,900.73**	**24,230.82**	**16,700.14**
加：信用减值损失	-673.81	1,043.58	1,685.19
资产减值准备	3,999.81	5,685.43	5,033.62
固定资产折旧	14,062.90	10,421.69	9,001.16
使用权资产折旧	1,256.08	1,318.52	1,471.35
无形资产摊销	2,085.76	2,078.26	2,067.55
长期待摊费用摊销	1,318.75	3,038.99	1,290.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-5.30	-109.89	19.89
固定资产报废损失	-	-	-
财务费用	2,987.67	3,197.76	3,823.45
投资损失	-9.00	-267.08	-72.59
递延所得税资产减少	72.99	-389.18	-998.90
递延所得税负债增加	-243.41	-282.06	-296.46
存货的减少	-11,868.62	-3,717.99	4,765.85
经营性应收项目的减少	-11,841.58	-18,385.98	-27,903.42
经营性应付项目的增加	-457.31	12,681.63	14,816.38
其他	3,648.99	4,806.19	1,561.99
经营活动产生的现金流量净额	**39,234.64**	**45,350.70**	**32,965.54**

公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额，主要受到存货、固定资产折旧和经营性应收、应付项目（含应收票据、应付票据）变化的综合影响。

2、投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	1,123.39	-	-
取得投资收益收到的现金	9.00	175.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45.44	36.18	28.64
收到其他与投资活动有关的现金	373.68	-	280.61
投资活动现金流入小计	**1,551.51**	**211.18**	**309.25**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,486.39	20,623.15	12,750.69
投资支付的现金	1,685.41	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	773.48	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	**18,171.80**	**21,396.63**	**12,750.69**
投资活动产生的现金流量净额	**-16,620.29**	**-21,185.46**	**-12,441.44**

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,441.44 万元、-21,185.46 万元和-16,620.29 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	13,133.80	13.20	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13.80	13.20	-
取得借款收到的现金	26,770.00	72,749.00	13,555.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,190.61	416.76	1,279.32
筹资活动现金流入小计	**43,094.41**	**73,178.96**	**14,834.32**
偿还债务支付的现金	22,612.96	75,736.90	23,079.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,259.58	2,697.29	3,104.44
支付其他与筹资活动有关的现金	39,598.93	1,485.23	1,409.30
筹资活动现金流出小计	**64,471.47**	**79,919.41**	**27,592.99**
筹资活动产生的现金流量净额	**-21,377.06**	**-6,740.45**	**-12,758.67**

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-12,758.67 万元、-6,740.45 万元和-21,377.06 万元。2025 年度，公司支付其他与筹资活动有关的现金金额相对较高，主要系购买新顺微少数股权支出的现金。

（八）重大资本性支出计划及资金需求量

截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资项目外，公司无可预见的重大资本性支出计划。本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的影响，请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”的相关内容。

（九）流动性风险分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.06 倍、1.75 倍和 1.89 倍，速动比率分别为 1.43 倍、1.29 倍和 1.35 倍。各期末流动比率和速动比率指标良好，流动性风险相对较小。

针对流动性风险，公司已加强监控长短期资金需求及银行的授信管理，并针对销售收款和采购付款制定了健全的内控制度，以确保资金流动性情况良好。未来通过首次公开发行并上市，公司将借助资本市场力量进一步夯实资本，抗流动性风险能力得到进一步提升。

（十）持续经营能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 225,989.82 万元、267,765.34 万元和 298,523.51 万元，归母净利润分别为 15,341.71 万元、21,911.20 万元和 33,573.44 万元。公司经营情况良好，管理层对公司经营情况进行审慎评估后认为在可预见的未来，公司能够保持良好的持续盈利能力。

发行人是一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。同时，公司依托 IDM 模式，具备晶圆和封测的全产业链经营能力。

公司是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业，连续六年被评定为“中国半导体行业功率器件十强企业”，是国内分立器件行业具有代表性的企业。公司主要产品及市场占有率在行业细分市场具有领先地位：（1）公司是国内二三极管产品的市场领先企业，根据中国半导体行业协会的证明，2024 年，公司二三极管合计销售规模在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 2 名，处于国内龙头地位；（2）在 MOSFET 产品领域，公司近年来收入快速增长，打造了第二增长曲线，自主研发的 CSP MOSFET 产品经江苏省工信厅鉴定为国内领先、国际先进水平，系公司实现国产自主创新的代表性产品。根据中国半导体行业协会证明，2024 年，公司 CSP MOSFET 市场占有率在中国市场位于全行业第 3 名，中国大陆企业第 1 名。

未来，公司以“市场引领”和“研发驱动”为发展战略，努力锻造技术优势，稳步推进供应链整合，持续深耕及推动分立器件和电源管理 IC 等业务板块快速、稳健、可持续发展，在持续经营能力方面不存在重大不利变化或风险因素。

此外，公司已在本招股说明书“第三节风险因素”中披露公司未来所面临的主要风险，公司特别提醒投资者仔细阅读本招股说明书中的上述内容。

九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项

（一）重大资本性支出情况

报告期各期，随着公司经营规模的扩大，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 12,750.69 万元、20,623.15 万元和 16,486.39 万元。

公司的重大资本性支出主要围绕主营业务进行，有利于促进公司主营业务的发展和经营业绩的提升。

（二）重大资产业务重组或股权收购合并事项

具体内容请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人成立以来重要事件”。

十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（三）重大担保、诉讼事项

截至本招股说明书签署日，公司无重大担保、诉讼事项。

（四）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无需披露的其他重要事项。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用情况

（一）募集资金运用概况

1、总体情况

经发行人 2026 年第一次临时股东大会审议通过，发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过 5,000.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金扣除发行等费用后的净额，拟按照轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额	实施主体
1	年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目	68,149.10	68,149.10	长晶浦联
2	MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目	23,190.90	23,190.90	长晶科技
3	电源管理 IC 技术研发项目	20,700.00	20,700.00	长晶科技
4	补充流动资金项目	37,000.00	37,000.00	长晶科技
合计		**149,040.00**	**149,040.00**	**-**

上述项目实施后，公司不会新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。本次募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，通过自有或自筹资金对上述项目进行前期投入；本次募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定对相关募集资金进行使用。

2、投资项目履行的审批、核准或备案情况

公司本次公开发行股票募集资金均用于公司的主营业务，公司根据募集资金投资项目的实际情况分别履行了项目核准或备案、环境影响评价等程序，具体情况如下：

序号	项目名称	投资项目备案文件	环保部门批复

序号	项目名称	投资项目备案文件	环保部门批复
1	年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目	江苏省投资项目备案证（浦政服备〔2026〕22 号）	宁环（浦）建〔2026〕13 号
2	MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目	江苏省投资项目备案证（宁新区管审备〔2026〕538 号）	无需进行环境影响评价
3	电源管理 IC 技术研发项目	江苏省投资项目备案证（宁新区管审备〔2026〕561 号）	无需进行环境影响评价
4	补充流动资金	不涉及项目备案	无需进行环境影响评价

3、本次募集资金投资项目的合规情况

本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（二）募集资金使用管理制度

公司已根据相关法律法规建立了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储、使用和管理的内控制度，明确了募集资金原则上应当用于主营业务。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将严格按照证监会及深圳证券交易所的相关规定存储、使用和管理募集资金。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司分立器件、电源管理 IC 业务的技术水平和产品多样性，提升公司分立器件封测技术水平和产能规模，从而全面提升公司的综合竞争能力，有效支持公司未来的产品创新、行业拓展及战略发展。具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、募集资金具体运用情况”。

（四）募集资金用途的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本次募投项目主要分为三大类：1、产能构建类，“年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目”；2、技术研发类，“MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目”、“电源管理 IC 技术研发项目”；3、补充流动资金。

其中，“年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目”对应发行人业务环节中的分立器件及电源管理 IC 的封装测试。随着业务发展和规模增

长，发行人对分立器件和电源管理 IC 封测的需求也在同步增加。报告期内，发行人已完成在封测领域自有产能的布局，但目前的封测主要集中于二三极管，而对于 MOSFET、IGBT、电源管理 IC 产品的封测，仍然主要通过 Fabless 模式向外部第三方供应商进行采购。本次募投项目围绕长晶科技现有的业务模式和管理体系，由长晶浦联在现有产线基础上予以扩建、提升。本次募集资金到位后，将有利于公司进一步深化 IDM 业务体系，实现成本优化、产能补强、品质提升。

其中，“MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目”、“电源管理 IC 技术研发项目”是在发行人现有的产品、技术的框架内，对部分产品和技术进行针对性研发、补强。发行人是“中国半导体行业功率器件十强企业”、工信部的专精特新“小巨人”企业，具有成熟的研发团队、完备的研发体系和覆盖全主营产品门类的核心技术布局。截至 2025 年 12 月末，公司已取得了 244 项专利，其中发明专利 85 项，并取得了集成电路布图设计 130 项。公司具有必备技术和研发基础，可确保相关募投项目顺利实施。

其中，补充流动资金有利于公司降低财务费用，改善公司财务结构，增加公司运营资金，为公司持续快速发展提供有力支持。

综上，本次募集资金均围绕发行人主营业务开展投资，募集资金的用途和规模与公司现有的经营情况、技术水平、管理能力相适应。

二、未来发展与规划

（一）公司战略规划

公司作为一家半导体行业的专精特新“小巨人”企业，将持续聚焦于分立器件及其晶圆、电源管理 IC 的研发、生产及销售。

未来期间，公司将遵循国际主流分立器件与模拟集成电路产业发展路径，深化确立“平台化”、“一体化”战略发展宗旨，致力于通过全矩阵的产品布局与垂直整合的制造协同，在下游消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等国民经济发展的支柱产业链，全面实现客户对一站式、系统级产品及解决方案的采购诉求，提升公司产品在先进生产力领域的应用深度与广度。

公司将以市场需求为导向，持续扩充二极管、三极管、全系列 MOSFET、IGBT 及各类电源管理 IC 的产品规格与技术能力；稳步推动业务向新能源汽车、光伏

储能、工业自动化、机器人、人工智能等高附加值应用领域拓展；依托 IDM 模式垂直整合能力的持续优化，进一步统筹设计与制造关键技术环节、全产业链产能布局，加速新产品的迭代周期，优化整体成本结构，持续提升核心产品的综合性能及供应链安全性。

公司秉持“创造世界一流半导体品牌”的发展愿景，以“市场引领”和“研发驱动”为发展战略，努力锻造技术优势，稳步推进供应链整合，持续深耕及推动分立器件和电源管理 IC 等业务板块快速、稳健、可持续发展，向具备国际竞争力的功率与模拟半导体综合供应商稳步迈进。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

报告期内，公司紧密围绕发展愿景，遵循“平台化”、“一体化”的战略发展宗旨，以“市场引领”和“研发驱动”为发展战略，在技术创新、供应链整合、市场开拓、品质管控等方面开展了一系列卓有成效的工作，稳步推进公司战略落地，有效提升公司的综合竞争力。

1、坚持技术创新，全面提升产品竞争力

坚持技术持续创新是公司在功率半导体行业保持领先地位的根本保证。报告期内，公司持续引入国内外高端研发人员，扩充、优化了研发团队结构，持续巩固技术创新优势。经过快速发展与布局，公司在保持二极管、三极管等传统产品优势的基础上，自主研究开发了 MOSFET、IGBT、电源管理 IC 等高价值、高技术含量产品的核心技术，并对包括第三代半导体在内的新兴技术领域进行了前瞻性研究和产品布局。

公司的具体产品方面：

（1）分立器件领域，公司的二极管产品涵盖 SBD、FRD、TVS、ESD、Zener 等种类，性能达到国际主流水准；公司的三极管产品工艺技术成熟、质量可靠，具有高性价比，广泛应用于消费电子、工业电子和汽车电子等领域，市场占有率领先；公司的 MOSFET 产品品类丰富，涵盖 Trench MOSFET、CSP MOSFET、SGT MOSFET、SJ MOSFET 和 VDMOS 等各类结构，其中 Trench MOSFET 及 SGT MOSFET 产品相关性能指标达到行业主流水平，公司自主研发的 CSP MOSFET 产品经江苏省工业和信息化厅鉴定，总体处于国内领先、国际先进水

平；公司研发并推出的大功率 IGBT 单管及模块，部分产品性能可对标国际一线品牌最新代次产品，技术实力位居国内品牌前列。同时，公司积极布局第三代半导体产品领域，现已具备部分第三代半导体的供应能力。

（2）电源管理 IC 领域，公司已拥有线性稳压器（包括 LDO 和三端稳压 IC）、电压基准源、DC-DC 等产品线，通过架构创新和电路优化实现了高耐压、低静态功耗、高 PSRR、低噪声、快速瞬态响应等核心指标的提升，并取得了多项发明专利。公司通过持续的研发投入，加紧布局 DC-DC、DrMOS 等产品线，实现电源管理 IC 的性能升级，综合产品性能已达到国内主流水平。

（3）为契合车规级市场巨大的增量需求，公司组建了专业的汽车电子研发团队，现已完成二、三极管及小功率 MOSFET 等存量产品的车规化升级。同时，公司大力推进车规级大功率 MOSFET 和 IGBT 等新产品的研发和量产工作。此外，公司在车规级第三代半导体等产品领域也取得了阶段性研发成果。公司现有车规级产品已成功导入比亚迪、长城汽车、吉利汽车、小米等主流汽车厂商的供应体系，助力我国汽车电子行业的国产自主创新进程。

与此同时，公司还与电子科技大学等高校联合开展技术创新和前瞻性研究，增强技术积累储备。随着技术创新、产品开发的力度不断加大，公司各产品条线同步推进，为参与国际市场竞争提供有力保障。

2、整合供应链资源，深化 IDM 业务模式

供应链资源的整合对于公司的持续、稳定发展而言，是不可或缺的关键支撑。报告期内，公司采用 Fabless+IDM 的经营模式，充分发挥两种模式的优势。

报告期内，一方面，公司通过多种方式，与海内外主流的晶圆代工厂和封测厂建立并巩固良好的合作关系，基本确保了公司供应链的安全可控；同时为了满足公司日益增长的业务发展需求、客户对于成本及供货能力越来越高的要求，公司封测工厂长晶浦联新厂房顺利落成投产、海德工厂持续升级改造，并对晶圆厂新顺微工艺平台不断升级，整合产业链资源，优化产品结构，构建覆盖设计、制造和封测的一体化、自主可控的产业链。

3、直销与渠道业务并重，精耕细作细分市场

报告期内，公司大力推进直销能力建设，搭建并完善境内外业务集群布局，

下设深圳、上海、北京、香港等子公司、分公司和办事处，直接负责区域内重要客户的拓展与服务工作，并不断提升属地化的终端客户拓展和服务能力。同时，公司高度重视渠道销售体系的构建，经销商网络广泛覆盖了国内外主要区域与行业市场，公司为经销商提供培训、FAE 属地化支撑等支持，强化了公司的销售覆盖面能力，提升了公司的市场推广效率。

公司以抓住消费电子、工业电子、汽车电子以及新能源领域的行业头部客户为目标，凭借可靠的产品品质和优良的销售服务，获得了行业内客户的广泛认可，积累了优质的客户资源。

4、全面加强体系管控，确保一流品质输出

对于半导体企业而言，有效的体系管控与稳定的品质输出，是品牌和业务的基础与保证。报告期内，公司高度重视品质体系建设，从外部供应链管控和内部品质控制两方面入手，确保产品品质。

外部供应链管控方面，报告期内，公司一方面严格把控供应商审核准入，重点考察产品性能和质量稳定性两大核心要素，在全球范围内选择一流的供应商进行合作；同时加强对所有供应商的常态化审核，对于无法达到公司品质管控要求或存在重大质量隐患的供应商，及时予以剔除、清退。

内部品质控制方面，报告期内，公司不断完善审核流程，从来料检验、工艺控制、操作规程、质量数据保存与追溯等方面入手，不断反馈优化，持续改进完善；另一方面，以质量文化建设、质量知识培训与考核、质量 KPI 设置与优化为抓手，持续提升全员质量意识，增强质量管控软实力。

5、健全人才管理体系，优化提升组织能力

半导体行业是人才密集型行业，公司始终坚持以人为本，通过正确评价价值、合理分配价值，激励全体员工为公司可持续发展全力贡献智能并创造价值。

报告期内，公司科学统筹人力资源配置，着力培养战略性核心人才队伍，建立了以绩效优先为导向的价值分配机制。同时，公司根据业务需要不定期举行员工培训，为各级员工提供了市场化的薪资和完善的职业晋升通道，营造了积极进取的团队氛围，使人力资源配置更加合理，高素质人才队伍得到了扩充，为公司的可持续发展提供了坚实基础。

综上所述，公司通过上述多种措施，在“创造世界一流半导体品牌”的发展目标中稳健发展，现已在部分产品领域具备了一定话语权和国际竞争能力。

（三）未来规划采取的措施

未来，公司将继续聚焦主业，遵循“平台化”、“一体化”的战略发展宗旨，坚持以“市场引领”和“研发驱动”的发展战略，不断提升自身核心竞争力。

1、平台化：对标国际主流水准，提升产品矩阵广度

横向拓宽产品边界，构建全矩阵供应体系：公司将以市场需求为导向，持续丰富二极管、三极管、MOSFET、IGBT 及各类电源管理 IC 的产品规格与拓扑结构，实现从低压到高压、从小信号到大功率核心元器件的全面覆盖，稳步提升为客户提供系统级解决方案的综合配套能力，在产品广度上向国际主流龙头厂商靠拢。

纵向深化应用渗透，优化下游产业结构：依托日益完善的平台化产品矩阵，公司将加速推动业务版图向汽车电子、光伏储能、高端工业控制、AI 服务器等具备前瞻性、高附加值的应用领域深度渗透，以此提升公司产品在先进制造领域的应用广度与深度。

2、一体化：提升垂直整合能力，不断加强供应链掌控

公司目前采用 Fabless 与 IDM 并行的运营模式。随着经营规模的扩大、产品门类的丰富，公司未来将不断强化完善供应链掌控能力。

晶圆方面，公司的 5 英寸、6 英寸晶圆将以新顺微自产为主要供应渠道，而 8 英寸、12 英寸晶圆仍以委外流片为主，与晶圆代工厂不断开发、优化工艺平台，形成技术层面的深度绑定，通过产能保障协议、预付货款等方式提高供应链的稳定性与安全性。

封测方面，公司将进一步做好外部供应链与自主生产两方面的平衡与协同。一方面继续加强与外部优质封测供应商的合作，提升供应链稳定性；另一方面，公司将稳步提升长晶浦联的自主产能，做好做细产能规划，确保市场新增需求的及时响应与保障。

通过上述措施，公司将有效整合内外部供应链资源，进一步提升自身供应链

的垂直整合能力，深化产业链内部协同效益，从而优化整体成本结构，加速新产品的迭代周期，提高产品市场竞争力。

3、加大研发投入，强化技术力量和人才队伍建设

半导体行业是典型的人才密集型与技术密集型行业，公司今后将根据市场需要及战略规划，持续保持高强度的研发投入，持续开展对新技术的研究，不断研发新产品和新工艺，丰富核心技术，进一步提升公司在行业内的竞争力。

此外，发行人将高度重视研发团队的建设：（1）持续关注关键技术人才的引进和培训，着力培养战略性核心人才队伍；（2）建立健全人才培养机制，不断提升研发团队专业素养和技术水平；（3）推行员工持股计划，将核心技术人员、研发骨干员工的个人利益与公司发展的长期利益相结合，增强团队的归属感和凝聚力；（4）坚持“以人为本”的企业文化，通过建立管理与技术双重体系，为研发技术人员提供完善的职业发展通道。公司通过研发团队的建设、培养、激励，保障了企业创新创造的可持续发展。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，发行人根据《公司法》等相关法律法规，建立和健全了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的，符合上市公司规范运作要求的公司法人治理结构。同时公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，分别在战略发展、审计、提名、薪酬与考核等方面协助董事会履行职能。为提高公司治理的效率及效果，发行人建立并完善了各项相关制度，制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列公司治理制度。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会依法规范运作，履行职责，公司治理结构不断健全和完善。

报告期内，发行人根据《公司法》、中国证监会关于公司治理的有关规定及《公司章程》的规定进行决策，公司法人治理不存在缺陷。

二、发行人内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），公司管理层结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制报告基准日至内部控制报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对发行人内部控制的评价

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，立信出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA13443 号），认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）报告期内公司的内控规范情况

报告期内，公司存在少量通过第三方进行回款的情形，具体如下：

1、第三方回款基本情况

报告期内，公司第三方回款金额分别为 64.53 万元、7.02 万元和 44.21 万元，占营业收入比例分别为 0.029%、0.003%和 0.015%，金额及占比较小，具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
第三方回款金额	44.21	7.02	64.53
营业收入	298,523.51	267,765.34	225,989.82
占比	**0.015%**	**0.003%**	**0.029%**

2、第三方回款的原因、必要性及商业合理性

报告期内，公司第三方回款主要包括以下情形：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
客户关联方代付	21.00	-	64.53
委托下游客户代付	23.21	7.02	-
合计	**44.21**	**7.02**	**64.53**

上述第三方回款的原因包括：（1）客户关联企业代付，主要为客户同一控制下的企业或其控股股东等；（2）部分客户出于资金计划等原因，委托其下游客户付款。

发行人形成了有效的第三方回款的内控管理，针对客户第三方回款的情况，制定了收款相关的内部控制制度，严格控制第三方回款的情形。具体执行过程中，获取了客户出具的委托付款书或代付款声明书。报告期内，公司不存在因第三方回款导致的货款纠纷；第三方回款的资金流、实物流与合同约定及商业实质一致，

第三方回款真实，不存在虚构交易或调节账龄情形。

综上，报告期内，公司第三方回款情形均基于客户自身实际经营需求或付款便利需求而产生，具有一定的商业合理性。公司第三方回款占收入比重较小，对公司生产经营不会产生重大不利影响。

三、报告期内发行人违法违规情况

报告期内，公司不存在重大违法违规情况。2025 年 6 月 13 日，深圳证券交易所出具《关于对江苏长晶科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证审纪【2025】21 号），依据深圳证券交易所《审核规则》第七十三条、第七十四条第三项的规定，对江苏长晶科技股份有限公司给予通报批评的处分。截至报告期末，相关问题已完成整改。

四、发行人资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力

公司自设立以来，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立并规范了法人治理结构，建立健全了各项内控管理制度，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。

（一）资产完整

公司由长晶有限整体变更设立，承继了长晶有限全部的资产、负债及权益，未进行任何业务和资产剥离。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。

（二）人员独立

公司建立了独立的劳动、人事、工资福利及社会保障体系，拥有独立的人事自主权，公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。截至本招股说明书签署日，公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业中兼职。

（三）财务独立

公司已设置了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形。公司独立办理了税务登记并依法独立申报并缴纳税款。公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保，或被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用资金的情况。

（四）机构独立

公司已依照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会专门委员会等内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近 3 年内主营业务和董事、高级管理人员及其他核心人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 3 年实际控制人没有发生

变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）权属纠纷情况

公司合法独立拥有与生产经营有关资产，不存在主要资产、核心技术、商标等方面的重大权属纠纷。公司生产经营合法合规、财务状况稳健，截至本招股说明书签署日，公司不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。截至本招股说明书签署日，公司所处经营环境良好，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为上海江昊，实际控制人为杨国江，上海江昊及杨国江控制的其他企业基本情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	主营业务	与发行人是否存在相同或相似的业务
1	南京江澄	9,693.32	股权投资，系发行人的员工持股平台，以直接或间接持有发行人股权	否
2	傅传企管	4,272.96		否
3	长晶企达	1,275.00		否
4	长晶佳瑞	1,377.25		否

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与发行人构成同业竞争的业务，与发行人不存在同业竞争情况。

（二）避免同业竞争的承诺

具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（七）关于避免同业竞争的承诺”。

七、关联方及关联交易

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的主要关联方及关联关系如下：

1、关联自然人

（1）直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人

发行人实际控制人杨国江、副总经理范荣定为直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人，除杨国江、范荣定外，不存在其他持有发行人 5%以上股份的自然人股东。

（2）发行人的董事及高级管理人员

序号	关联方姓名	关联关系
1	杨国江	发行人董事长、总经理
2	陈益忠	发行人董事、副总经理
3	王楚璇	发行人董事
4	邓德强	发行人独立董事
5	张金隆	发行人独立董事
6	范荣定	发行人副总经理
7	李澄	发行人财务负责人兼董事会秘书

（3）直接或者间接控制发行人的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员

序号	关联方名称/姓名	关联关系
1	杨国江	发行人控股股东上海江昊的执行董事
2	夏昊天	发行人控股股东上海江昊的监事

（4）上述第（1）项至第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

（5）其他关联自然人

根据《股票上市规则》“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司其他关联自然人情况如下：

序号	关联方姓名	关联关系
1	王歆悦	过去十二个月担任公司监事，于 2026 年 5 月卸任
2	徐佰慧	过去十二个月担任公司监事，于 2026 年 5 月卸任

序号	关联方姓名	关联关系
3	张宇诗	过去十二个月担任公司监事，于 2026 年 5 月卸任

2、关联法人

（1）直接或者间接控制发行人的法人或者其他组织

发行人控股股东为上海江昊，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

（2）由前项所述法人直接或者间接控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

截至本招股说明书签署之日，发行人控股股东控制的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	南京江澄	发行人的员工持股平台、上海江昊担任执行事务合伙人
2	傅传企管	发行人的员工持股平台、上海江昊担任执行事务合伙人

（3）持有发行人 5%以上股份的法人或者一致行动人

截至 2025 年 12 月 31 日，除控股股东外，持股 5%以上的法人股东、非法人机构股东及其一致行动人具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	南京江澄	持有公司 22.28%的股份，与上海江昊、傅传企管系一致行动人
2	南京瑞联	持有公司 10.36%的股份
3	晨壹越腾	持有公司 5.71%的股份，与晨壹佰赢系一致行动人
4	傅传企管	持有公司 1.96%的股份，与南京江澄、上海江昊系一致行动人
5	晨壹佰赢	持有公司 0.89%的股份，与晨壹越腾系一致行动人

（4）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	长晶企达	发行人的员工持股平台、杨国江担任执行事务合伙人的企业
2	长晶佳瑞	发行人的员工持股平台、杨国江担任执行事务合伙人的企业

序号	关联方名称	关联关系
3	芯德半导体	发行人董事王楚璇担任董事的企业
4	晶智众达	发行人的员工持股平台，控股股东上海江昊的监事夏昊天担任执行事务合伙人的企业
5	上海观成	发行人的员工持股平台，控股股东上海江昊的监事夏昊天持股 49.79%的企业
6	湖北华商科技投资集团有限公司	发行人独立董事张金隆担任董事的企业
7	湖北华商鲲池科创服务集团有限公司	发行人独立董事张金隆担任董事的企业

（5）发行人的控股子公司、参股公司

序号	企业名称	与发行人的关联关系
1	深圳长晶	发行人全资子公司
2	长华智芯	发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司
3	香港长晶	发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司
4	Universal	发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司
5	海德半导体	发行人全资子公司
6	长芯检测	发行人全资子公司
7	南京海德	发行人全资子公司，于 2026 年 3 月注销
8	上海长晶	发行人全资子公司
9	新顺微	发行人直接和间接合计持股 100%的全资子公司
10	长晶浦联	发行人控股子公司
11	长晶微电子	发行人控股子公司
12	长芯顺联	公司原全资子公司，于 2025 年 1 月注销
13	南京芯联	发行人原直接和间接持股 100%的合伙企业，于 2025 年 9 月注销
14	南京顺芯	发行人全资子公司
15	长晶联合	发行人全资子公司
16	G&C	发行人全资孙公司 Universal 的参股公司

（6）其他关联法人

根据《股票上市规则》“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司其他关联法人情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	天津长山科技发展有限公司	曾任监事徐佰慧配偶的父亲持股 100.00%、担任经理、执行董事的企业

序号	关联方名称	关联关系
2	天津耀通科技股份有限公司	曾任监事王歆悦父亲持股并担任董事长、总经理，母亲持股并担任董事的企业

3、其他关联方

根据实质重于形式的原则认定的其他关联企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	格瑞宝	发行人副总经理范荣定的亲属任董事兼高级管理人员的企业，根据实质重于形式原则及谨慎性原则视同关联方进行披露

（二）关联交易

1、报告期内关联交易总体情况

报告期内，公司关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易类别	关联交易原因	未来是否持续
重大经常性关联交易	上海格瑞宝电子有限公司及其下属子公司	关联采购	晶圆、集中委托成品采购	是
重大偶发性关联交易	南京瑞联	关联股权收购	为实现对新顺微的全资控股，南京瑞联将其持有的新顺微股东南京芯联 30%的实缴合伙份额转让给公司子公司长芯顺联，对应新顺微 9.51%股权	否
	杨国江	关联担保	满足公司融资需要	是
一般关联交易	上海格瑞宝电子有限公司及其下属子公司	关联销售	销售分立器件成品及晶圆	是
	芯德半导体	关联采购	采购封测服务	是
			采购水电气能源费	否
			采购电镀加工服务及其他	否
		设备租赁	租赁临时空闲的设备给芯德半导体	否
		厂房装修转让	转让厂房装修资产给芯德半导体	否
		关联股权收购	提升公司自产产品的检测分析能力，加强产品质量把控，收购芯德半导体持有的长芯检测 50%的股权	否
	长芯检测	关联采购	采购检测服务	否
	董事、监事和高管	关键管理人员薪酬	工资及奖金	是

2、重大关联交易的判断标准及依据

参照《深圳证券交易所股票上市规则》，发行人重大关联交易的判断标准如下：（1）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；（2）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。

关键管理人员薪酬和不符合上述标准的交易为一般关联交易。

3、重大经常性关联交易

报告期内，公司向格瑞宝采购商品及劳务的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占营业成本的比例	金额	占营业成本的比例	金额	占营业成本的比例
格瑞宝	晶圆、集中委托成品采购	8,068.15	3.94%	8,043.13	4.29%	6,122.69	3.80%

注：同一控制下的企业合并披露。

格瑞宝是行业知名从事 MOSFET 等分立器件研发、设计应用、销售的半导体公司，与华虹宏力等知名晶圆厂长期合作。报告期内，公司主要向格瑞宝采购 MOSFET 晶圆及成品，公司向格瑞宝采购晶圆后进行封测，形成成品后对外销售，或由格瑞宝协调产业链资源，直接根据公司产品定义和需求交付成品。公司与格瑞宝的采购定价系参考市场价格经协商确定，交易价格公允。

4、重大偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方之间的重大偶发性关联交易情况如下：

（1）关联股权收购

为实现对新顺微的全资控股，2024 年 12 月 23 日，公司及其子公司长芯顺联与南京瑞联签订《股权转让协议》，约定南京瑞联将其持有的新顺微股东南京芯联 30%的实缴合伙份额转让给公司子公司长芯顺联，对应新顺微 9.51%股权，转让对价为 15,209.57 万元。

本次收购南京瑞联持有的新顺微少数股权对应的新顺微整体估值为 16.00 亿元，系结合市场环境、经营情况、行业估值水平等因素，经交易各方协商确定，定价公允。

（2）关联担保

报告期内，发行人重大偶发性关联担保均系发行人作为被担保方，具体情况如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨国江	20,000.00	2022.9.29	2025.10.16	是
杨国江	8,000.00	2021.9.26	2024.9.26	是
杨国江	20,000.00	2022.11.21	2023.4.10	是

报告期内，为满足公司融资需要，公司实际控制人杨国江为公司银行借款提供担保。上述担保未收取担保费用，亦无其他附加条件，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、一般关联交易简要汇总表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
芯德半导体	采购封测服务	115.73	184.41	215.62
	采购水电气能源费用	-	1,004.29	1,091.62
	采购电镀加工服务及其他	1.47	623.44	829.53
	向芯德半导体转让厂房装修	438.53	-	-
	向芯德半导体租出设备	7.87	47.79	47.79
	收购长芯检测 50%股权	-	1,000.00	-
长芯检测	采购检测服务	-	620.33	960.16
格瑞宝	销售晶圆、二极管、三极管，提供测试服务等	120.93	70.75	43.54
董事、监事和高管	关键管理人员薪酬	1,142.15	1,134.27	1,219.55

（1）向芯德半导体采购封测服务、水电气能源、电镀加工服务及其他

芯德半导体是一家半导体封测技术解决方案提供商，主要从事开发封装设计、提供定制封装产品以及封装产品测试服务。报告期内，公司向芯德半导体采购封测服务，采购定价系参考市场价格经协商确定，交易价格公允。

报告期期初，发行人子公司长晶浦联自有厂房仍处于建设阶段，其租赁南京浦口经济开发区能源产业园内的临时厂房开展经营。由于该临时厂房与芯德半导体共用水表、电表等，因此长晶浦联经营产生的水电气能源费用，先由芯德半导

体统一缴纳结算，再由公司按应承担的相关费用向其支付。报告期内，该等水电气能源费金额均按实际发生额进行结算，双方交易价格公允。2024 年，长晶浦联完成自有厂房搬迁工作，自此不再与芯德半导体发生水电气能源费用结算事宜。

除前述采购活动外，发行人向芯德半导体主要采购电镀加工服务，主要系长晶浦联暂未具备电镀加工产能，故报告期内委托芯德半导体提供电镀加工服务。该服务对应的加工费用主要由人工劳务费、原材料及易耗品费用、加工费率构成，定价依据充分、公允。长晶浦联完成自有厂房搬迁后已配套建成电镀加工产能，具备自主开展电镀加工的能力，无需再通过委外采购满足生产需求。

（2）向芯德半导体租出设备、转让厂房装修

长晶浦联与芯德半导体原共同租赁浦口区新能源产业园临时厂房，双方各自承租部分区域，为满足生产经营需求，长晶浦联对承租部分厂房进行了专项装修改造。长晶浦联搬离后，该部分厂房由芯德半导体继续承租使用，长晶浦联将厂房装修资产转让给芯德半导体。结合长晶浦联实际承担成本余额，经双方协商确定厂房装修资产的转让价格为 438.53 万元，定价合理。

此外，报告期内发行人存在向芯德半导体租出生产设备的情形，相关租赁金额较小，所租出设备均为发行人临时闲置的生产设备，未影响发行人正常生产经营活动，对公司整体经营业绩无重大影响。

（3）向芯德半导体收购长芯检测 50%股权

长芯检测为长晶科技和芯德半导体于 2021 年 9 月成立的各自持股 50%的合资公司，主要从事功率器件和 IC 产品的可靠性检测和失效分析业务。为了进一步提升公司自产产品的检测分析能力，加强产品质量把控，公司于 2024 年 9 月完成收购芯德半导体持有的长芯检测 50%的股权。

2024 年 8 月 30 日，公司与芯德半导体签署了《股权转让协议》，公司按照人民币 1,000 万元的价格受让芯德半导体所持长芯检测 50%股权（其中实缴出资 1,000 万元）。该等股权转让定价参照股东实缴投资额、长芯检测净资产等由交易双方协商确定。

（4）向长芯检测采购检测服务

报告期内，公司向长芯检测采购功率器件及 IC 产品的可靠性检测、失效分析等相关服务，该类交易定价以市场价格为参考，经双方协商确定，交易价格公允。2024 年，公司完成对芯德半导体所持长芯检测 50%股权的收购，收购完成后，长芯检测成为发行人全资子公司。

（5）向格瑞宝销售分立器件成品及晶圆

报告期内，公司存在向格瑞宝销售分立器件成品及晶圆的业务往来，相关销售金额较小，对公司整体生产经营活动及经营业绩影响较小。该类交易定价均以市场价格为参考，经双方协商确定，交易价格公允。

（6）关键管理人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员报酬包括支付给董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员的报酬。

单位：万元

关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	1,142.15	1,134.27	1,219.55

6、关联方应收应付款项

报告期各期末，公司与关联方之间的应收应付余额如下表所示：

单位：万元

科目名称	关联方	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应付账款	格瑞宝	1,349.81	1,085.52	825.90
	芯德半导体	21.50	499.93	407.51
	长芯检测	-	-	630.28
应收账款	格瑞宝	7.27	24.23	7.37
	芯德半导体	-	-	36.00
应收票据	格瑞宝	0.78	3.78	-
应收款项融资	格瑞宝	3.15	11.85	1.68

注：2023 年度，公司收回南京瑞联其他应收款 280.61 万元，该款项主要为 2022 年收购新顺微电子股权交割前所涉相关税费。

（三）报告期内关联交易履行程序的合法合规情况

报告期内，公司依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》，对报告期内关联交易履行了相关决策程序。

（四）关联方变化情况

报告期内，公司主要关联方的变化情况具体如下：

1、关联自然人

报告期内，持有发行人 5%以上股份的自然人股东未发生变化，发行人关联自然人的变化主要体现为董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员的变化，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十五、董事（含董事会审计委员会成员）、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况”。其中，报告期内曾存在的关联自然人如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	孔晓明	发行人曾任董事，2024 年 6 月起不再担任董事
2	徐牧之	发行人曾任监事，2024 年 12 月不再担任监事

2、关联法人

报告期内，公司关联法人的关联关系发生变化的情况如下：

序号	名称	关联关系变化情况
1	上海睿欧博管理咨询有限公司	报告期曾任董事孔晓明持股 100.00%并担任董事、经理
2	扬州广壹投资合伙企业（有限合伙）	报告期曾任董事孔晓明持股 75.00%
3	厦门职行力信息科技有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
4	北京云杉世纪网络科技有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
5	虹软科技股份有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
6	北京互时科技股份有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
7	上海安势信息技术有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
8	江苏易安联网络技术有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
9	北京必示科技有限公司	报告期曾任董事孔晓明曾担任董事，已于 2025 年 5 月卸任
10	北京易成时代科技有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
11	利穗科技（苏州）有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
12	杭州华橙网络科技有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任法定代表人、董事
13	杭州华橙软件技术有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
14	厦门职行力信息科技有限公司	报告期曾任董事孔晓明担任董事
15	扬州麟琪股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期曾任董事孔晓明持股 20.00%
16	嘉兴竑瑜泰盈股权投资合伙企业	报告期曾任董事孔晓明持股 30.30%

序号	名称	关联关系变化情况
	（有限合伙）	
17	嘉兴瑞彤股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期曾任董事孔晓明持股 20.00%
18	扬州瑞晟股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期曾任董事孔晓明持股 36.36%

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序

根据公司 2026 年第一次临时股东大会通过的决议，公司本次发行上市完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

二、发行人的股利分配政策

（一）公司章程中利润分配相关规定

1、本次发行前公司利润分配政策

根据本次发行前公司适用的《公司章程》，公司的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报并有利于公司的长远发展，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

2、本次发行后公司利润分配政策

根据本次发行后公司适用的《公司章程（草案）》，公司的利润分配政策如下：

“（一）公司利润分配原则

1、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

2、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。公司现金股利政策目标为剩余股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）现金分红条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

1、公司合并资产负债表及母公司单体资产负债表未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利

润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）；

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司再融资的募集资金投资项目除外）；

4、公司资产负债率未超过 70%。

在实际分红时，公司董事会需综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。

（四）利润分配的最低比例和时间间隔

在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司可以根据盈利情况和资金需求状况增加现金分红频次，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东会审议决定。

（五）发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

（六）利润分配的决策机制和程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案；公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

2、审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

3、股东会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（七）利润分配政策调整的决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，审计委员会应当对利润分配政策调整发表监督意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东会审议，在董事会审议通过后提交股东会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。股东会审议调整利润分

配政策的，需经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（八）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1、是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；

2、分红标准和比例是否明确和清晰；

3、相关的决策程序和机制是否完备；

4、公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

3、本次发行前后股利分配政策差异情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司进一步完善了本次发行后的股利分配政策，对股利分配形式、股利分配的期间间隔、股利分配的条件、股利分配的决策程序及监督机制等事项进行了明确。

（二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》《公司章程（草案）》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，特制订了《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》。

分红回报规划制定的基本原则如下：公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战略发展等实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。

分红回报规划制定的考虑因素如下：分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点、资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

（三）上市后三年内现金分红等利润分配计划以及相关安排

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《公司章程（草案）》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，特制订了《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，具体详见本节之“二、发行人的股利分配政策”之“（一）公司章程中利润分配相关规定”。

（四）未分配利润的使用安排

公司已承诺在审期间不进行现金分红，公司的未分配利润将用于公司正常生产经营。本次发行上市后，公司将严格执行《公司章程》《江苏长晶科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，合理使用未分配利润。

（五）公司长期回报规划以及规划制定时的主要考虑因素

本次发行后公司适用的《公司章程（草案）》对公司的利润分配政策、调整利润分配政策的审议程序等进行了规定。同时，公司制定了《江苏长晶科技股份有限公司上市后三年分红回报规划》，并明确以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内

容。具体情况及主要考虑因素请参见本节上述“二、发行人的股利分配政策”之“（一）公司章程中利润分配相关规定”、“（二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由”、“（三）上市后三年内现金分红等利润分配计划及安排”的相关内容。

三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，以及尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形。

第十节 其他重要事项

一、重要合同

（一）重大销售合同

公司主要产品为分立器件及其晶圆、电源管理 IC 等，面向的客户群体具有数量较多、单笔订单金额较小、下单频率较高等特点。公司通常采用“双方签订框架性协议+公司接收客户订单/通知”的方式向客户进行销售，通过签订“框架性协议”约定交货方式、付款方式等基本购销义务，客户会根据其需求不定期通过发送采购订单、采购通知单或通过客户自身采购系统推送需求通知单等多种形式向公司发出采购需求。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司与各期前五大客户报告期内已履行和正在履行的框架性协议如下：

序号	销售方	客户名称	合同名称	主要销售内容	签署日期	合同期限	截至报告期期末的履行情况
1	深圳长晶	深圳市联盛电子有限公司	购销合同	二三极管、MOSFET、电源管理 IC 等	2021.7.1	2021.7.1-2026.6.30，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
2	长晶科技		购销合同	二三极管、MOSFET、电源管理 IC 等	2023.1.6	2023.1.6-2024.1.6，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	履行完毕
3					2025.1.6	2025.1.6-2030.1.5，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
4	深圳长晶	深圳市广丰盛电子有限公司	购销合同	二三极管、MOSFET、电源管理 IC 等	2021.10.18	2021.10.18-2022.10.17，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	履行完毕
5					2023.10.18	2023.10.18-2028.10.17，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
6	长晶科技		购销合同	二三极管、MOSFET、电源管理 IC 等	2023.3.1	2023.3.1-2025.2.28，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
7			购销合同		2024.1.1	2024.1.1-2025.12.31	履行完毕

序号	销售方	客户名称	合同名称	主要销售内容	签署日期	合同期限	截至报告期期末的履行情况
8	深圳长晶	深圳海格微电子有限公司	购销合同	MOSFET、二三极管等	2020.3.11	2020.3.11-2022.3.10，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	履行完毕
9					2023.3.10	2023.3.10-2024.3.9，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	履行完毕
10					2025.3.10	2025.3.10-2030.3.9，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
11	海德半导体		购销合同	二三极管	2020.1.15	2020.1.15-2023.1.15，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	履行完毕
12					2023.1.15	2023.1.15-长期有效，合同一方未在 3 个月前通知另一方终止合同，那么合同将保持长期有效。	正在履行
13	长晶科技	南京高上美电子有限公司	购销合同	二三极管、MOSFET、电源管理 IC 等	2022.1.1	2022.01.01-2024.12.31，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	履行完毕
14					2025.1.31	2025.1.31-2028.12.31，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
15	深圳长晶	深圳翰世宇科技有限公司	购销合同	二三极管、MOSFET、电源管理 IC 等	2021.7.1	2021.7.1-2026.6.30，合同一方在合同到期日的前 2 个月未有通知另一方终止合同，那么合同将自动延展一年。	正在履行
16	海德半导体		购销合同	二三极管等	2018.12.8	2018.12.8-长期有效	正在履行
17	深圳长晶	欣旺达电子股份有限公司	基本采购合同	二三极管、MOSFET 等	2022.3.29	有效期一年，合同期满之日前两个月双方均未书面提出终止合同，则合同有效期自动延续一年，且此后以同样方式延续，直至双方业务往来结束	正在履行

注：公司与欣旺达电子股份有限公司签订的合同，适用于欣旺达电子股份有限公司所控股子公司及分公司。

（二）重大采购合同

公司结合自身业务特点通常采用“框架性协议+订单”的方式向供应商进行采购。截至 2025 年 12 月 31 日，公司与各期前五大供应商报告期内已履行和正在履行的框架性协议如下：

序号	采购方	供应商名称	合同名称	主要采购内容	签署日期	合同期限	截至报告期期末的履行情况
1	长晶科技	江苏长电科技股份有限公司	委托芯片封装设计及加工合同	封测服务	2022.1.1	2022.1.1-2023.12.31	履行完毕
2	长晶科技				2023.12.4	2024.1.1-2026.12.31	正在履行
3	长华智芯		委托芯片封装设计及加工合同	封测服务	2022.1.1	2022.1.1-2023.12.31	履行完毕
4	长晶科技	江苏格瑞宝电子有限公司	委托代工合同	分立器件、晶圆	2021.12.8	2021.12.8-存在新的书面基本供货合同约束双方之间的业务关系	履行完毕
5			采购合同	分立器件、晶圆	2025.1.2	2025.1.2-存在新的书面基本供货合同约束双方之间的业务关系	正在履行
6			委托芯片封装设计及加工合同	封测服务	2021.11.15	2021.11.15-2024.11.16	履行完毕
7	长晶科技	北京伊泰克电子有限公司	采购合同	晶圆	2021.12.8	2021.12.8-存在新的书面基本供货合同约束双方之间的业务关系	正在履行
8	海德半导体		购销合同	晶圆	2023.2.1	2023.2.1-存在新的书面基本供货合同约束双方之间的业务关系	正在履行
9	长晶科技	芯联集成电路制造股份有限公司	芯片代工协议	晶圆、封测服务、分立器件	2020.5.29	2020.5.29-2023.5.29	履行完毕
10					2022.1.18	2022.1.18-2025.1.18	履行完毕
11					2025.1.18	2025.1.18-2028.1.18	正在履行
12	长晶科技	江阴市州禾电子科技有限公司	委托芯片封装设计及加工合同	封测服务	2021.12.8	2021.12.8-2024.12.7	履行完毕
13					2024.12.31	2024.12.31-2027.12.31	正在履行

注：公司与江阴市州禾电子科技有限公司、江苏格瑞宝电子有限公司签订的合同，适用于海德半导体等公司关联子公司。

（三）重大借款合同

报告期内，发行人及其子公司已履行和正在履行的金额 3,000.00 万元以上（含 3,000 万元）的借款合同如下：

序号	协议名称	借款人	贷款机构	贷款金额（万元）	贷款期限	担保方式	截至报告期期末的履行情况
1	流动资金借款合同	长晶科技	中国工商银行股份有限公司南京江北新区分行	3,000.00	2024.11.20-2025.11.20	-	履行完毕
2	流动资金借款合同	长晶科技	中国工商银行股份有限公司南京江北新区分行	3,000.00	2025.7.28-2026.7.24	-	正在履行
3	人民币流	长晶	中信银行股份有	3,000.00	2025.8.29-2027.8.29	-	正在履行

序号	协议名称	借款人	贷款机构	贷款金额（万元）	贷款期限	担保方式	截至报告期期末的履行情况
	动资金贷款合同	科技	限公司南京分行				
4	人民币流动资金贷款合同	长晶科技	中信银行股份有限公司南京分行	3,000.00	2025.9.23-2027.9.13	-	正在履行
5	并购贷款合同	长晶科技	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	50,000.00	2024.9.5-2029.3.14	长晶科技、南京顺芯以新顺微股权提供质押担保，长晶科技另以保证金形式提供担保	正在履行
6	固定资产借款合同	长晶浦联	中国工商银行股份有限公司南京浦口支行	75,000.00	2022.11.23-2037.9.20	长晶浦联以不动产权提供抵押担保，长晶科技提供连带责任保证担保	正在履行
7	并购贷款合同	长芯顺联	招商银行股份有限公司南京分行	78,500.00	84 个月，自贷款实际发放日起算	长晶科技提供连带责任保证担保	履行完毕
8	并购借款合同	长芯顺联	中国工商银行股份有限公司南京浦口支行	9,700.00	84 个月，自首次提款日起算	长晶科技提供连带责任保证担保	履行完毕

（四）其他重大合同

报告期内，发行人及其子公司已履行、正在履行和将要履行的其他重大合同的具体情况如下：

序号	签订时间	合同名称	合同各方	主要合同内容	履行情况
1	2020 年 10 月	《关于江苏长晶浦联功率半导体有限公司之投资协议》	长晶浦联、长晶科技（合称承诺方）；南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企业 （有限合伙）（投资方）	1、投资方案：投资方出资 3 亿元占长晶浦联功率半导体 30%股权，不参与实际运营，交割后投资方暂放弃表决权和利润分配权； 2、股权回购：投资方资金全部到位后 4 年内，长晶科技可按原投资总额 100%免息回购股权；5-9 年未回购需按银行同期贷款基准利率支付单利；9 年未回购投资方恢复全部股东权利并享有优先购买权等特殊权利；	正在履行
2	2020 年 10 月	《关于江苏长晶浦联功率半导体有限公司之股东协议》	长晶浦联、长晶科技（合称承诺方）；南京浦口开发区战略新兴产业投资合伙企	1、股权限制：投资方退出前，现有股东未经其书面同意不得转让股权；长晶科技回购前，投资方未经其书面同意	正在履行

序号	签订时间	合同名称	合同各方	主要合同内容	履行情况
			业 （有限合伙）（投资方）	不得处置股权； 2、投资方权利：投资方享有财务信息查阅权，在投资款被挪用、股东会超 12 个月无法召开时享有强制清算权；投资方资金到位 9 年未被回购的，享有优先购买权、跟随出售权、优先认购权、优先清偿权等特殊权利；	

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形。

三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，不存在公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生重大不利影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

第十一节 声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事：

杨国江　陈益忠　王楚璇

邓德强　张金隆

除董事外的高级管理人员：

范荣定　李澄

江苏长晶科技股份有限公司

2016 年 6 月 8 日

发行人审计委员会声明

本公司全体审计委员会成员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会全体成员：

邓德强　　张金隆　　王楚璇

江苏长晶科技股份有限公司

2026年2月8日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司（或本人）承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

上海江昊企业管理咨询有限公司

控股股东的法定代表人：

杨国江

实际控制人：

杨国江

江苏长晶科技股份有限公司

2016 年 6 月 8 日

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

颜嘉俊

保荐代表人：

姚黎 张晨曦

法定代表人（或授权代表）：

江 禹

华泰联合证券有限责任公司

2026年 6月 8日

本人已认真阅读长晶科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理：

马 骁

保荐人董事长（或授权代表）：

江 禹

华泰联合证券有限责任公司

2026年 6月 8日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（签名）：

许　成　宝

经办律师（签名）：

谢　文　武

常　桂　铷

江苏世纪同仁律师事务所

2026 年 6 月 8 日

五、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、审阅报告（如有）、盈利预测审核报告（如有）、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、审阅报告（如有）、盈利预测审核报告（如有）、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

杨景欣 王佳良

童英

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年6月8日

六、承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，并确认《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中援引本公司出具的《江苏长晶科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目》（中联评报字[2021]第 3086 号）的专业结论无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中完整准确地援引本公司出具的《江苏长晶科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目》（中联评报字[2021]第 3086 号）的专业结论无异议。确认《江苏长晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》不致因援引本机构出具的资产评估专业结论而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

周斌（已离职） 李洪柱（已离职）

资产评估机构负责人：

胡 智

中联资产评估集团有限公司

2026 年 6 月 8 日

承担评估业务的机构关于经办资产评估事项的签字资产评估师离职的说明

本公司为江苏长晶科技股份有限公司出具《江苏长晶科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司项目》（中联评报字[2021]第 3086 号）资产评估报告，该报告签字资产评估师为周斌、李洪柱。

目前，周斌、李洪柱已从本公司离职，不在本公司执业。

特此说明。

资产评估机构负责人：

胡 智

中联资产评估集团有限公司

2021 年 6 月 8 日

七、承担验资业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

朱海平 程鹏远

杨景欣 王佳良

会计师事务所负责人：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年6月8日

第十二节 附件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（七）与投资者保护相关的承诺；

（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（九）内部控制审计报告；

（十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十一）股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（十三）募集资金具体运用情况；

（十四）子公司、参股公司简要情况；

（十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

1、信息披露制度和流程

（1）信息披露制度

公司制定了《信息披露管理制度》，明确了发行人信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息披露事务管理及相关人员的职责等，有利于提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。《信息披露管理制度》规定，披露的信息应当及时、真实、准确、完整；公司及相关信息披露义务人信息披露要遵循公开、公平、公正对待所有股东的原则；公司及相关信息披露义务人除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

（2）信息披露流程

① 公司定期报告的编制、审议和披露程序：

A.公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，并提请董事会审议。

B.公司董事会秘书和财务总监负责组织定期报告的起草和编制，并由董事会秘书及时送达董事审阅。

C.董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，明确表示是否同意定期报告的内容；

D.审计委员会召集人组织审计委员会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

E.董事会秘书负责组织董事会办公室完成定期报告的披露工作；可以依照深圳证券交易所的审核意见，对已经公司董事会和审计委员会审核通过的定期报告进行合理修订；并将修订内容通过邮件、电话等方式告知董事、审计委员会委员及高级管理人员。

F.公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。半数以上的董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的，视为未审议通过。

② 公司临时公告的编制、审议及披露程序：

除董事会、股东会决议公告外的其他按有关规定要求应予披露的涉及重大事项的公告：

A.信息披露义务人应当在知悉相关信息可能触发信息披露义务时第一时间告知公司董事会秘书，相关信息披露义务人提供信息前应当认真核对相关信息资料；

B.董事会秘书收到信息披露义务人提交的信息后应当及时进行审查。对于需要履行信息披露义务的重大事项，董事会秘书应立即向董事长报告并根据董事长的指示，及时组织董事会办公室草拟临时公告草稿。董事长接到报告后，应立即向董事会报告。

C.临时公告草稿起草完成后，信息披露义务人应当对临时公告草稿内容进行认真核对并确认相关信息；

D.董事会秘书负责对临时公告文稿进行审核，并组织董事会办公室完成临时公告的披露工作。

2、投资者沟通渠道的建立情况

为了规范公司的投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，发行人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》。

公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查投资者关系管理事务的落实、运行情况。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

3、未来开展投资者关系管理的规划

为了规范公司的投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，发行人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》。

公司将设立投资者联系电话、传真和电子邮箱等，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。公司将加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。公司将积极利用中国投资者网、互动易平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。公司将通过新媒体平台开展投资者关系管理活动。已开设的新媒体平台及其访问地址，应当在公司官网投资者关系专栏公示，及时更新。

（二）股利分配决策程序

公司的股利分配决策程序参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”之“（三）上市后三年内现金分红等利润分配计划以及相关安排”。

（三）股东投票机制的建立情况

根据公司制定的《公司章程（草案）》《股东会议事规则》等相关规定，发行人股东投票机制的建立情况如下：

1、累积投票制度建立情况

股东会选举二名以上董事时应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

2、中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

3、对法定事项采取网络投票方式的相关机制

股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

4、对征集投票权的相关机制

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

三、与投资者保护相关的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1、实际控制人杨国江关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间公司发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。

（3）股份锁定期满后，本人如担任公司董事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

（4）股份锁定期满之日起后 24 个月内，若本人减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份，减持价格不低于发行价。若上述期间公司发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。

（5）如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

（6）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

（7）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

2、控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄和傅传企管关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间公司发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。

（3）股份锁定期满之日起后 24 个月内，若本企业减持公司首次公开发行股票前本企业已持有的公司股份，减持价格不低于发行价。若上述期间公司发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。

（4）如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

（5）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的发行人

股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

3、持股 5%以上股东关于持股及减持意向的承诺

持股 5%以上股东及其一致行动人南京江澄、上海江昊、傅传企管、南京瑞联、晨壹越腾、晨壹佰赢承诺如下：

（1）在法律、法规以及规范性文件规定的限售期限届满及本企业承诺的限售期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格（若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价相应调整为除权除息后的价格），减持比例不超过有关法律法规或中国证监会和证券交易所对本人/本企业持有的首发前股份的限售规定。

（2）减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章及证券交易所监管规则等规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。在本企业及本企业一致行动人合计持有发行人 5%以上股份期间，本企业应在减持前 3 个交易日予以公告，本企业通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易首次减持的应在减持前 15 个交易日予以公告；本企业将按照相关法律法规披露减持计划，并在相关信息披露文件中披露拟减持数量等法定信息披露内容。

（3）本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如因违反承诺给公司或投资者造成损失的，本企业将依法对公司或投资者进行赔偿。

（4）本企业上市后依法增持的股份不受上述承诺约束。

（5）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的发行人股份减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

4、公司 IPO 申报前 12 个月内新增股东关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺

（1）节能环保战新、聿泉金环、蓝天投资、晶智众达、季学庆、广东广祺、苏州广祺和陈位平系 IPO 申报前 12 个月内新增股东，承诺如下：

①自发行人股票上市之日起 12 个月内以及自本企业/本人取得发行人股份之日起 36 个月内（以较晚到达的时间为准），本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

②如未履行上述承诺出售股票，本企业/本人将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。

③如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业/本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本企业/本人将按此等要求执行。

（2）虹润科技存在部分股权为发行人申报前 12 个月内取得，部分股权系 IPO 申报前 6 个月内从控股股东一致行动人南京江澄处受让取得，承诺如下：

①本企业于 2026 年 2 月受让南京江澄取得的 206.6770 万股股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；本企业于 2026 年 2 月受让泉州海丝取得的 23.2389 万股股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内以及自本企业取得该部分股份之日起 36 个月内（以较晚到达的时间为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

②如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。

③如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

5、其他股东关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。

（3）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本企业持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本企业将按此等要求执行。

6、持股董事、高级管理人员关于股份限售、减持安排及股份自愿锁定的承诺函

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若上述期间公司发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。

（3）股份锁定期满后，本人如担任公司董事、高级管理人员的，任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

（4）股份锁定期满之日起后 24 个月内，若本人减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份，减持价格不低于发行价。若上述期间公司发生派发现金红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。

（5）如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如

有）上缴发行人所有。若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。

（6）如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人股份之锁定、减持另有要求的，本人将按此等要求执行。

（7）在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力，在此期间本人继续履行上述承诺。

（二）稳定股价的措施和承诺

1、发行人关于稳定公司股价的预案

为维护公众投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规要求，就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的相关事宜，公司特制定预案如下：

公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司发生利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况的，收盘价相应进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产，非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。

（1）稳定股价的具体措施

① 公司回购

公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司可以依照公司章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：

A.公司回购股份的资金为自有资金、发行优先股、债券等募集的资金、金融机构借款等合法资金，回购股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产；

B.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；

C.公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；

D.公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。如与指标 C 有冲突的，以不超过 2%为准；

E.同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过公司最近一期经审计的每股净资产，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。

② 控股股东及其一致行动人、实际控制人增持

下列任一条件发生时，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体应在符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

A.公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；

B.公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内稳定股价的条件再次被触发。

控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体用于增持股份的资金金额原则上不低于本企业自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%，且不超过本企业自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红总额；自公

司上市后每 12 个月内增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。

③ 董事、高级管理人员增持

下列任一条件发生时，届时在公司领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

A.控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日公司股份收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产；

B.控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体增持股份方案实施完毕之日起 3 个月内稳定股价的条件再次被触发。

有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员个人上年度税后薪酬总额的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员个人上年度税后薪酬总额。公司全体董事（独立董事除外）、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

（2）稳定股价措施的启动程序

① 公司回购

公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议，并在最终回购预案方案通过之日起 3 个月内实施完毕。

公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在

3 年内转让或者注销。

② 控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体、董事、高级管理人员增持

公司董事会应在上述控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体、董事、高级管理人员稳定股价的条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。

控股股东及其一致行动人、实际控制人或其指定的主体、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。

（3）约束措施

① 公司未履行稳定股价承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

② 控股股东及其一致行动人、实际控制人未履行稳定股价承诺的约束措施

如控股股东及其一致行动人、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

③ 董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，应在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资

者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

2、实际控制人杨国江、控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄和傅传企管关于稳定公司股价的承诺

（1）本人/本企业将根据公司股东会批准的《关于稳定公司股价预案的议案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

（2）本人/本企业将根据公司股东会批准的《关于稳定公司股价预案的议案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

（3）若本人/本企业未履行稳定股价措施的，将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权将与本人/本企业拟根据上述预案中增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，同时本人/本企业持有的公司股份不得转让，直至按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

3、全体非独立董事关于稳定公司股价的承诺

（1）本人将根据公司股东会批准的《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票。

（2）本人将根据公司股东会批准的《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

（3）如本人属于公司股东会批准的《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中有增持义务的董事，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护

投资者利益。

4、全体高级管理人员关于稳定公司股价的承诺

（1）本人将根据公司股东会批准的《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。

（2）如本人属于公司股东会批准的《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》中有增持义务的高级管理人员，且本人未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，如非因不可抗力导致，公司有权将与本人拟根据《江苏长晶科技股份有限公司关于稳定公司股价的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力导致，将尽快研究使投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。

（三）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

（1）公司首次公开发行股票并上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法回购欺诈发行上市的股份，回购价格为股票发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3）公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

2、控股股东上海江昊关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

（1）公司首次公开发行股票并上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，自行和/或督促公司依法启动回购欺诈发行上市股份的程序，并购回本企业已转让的原限售股份（如涉及），回购价格为股票发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3）公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

3、实际控制人杨国江关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

（1）公司首次公开发行股票并上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次公开发行股票并在深圳证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，自行和/或督促公司依法启动回购欺诈发行上市股份的程序，回购价格为股票发行价格加上同期银行存款利息（若本公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

（3）公司因欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最

终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人关于填补被摊薄即期回报之措施的承诺

公司首次公开发行 A 股股票并上市完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体措施如下：

（1）保证本次募集资金有效使用，加快项目建设进度

公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，加强项目相关的人才与技术储备，争取募投项目早日达成并实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

同时，为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件及公司章程，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、管理与监督和责任追究等方面进行明确规定。本次公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

（2）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（3）加强研发、拓展业务，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩

本次发行完成后，公司在执行募集投资项目的同时，将更加注重公司日常的运营效率，节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本，同时优化完善各流程生产工艺，提高经营效率，提升公司经营业绩。

公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技术水平，持续拓展市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。

（4）完善利润分配机制、强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。

2、控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，作为公司的控股股东和实际控制人，上海江昊企业管理咨询有限公司、杨国江作出了本承诺，内容如下：

（1）本人/本企业作为江苏长晶科技股份有限公司的控股股东/实际控制人，本人/本企业不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）本人/本企业将严格履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施及本人/本企业作出的承诺。若本人/本企业未履行上述承诺给公司或者公司股东造成损失，本人/本企业将依法承担补偿责任。

3、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，

作为公司的董事、高级管理人员，对公司填补即期汇报措施作出承诺内容如下：

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费行为。

（4）承诺支持董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺公司的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

若本人违反该等承诺，本人将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受中国证监会、证券交易所采取相应的监管措施；如给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。

（五）利润分配政策的承诺

1、本次发行前滚存利润的安排

公司本次发行上市完成日前滚存的未分配利润由本次发行上市后的新老股东按照各自的持股比例共同享有。

2、本次发行完成后的主要利润分配政策

公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对《公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了完善，并制定了关于上市后三年股东分红回报规划。

公司高度重视对股东的分红回报，公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》及关于上市后三年股东分红回报规划规定的利润分配政策。

如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时调整利润分配政策并严格执行。如公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，将依照未能行承诺时的约束措施承担相应责任。

3、公司在审期间现金分红事项的承诺

自本承诺函出具之日起至公司首次公开发行股票并上市完成前，本公司将不再进行现金分红。

（六）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人关于依法承担赔偿责任的承诺

（1）公司招股说明书及其他信息披露文件所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且公司对招股说明书及其他信息披露文件所载之内容真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（2）如招股说明书及其他信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，公司将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作，回购价格将按照如下原则：

①若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

②在本公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

（3）若公司招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（4）若公司违反上述承诺，则将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

2、实际控制人杨国江、控股股东上海江昊关于依法承担赔偿责任的承诺

（1）公司的招股说明书及其他信息披露文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本企业/本人对招股说明书及其他信息披露文件内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（2）如招股说明书及其他信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本企业/本人将采取下列措施依法回购首次公开发行的全部新股：

①若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后至股票尚未上市交易前的时间段内发生上述情况，本企业/本人将依法督促公司将按照投资者所缴纳的股票申购款加计该期间内银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

②若在公司首次公开发行的股票上市交易后发生上述情况，本企业/本人将自行或督促发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为股票发行价格加算同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

（3）如因公司招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业/本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（4）若本企业/本人违反上述承诺，则将在公司股东会及中国证监会指定报

刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

3、全体董事、审计委员会成员及高级管理人员出具的承诺

（1）公司的招股说明书及其他信息披露文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且本人对招股说明书及其他信息披露文件内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

（2）如因公司招股说明书及其他信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

（3）若本人违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。

（七）关于避免同业竞争的承诺

（1）实际控制人杨国江、控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄和傅传企管承诺

①截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与长晶科技及其控制的企业相同、相似业务的情形。

②本人/本企业不会利用控股股东、实际控制人地位对长晶科技及其控制的企业的市场行为施加影响，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将采用市场化方式开拓市场并以公允的价格销售产品或者提供服务，本人/本企业保证不利用长晶科技控股股东、实际控制人的身份进行损害长晶科技及长晶科技的股东利益的经营活动。

③本人/本企业将尽一切合理努力保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未来避免新增对长晶科技及其控制的企业已有业务构成或可能构成竞争关系的业务。

④本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未来拓展其业务范围，与长晶

科技产生或可能产生对长晶科技构成竞争的情形，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将及时采取措施将构成竞争或可能构成竞争的产品或业务控制或降低至依据相关规定不构成重大不利影响的范围内。

⑤若本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业应对长晶科技因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

⑥本承诺函一经签署，即构成本人/本企业不可撤销的法律义务。本承诺函自本人/本企业签署之日起生效，其效力至本人/本企业不再是公司的控股股东/实际控制人及其一致行动人之日终止。

（2）公司董事、高级管理人员承诺

①截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与长晶科技及其控制的企业相同、相似业务的情形。

②本人不会利用本人董事/高级管理人员地位对长晶科技及其控制的企业的市场行为施加影响，本人及本人控制的其他企业将采用市场化方式开拓市场并以公允的价格销售产品或者提供服务，本人保证不利用本人担任长晶科技董事/高级管理人员的身份进行损害长晶科技及长晶科技的股东利益的经营活动。

③本人将尽一切合理努力保证本人及本人控制的其他企业未来避免新增对长晶科技及其控制的企业已有业务构成或可能构成竞争关系的业务。

④本人及本人控制的其他企业未来拓展其业务范围，与长晶科技产生或可能产生对长晶科技构成竞争的情形，本人及本人控制的其他企业将及时采取措施将构成竞争或可能构成竞争的产品或业务控制或降低至依据相关规定不构成重大不利影响的范围内。

⑤若本人违反上述承诺，本人应对长晶科技因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

⑥本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司的董事/高级管理人员之日终止。

（八）关于减少和规范关联交易的承诺

1、实际控制人杨国江、控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄和傅传企管关于减少和规范关联交易的承诺

（1）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人/本企业地位及控制性影响谋求长晶科技及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利。

（2）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人/本企业地位及控制性影响谋求与长晶科技及其控制的其他企业达成交易的优先条件。

（3）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与长晶科技及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害长晶科技及其控制的企业利益的行为。

（4）本人/本企业承诺并促使本人/本企业控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将尽量避免或减少与长晶科技及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。

（5）本人/本企业承诺本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长晶科技及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长晶科技及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。

（6）本人/本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人/本企业若违反本承诺约定的义务与责任，而给长晶科技及其控制的企业或其他股东造成损失，本人/本企业将承担连带赔偿责任。

（7）本承诺函一经签署，即构成本人/本企业不可撤销的法律义务。本承诺

函自本人/本企业签署之日起生效，其效力至本人/本企业不再是公司的控股股东/实际控制人或其一致行动人之日终止。

2、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

（1）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）不利用本人地位及控制性影响谋求长晶科技及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利；

（2）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不利用本人地位及控制性影响谋求与长晶科技及其控制的其他企业达成交易的优先条件；

（3）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员不以低于或高于市场价格的条件与长晶科技及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害长晶科技及其控制的企业利益的行为；

（4）本人承诺并促使本人控制的其他企业、与本人关系密切的家庭成员将尽量避免或减少与长晶科技及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益；

（5）本人承诺本人及本人所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长晶科技及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长晶科技及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来；

（6）本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本人若违反本承诺约定的义务与责任，而给长晶科技及其控制的企业或其他股东造成损失，本人将承担连带赔偿责任；

（7）本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。本承诺函自本人签署之日起生效，其效力至本人不再是公司董事、审计委员会成员、高级管理人员之日终止。

3、其他持股 5%以上股东南京瑞联、晨壹越腾及晨壹越腾的一致行动人晨壹佰赢关于减少和规范关联交易的承诺

（1）本企业承诺并促使本企业控制的其他企业不利用本企业地位及影响谋求长晶科技及其控制的其他企业在业务合作等方面优于市场第三方的权利。

（2）本企业承诺并促使本企业控制的其他企业不利用本企业地位及影响谋求与长晶科技及其控制的其他企业达成交易的优先条件。

（3）本企业承诺并促使本企业控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与长晶科技及其控制的企业进行交易，不会利用关联交易转移、输送利润，亦不利用关联交易从事任何损害长晶科技及其控制的企业利益的行为。

（4）本企业承诺并促使本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与长晶科技及其控制的企业之间发生关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。

（5）本企业承诺本企业及本企业所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用长晶科技及其下属子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与长晶科技及其下属子公司发生除正常业务外的一切资金往来。

（6）本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，本企业若违反本承诺约定的义务与责任，而给长晶科技及其控制的企业或其他股东造成损失，本企业将承担连带赔偿责任。

（7）本承诺函一经签署，即构成本企业不可撤销的法律义务。本承诺函自本企业签署之日起生效，其效力至本企业及本企业一致行动人合计不再持有长晶科技 5%以上股份之日终止。

（九）关于未能履行承诺的约束措施的承诺

1、发行人关于未履行承诺的约束措施的承诺

（1）公司违反关于首次公开发行股票并上市申请文件真实、准确、完整的承诺，关于稳定股价的承诺，关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏应回购股票及赔偿投资者损失的承诺等公开承诺事项的，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，公司将：

①在公司股东会或中国证监会指定的信息披露平台披露未履行公开承诺事项的详细情况，包括但不限于未履行承诺的内容、原因及后续处理等，并向公司股东和社会公众公开道歉。

②自愿接受社会监督，中国证监会等监督管理部门可以督促公司及时改正并继续履行公开承诺事项，同时接受中国证监会等监督管理部门依法进行的处理。

③因未履行公开承诺事项给公司股东和社会公众投资者造成损失的，承担相应的赔偿责任。

④承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司股东和社会公众投资者权益的，将变更承诺或提出新承诺或者提出豁免履行承诺义务，并经公司股东会审议通过，股东会应向股东提供网络投票方式。

（2）如因不可抗力原因导致公司未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

2、控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄、傅传企管关于未履行承诺的约束措施的承诺

如本企业所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的

（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本企业将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本企业在股东会审议该事项时回避表决。

如因本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本企业将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）将本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

（2）若本企业在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本企业承诺履行完毕或弥补完公司、投资者的损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将通过公司及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

3、实际控制人杨国江关于未履行承诺的约束措施的承诺

如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东会审议该事项时回避表决。

如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

（2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完公司、投资者的损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

4、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺

如本人所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本人将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本人在股东会审议该事项时回避表决。

如因本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本人将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）同意公司停止向本人发放工资、奖金或津贴等，并将此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司及投资者带来的损失。

（2）若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完公司、投

资者的损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

5、其他持股 5%以上股东及其一致行动人南京瑞联、晨壹越腾、晨壹佰赢关于未履行承诺的约束措施的承诺

如本企业所作出的相关公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）或履行相关承诺将不利于维护公司及投资者权益的，本企业将采取以下措施：

（1）通过公司及时披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（2）向公司及其投资者提出变更承诺或豁免履行承诺申请，并提交股东会审议以保护公司及其投资者的权益。本企业在股东会审议该事项时回避表决。

如因本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行给公司或投资者造成损失的，本企业将依法对公司或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）将本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。

（2）若本企业在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本企业承诺履行完毕或弥补完公司、投资者的损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将通过公司及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并积极采取变更承诺、补充承诺等方式维护公司和投资者的权益。

（十）关于业绩下滑延长锁定期的承诺

如公司上市后发生业绩大幅下滑，公司实际控制人杨国江、控股股东上海江昊及其一致行动人南京江澄和傅传企管自愿延长股份锁定期，并承诺如下：

1、发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；

2、发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月；

3、发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。

其中“届时所持股份”是指本人/本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

本人/本企业将严格履行上述承诺。如本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本人/本企业因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。

（十一）关于股东信息披露的专项承诺

本公司根据中国证监会发布的《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的相关要求，就本次发行上市中发行人股东相关事宜作出如下说明与承诺：

（1）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；

（2）本公司直接层面股东不存在股份代持情况，也不存在纠纷或潜在纠纷。本公司员工持股平台南京江澄曾存在合伙份额代持情形，合伙份额代持已经通过转让方式完成解除，不存在纠纷或者潜在纠纷。

（3）本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。

（4）除保荐机构华泰联合证券有限责任公司的控股股东华泰证券股份有限公司通过公司股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴晨壹越腾股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股份外，本次发行的中介

机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形。

（5）本公司及本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情形。

（6）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。

四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

（一）保荐机构华泰联合证券的承诺

因华泰联合证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（二）发行人律师世纪同仁的承诺

因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，但证明本所没有过错或证监会认定无责任的除外。

（三）审计机构、验资机构立信的承诺

因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（四）评估机构中联资产评估集团有限公司的承诺

若因本公司制作、出具的资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司未勤勉尽责的，将依法赔偿投资者损失。

五、股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立情况

发行人自设立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，已建立健全股东（大）会、董事会、监事会、董事会秘书制度，并在董事会下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会专门委员会，形成了较为规范的公司治理结构。

公司股东（大）会、董事会、监事会按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，制定了《股东（大）会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》等，明确了股东（大）会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书、董事会专门委员会的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。

公司召开 2025 年年度股东大会，审议通过了修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等，并决议取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会相关职权。

（二）股东（大）会、董事会和监事会的运行情况

1、股东（大）会的运行情况

自股份公司设立以来，股东（大）会的召开程序均符合《公司章程》及相关法律法规的要求，决议内容均真实有效。公司建立了较为完善的股东（大）会制度并良好运行，维护了公司和股东的合法权益。

2、董事会的运行情况

自股份公司设立以来，董事会的召开程序均符合《公司章程》及相关法律法

规的内容，决议内容均真实有效。公司建立了较为完善的董事会运行和决策机制，为规范公司的运作和高效的业务运营发挥了积极作用。

3、监事会的运行情况

自股份公司设立以来，监事会的召开程序均符合《公司章程》及相关法律法规的内容，决议内容均真实有效。公司监事会依据相关规章制度要求，独立充分行使权力，认真履行了对公司运营、董事、高级管理人员工作的监督职责，依法维护公司和全体股东的合法权益。

2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东大会，根据《公司法》的相关规定并结合实际情况，公司不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利、履行义务，积极参与公司决策，为公司治理结构的完善和规范运作起到了积极作用。公司独立董事参与了本公司本次股票发行方案、本次发行募集资金运用方案的决策，并利用专业知识，对本次股票发行方案和募集资金投资方案提出了意见。各位独立董事根据自身的专长，分别任董事会下属各专业委员会委员。各位独立董事以其专业能力和勤勉尽责精神，在公司内部控制、绩效考核、制订公司发展战略和发展计划等方面发挥了良好的作用，有力地保障了公司内部控制的有效性和经营决策的科学性。

（四）董事会秘书履职情况

公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等规定履行职责，认真筹备历次董事会会议和股东（大）会，及时向公司股东、董事、监事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，促进了公司治理结构的完善和董事会、股东（大）会职权的正常行使。

六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。截至本招股说明书签署日，各专门委员会的组成如下表所示：

名称	主任委员	成员
战略委员会	杨国江	杨国江、陈益忠、邓德强
审计委员会	邓德强	邓德强、张金隆、王楚璇
提名委员会	邓德强	杨国江、邓德强、张金隆
薪酬与考核委员会	邓德强	杨国江、邓德强、张金隆

公司各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良好。

七、募集资金具体运用情况

（一）年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目

1、项目的基本情况

本项目是公司积极把握功率半导体器件行业快速发展机遇，基于现有业务与公司未来发展战略审慎确定的。项目拟通过建设生产车间与动力车间、购置先进的自动化封装测试设备，进一步扩大并升级现有封装测试能力。一方面，提升产品自主封装测试比例，降低外协封装服务成本，提高产品利润空间与市场竞争力，增强公司盈利水平；另一方面，提升公司封装测试技术能力，推动产品向小型化、高密度、工控及车规级方向发展，满足下游市场对产品的高性能、高品质要求，提高公司在汽车电子、工业控制等高端领域的市场份额，促进公司长远可持续发展。

项目实施主体为江苏长晶浦联功率半导体有限公司，建设期 3 年，总投资金额 68,149.10 万元，主要包含建筑工程、设备购置及安装、基本预备费等投资。

2、项目建设的必要性

（1）突破产能瓶颈，满足不断增长的市场需求

功率半导体器件行业发展与下游市场运行情况息息相关。近年来，在智能手机及平板电脑产品加速迭代更新、国补政策持续加码等利好因素驱动下，消费电子行业逐步恢复增长并向好发展。同时，随着行业的快速发展，功率半导体器件产品技术不断进步升级，产品在电学性能、可靠性和质量稳定性等方面均有显著提升，能够更好的满足工业电子、通信设备领域的快速发展需求，并与汽车电动化、智能化、网联化趋势相匹配，使得功率半导体器件市场需求持续增长。

2021-2024 年期间，全球及我国功率分立器件市场规模分别从 265.88 亿美元、110.59 亿美元增长至 323.00 亿美元和 145.76 亿美元，年均复合增长率分别为 6.70%、9.64%；预计 2028 年市场规模将达到 475.19 亿美元、212.51 亿美元。作为一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，公司深耕半导体行业多年，具备较高的品牌知名度和认可度。伴随下游市场需求的持续释放，报告期内公司业务规模不断扩大，订单量快速提升，导致现有自有封装测试产线产能已接近饱和，难以满足未来快速增长的业务需求，亟需进行产能扩充。

本项目是公司积极把握功率半导体器件行业快速发展机遇，深化半导体封装测试领域布局，从而实现企业规模扩张与长远发展的战略之举。项目建设将通过新建封测生产车间并引入先进的软硬件设备，提升公司现有封装测试产线的生产能力，突破产能瓶颈，满足不断增长的下游市场及业务订单需求，保障公司经营稳定性与长远可持续发展。

（2）提高封测环节自主管控能力，强化业务竞争优势

制造能力是半导体行业相关企业获得差异化竞争优势的关键因素。拥有自主制造能力的企业，能够在维持或提升产品质量与性能的同时，提高生产效率，有效控制产品生产成本，从而获取更多产业链价值。报告期内，公司功率半导体分立器件销售收入逐年增长，对封装测试的需求也同步增加，导致现有自主封测产能缺口不断扩大，而外部封测服务成本较高，不利于公司功率半导体器件的质量管理与成本控制。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，公司亟需进一步强化自主封装测试产能，减少外协封测影响。

公司拟通过本项目，建设自主控制的高质量、高技术封测产线，强化公司功率半导体器件从产品设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。项目建成后，一方面能更好的把控产品技术与质量稳定性、可靠性，满足功率半导体器件工控及车规级技术与品质要求；另一方面，控制封测环节成本，提高产品利润空间与业务竞争力，实现公司业务可持续发展。

（3）增强公司封装测试能力，提高产品性能与技术水平

伴随我国产业结构升级、“新型基础设施建设”不断推进，下游市场对于功率半导体器件的产品性能、品质稳定性要求不断提高。尤其是伴随汽车电动化、

智能化、网联化趋势日趋显著，功率半导体器件车规级要求逐步显现，对于封装测试技术工艺能力提出更高标准。公司是国内产品门类最齐全、系列最丰富的功率半导体器件企业之一，具备上万种规格型号产品的量产能力，并且委托子公司长晶浦联进行封装测试。经过多年行业深耕与积累，长晶浦联逐步积累了 SOT 系列、SOD 系列、DFN 系列、PDFN 系列、TO 系列等多种封装形式，封测产品类型逐步由二三极管向 MOSFET、IGBT 拓展。为顺应行业性能及技术升级趋势，推动业务领域进一步拓展，公司有必要持续升级现有封测技术及工艺，提升自主封测能力，满足下游汽车等领域对于功率半导体器件的高性能、高可靠性要求，同时促进公司半导体产业链垂直整合，强化业务核心竞争优势。

公司拟通过本项目建设，新增功率半导体封测车间与相关配套设施，并健全相关文件管理体系，优化技术人员配置，以进一步提高公司功率半导体封装测试水平，推动封装测试技术向小型化、高密度方向发展，从而满足下游市场高性能、工控及车规级产品要求。项目建成后，有利于公司进一步强化产品品质、性能及业务竞争力，提高在汽车电子、工业控制等高端技术领域的市场份额，巩固并提升公司的市场地位。

3、项目建设的可行性

（1）顺应国家产业政策导向，符合国家发展战略要求

功率半导体器件产业是半导体产业的重要组成部分，并且对于国民经济与国家安全意义重大，属于国家鼓励和支持的战略性新兴产业之一。近年来，国家相关部门相继出台了多项产业扶持政策，为我国半导体封装测试行业发展营造了良好的政策环境。2021 年 3 月，全国人民代表大会通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2024 年 1 月，工信部等七部门发布的《制造业可靠性提升实施意见》提出重点提升高端通用芯片（如 SOC/MCU/GPU）、宽禁带半导体（如氮化镓/碳化硅）、传感器、射频器件可靠性。国家层面通过顶层设计规划，从财政、税收、金融、营商等多方面为半导体制造企业提供扶持与积极引导，为功率半导体器件封装测试行业技术升级、规模扩张营造了良好的政策环境。

本项目建设将进一步扩大公司自主封测产线规模，并提升封测技术水平，保持产品技术领先性和独特性，为公司业务持续拓展与在汽车半导体产业布局注入动力。项目实施符合国家发展战略与产业规划，具备可行性。

（2）良好的人才储备和技术积累，为项目实施提供有力支撑

半导体行业是典型的人才密集型与技术密集型行业，具备较高的进入门槛。公司高度重视技术研发和产品创新，基于行业先进技术发展方向组建了专业的研发团队。研发团队拥有多名具备知名半导体芯片代工企业、半导体封装测试企业工作经验的复合型人才，且团队核心骨干成员均具备 10 年以上的相关工作经验。同时，公司是国家级专精特新“小巨人”企业与高新技术企业，具备独立的产品设计能力并搭建了自主产品工艺技术平台，新产品开发能力强，产品市场导入速度快。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有专利 244 项，其中发明专利 85 项，同时拥有主营产品相关集成电路布图设计 130 项，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。

综上，公司良好的人才储备以及充足的技术储备为本项目顺利实施提供有力支撑。

（3）稳定的客户基础和良好的品牌声誉，为项目实施提供重要保障

半导体行业下游客户对于产品性能、质量稳定性与可靠性要求较高，在供应商选择方面拥有一套严格、全面的审核流程，功率半导体企业需要经过一系列测试、认证之后，才能进入客户的供应链体系。同时，客户一旦确定供应商并实现规模化应用后，不会轻易更换供应商。因此，半导体行业产业链粘性较强，具备较高的准入门槛。依托优良的产品品质、齐全的产品规格型号、坚实的研发设计能力以及快速的客户服务响应机制，公司产品在消费电子、工业控制、汽车电子、新能源、机器人及服务器等多个领域得到广泛应用，覆盖小米、三星、荣耀、传音控股、华勤技术、立讯精密、石头科技、格力电器、海尔智家、欣旺达、新能德、德赛电池、安克创新、麦格米特、创科实业（TTI）、泉峰控股、大疆创新、影石创新、中兴通讯、比亚迪、埃泰克、安瑞光电、德业股份、固德威等多家行业龙头企业。

由此可见，公司拥有稳定的优质客户资源基础，具备较高的行业声誉与品牌

知名度，能够为本项目新增产能消化提供重要保障，项目实施具备可行性。

4、项目投资概算

本项目具体投资概算如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比
1	建筑工程投资	15,820.00	23.21%
2	设备购置及安装	50,344.10	73.87%
3	基本预备费	1,985.00	2.91%
合计		**68,149.10**	**100.00%**

5、项目实施周期及进度安排

本项目预计建设期 3 年，具体进度如下表所示：

	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备工作												
工程建设												
设备询价、订购												
设备安装、调试												
生产线试运行及部分量产												
整体竣工验收												

6、项目备案程序的履行情况

本项目已经取得南京市浦口区政务服务管理办公室出具的《江苏省投资项目备案证》（浦政服备〔2026〕22 号），南京市生态环境局出具的《关于年产 100 亿颗工控及车规级功率器件封装测试产业化项目环境影响报告表的批复》（宁环（浦）建〔2026〕13 号）。

7、项目实施地点与环境保护情况

本项目建设地点位于江苏省南京市浦口区浦口开发区云实路 28 号，项目利用公司现有场地实施，不涉及新增用地。

本项目为分立器件封装测试产业化项目，不属于重度污染行业。本项目建设和运营按照清洁生产的原则，严格执行环境保护“三同时”制度；本项目将通过

购买安装相关的环保设施，对项目运营期间对环境产生影响的污染物固体废弃物、废水、废气各项污染进行规范治理。

8、项目经济效益分析

项目的税后全部投资回收期为 6.65 年（含建设期 3 年），税后投资内部收益率 17.58%，税后净现值为 25,860.49 万元（测算期间为 12 年，含 3 年建设期）。

（二）MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目

1、项目的基本情况

本项目建设地点为公司现有场地，建设周期 4 年，总投资 23,190.90 万元。本项目将在国家大力支持半导体行业技术进步和创新发展的背景下开展。公司拟通过本项目建设，加大对 MOSFET、IGBT 以及第三代半导体的技术研发及创新投入，增强自主创新能力，提高业务竞争优势，为公司长期可持续发展提供技术支持。

项目将购置先进的研发检测设备、引进相关专业人员，改善并升级现有研发相关配套基础设施资源，并围绕“宽禁带 SiC 工艺平台开发及元器件产品技术研发”、“宽禁带氮化镓元器件技术研发”、“IGBT 芯片工艺平台开发及 IGBT 器件及模块技术研发”、“新一代的 CSP 工艺平台和产品开发”、“SGT 芯片工艺平台与产品技术研发”等方向开展深度技术研发，加速研发成果落地，突破中高端功率半导体器件技术壁垒，提升产品关键技术性能指标，助力国产自主创新。

2、项目实施的必要性

（1）紧跟行业发展趋势，加速推进新技术、新产品布局

近年来，随着下游应用领域的持续拓展和深化，市场对于半导体产品高温、高压状态下的低能耗和高可靠性，以及高频高效、高度集成化提出更高要求。以汽车领域为例，新能源汽车的续航里程、充电速度、能效比等核心性能指标直接依赖分立器件的技术突破。同时，新能源汽车电压平台已经升高至 800V，对相应分立器件产品的耐压性、耐高温性、低能耗等性能提出一定挑战。现阶段提升分立器件产品性能的方式主要有两种：一种是通过改变器件结构、优化工艺设计

提升产品性能，如以沟槽结构取代平面结构的二极管、采用兼具高输入阻抗与低导通压降优势的 IGBT 等；另一种则是通过提升半导体材料性能优化产品性能，例如研发以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带半导体材料为基底的半导体产品等。

通过本次项目的实施，公司将顺应行业技术发展趋势，围绕“宽禁带碳化硅元器件研发与产业化”、“宽禁带氮化镓元器件研究”、“IGBT 产品研发与产业化”、“CSP 新平台和产品的建立”、“SGT 器件研发与产业化”等方面开展深度研发。因此，通过本次项目的实施，将有利于公司紧跟行业技术发展趋势，对 MOSFET、IGBT 等新型半导体与宽禁带半导体材料的产品进行新技术和结构研究、技术储备，巩固公司技术核心竞争力，为企业远期可持续发展奠定技术基础。

（2）突破中高端分立器件技术壁垒，助力国产自主创新

近年来我国半导体行业快速发展，行业技术水平与国际差距日益缩小。具体至功率半导体领域，现阶段我国低压分立器件产品技术水平已实现与国际接轨，并初步实现相应产品的自给自足。但在高压 IGBT、中低压 MOSFET 等中高端产品领域，由于技术研发创新难度较高，国内厂商在产品材料、工艺设备、封装技术等方面存在不足，与国际先进水平仍有较大差距，相关领域仍被欧美等海外龙头企业主导，国产自主创新空间广阔。根据芯谋研究数据，2024 年中国 IGBT、MOSFET 行业营收排名前 10 的企业中仅有五家中国厂商，主要市场仍被英飞凌、安森美等欧美龙头企业占据。由此可见，我国中高端分立器件产品国产化需求强烈。在第三代半导体研发领域，全球宽禁带半导体行业仍处于初步发展阶段，目前国内技术与国际先进技术差异较小。同时，第三代半导体可广泛应用于数据中心、人工智能、工业控制等多个国家前沿战略性行业，其国产化对于避免核心技术受制于人，保证国防安全和国民经济稳定运行意义重大。

公司拟通过本项目建设，一方面对高压 IGBT、中低压 MOSFET 等中高端功率半导体器件进行技术研发，以突破产品技术壁垒，提升国产高压 IGBT、中低压 MOSFET 产品性能，争取在产品关键技术指标方面与国际先进产品平齐；另一方面加强对第三代半导体元器件的深入研发，弥补国内中高端功率半导体器件与第三代半导体的技术不足，对于推动产品技术升级与国产自主创新，形成国内

自有专利集群有着重要意义。

（3）增强公司研发能力与自主创新能力，巩固并提升公司的行业地位

当前，新一轮科技革命和产业变革加速推进，科技创新已经成为企业生存发展的基石。新技术研发及创新是提升企业产品性能、研发和生产新产品的关键和基础，能够帮助企业持续进行产品升级、完善产品结构、增强自身服务能力与持续盈利能力。半导体行业是典型的技术密集型行业，每一轮新的技术革命和变革都将重塑行业竞争格局，并且技术变革带来的产品性能差距难以在短时间内进行复制，因此半导体行业对于相关企业的技术水平和持续创新能力提出较高要求。

公司拟通过本项目建设，为核心产品和关键技术研发提供必要配套设施，持续优化并升级现有研发条件。同时，引进专业的高素质技术人才，为相应课题研发提供人才保障，推动新技术、新产品成果转化与产业化落地。

3、项目实施的可行性

（1）项目建设符合国家政策导向，具备可行性

半导体行业作为现代信息产业的核心，其技术突破和创新发展得到国家政策的大力支持。2017 年发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将绝缘栅双极晶体管芯片（IGBT）及模块等新型元器件列入战略性新兴产业重点产品和服务目录。2020 年 9 月发改委等四部门在《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》中指出要聚焦新能源装备制造“卡脖子”问题，加快主轴承、IGBT、控制系统、高压直流海底电缆等核心技术部件研发。2021 年工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》也强调“实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。重点发展耐高温、耐高压、低损耗、高可靠半导体分立器件及模块等”。此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出要瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。其中集成电路行业重点进行集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，

碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。2023 年 6 月，工信部等五部门发布《制造业可靠性提升实施意见》，重点提升高端通用芯片（如 SOC/MCU/GPU）、宽禁带半导体（如氮化镓/碳化硅）、传感器、射频器件等的可靠性。

本次 MOSFET、IGBT 及第三代半导体技术研发项目的实施是在公司现有技术积累的基础上，对高压 IGBT、中低压 MOSFET 等中高端功率半导体器件进行研发与技术突破，并对第三代半导体相关技术进行预研与储备，推动我国半导体行业国产自主创新进程。综上，本项目建设符合国家产业政策导向，相关支持性、引导性政策的密集出台，将为行业高质量发展提供良好保障。

（2）专业的技术团队和完善的管理制度，为项目实施提供重要保障

公司所属的半导体行业是典型的技术密集型行业。人才是技术创新的源泉和基础。公司自成立以来始终将人才队伍建设作为企业发展的核心驱动力，拥有一支年轻化、知识化、专业化的研发队伍，勇于创新，开拓进取。公司研发负责人从事多年功率半导体产品研发，拥有丰富的专业知识和相关经验。与此同时，公司领导层还高度重视科技创新对于企业的推动力，搭建了完善的研发创新制度，成立了项目专项研发小组，实行项目负责人负责制，有助于缩短公司研发周期，提高预研水平与研发创新能力。

此外，公司还建立了完善的人力资源管理体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等方面工作均有着详细的规定。公司建立了相应的激励制度，激发技术人员的积极性、主动性和创造性，从不同角度和形式提升员工工作积极性，激发技术创新的热情，增强自主创新能力，多重作用促进公司人才队伍的建立、培养和积累。因此，公司专业的技术团队和完善的管理制度，为本项目顺利实施提供良好保障。

（3）坚实的研发能力与充足的技术储备，为项目建设奠定基础

公司是一家国内领先的 Fabless 与 IDM 模式并行的综合型半导体企业，具备从产品定义设计、晶圆制造到封装测试的一体化生产经营能力。公司主营产品涵盖二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立器件、电源管理 IC、分立器件晶圆等多种半导体产品。作为国家级专精特新“小巨人”企业与高新技术企业，公司高度重视技术研发和产品创新，基于行业先进技术发展方向组建了专业的研发团

队，具备独立的产品设计能力并搭建了自主产品工艺技术平台，新产品开发能力强，产品市场导入速度快。

凭借较强的研发创新能力和丰厚的技术积累，公司连续多年入选“中国半导体行业功率器件十强企业”，并且公司承担了江苏省重点研发计划“低功耗高可靠超结 MOS 器件关键技术研究”和南京市江北新区重点研发计划“超低内阻晶圆级封装功率 MOS 器件”等重大科研项目，在超结结构设计、晶圆级封装等关键技术领域取得突破性进展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司取得了“一种低导通电阻沟槽式 MOSFET 结构及其制备方法”、“芯片封装结构、方法和半导体器件”、“屏蔽栅沟槽 MOSFET 及其制备方法、电子设备”、“一种基于 DFN 封装的散热装置”等 244 项专利，其中发明专利 85 项，并拥有主营产品相关集成电路布图设计 130 项，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。

4、项目投资测算

本项目总投资的概算表如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占总投资额的比例
1	设备购置	2,945.90	12.70%
2	研发人员投入	6,735.00	29.04%
3	研发实施费用	13,510.00	58.26%
合计		**23,190.90**	**100.00%**

5、项目实施周期及进度安排

本项目预计建设期 4 年，具体进度如下表所示：

	T+1				T+2				T+3				T+4			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备																
人员招聘及培训																
设备购置及安装调试																
技术研发																

6、项目备案程序的履行情况

本项目已经取得南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室出具的江苏

省投资项目备案证（宁新区管审备〔2026〕538 号）。

本项目不涉及生产加工环节，不会对周围环境产生不良影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本项目无需取得环评批复或者环评备案。

7、项目实施地点与环境保护情况

本项目建设地点位于江苏省南京市自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座，不涉及新增用地。

本项目不涉及生产加工环节，不会对周围环境产生不良影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本项目无需取得环评批复或者环评备案。

8、项目经济效益分析

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但将提升公司整体研发实力及核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。

（三）电源管理 IC 技术研发项目

1、项目的基本情况

本项目实施主体为江苏长晶科技股份有限公司，建设周期 4 年，总投资 20,700.00 万元。公司拟通过本项目建设，进一步扩大研发投入，购置专业研发检测设备并引入优秀研发技术人员。

项目建成后，一方面将进一步强化公司自主研发创新能力，持续推动电源管理 IC 产品技术升级，满足下游客户高效率、低功耗、高集成度、高精度产品升级需求，同时突破行业技术壁垒，实现关键工艺及核心技术的自主控制，推动高端电源管理 IC 产品国产化进程；另一方面，本项目将围绕“高精度模拟前端芯片”、“高性能 DrMOS 驱动”、“高压大电流智能马达驱动芯片”、“车载摄像头 PMU”等前瞻性开展技术研发，把握行业前沿技术与发展趋势，巩固及提升公司在行业中的技术地位，助力公司实现远期战略目标。

2、项目建设的必要性

（1）顺应电源管理 IC 技术发展方向，把握行业重要机遇

电源管理 IC 作为电子装备的核心关键器件，广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制、通信设备、人工智能等国民经济的众多领域。随着我国产业转型调整与“新型基础设施建设”的不断推进，下游行业呈现快速发展态势，对于电源管理 IC 的市场需求持续增加。相关数据显示，全球及我国电源管理 IC 市场规模呈现稳定增长趋势，2024 年全球电源管理芯片市场规模约 486 亿美元，预计 2025 年将达到 526 亿美元；同期我国电源管理芯片市场规模从 2020 年的 768 亿元增长至 2024 年的 1,246 亿元，预计 2025 年将达到 1,417 亿元。另一方面，伴随汽车电动化、智能化、网联化发展不断深入，以及 AI、云计算等新兴领域的快速崛起，电源管理 IC 重要性持续提升，下游客户对于高效率、低功耗、高集成度、高精度产品需求不断增加，电源管理 IC 产品技术升级与性能提升也成为产业链制造企业差异化竞争的关键。因此，公司有必要积极把握行业重要发展机遇，加大相关高端、前沿技术研发投入，不断调整和优化现有产品结构，更好的满足下游客户持续增长与快速升级的产品需求，提高公司核心竞争力。

公司将通过本项目建设，积极跟进行业技术整体升级趋势，针对“高精度模拟前端芯片”、“高性能 DrMOS 驱动”、“高压大电流智能马达驱动芯片”、“车载摄像头 PMU”等前沿技术发展方向进行预研，提升公司电源管理 IC 业务竞争力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，项目将助力公司积极抢占市场份额，把握不断增长的下游市场需求，推动公司健康可持续发展。

（2）推动关键技术自主可控，加速高端产品国产化进程

电源管理 IC 是所有电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需电能的变换、分配、检测等管控功能。作为集成电路产业链的关键环节，近年来电源管理 IC 行业发展得到了国家层面的重点关注与大力扶持，并且被纳入多项重大科技专项与产业发展规划，行业取得长足进步，中低端产品国产化水平取得显著突破，并逐步向车规级、高功率密度等高端产品领域迈进。但是，高效率、高压、高精度的高端电源管理 IC 产品存在较高技术壁垒，国内相关制造企业在自主创新、结构设计、研发设备、工艺精度等方面与国际龙头企业相比存在一定差距，高端

产品国产自主创新需求强烈。例如，用于动力电池以及高压储能领域的模拟前端（AFE）市场主要被 TI、ADI、NXP 等外资企业占据，国产企业参与者较少，国产自主创新是必然趋势。自成立以来，公司始终秉持“创造世界一流半导体品牌”的发展愿景，以实现我国功率半导体领域关键核心技术的自主可控为己任，努力锻造技术优势，持续深耕及推动电源管理 IC 业务快速、稳健与可持续发展。

本项目是公司贯彻企业战略目标与发展愿景的重要举措。项目将进一步加大在电源管理 IC 核心技术与前沿技术领域的研发投入，整合并升级现有研发资源，针对高精度模拟前端芯片等高端产品进行技术研发，突破行业技术壁垒，实现核心技术自主可控，推动产品技术升级与国产化进程。

（3）改善研发资源条件，提高公司自主研发创新能力

自成立以来，公司凭借一体化生产经营能力、丰富的产品规格型号以及坚实的自主研发实力，连续多年入选“中国半导体行业功率器件十强企业”，在行业内具备较高影响力。公司始终奉行“研发驱动”的发展战略，高度重视基础科学研究与产品工艺创新，大力投入研发资源，设立多层次研发机构，对技术创新实施针对性奖励。立足于公司的业务发展现状及行业目标定位，未来公司将持续加强自主研发创新能力，提高核心工序加工精度与生产效率，以保障核心技术的创新性与领先性，推动企业长远发展。

本项目将为公司相关前沿技术预研提供必要的实验设备和实验材料，为公司持续创新与技术升级提供良好的外部环境保障。同时，将进一步扩充现有研发团队，培育良好的研发梯队，形成人才与技术螺旋上升的效应。项目建成后，有助于增强公司自主创新能力，加速相关研发课题的转化效率，促进企业健康、可持续发展。

3、项目建设的可行性

（1）国家积极引导性政策密集出台，为项目顺利实施提供重要支持

作为现代信息产业的核心，近年来我国先后出台了多项支持性、引导性产业政策，为半导体产业高质量发展提供良好的政策环境。2021 年 6 月，工信部等六部门发布的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》指出加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成

电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。2022 年 6 月，工信部等多部门颁布《工业能效提升行动计划》，提出推动低功耗芯片等产品和技术在移动通信网络中的应用，推动电源、空调等配套设施绿色化改造。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展》、《制造业可靠性提升实施意见》、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》、《关于推动技能强企工作的指导意见》等一系列政策，强调支持集成电路产业创新发展与技术突破。在上述政策推动下，相关企业不断加大研发投入力度，带动行业技术水平持续提高与不断升级。

综上，本项目是公司响应国家产业政策指导方向的重要措施，项目在宏观政策层面具有可行性。

（2）公司拥有丰富的研发资源，技术实力强劲，保障项目顺利实施

公司拥有一支涵盖数学、物理、化学、材料、机械、信息和计算机等交叉学科背景的复合型人才团队，团队内主要成员在半导体行业从业经验达 10 年以上，并且拥有知名半导体芯片代工企业、半导体封装测试企业的工作经验。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有专利 244 项，其中发明专利 85 项，同时拥有主营产品相关集成电路布图设计 130 项，形成了具有自主知识产权的核心技术体系。

在电池管理 IC 产品领域，公司通过架构创新和电路优化实现了高耐压、低静态功耗、高 PSRR、低噪声、快速瞬态响应等核心指标的提升，并且积累了“一种基于数码雷管应用的 LDO 优化电路”、“一种供电电源的升降压控制系统及其控制方法”、“改善低压差线性稳压器全负载稳定性的补偿方法及其电路”、“一种线性稳压器的线损补偿方法及其电路”等多项前沿技术，能够为公司后续在电源管理 IC 产品领域进行持续研发与成果转化奠定基础。因此，公司夯实的研发创新实力与丰富的技术资源储备，保障了本项目的顺利实施。

4、项目投资概算

本项目总投资的概算表如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	占比
1	设备购置	300.00	1.45%
2	研发人员投入	12,900.00	62.32%

序号	项目	总投资金额	占比
3	研发实施费用	7,500.00	36.23%
合计		**20,700.00**	**100.00%**

5、项目实施周期及进度安排

本项目预计建设期 4 年，具体进度如下表所示：

	T+1				T+2				T+3				T+4			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备																
人员招聘及培训																
设备购置及安装调试																
技术研发																

6、项目备案程序的履行情况

本项目已经取得南京江北新区管理委员会政务服务管理办公室出具的江苏省投资项目备案证（宁新区管审备〔2026〕561 号）。

本项目不涉及生产加工环节，不会对周围环境产生不良影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本项目无需取得环评批复或者环评备案。

7、项目实施地点与环境保护情况

本项目建设地点位于江苏省南京市自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座，不涉及新增用地。

本项目不涉及生产加工环节，不会对周围环境产生不良影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》等相关规定，本项目无需取得环评批复或者环评备案。

8、项目经济效益分析

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但将提升公司整体研发实力及核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。

（四）补充流动资金

1、项目概况

综合考虑公司自身经营特点、银行负债情况及业务发展规划等情况，公司拟将本次募集资金中的 37,000.00 万元用于补充流动资金，以优化资产结构，降低财务风险，同时满足公司日常业务的资金需求。

2、补充流动资金的必要性与合理性

（1）业务规模增长需要流动资金的支持

近年来，随着业务规模的快速增长，公司应收账款、预付账款等规模也相应提升，对流动资金的需求也随之增长。本次补充流动资金有助于公司主营业务持续稳定增长。

（2）研发和生产对流动资金需求较大

针对车规级功率二极管、功率 MOSFET、IGBT、宽禁带半导体器件以及中高端电源管理 IC 等产品，技术研发壁垒高，核心工艺与人才引进难度大；下游新能源、汽车电子、高端工控等领域客户准入标准严苛，产品可靠性认证、批量导入周期长，研发及验证环节存在一定不确定性。上述全流程均需要充足的流动资金提供保障。伴随公司持续布局高端分立器件、第三代半导体及多品类电源管理 IC，公司整体流动资金需求将持续增加。

（3）补充流动资金有助于优化资本结构、提升抗风险能力

使用募集资金补充流动资金可以有效降低公司融资成本、减少财务费用，有利于优化公司资本结构、提升公司抗风险能力。

3、项目管理运行安排

公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及公司的《募集资金管理制度》，根据业务发展真实需要使用上述流动资金，科学安排资金的使用方向、进度和金额，以确保募集资金的安全及使用效率。

八、其他子公司及参股公司简要情况

（一）长晶微电子

公司名称	深圳长晶微电子有限公司
成立时间	2019 年 4 月 8 日
注册资本	500.00 万元人民币
实收资本	402.00 万元人民币
注册地址	深圳市龙岗区布吉街道文景社区广场路中安大厦 1803-11
主要生产经营地	深圳市龙岗区布吉街道文景社区广场路中安大厦 1803-11
主营业务情况	主要负责可控硅和大功率 TVS 二极管的销售
在发行人业务板块中定位	是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人持股 75.00%，刘宗贺持股 25.00%

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	3,039.99	1,451.71	5,464.41	265.27

注：以上财务数据经立信审计，下同

（二）长华智芯

公司名称	南京长华智芯微电子有限公司
成立时间	2020 年 11 月 20 日
注册资本	100.00 万元人民币
实收资本	100.00 万元人民币
注册地址	南京市浦口区云实路 28 号
主要生产经营地	南京市浦口区江淼路 88 号腾飞大厦 C 座
主营业务情况	主要负责部分半导体产品的设计
在发行人业务板块中定位	是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人全资子公司深圳长晶持股 100%

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	1,340.52	1,340.52	-	0.85

（三）香港长晶

公司名称	长晶科技（香港）有限公司
成立时间	2009 年 12 月 24 日
注册资本	1.00 万港币
注册地址	香港九龙观塘兴业街 19 号明生工业大厦前座 10 楼 1009 室
主营业务情况	主要负责半导体产品的境外及港澳台地区销售
在发行人业务板块中定位	是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人全资子公司深圳长晶持股 100.00%

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	5,754.88	4,462.37	11,415.49	819.23

（四）南京顺芯

公司名称	南京顺芯管理咨询有限公司
成立时间	2018 年 11 月 29 日
注册资本	28,231.31 万元
实收资本	28,231.31 万元
注册地址	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1085 室
主要生产经营地	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1085 室
主营业务情况	未开展实际经营业务
在发行人业务板块中定位	持有发行人对全资子公司新顺微的股权
股东构成及控制情况	发行人全资子公司

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	27,783.26	27,754.26	-	-0.04

（五）长芯检测

公司名称	南京长芯检测科技有限公司
成立时间	2021 年 9 月 6 日
注册资本	2,000.00 万元人民币
实收资本	2,000.00 万元人民币

注册地址	南京市浦口区大余所路 5 号 7 号楼 2 楼
主要生产经营地	南京市浦口区大余所路 5 号 7 号楼 2 楼
主营业务情况	主要负责功率器件和 IC 产品的可靠性检测和失效分析业务
在发行人业务板块中定位	为发行人提供功率器件和 IC 产品的可靠性检测和失效分析服务
股东构成及控制情况	发行人全资子公司

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	3,329.18	2,578.95	1,241.67	307.58

（六）上海长晶

公司名称	长晶（上海）半导体有限公司
成立时间	2024 年 9 月 27 日
注册资本	50.00 万元人民币
实收资本	50.00 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区老芦公路 536 号
主要生产经营地	上海市浦东新区东育路 221 弄 11 号前滩世贸中心三期 B 栋 704 室
主营业务情况	主要负责分立器件的销售
在发行人业务板块中定位	是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人全资子公司

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	42.46	-245.15	-	-274.34

（七）Universal

公司名称	UNIVERSAL SEMICONDUCTOR PTE. LTD.
成立时间	2024 年 11 月 19 日
注册资本	10,000.00 元新币
实收资本	10,000.00 元新币
注册地址	新加坡巴耶利峇广场巴耶利峇路 60 号 12 楼 03 室（邮编 409051）
主要生产经营地	新加坡巴耶利峇广场巴耶利峇路 60 号 12 楼 03 室（邮编 409051）
主营业务情况	主要负责分立器件的销售
在发行人业务板块	是发行人主营业务的组成部分

中定位	
股东构成及控制情况	发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	6.99	5.37	-	-0.09

（八）长晶联合

公司名称	江苏长晶联合电子有限公司
成立时间	2025 年 11 月 20 日
注册资本	1,000.00 万元人民币
实收资本	200.00 万元人民币
注册地址	江苏省南京市浦口区浦口经济开发区百合路 121 号-682
主要生产经营地	江苏省南京市浦口区浦口经济开发区百合路 121 号-682
主营业务情况	主要负责分立器件的销售
在发行人业务板块中定位	是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人全资子公司

主要财务数据（单位：万元）

日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 12 月 31 日/2025 年度	198.08	180.64	-	-19.36

（九）G&C

公司名称	G&C MICROTECH COMPANY LIMITED
成立时间	2026 年 1 月 9 日
注册资本	10,000,000,000 越南盾
实收资本	10,000,000,000 越南盾
注册地址	Tầng 18, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
主要生产经营地	Tầng 18, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
主营业务情况	主要负责分立器件的销售
在发行人业务板块中定位	是发行人主营业务的组成部分
股东构成及控制情况	发行人全资子公司深圳长晶的全资子公司 Universal 的参股公司

注：G&C 于 2026 年 1 月成立，尚未开展实质经营。

第十三节 附表

附表一：专利权

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
1	长晶科技	发明专利	2020104046090	承载半导体组件的基板结构、半导体晶圆与晶圆制造方法	2020-5-14	原始取得	专利权维持
2	长晶科技	发明专利	202010446120X	一种低导通电阻沟槽式 MOSFET 结构及其制备方法	2020-5-25	原始取得	专利权维持
3	长晶科技	发明专利	2020104521751	一种线性稳压器的线损补偿方法及其电路	2020-5-26	原始取得	专利权维持
4	长晶科技	发明专利	2020104524016	改善低压差线性稳压器全负载稳定性的补偿方法及其电路	2020-5-26	原始取得	专利权维持
5	长晶科技	发明专利	2020107147229	一种供电电源的升降压控制系统及其控制方法	2020-7-23	原始取得	专利权维持
6	长晶科技	发明专利	2020110873141	一种沟槽型 MOSFET 的制造方法及其结构	2020-10-13	原始取得	专利权维持
7	长晶科技	发明专利	2021103551788	一种屏蔽栅-沟槽型 MOSFET 的结构及其制造方法	2021-4-1	原始取得	专利权维持
8	长晶科技	发明专利	2021105747798	一种减少高压厚栅氧 MOS 管的电池 0V 禁止充电电路	2021-5-26	原始取得	专利权维持
9	长晶科技	发明专利	2021107595291	一种 3D 堆叠且背部导出的扇出型封装结构及其制造方法	2021-7-6	原始取得	专利权维持
10	长晶科技	发明专利	2021108222378	一种屏蔽栅沟槽型 MOSFET 结构及其制造方法	2021-7-21	原始取得	专利权维持
11	长晶科技	发明专利	2021111432475	晶片尺寸封装	2021-9-28	原始取得	专利权维持
12	长晶科技	发明专利	2021114365824	一种基于可塑性基板的芯片 3D 堆叠的封装结构及其制造方法	2021-11-30	原始取得	专利权维持
13	长晶科技	发明专利	2021115928431	一种防止误操作的低功耗控制端口	2021-12-24	原始取得	专利权维持
14	长晶科技	发明专利	2021116069083	一种快速响应的高速线性稳压器	2021-12-27	原始取得	专利权维持
15	长晶科技	发明专利	2022100885103	一种基准和运放合二为一的线性稳压器	2022-1-26	原始取得	专利权维持
16	长晶科技	发明专利	2022102744627	一种集成防反向电流的电子保险丝电路	2022-3-21	原始取得	专利权维持
17	长晶科技	发明专利	2022102792387	一种高压线性稳压器	2022-3-22	原始取得	专利权维持
18	长晶科技	发明专利	2022103526348	一种低噪声基准电路及其低压差线性稳压电路	2022-4-6	原始取得	专利权维持
19	长晶科技、长晶浦联	发明专利	2022103571254	一种集成电流采样功能的超结器件	2022-4-7	原始取得	专利权维持
20	长晶科技、长晶浦联	发明专利	2022103707273	一种超低比导的超结 MOSFET 及其制备方法	2022-4-11	原始取得	专利权维持
21	长晶科技、长晶浦联	发明专利	2022103707396	一种改善体二极管特性的超结器件	2022-4-11	原始取得	专利权维持
22	长晶科技	发明专利	2022104180760	一种改善全负载稳定性的 LDO 电路	2022-4-21	原始取得	专利权维持
23	长晶科技	发明专利	2022111128164	一种超结半导体器件及其制造方法	2022-9-14	原始取得	专利权维持
24	长晶科技	发明专利	2022112768647	一种芯片封装结构及芯片封装方法	2022-10-19	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
25	长晶科技	发明专利	2022115689740	一种双向 TVS 器件的制造方法及结构	2022-12-8	原始取得	专利权维持
26	长晶科技	发明专利	2022115874883	一种碳化硅功率器件以及开关器件	2022-12-12	原始取得	专利权维持
27	长晶科技	发明专利	2022115890034	一种增强型氮化镓高电子迁移率晶体管制造方法及器件	2022-12-12	原始取得	专利权维持
28	长晶科技	发明专利	2022116702189	一种纳安级别消耗的低功耗 LDO 电路	2022-12-26	原始取得	专利权维持
29	长晶科技	发明专利	202310049113X	碳化硅 MOSFET 器件及其制备方法、芯片	2023-2-1	原始取得	专利权维持
30	长晶科技	发明专利	2023103112722	一种沟槽 MOSFET 器件的制造方法及其结构	2023-3-28	原始取得	专利权维持
31	长晶科技	发明专利	2023102247915	一种碳化硅功率器件及开关元件	2023-3-10	原始取得	专利权维持
32	长晶科技	发明专利	2023103100212	一种集成电路的电压基准电路	2023-3-28	原始取得	专利权维持
33	长晶科技	发明专利	2023102701147	一种采用自举技术实现低压运放应用于高压的电路	2023-3-20	原始取得	专利权维持
34	长晶科技	发明专利	2023108010138	用于芯片测试流程的分析方法、系统、设备及存储介质	2023-7-3	原始取得	专利权维持
35	长晶科技	发明专利	2022110672103	一种碳化硅功率器件	2022-9-1	原始取得	专利权维持
36	长晶科技	发明专利	2022111946420	一种金属封装方法及结构	2022-9-29	原始取得	专利权维持
37	长晶科技	发明专利	2022115815599	一种高压双向晶闸管的制造方法及结构	2022-12-8	原始取得	专利权维持
38	长晶科技	发明专利	202311146487X	一种基于 3D 打印的凸点制作方法及芯片封装结构	2023-9-7	原始取得	专利权维持
39	长晶科技	发明专利	2022115692438	一种包括两步湿刻的双向 TVS 器件的制造方法	2022-12-8	原始取得	专利权维持
40	长晶科技	发明专利	2022115692245	一种具有BPTM结构的TVS器件及其制造方法	2022-12-8	原始取得	专利权维持
41	长晶科技	发明专利	2020109061595	屏蔽栅沟槽 MOSFET 及其制备方法、电子设备	2020-9-1	原始取得	专利权维持
42	长晶科技、长晶浦联	发明专利	2022103571659	一种超结终端结构	2022-4-7	原始取得	专利权维持
43	长晶科技、长晶浦联	发明专利	2022103707377	一种改善栅电容特性的超结 MOSFET	2022-4-11	原始取得	专利权维持
44	长晶科技	发明专利	2025100004852	一种实现恒功率控制的限流电路、线性稳压器	2025-1-2	原始取得	专利权维持
45	长晶科技	发明专利	2025100004871	一种零温度系数的基准电路	2025-1-2	原始取得	专利权维持
46	长晶科技	发明专利	2025104583727	一种消除电压钳位的屏蔽栅场效应晶体管及其制备方法	2025-4-14	原始取得	专利权维持
47	长晶科技	发明专利	2025105122840	一种源区掺杂调制 IGBT 结构及制备方法	2025-4-23	原始取得	专利权维持
48	长晶科技	发明专利	2025109200942	半导体结构的制备方法	2025-7-4	原始取得	专利权维持
49	长晶科技	发明专利	2025109630353	屏蔽栅场效应晶体管的制备方法和半导体结构	2025-7-14	原始取得	专利权维持
50	长晶科技	发明专利	2025113003148	堆叠型屏蔽栅场效应晶体管及其制备方法	2025-9-12	原始取得	专利权维持
51	海德半导体	发明专利	2017109177443	贴片二极管防应力自动成型工艺	2017-9-30	原始取得	专利权维持
52	海德半导体	发明专利	2017109386913	二极管高效针转移装片工艺	2017-9-30	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
53	海德半导体	发明专利	2018100455414	一种芯片封装超声波焊接工艺	2018-1-17	原始取得	专利权维持
54	长晶浦联	发明专利	2021114872566	屏蔽栅沟槽型场效应晶体管的制作方法及其器件	2021-12-8	原始取得	专利权维持
55	长晶浦联	发明专利	2021114872250	一种屏蔽栅沟槽场效应管制造方法及屏蔽栅沟槽场效应管	2021-12-8	原始取得	专利权维持
56	长晶浦联	发明专利	2021116148649	晶圆切割保护方法及具有切割保护环的晶圆	2021-12-28	原始取得	专利权维持
57	长晶浦联	发明专利	2022104011122	一种半导体封装打线结构	2022-4-18	原始取得	专利权维持
58	长晶浦联	发明专利	2022109416089	一种电磁屏蔽封装结构及制作方法	2022-8-8	原始取得	专利权维持
59	长晶浦联	发明专利	202211075697X	三维立体封装结构及其制作方法	2022-9-5	原始取得	专利权维持
60	长晶浦联	发明专利	2022115604776	一种芯片封装结构及其制作方法	2022-12-7	原始取得	专利权维持
61	长晶浦联	发明专利	2023100233138	一种扁平无引脚元件及其封装方法	2023-1-9	原始取得	专利权维持
62	新顺微	发明专利	2010101197112	可控硅器件的复合平面终端钝化方法	2010-3-4	原始取得	专利权维持
63	新顺微	发明专利	2011101750143	适用于共晶封装的半导体芯片背面金属化方法	2011-6-27	原始取得	专利权维持
64	新顺微	发明专利	2012101477517	测试分立器件三极管芯片正向与饱和压降的方法	2012-5-14	原始取得	专利权维持
65	新顺微	发明专利	2013101426702	在半导体硅片上淀积与掺杂 Pt 的工艺方法	2013-4-24	原始取得	专利权维持
66	新顺微	发明专利	2013103578625	适用于半导体芯片的单面腐蚀装置	2013-8-16	原始取得	专利权维持
67	新顺微	发明专利	2014100644901	一种可调恒流源集成芯片及制造方法	2014-2-26	原始取得	专利权维持
68	新顺微	发明专利	201410260298X	检测半导体芯片背面金属层分离的方法	2014-6-12	原始取得	专利权维持
69	新顺微	发明专利	201810397906X	一种高压 VDMOS 器件的制造方法	2018-4-28	原始取得	专利权维持
70	新顺微	发明专利	2018103979178	一种复合型 TMBS 器件及其制造方法	2018-4-28	原始取得	专利权维持
71	新顺微	发明专利	2019103377407	一种改善结终端延伸结构三极管可靠性的器件结构及其制造方法	2019-4-25	原始取得	专利权维持
72	新顺微	发明专利	202010146744X	一种 MOS 结构沟槽二极管器件及其制造方法	2020-3-5	原始取得	专利权维持
73	新顺微	发明专利	2020101492102	PNP 型低 BV_{EBO} 达林顿三极管器件结构及制造方法	2020-3-6	原始取得	专利权维持
74	新顺微	发明专利	2020101492969	双胞封装肖特基二极管芯片的双芯隔离结构及制造方法	2020-3-6	原始取得	专利权维持
75	新顺微	发明专利	2021103073606	高温高压的钳位保护的器件结构及制造方法	2021-3-23	原始取得	专利权维持
76	新顺微	发明专利	2021103080474	双极晶体管集成高压启动电阻的器件结构及制造方法	2021-3-23	原始取得	专利权维持
77	新顺微	发明专利	2021103666866	一种提高沟槽 MOS 结构肖特基二极管性能的工艺方法	2021-4-6	原始取得	专利权维持
78	新顺微	发明专利	2022106777742	一种高速软恢复高压肖特基二极管器件及制造方法	2022-6-15	原始取得	专利权维持
79	新顺微	发明专利	2022106970504	带反向放大作用的吸收二极管器件结构及制造方法	2022-6-20	原始取得	专利权维持
80	新顺微	发明专利	2022108831224	一种新型终端结构的肖特基二极管的制造方法	2022-7-26	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
81	长晶微电子	发明专利	2022104139130	超低压低容单向保护器及其制作方法	2022-4-20	原始取得	专利权维持
82	长晶微电子	发明专利	2023112487192	单向浪涌防护装置及其制作方法	2023-9-25	原始取得	专利权维持
83	长晶微电子	发明专利	2025110205561	非对称的半导体放电管芯片及其制作方法	2025-7-24	原始取得	专利权维持
84	长芯检测	发明专利	2023117053946	一种 IC 封装样品内非导电胶失效确定方法及系统	2023-12-12	原始取得	专利权维持
85	长芯检测	发明专利	202211345268X	一种可区分增强型和耗尽型 MOS 晶体管的染色溶液及其应用	2022-10-31	原始取得	专利权维持
86	长晶科技	实用新型	2019211601132	一种新型 IC 测试座	2019-7-23	原始取得	专利权维持
87	长晶科技	实用新型	2019211601217	一种改进型引线框架	2019-7-23	原始取得	专利权维持
88	长晶科技	实用新型	2019211601236	一种 IC 软化槽的水循环保温系统	2019-7-23	原始取得	专利权维持
89	长晶科技	实用新型	201921160126X	一种划片机自动清洗用转盘	2019-7-23	原始取得	专利权维持
90	长晶科技	实用新型	2019211601293	一种半导体框架材料清洗用甩干桶	2019-7-23	原始取得	专利权维持
91	长晶科技	实用新型	2019211601359	一种半导体封装用切筋机安全防护装置	2019-7-23	原始取得	专利权维持
92	长晶科技	实用新型	2019211601560	一种划片机划片去离子水流量自动报警装置	2019-7-23	原始取得	专利权维持
93	长晶科技	实用新型	2019211601630	一种去离子水电阻率报警装置	2019-7-23	原始取得	专利权维持
94	长晶科技	实用新型	2019211605966	一种带有自动监测报警功能的化学软化槽	2019-7-23	原始取得	专利权维持
95	长晶科技	实用新型	2019211605985	一种封装三极管的胶口结构	2019-7-23	原始取得	专利权维持
96	长晶科技	实用新型	2019211606066	一种半导体封装用排片机的一体式滚轮	2019-7-23	原始取得	专利权维持
97	长晶科技	实用新型	201921160616X	一种测试打印编带机用振动盘	2019-7-23	原始取得	专利权维持
98	长晶科技	实用新型	2019211606174	一种三极管	2019-7-23	原始取得	专利权维持
99	长晶科技	实用新型	2019211606263	一种 SMD 半自动编带机	2019-7-23	原始取得	专利权维持
100	长晶科技	实用新型	2019211663410	一种三极管切筋机	2019-7-23	原始取得	专利权维持
101	长晶科技	实用新型	2019211908386	一种芯片利用率控制系统	2019-7-26	原始取得	专利权维持
102	长晶科技	实用新型	2019211908719	一种新型手持电子血压计	2019-7-26	原始取得	专利权维持
103	长晶科技	实用新型	2019211908757	一种高精度数字晶体管电阻测试装置	2019-7-26	原始取得	专利权维持
104	长晶科技	实用新型	2019211908780	一种三端稳压器用检测装置	2019-7-26	原始取得	专利权维持
105	长晶科技	实用新型	2019211908865	一种电子血压计线路控制系统	2019-7-26	原始取得	专利权维持
106	长晶科技	实用新型	2019211908901	一种手工检测双芯片产品的测试装置	2019-7-26	原始取得	专利权维持
107	长晶科技	实用新型	201921190894X	一种用于线性充电的 PNP 型三极管	2019-7-26	原始取得	专利权维持
108	长晶科技	实用新型	2019211908973	一种基于数码雷管应用的 LDO 优化电路	2019-7-26	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
109	长晶科技	实用新型	2019211909054	一种集成电路散热型引脚结构	2019-7-26	原始取得	专利权维持
110	长晶科技	实用新型	201921191400X	一种 431 应用电路优化系统	2019-7-26	原始取得	专利权维持
111	长晶科技	实用新型	2019211914226	一种 CJ431 应用电阻匹配装置	2019-7-26	原始取得	专利权维持
112	长晶科技	实用新型	2019211914245	一种基于 DFN 封装的散热装置	2019-7-26	原始取得	专利权维持
113	海德半导体	实用新型	2023234604875	一种便于上锡的引线框架	2023-12-19	原始取得	专利权维持
114	海德半导体	实用新型	2023234604998	一种检验装置	2023-12-19	原始取得	专利权维持
115	海德半导体	实用新型	202323554836X	一种测试用固定装置	2023-12-26	原始取得	专利权维持
116	海德半导体	实用新型	2023234604930	一种去废机自动抬料装置	2023-12-19	原始取得	专利权维持
117	海德半导体	实用新型	2023232720049	一种自动上料装置	2023-12-1	原始取得	专利权维持
118	海德半导体	实用新型	2023232720284	一种调节型收料装置	2023-12-1	原始取得	专利权维持
119	海德半导体	实用新型	2023200959450	一种自动吹气的切筋装置	2023-2-1	原始取得	专利权维持
120	海德半导体	实用新型	202223448936X	一种贴片二极管	2022-12-23	原始取得	专利权维持
121	海德半导体	实用新型	2023201290082	一种双头同步写锡装置	2023-1-17	原始取得	专利权维持
122	海德半导体	实用新型	2023200959499	一种碎屑筛分装置	2023-2-1	原始取得	专利权维持
123	海德半导体	实用新型	2023200959516	一种料片测量用固定装置	2023-2-1	原始取得	专利权维持
124	海德半导体	实用新型	202320128909X	一种封装入料定位机构	2023-1-17	原始取得	专利权维持
125	海德半导体	实用新型	2022234579474	一种自动回收废料的扩膜装置	2022-12-23	原始取得	专利权维持
126	海德半导体	实用新型	202223449016X	一种具有防呆功能的预热装置	2022-12-23	原始取得	专利权维持
127	海德半导体	实用新型	2023201308404	一种对插式框架	2023-1-17	原始取得	专利权维持
128	海德半导体	实用新型	202123098271X	一种矩阵式框架辅助下料装置	2021-12-10	原始取得	专利权维持
129	海德半导体	实用新型	2021231498945	一种框架放反联动报警生产装置	2021-12-15	原始取得	专利权维持
130	海德半导体	实用新型	2021231521091	一种一次性投料装置	2021-12-15	原始取得	专利权维持
131	海德半导体	实用新型	2021231521000	一种入口分管机构	2021-12-15	原始取得	专利权维持
132	海德半导体	实用新型	202123098264X	一种用于验证铝线焊接可靠性的拉力检测装置	2021-12-10	原始取得	专利权维持
133	海德半导体	实用新型	2021231168216	一种双摆臂固晶装置	2021-12-10	原始取得	专利权维持
134	海德半导体	实用新型	2021230964444	一种矩阵式二极管材料自动拾取包装装置	2021-12-10	原始取得	专利权维持
135	海德半导体	实用新型	2020230728038	一种防卡死送料装置	2020-12-18	原始取得	专利权维持
136	海德半导体	实用新型	2020230727798	一种适用于 TO-220 和 TO-220F 封装的兼容型检测机	2020-12-18	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
137	海德半导体	实用新型	2020230847802	一种通用型测试夹具	2020-12-18	原始取得	专利权维持
138	海德半导体	实用新型	2020230656576	一种便于观察的芯片检查盘	2020-12-18	原始取得	专利权维持
139	海德半导体	实用新型	2020230656608	一种适用于 SMA 和 SOD 芯片的改进型导模	2020-12-18	原始取得	专利权维持
140	海德半导体	实用新型	2020230728254	一种改进型软焊料装片机	2020-12-18	原始取得	专利权维持
141	海德半导体	实用新型	2019221986288	带自保护功能的切晶冲床	2019-12-10	原始取得	专利权维持
142	海德半导体	实用新型	2019221986451	一种自动拉丝装置	2019-12-10	原始取得	专利权维持
143	海德半导体	实用新型	2019221984441	集成化测试片组	2019-12-10	原始取得	专利权维持
144	海德半导体	实用新型	2019221986358	一种带回收功能的回流焊装置	2019-12-10	原始取得	专利权维持
145	海德半导体	实用新型	2019221984935	一种具有防粘锡膏功能的粘胶装置	2019-12-10	原始取得	专利权维持
146	海德半导体	实用新型	2019222001029	一种带调节功能的测试片固定装置	2019-12-10	原始取得	专利权维持
147	海德半导体	实用新型	2018206485194	一种点胶用的石墨舟固定设备	2018-5-3	原始取得	专利权维持
148	海德半导体	实用新型	2018206488455	一种高效稳定自动供料系统	2018-5-3	原始取得	专利权维持
149	海德半导体	实用新型	2018206494598	一种锡膏厚度可控型自动刮胶设备	2018-5-3	原始取得	专利权维持
150	海德半导体	实用新型	2018206493684	一种高效稳定测试组合平台	2018-5-3	原始取得	专利权维持
151	海德半导体	实用新型	2018206487912	一种高效吸嘴加工设备	2018-5-3	原始取得	专利权维持
152	海德半导体	实用新型	2018206493364	一种易更换的入口阻挡针	2018-5-3	原始取得	专利权维持
153	海德半导体	实用新型	2017211583741	一种环保紧凑型桥式整流器	2017-9-11	原始取得	专利权维持
154	海德半导体	实用新型	2017211603656	环保超薄型片式功率二极管	2017-9-11	原始取得	专利权维持
155	新顺微	实用新型	2016203221890	一种复合型结终端结构	2016-4-18	原始取得	专利权维持
156	新顺微	实用新型	2016203221903	一种适用于超薄圆片背面金属化的固定装置	2016-4-18	原始取得	专利权维持
157	新顺微	实用新型	2017202568776	一种 N+P-结构快恢复二极管芯片	2017-3-16	原始取得	专利权维持
158	新顺微	实用新型	2017202572926	一种具有高反压终端保护膜的平面整流二极管芯片	2017-3-16	原始取得	专利权维持
159	新顺微	实用新型	2017202572930	一种 VDMOS 器件截止环结构	2017-3-16	原始取得	专利权维持
160	新顺微	实用新型	2017202870501	适用于扩散炉的一体式外点火装置	2017-3-23	原始取得	专利权维持
161	新顺微	实用新型	2017202870624	半导体湿法清洗设备中水回收装置	2017-3-23	原始取得	专利权维持
162	新顺微	实用新型	2017202982422	适用于蒸发台产能提升的装置	2017-3-25	原始取得	专利权维持
163	新顺微	实用新型	2017203073982	一种阻尼二极管	2017-3-28	原始取得	专利权维持
164	新顺微	实用新型	2018206251401	一种复合型 TMBS 器件	2018-4-28	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
165	新顺微	实用新型	2018206253638	适用于备件清洗的化剂重复利用装置	2018-4-28	原始取得	专利权维持
166	新顺微	实用新型	201820636987X	半导体湿法清洗全自动多槽清洗机片篮固定、抓取装置	2018-4-28	原始取得	专利权维持
167	新顺微	实用新型	2019205527936	一种光刻机出片的感应装置	2019-4-23	原始取得	专利权维持
168	新顺微	实用新型	2019205529382	一种穿通结构的瞬态电压抑制二极管芯片	2019-4-23	原始取得	专利权维持
169	新顺微	实用新型	2019205741677	一种改善结终端延伸结构三极管可靠性的器件结构	2019-4-25	原始取得	专利权维持
170	新顺微	实用新型	2019206061558	一种卧式扩散炉恒温区温度检测装置	2019-4-29	原始取得	专利权维持
171	新顺微	实用新型	2020202752846	一种适用于超薄硅片的腐蚀装置	2020-3-9	原始取得	专利权维持
172	新顺微	实用新型	2020202753891	一种硅片翘曲度测试装置	2020-3-9	原始取得	专利权维持
173	新顺微	实用新型	2020202755469	一种水电阻率探头的安装结构	2020-3-9	原始取得	专利权维持
174	新顺微	实用新型	2020203192752	一种半导体湿法清洗设备的智能化改造系统	2020-3-16	原始取得	专利权维持
175	新顺微	实用新型	2020203225402	一种新型滚筒式等离子去胶装置	2020-3-16	原始取得	专利权维持
176	新顺微	实用新型	2020203701875	一种圆片自动贴膜装置	2020-3-20	原始取得	专利权维持
177	新顺微	实用新型	2020203991577	一种功率 MOSFET 栅电荷测试装置	2020-3-26	原始取得	专利权维持
178	新顺微	实用新型	2020204645459	一种适用于硅片背面注入工艺的镂空装载结构	2020-4-2	原始取得	专利权维持
179	新顺微	实用新型	2021202043435	一种提升匀胶工艺胶膜质量的装置	2021-1-26	原始取得	专利权维持
180	新顺微	实用新型	202120204344X	一种适用于非标准尺寸硅片的清洗片架	2021-1-26	原始取得	专利权维持
181	新顺微	实用新型	2021202043543	一种 PNP 双极型晶体管开关时间的测试装置	2021-1-26	原始取得	专利权维持
182	新顺微	实用新型	2021202043558	一种对水路流量实时监测的电极冷却装置	2021-1-26	原始取得	专利权维持
183	新顺微	实用新型	2021202043670	一种透明片传片装置	2021-1-26	原始取得	专利权维持
184	新顺微	实用新型	2021203534260	一种提升背面金属化质量的晶圆蒸发盘	2021-2-8	原始取得	专利权维持
185	新顺微	实用新型	2021203623743	一种适用于蒸发料粒干燥装置	2021-2-8	原始取得	专利权维持
186	新顺微	实用新型	2021203882413	一种开管扩散炉炉帽提醒装置	2021-2-22	原始取得	专利权维持
187	新顺微	实用新型	2022205131856	一种防特气泄漏的连锁保护装置	2022-3-9	原始取得	专利权维持
188	新顺微	实用新型	202220514791X	一种适用于抛光垫坑深的测量装置	2022-3-9	原始取得	专利权维持
189	新顺微	实用新型	2022205147939	一种适用于收集蒸发废金属的装置	2022-3-9	原始取得	专利权维持
190	新顺微	实用新型	2022207012156	一种半导体分立器件校准测试装置	2022-3-29	原始取得	专利权维持
191	新顺微	实用新型	2022207012226	一种氢气合金扩散炉用炉塞检测装置	2022-3-29	原始取得	专利权维持
192	新顺微	实用新型	2022207895718	一种基于清洗机溢流槽纯水的有机槽降温冷却装置	2022-4-7	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
193	新顺微	实用新型	202220791582X	一种改善晶圆表面质量的显影装置	2022-4-7	原始取得	专利权维持
194	新顺微	实用新型	202220834678X	一种适用于蒸发台的玻璃清洗装置	2022-4-12	原始取得	专利权维持
195	新顺微	实用新型	2022210205756	一种半导体湿法有机化剂清洗设备的智能消防监控系统	2022-4-29	原始取得	专利权维持
196	新顺微	实用新型	2022228467221	一种配套城市外协废液处理用小桶有机废液回收装置	2022-10-27	原始取得	专利权维持
197	新顺微	实用新型	2022228467240	一种贴膜加热石英缸快速降温装置	2022-10-27	原始取得	专利权维持
198	新顺微	实用新型	2022229246758	一种实现晶圆定点测量的手动测试平台	2022-11-3	原始取得	专利权维持
199	新顺微	实用新型	2022229249953	一种显影设备自动供液装置	2022-11-3	原始取得	专利权维持
200	新顺微	实用新型	2022229784873	一种适用于半导体分立器件芯片测试装置	2022-11-9	原始取得	专利权维持
201	新顺微	实用新型	2023202977078	一种提升晶圆曝光质量的装置	2023-2-23	原始取得	专利权维持
202	新顺微	实用新型	2023202977932	一种简易、高效、稳定的光刻匀胶胶泵系统	2023-2-23	原始取得	专利权维持
203	新顺微	实用新型	2023203648650	一种半导体扩散炉湿氧氧化工艺用高效率气路连接系统	2023-3-2	原始取得	专利权维持
204	新顺微	实用新型	2023203648701	一种淀积设备高效率保养装置	2023-3-2	原始取得	专利权维持
205	新顺微	实用新型	2023203998230	一种适用于硅片无蜡抛光的夹具	2023-3-7	原始取得	专利权维持
206	新顺微	实用新型	2023203998264	一种涂胶轨道工作腔体的排风风速测量装置	2023-3-7	原始取得	专利权维持
207	新顺微	实用新型	2023204587480	一种改善卧式高温扩散炉炉内气流分布的石英炉帽	2023-3-13	原始取得	专利权维持
208	新顺微	实用新型	2023204587705	一种非悬臂桨作业下实现串级控温的卧式扩散石英炉管	2023-3-13	原始取得	专利权维持
209	新顺微	实用新型	2023205414421	一种半导体离子注入机设备排风监测集成系统	2023-3-20	原始取得	专利权维持
210	新顺微	实用新型	2023208091164	提高卧式扩散炉非悬臂桨作业下进出舟稳定性的锁扣装置	2023-4-13	原始取得	专利权维持
211	新顺微	实用新型	2023212869690	一种适用于石英炉管外观检查的支架	2023-5-25	原始取得	专利权维持
212	新顺微	实用新型	202322693283X	一种基于 HTRB 试验的功率器件和散热片的安装机构	2023-10-9	原始取得	专利权维持
213	新顺微	实用新型	202420736407X	一种降低晶圆金属化后手动取片碎片率装置	2024-4-11	原始取得	专利权维持
214	新顺微	实用新型	2024207364065	一种适用于超薄硅片背面金属化后转换作业装置	2024-4-11	原始取得	专利权维持
215	新顺微	实用新型	2024206205517	一种改善晶圆装片后左右倒伏的石英舟结构	2024-3-28	原始取得	专利权维持
216	新顺微	实用新型	2024206205502	一种适用于半导体湿法清洗设备的加热载体结构	2024-3-28	原始取得	专利权维持
217	新顺微	实用新型	2024204699762	一种适用于半导体湿法清洗装置	2024-3-12	原始取得	专利权维持
218	新顺微	实用新型	202420496722X	一种功率半导体分立器件腐蚀清洗设备药液回收利用装置	2024-3-14	原始取得	专利权维持
219	新顺微	实用新型	2024204699688	一种适用于晶圆涂胶前烘工艺的接近式烘烤热盘结构	2024-3-12	原始取得	专利权维持
220	新顺微	实用新型	2024212651854	一种基于反激变换器的 VDMOS 管开启时间的测试装置	2024-6-5	原始取得	专利权维持

序号	权属人	专利类型	专利号	专利名称	专利申请日	取得方式	法律状态
221	新顺微	实用新型	2024216485209	一种适用于半导体分立器件的校样夹具	2024-7-12	原始取得	专利权维持
222	新顺微	实用新型	2024216485177	一种卧式 LPCVD 炉悬臂桨装置	2024-7-12	原始取得	专利权维持
223	新顺微	实用新型	2024218016501	一种用于电特性参数测试的探针支架	2024-7-26	原始取得	专利权维持
224	长晶浦联	实用新型	2022232591791	一种封装结构	2022-12-6	原始取得	专利权维持
225	长晶浦联	实用新型	2024227929862	散热封装结构	2024-11-15	原始取得	专利权维持
226	长晶微电子	实用新型	2024216467944	新型玻璃钝化结构的芯片	2024-7-11	原始取得	专利权维持
227	长晶微电子	实用新型	2024215643474	单台面的双向 TVS 器件	2024-7-3	原始取得	专利权维持
228	长晶微电子	实用新型	2023226285670	单向浪涌防护装置	2023-9-25	原始取得	专利权维持
229	长晶微电子	实用新型	2022209199608	超低压低容单向保护器	2022-4-20	原始取得	专利权维持
230	长晶微电子	实用新型	2020219571797	具有异常持续过压保护功能的保护电路	2020-9-9	原始取得	专利权维持
231	长晶微电子	实用新型	2020220522838	集成保护芯片结构	2020-9-17	原始取得	专利权维持
232	长晶微电子	实用新型	2020219964989	相同电压不同浪涌功率的双路单向 TVS 保护芯片	2020-9-11	原始取得	专利权维持
233	长晶微电子	实用新型	2020221457056	具有浪涌防护功能的肖特基结构	2020-9-25	原始取得	专利权维持
234	长晶微电子	实用新型	2020219915821	相同电压不同浪涌功率的双路双向 TVS 保护芯片	2020-9-11	原始取得	专利权维持
235	长晶微电子	实用新型	2020219927354	非对称电压的双路双向 TVS 保护器件	2020-9-11	原始取得	专利权维持
236	长晶微电子	实用新型	2020219927655	高浪涌能力的双向 TVS 器件结构	2020-9-11	原始取得	专利权维持
237	长晶微电子	实用新型	2020220495648	低嵌位电压的单向 TVS 芯片结构	2020-9-17	原始取得	专利权维持
238	长晶微电子	实用新型	2020219957627	非对称电压的单路双向 TVS 浪涌保护芯片	2020-9-11	原始取得	专利权维持
239	长晶微电子	实用新型	2020221457910	可控硅结构	2020-9-25	原始取得	专利权维持
240	长晶微电子	实用新型	2020219916400	非对称电压的双路单向 TVS 保护器件	2020-9-11	原始取得	专利权维持
241	长晶微电子	实用新型	2024216493436	非对称台面的双向 TVS 器件	2024-7-12	原始取得	专利权维持
242	长晶微电子	实用新型	2024216873539	高浪涌低钳位电压的玻璃气体放电管	2024-7-16	原始取得	专利权维持
243	长芯检测	实用新型	202420037046X	一种半导体检测定位结构	2024-1-8	原始取得	专利权维持
244	长芯检测	实用新型	2022217214224	半导体参数检测夹具	2022-7-4	原始取得	专利权维持

附表二：集成电路布图设计

序号	权属人	布图设计名称	登记证书号	布图设计登记号	登记申请日	创作完成日
1	长晶科技	CJTP0002 版图	第 31658 号	BS.20552379X	2020/4/22	2019/7/15
2	长晶科技	DCM031 电源管理模块	第 25347 号	BS.195611241	2019/9/25	2019/3/10
3	长晶科技	ESD array 开关防护版图	第 25349 号	BS.195611969	2019/9/30	2019/3/10
4	长晶科技	CJWC0001 版图	第 25390 号	BS.195613872	2019/10/14	2019/3/10
5	长晶科技	CJFC0001 版图	第 26938 号	BS.195626958	2019/11/19	2019/3/10
6	长晶科技	CJPS0001 版图	第 31636 号	BS.205523773	2020/4/22	2019/7/15
7	长晶科技	CJTP0001 版图	第 32027 号	BS.205523781	2020/4/22	2019/7/15
8	长晶科技	CJDC0001 版图	第 31987 号	BS.205523803	2020/4/22	2019/7/15
9	长晶科技	CJ6212	第 50339 号	BS.215573331	2021/6/23	2020/5/20
10	长晶科技	MNDJ0T602002A	第 50340 号	BS.215574362	2021/6/24	2021/1/25
11	长晶科技	MNDP0TA02004A	第 50347 号	BS.215574370	2021/6/24	2020/9/27
12	长晶科技	MNU80C201210A	第 50346 号	BS.215575210	2021/6/25	2020/9/8
13	长晶科技	MNU80C201228A	第 50344 号	BS.215575881	2021/6/28	2020/12/18
14	长晶科技	MNU80T181004A	第 50341 号	BS.21557589X	2021/6/28	2021/2/4
15	长晶科技	MNU80T201010A	第 50338 号	BS.215576225	2021/6/29	2021/5/25
16	长晶科技	MNUE0T40201DA	第 50343 号	BS.215576586	2021/6/30	2020/10/20
17	长晶科技	CJ6215	第 50355 号	BS.215586328	2021/7/21	2020/8/20
18	长晶科技	MNDP0TA02012A	第 50363 号	BS.215587618	2021/7/23	2020/11/7
19	长晶科技	MNU10TA02003A	第 50359 号	BS.215588568	2021/7/26	2020/9/16
20	长晶科技	MNU80C201007A	第 50360 号	BS.215588576	2021/7/26	2020/6/20
21	长晶科技	MPUE0TA02038A	第 50356 号	BS.215589378	2021/7/27	2021/3/18
22	长晶科技	MNDP0TA02014A	第 51844 号	BS.215604113	2021/8/23	2021/4/24
23	长晶科技	MNU80C241239A	第 51847 号	BS.215605241	2021/8/24	2021/6/10
24	长晶科技	MNU80T302006A	第 51801 号	BS.215576241	2021/6/29	2020/9/11
25	长晶科技	MNU80T201203A	第 51850 号	BS.215606280	2021/8/25	2021/4/9
26	长晶科技	MPU80T200837A	第 51849 号	BS.215607562	2021/8/27	2021/7/20
27	长晶科技	MPDP0T302510A	第 51853 号	BS.215607546	2021/8/27	2021/6/5
28	长晶科技	MNU80T201007A	第 51815 号	BS.215590384	2021/7/28	2021/3/8
29	长晶科技	MNU80T201217C	第 51846 号	BS.215606299	2021/8/25	2021/6/10
30	长晶科技	MPU80T302506A	第 51816 号	BS.215590392	2021/7/28	2021/5/30
31	长晶科技	MNU80T302002A	第 51848 号	BS.215606876	2021/8/26	2021/4/9

序号	权属人	布图设计名称	登记证书号	布图设计登记号	登记申请日	创作完成日
32	长晶科技	MNU80T402003A	第 51837 号	BS.215622073	2021/9/23	2021/3/1
33	长晶科技	MND90D302003A	第 51820 号	BS.215619595	2021/9/16	2020/11/5
34	长晶科技	CJ6102	第 51710 号	BS.215573307	2021/6/23	2020/11/30
35	长晶科技	MNU80C231203A	第 51845 号	BS.215604121	2021/8/23	2021/7/23
36	长晶科技	MNU65C120802B	第 52997 号	BS.215575202	2021/6/25	2019/10/15
37	长晶科技	CJ6021	第 53000 号	BS.215586301	2021/7/21	2021/3/18
38	长晶科技	MNU80C231202A	第 52998 号	BS.215588606	2021/7/26	2021/1/3
39	长晶科技	CJ5223	第 53005 号	BS.215604105	2021/8/23	2021/1/13
40	长晶科技	MNUF7T802004A	第 54970 号	BS.215606930	2021/8/26	2021/5/16
41	长晶科技	MND90D30209A	第 53001 号	BS.215619560	2021/9/16	2021/5/5
42	长晶科技	MNDK0T602003C	第 53002 号	BS.215621263	2021/9/18	2020/10/5
43	长晶科技	MNU65C12082DA	第 53003 号	BS.215622065	2021/9/23	2020/9/22
44	长晶科技	MNUE0T402001A	第 53004 号	BS.215624262	2021/9/26	2020/10/13
45	长晶科技	MNUE0T402002A	第 53048 号	BS.215625501	2021/9/27	2020/10/13
46	长晶科技	MPU80T200890A	第 53049 号	BS.215625536	2021/9/27	2021/7/5
47	长晶科技	MPU80T402010A	第 53050 号	BS.215627806	2021/9/29	2021/5/17
48	长晶科技	MNDA0D402001A	第 54971 号	BS.215645421	2021/10/29	2021/8/31
49	长晶科技	MNDF7T8020036	第 54979 号	BS.215644999	2021/10/28	2021/5/5
50	长晶科技	MPU80T302010A	第 54977 号	BS.215645006	2021/10/28	2021/9/24
51	长晶科技	MPU80T302048A	第 54972 号	BS.21564543X	2021/10/29	2021/9/2
52	长晶科技	MNDF7T802003A	第 55003 号	BS.215658892	2021/11/19	2020/11/30
53	长晶科技	MNDJ0T602008A	第 54982 号	BS.215658906	2021/11/19	2021/7/15
54	长晶科技	MNDP0TA0203DA	第 55001 号	BS.215659864	2021/11/22	2020/11/30
55	长晶科技	MNU80T302002B	第 54992 号	BS.215660846	2021/11/23	2021/9/13
56	长晶科技	MNU80T302010A	第 55005 号	BS.215660862	2021/11/23	2021/10/9
57	长晶科技	MNDPOTA02006A	第 52999 号	BS.21558760X	2021/7/23	2021/1/27
58	长晶科技	MNUE0T402003A	第 53010 号	BS.215606906	2021/8/26	2021/4/29
59	长晶科技	MNDB0D40200GA	第 59088 号	BS.22554461X	2022/4/27	2022/1/25
60	长晶科技	MNDP0DA02004A	第 59066 号	BS.225544652	2022/4/27	2022/3/30
61	长晶科技	MNSC1TF530P9A	第 59081 号	BS.225545020	2022/4/28	2022/1/30
62	长晶科技	MNU80T30203AA	第 59086 号	BS.225545837	2022/4/29	2022/2/28
63	长晶科技	MNU80T201213A	第 59077 号	BS.225545853	2022/4/29	2021/12/6
64	长晶科技	MNDP0TA02007A	第 59586 号	BS.225557797	2022/5/30	2022/4/30

序号	权属人	布图设计名称	登记证书号	布图设计登记号	登记申请日	创作完成日
65	长晶科技	MNSC1TF030F0A	第 59589 号	BS.225559765	2022/6/6	2022/4/30
66	长晶科技	MNU80C120802A	第 59588 号	BS.225559730	2022/6/6	2021/7/30
67	长晶科技	MNUA0T6020B1E	第 59583 号	BS.225559773	2022/6/6	2022/4/20
68	长晶科技	CJ6111	第 61712 号	BS.225543826	2022/4/26	2021/12/23
69	长晶科技	CJ6213	第 61710 号	BS.225543842	2022/4/26	2022/3/22
70	长晶科技	CJ6108	第 61757 号	BS.225557789	2022/5/30	2022/5/10
71	长晶科技	CJG06T65AF5SA	第 61727 号	BS.225572877	2022/7/5	2022/5/10
72	长晶科技	MNDA0D402002A	第 61728 号	BS.225572893	2022/7/5	2022/4/22
73	长晶科技	MNUA0T6020B0A	第 61729 号	BS.225573466	2022/7/6	2022/2/23
74	长晶科技	MNUE0TA020J8A	第 61725 号	BS.225573474	2022/7/6	2022/3/24
75	长晶科技	CJ6206	第 61726 号	BS.225572869	2022/7/5	2022/6/29
76	长晶科技	CJG40N120F2KAA	第 61718 号	BS.225586800	2022/8/15	2022/8/4
77	长晶科技	MNU80C1208D9A	第 61721 号	BS.225586819	2022/8/15	2022/6/21
78	长晶科技	MNU80C12081DA	第 61722 号	BS.225587114	2022/8/16	2022/5/23
79	长晶科技	MNU80C120805A	第 61724 号	BS.225587149	2022/8/16	2022/5/25
80	长晶科技	CJ6216	第 63143 号	BS.225602318	2022/9/29	2022/8/31
81	长晶科技	MNU80T301210A	第 63151 号	BS.225602369	2022/9/29	2022/6/27
82	长晶科技	MPU80T602060A	第 63146 号	BS.225602377	2022/9/29	2022/7/11
83	长晶科技	CJ6022	第 64086 号	BS.225623919	2022/12/6	2022/10/24
84	长晶科技	MNU80C1208D9A	第 64128 号	BS.225623935	2022/12/6	2022/8/18
85	长晶科技	MPU80T302008A	第 64090 号	BS.225623951	2022/12/6	2022/6/29
86	长晶科技	MPU80T302013A	第 64127 号	BS.225623900	2022/12/6	2022/8/16
87	长晶科技	CJ6370	第 67209 号	BS.23551201X	2023/3/1	2023/2/2
88	长晶科技	CJ6380	第 67233 号	BS.235532614	2023/5/9	2023/2/13
89	长晶科技	MND90D30200GA	第 72659 号	BS.235581623	2023/10/7	2023/4/25
90	长晶科技	MND90D30201BA	第 72658 号	BS.235581577	2023/10/7	2023/4/25
91	长晶科技	MND90D30201DA	第 72628 号	BS.235581585	2023/10/7	2023/4/25
92	长晶科技	MNDTOTA52010A	第 72655 号	BS.235581615	2023/10/7	2022/9/14
93	长晶科技	CJ431L	第 80939 号	BS.245553215	2024/7/20	2024/4/24
94	长晶科技	CJ31043	第 80940 号	BS.245553223	2024/7/20	2024/5/28
95	长晶科技	LM358E	第 80941 号	BS.245553231	2024/7/20	2024/3/4
96	长晶科技	MNDA0T30204HA	第 84370 号	BS.245593950	2024/11/23	2024/11/15
97	长晶科技	MNDP0DA02004AS	第 84368 号	BS.245593985	2024/11/23	2022/1/18

序号	权属人	布图设计名称	登记证书号	布图设计登记号	登记申请日	创作完成日
98	长晶科技	MNDG0D602001A	第 84367 号	BS.245593969	2024/11/23	2024/11/13
99	长晶科技	MNDA0T30204DA	第 84365 号	BS.245593942	2024/11/23	2024/11/11
100	长晶科技	MNDA0T30202CA	第 84366 号	BS.245593934	2024/11/23	2024/11/13
101	长晶科技	MNDP0DA0203DA	第 84369 号	BS.245593977	2024/11/23	2023/8/30
102	长晶科技	AB-MNDJ0T602009A	第 86566 号	BS.255508522	2025/2/12	2022/12/16
103	长晶科技	MNDJ0T602010B	第 86525 号	BS.255502362	2025/1/10	2022/12/16
104	长晶科技	MNDJ0T602005B	第 86543 号	BS.255502346	2025/1/10	2022/12/16
105	长晶科技	MNDJ0T602004B	第 86534 号	BS.255502370	2025/1/10	2022/11/16
106	长晶科技	MNU80C201214A	第 86535 号	BS.255502397	2025/1/10	2023/11/16
107	长晶科技	MNDJ0T602003C	第 86533 号	BS.255502338	2025/1/10	2022/11/16
108	长晶科技	MNDJ0T65206FA	第 86567 号	BS.255508557	2025/2/12	2022/11/16
109	长晶科技	CJG80N65F2KAA	第 86544 号	BS.255502311	2025/1/10	2022/6/11
110	长晶科技	CJG100N120F2KAA	第 86545 号	BS.25550232X	2025/1/10	2022/12/19
111	长晶科技	MNDJ0T602008B	第 86547 号	BS.255502354	2025/1/10	2022/12/16
112	长晶科技	MNDB0D40203HA	第 89857 号	BS.255545118	2025/6/13	2023/4/22
113	长晶科技	MNU65C241203A	第 89865 号	BS.255545177	2025/6/13	2020/10/23
114	长晶科技	MNDD0T40200CA	第 89858 号	BS.255545126	2025/6/13	2023/4/2
115	长晶科技	AB-MNDD0D40202DH	第 89855 号	BS.25554507X	2025/6/13	2022/3/22
116	长晶科技	AB-MNDB0D40200GL	第 89880 号	BS.255545037	2025/6/13	2022/1/4
117	长晶科技	MNDB0D40201CA	第 89875 号	BS.25554510X	2025/6/13	2022/4/28
118	长晶科技	MNU80C24162CA	第 89866 号	BS.255545193	2025/6/13	2023/10/18
119	长晶科技	MNU80C12081BA	第 89876 号	BS.255545185	2025/6/13	2024/2/23
120	长晶科技	AB-MNDD0D40201EA	第 89863 号	BS.255545053	2025/6/13	2024/2/4
121	长晶科技	AB-MNDD0D40200HA	第 89854 号	BS.255545045	2025/6/13	2023/1/22
122	长晶科技	AB-MNDD0D40203DA	第 89856 号	BS.255545088	2025/6/13	2024/5/12
123	长晶科技	MNU80T12084DA	第 89867 号	BS.255545207	2025/6/13	2024/4/22
124	长晶科技	MNU65C12081DAB	第 89864 号	BS.255545150	2025/6/13	2020/11/3
125	长晶科技	AB-MNDD0D40202DA	第 89881 号	BS.255545061	2025/6/13	2022/3/22
126	长晶科技	MNDB0D40200DA	第 89874 号	BS.255545096	2025/6/13	2022/3/23
127	长晶科技	MNDD0T40200FA	第 89859 号	BS.255545142	2025/6/13	2023/4/22
128	长晶科技	MNU65C12082BA	第 88386 号	BS.255502389	2025/1/10	2023/9/12
129	长晶微电子	单路双向非对称 TVS 浪涌保护芯片	第 35259 号	BS.205567274	2020/9/2	2020/3/18
130	长晶微电子	双路双向非对称 TVS 浪涌保	第 35264 号	BS.205567290	2020/9/2	2020/3/18

序号	权属人	布图设计名称	登记证书号	布图设计登记号	登记申请日	创作完成日
		护芯片				

附表三：商标专用权

序号	申请人	商标内容	注册类别	注册证号	有效期（截至）	取得方式	状态
1	长晶科技	长晶科技	第 9 类	37915479	2029-12-20	原始取得	已注册
2	长晶科技	长晶科技	第 35 类	37934830	2029-12-20	原始取得	已注册
3	长晶科技	长晶科技	第 42 类	37920520	2029-12-20	原始取得	已注册
4	长晶科技	长晶科技	第 9 类	51672045	2031-11-27	原始取得	已注册
5	长晶科技	JSCJ	第 9 类	37904541	2029-12-20	原始取得	已注册
6	长晶科技	JSCJ	第 35 类	37912971	2029-12-27	原始取得	已注册
7	长晶科技	JSCJ	第 42 类	37909121	2029-12-20	原始取得	已注册
8	长晶科技		第 9 类	37904880	2030-04-06	原始取得	已注册
9	长晶科技	JSCJ	第 42 类	47046362	2031-06-27	原始取得	已注册
10	长晶科技	JSCJ	第 9 类	47045993	2031-07-06	原始取得	已注册
11	海德半导体		第 9 类	13893123	2035-02-27	原始取得	已注册
12	新顺微	新顺	第 9 类	4038510	2036-05-27	原始取得	已注册
13	新顺微	XINSUN	第 9 类	4038509	2036-05-27	原始取得	已注册
14	新顺微		第 9 类	4038508	2036-07-27	原始取得	已注册
15	长晶微电子		第 42 类	73266463	2034-4-6	原始取得	已注册
16	长晶微电子		第 35 类	73256357	2034-1-27	原始取得	已注册

序号	申请人	商标内容	注册类别	注册证号	有效期（截至）	取得方式	状态
17	长晶微电子		第 40 类	73250115	2034-1-27	原始取得	已注册
18	长晶微电子		第 42 类	73247370	2034-1-27	原始取得	已注册
19	长晶微电子		第 40 类	73262946	2034-1-27	原始取得	已注册
20	长晶微电子		第 9 类	68663129	2033-6-6	原始取得	已注册
21	长芯检测	长芯威	第 9 类	65086695	2033-1-27	原始取得	已注册
22	长芯检测	长芯威	第 42 类	65092134	2032-11-20	原始取得	已注册
23	长芯检测	长芯威	第 35 类	65109377	2032-1-27	原始取得	已注册

附表四：软件著作权

序号	著作权人	软件名称	版本号	首次发表日期	登记号
1	长晶科技	长晶 32 位超低功耗 MCU&BLE4.2 产品平台	V1.0	2019-03-28	2019SR0717340
2	长晶浦联	塑封包封自动化 AUTO 模式系统连接控制系统	V1.0	2021-10-14	2022SR0064467
3	长晶浦联	产品测试方案自动化筛选程序模式软件	V1.0	2021-11-04	2022SR0064468
4	长晶浦联	焊丝焊接芯片程序调用参数调控软件	V1.0	2021-08-12	2022SR0064733
5	新顺微	划片管理系统	V1.0	2008-12-10	2010SR025311
6	新顺微	新顺电子报表系统	V1.0	2008-12-10	2010SR025282
7	新顺微	新顺电子芯片生产线 MES 系统	V1.0	2008-10-10	2010SR025287
8	新顺微	新顺微电子管理信息系统	V1.0	2008-04-01	2010SR025279
9	新顺微	产品盘点系统	V1.0	2009-02-10	2010SR025280
10	新顺微	新顺硅片筛选系统	V1.0	2009-08-10	2010SR025284
11	新顺微	硅片中测五点数据自动上传系统软件	V1.0	2012-03-01	2012SR079131
12	新顺微	新顺微电子材料片销售出库及打印软件	V1.0	2012-03-01	2012SR079307
13	新顺微	新顺微电子中间库流通盘点系统软件	V1.0	2012-03-01	2012SR098266
14	新顺微	新顺微电子 MES 新增硅片击穿数据信息软件	V1.0	2013-12-01	2014SR092567
15	新顺微	新顺微电子订单管理系统	V1.0	2013-01-10	2013SR058587
16	新顺微	新顺微电子硅片发货系统	V1.0	2013-01-10	2013SR058579
17	新顺微	新顺微电子硅片五点数据显示及自动筛选系统	V1.0	2013-03-01	2013SR058591
18	新顺微	新顺微电子人事培训系统	V1.0	2014-01-10	2014SR081282
19	新顺微	新顺微电子芯片数据导出系统	V1.0	2014-03-10	2014SR081052
20	新顺微	新顺微电子 MES 硅片外协加工系统	V1.0	2015-05-26	2015SR138591
21	新顺微	新顺微电子成品率在制查询系统	V1.0	2015-05-04	2015SR138724
22	新顺微	新顺微电子外代工芯片数据导入系统	V1.0	2015-04-10	2015SR138585
23	新顺微	新顺光刻版管理系统	V1.0	2016-04-10	2016SR214909
24	新顺微	新顺送样跑片管理系统	V1.0	2016-04-10	2016SR214608
25	新顺微	新顺微电子批次加工历史信息查询系统	V1.0	2016-05-30	2016SR213615

序号	著作权人	软件名称	版本号	首次发表日期	登记号
26	新顺微	订单评审及发货单系统	V1.0	2017-04-10	2017SR377146
27	新顺微	年休管理系统	V1.0	2017-01-10	2017SR379195
28	新顺微	新顺修改批次五点对档考核条件系统	V1.0	2017-05-20	2017SR379205
29	长芯检测	微电子温度安全管理软件	V1.0	-	2024SR1265938
30	长芯检测	芯片速度与响应时间测量系统	V1.0	-	2024SR0607487
31	长芯检测	长芯半导体射线检测系统软件	V1.0	2022-06-28	2022SR1197820
32	长芯检测	长芯半导体参数检测系统软件	V1.0	2022-05-18	2022SR1197821
33	长芯检测	长芯数据库信息统计软件	V1.0	2022-04-21	2022SR1201862

附表五：美术作品著作权

序号	著作权人	作品名称	作品类别	作品登记号	首次发表日期	创作完成日期
1	长晶科技	长晶科技（1）	美术作品	国作登字-2019-F-00883683	2019-04-30	2019-03-02
2	长晶科技	长晶科技（2）	美术作品	国作登字-2019-F-00883684	2019-04-30	2019-03-02
3	长晶科技	长晶科技（3）	美术作品	国作登字-2019-F-00883685	2019-04-30	2019-03-02
4	长晶科技	长晶科技（4）	美术作品	国作登字-2019-F-00883686	2019-04-30	2019-03-02
5	长晶科技	长晶科技（5）	美术作品	国作登字-2019-F-00883687	2019-04-30	2019-03-02
6	长晶科技	长晶科技（6）	美术作品	国作登字-2019-F-00883688	2019-04-30	2019-03-02
7	长晶科技	长晶科技（7）	美术作品	国作登字-2019-F-00883689	2019-04-30	2019-03-02
8	长晶科技	长晶科技（8）	美术作品	国作登字-2019-F-00883690	2019-04-30	2019-03-02
9	长晶科技	长晶科技（9）	美术作品	国作登字-2019-F-00883691	2019-04-30	2019-03-02